创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

苏州锦艺新材料科技股份有限公司

Suzhou Ginet New Material Technology Co., Ltd.

（常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号）

GiNET

EMPOWERED BY INNOVATION

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

免责声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

国信证券股份有限公司

GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

声明及承诺

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、公司上市的目的

新材料作为制造业转型升级的产业基础，是推进我国新型工业化的重要驱动力。公司专业从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售，致力于新材料领域的创新性技术研发及产业化应用，历经二十余载耕耘，已成长为电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业。当前，全球正在加速进入 AI 时代，随着 AI 的快速发展，带动对电路传输速率、传输损耗、热稳定性、散热效率的要求持续升级，公司以高性能球形硅微粉为代表的无机粉体材料，日益成为支撑 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等终端设施核心性能要求与迭代升级的关键材料之一。

通过本次在创业板的上市，公司旨在实现一系列战略目标：首先，公司通过募集资金加快完善产能布局，提升整体研发实力，为公司进一步丰富产品体系、拓展产业化应用、完善技术谱系提供有力保障；其次，公司上市将有利于巩固和提升公司在先进无机非金属材料领域的竞争力和影响力，在全球范围吸引更多优质客户、招揽更多优秀科技人才，从而带动企业技术创新能力以及客户服务能力的持续提升；最后，公司上市后将持续保持规范运营，合理利用丰富便利的融资渠道，实现持续创新与高质量发展，为社会和广大投资者创造更大价值。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，健全风险管理、内部控制组织体系和有效的内部控制制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求。公司已建立股东会、董事会、独立董事、职工代表董事、董事会秘书制度和董事会各专门委员会制度，依法规范运作，管理效率不断提高，能够有效保障公司经营管理的有序进行以及公司和股东的合法权益。

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，推动公司产品结构的调整升级，增强公司的研发和创新能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力，对巩固公司现有的行业地位，拓展发展空间有

着积极作用。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。

公司本次拟公开发行不超过 55,715,025 股人民币普通股（A 股），发行募集资金扣除发行费用后净额用于“电子信息用高性能粉体材料扩产项目”、“扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目”、“智能化升级改造项目”、“研发中心建设项目”的建设投入，并补充流动资金。为保证募集资金投资项目的顺利实施和募集资金的有效使用，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确的规定。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，做到专款专用，提高使用效率，切实保护公司和投资者的权益。

四、公司持续经营能力及未来发展规划

报告期内，公司业绩持续增长，具备良好的持续经营能力。2023 年度至 2025 年度，公司营业收入分别为 51,950.91 万元、72,857.24 万元和 103,586.02 万元，最近三年营业收入复合增长率达到 41.21%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 6,479.43 万元、8,748.54 万元和 16,354.92 万元，最近三年复合增长率为 58.88%，盈利能力良好。

未来公司将以技术创新为驱动，巩固在电子信息领域无机功能性粉体材料的领先地位，同时进一步深化在导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等领域的业务布局及市场拓展。此外，公司还将加快新技术、新产品的规模化量产和客户推广，持续攻克业界重难点前沿品类的技术落地及国产化，逐步形成重点突出、多点突破的战略发展格局。公司将通过不断的研发投入推动发展战略的有效落地，不断巩固和提升公司在先进无机非金属材料领域的竞争力和影响力，成为品类丰富、应用行业广泛、技术谱系全面的应用型新材料行业代表企业。

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页）

实际控制人、董事长：

陈锦魁

苏州锦艺新材料科技股份有限公司

2026 年 6 月 23 日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟公开发行股票总数不超过 55,715,025 股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 222,860,100 股（不含行使超额配售选择权发行的股份）
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目录

声明及承诺 1

致投资者的声明 2

一、公司上市的目的 2

二、公司现代企业制度的建立健全情况 2

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 2

四、公司持续经营能力及未来发展规划 3

本次发行概况 5

目录 6

第一节 释义 10

一、普通术语 10

二、专业术语 14

第二节 概览 18

一、重大事项提示 18

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 20

三、本次发行概况 21

四、发行人主营业务经营情况 22

五、发行人符合创业板定位的说明 24

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 28

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 29

八、发行人选择的具体上市标准 29

九、发行人公司治理特殊安排 29

十、发行人募集资金运用与未来发展规划 29

十一、其他对发行人有重大影响的事项 31

第三节 风险因素 32

一、与发行人相关的风险 32

二、与行业相关的风险 34

三、其他风险 35

第四节 发行人基本情况 37

一、发行人基本情况.....37
二、发行人设立情况.....37
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.....40
四、发行人成立以来的重要事件.....44
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.....45
六、发行人股权结构.....46
七、发行人控股子公司、参股公司情况.....47
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.....52
九、发行人特别表决权股份或类似安排情况.....57
十、发行人协议控制情况.....57
十一、发行人股本情况.....57
十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况.....85
十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排.....97
十四、发行人员工及其社会保障情况.....102
第五节 业务与技术.....105
一、发行人主营业务及主要产品情况.....105
二、公司所处行业的基本情况及竞争状况.....126
三、销售情况和主要客户.....180
四、采购情况和主要供应商.....183
五、发行人主要资产情况.....186
六、公司核心技术及研发情况.....194
七、发行人环境保护及安全生产情况.....211
八、发行人境外经营情况.....212
第六节 财务会计信息与管理层分析.....213
一、财务报表.....213
二、财务报表的编制基础及审计意见.....217
三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.....218
四、合并财务报表的范围及具体变化情况.....220
五、分部信息.....221
六、重要的会计政策和会计估计.....221

七、主要税种、税率及税收优惠情况.....245
八、经申报会计师核验的非经常性损益.....248
九、报告期内发行人主要财务指标.....249
十、经营成果分析.....251
十一、资产质量分析.....281
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....298
十三、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.....312
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项.....313
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.....313
十六、盈利预测.....313
第七节 募集资金运用与未来发展规划 314
一、募集资金运用概况.....314
二、募集资金投资项目具体情况.....316
三、项目的必要性和可行性分析.....316
四、公司未来发展战略及发展规划.....319
第八节 公司治理与独立性 323
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.....323
二、发行人内部控制情况.....323
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施等情况.....324
四、发行人资金占用和对外担保情况.....325
五、独立性.....325
六、同业竞争.....327
七、关联方、关联关系.....327
八、关联交易.....333
第九节 投资者保护 340
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....340
二、发行人股利分配政策.....340
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业关于投资者保护的措施.....342

第十节 其他重要事项 343
一、重大合同 343
二、对外担保 347
三、重大诉讼及仲裁事项 347
四、违法违规情况 347
第十一节 声明 349
一、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 349
二、发行人控股股东、实际控制人声明 350
三、保荐人（主承销商）声明 351
四、发行人律师声明 353
五、会计师事务所声明 354
六、资产评估机构声明 355
七、验资复核机构声明 357
第十二节 附件 358
一、备查文件 358
二、查阅时间和地点 358
附件 1 与投资者保护相关的承诺 360
附件 2 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 391
附件 3 股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 401
附件 4 审计委员会及其他专门委员会的设置情况 405
附件 5 募集资金投资项目具体情况 405

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、普通术语

锦艺新材、公司、本公司、发行人、股份公司	指	苏州锦艺新材料科技股份有限公司
锦艺有限	指	苏州锦艺新材料科技有限公司，系锦艺新材的前身
苏州海旭	指	苏州海旭新材料科技有限公司，发行人曾用名
山东锦艺、南京宇热	指	山东锦艺新材料有限公司，曾用名为南京宇热材料科技有限公司，发行人一级子公司
云阳锦艺	指	云阳县锦艺新材料科技有限公司，发行人一级子公司
功能材料	指	江苏锦艺功能材料有限公司，发行人一级子公司
铭隆新材料	指	苏州铭隆新材料有限公司，发行人一级子公司
锦艺半导体	指	锦艺半导体材料（苏州）有限公司，发行人一级子公司
新加坡锦艺	指	锦艺新材料有限公司（新加坡），发行人一级子公司，英文名称为 GINET NEW MATERIALS PTE. LTD.
临沂创实	指	临沂创实新型材料有限公司，发行人二级子公司
苏州锦禾	指	苏州锦禾纳米材料有限公司，发行人二级子公司
嘉兴锦艺	指	嘉兴锦艺新材料科技有限公司，曾经为发行人二级子公司，已于 2025 年 8 月注销
锦艺阿泰欧	指	锦艺阿泰欧（苏州）锂电池材料科技有限公司，发行人合营企业
重庆锦艺	指	重庆市锦艺硅材料开发有限公司及其分公司重庆市锦艺硅材料开发有限公司苏州分公司，发行人业务前身、原控股股东，已于 2022 年 12 月 1 日完成工商登记注销
广州锦族	指	广州锦族新材料投资有限公司，系发行人控股股东，实际控制人陈锦魁控制的企业
穗合投资	指	深圳穗合投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
平潭锦新	指	平潭锦新投资合伙企业（有限合伙），系发行人持股 5%以上股东、员工持股平台
哈勃投资	指	哈勃科技创业投资有限公司，系发行人股东
平潭锦材	指	平潭锦材投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台
国投创业基金	指	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人持股 5%以上股东
远致华信	指	深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
哇牛制享	指	嘉兴哇牛制享股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
百瑞信托	指	百瑞信托有限责任公司，系发行人股东
欣亿源	指	常州欣亿源股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

苏州时点	指	苏州时点管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名苏州工业园区时点管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东
信福汇四号	指	深圳市信福汇四号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
晨道投资	指	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
超兴创投	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
星火投资	指	深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
信福汇十二号	指	深圳市信福汇十二号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
常熟经开	指	常熟经开聚源旭航股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名常熟经开国发股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
杭州泽涵	指	杭州泽涵股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
尚融投资	指	尚融（宁波）投资中心（有限合伙），系发行人股东
君安勇诚	指	君安勇诚（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
华泰渝富	指	重庆华泰渝富并购私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
君安嘉平	指	君安嘉平（平湖）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
宁波甬诚	指	宁波前湾新区甬诚创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
华泰产发	指	宿迁华泰产发科技股权投资基金（有限合伙），系发行人股东
广发信德	指	东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
合肥经韬	指	合肥经韬睿诚智造创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
厦门经韬	指	厦门经韬睿诚二期创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名共青城经韬睿诚二期创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
尚融聚鑫	指	尚融聚鑫（宁波）创业投资中心（有限合伙），系发行人股东
成都建鑫	指	成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
南京厚盈	指	南京厚盈科技投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
物产中大	指	物产中大集团股份有限公司（600704.SH）
华泰紫金	指	华泰紫金投资有限责任公司
常熟创投	指	常熟市常创人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
福建创盈	指	福建创新创盈投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
福州创科	指	福州创新创科投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
嘉兴萃英	指	嘉兴青蒿萃英沛泓股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
嘉兴经韬	指	嘉兴经韬睿诚锦辉创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

东方富海三号	指	东方富海精选三号（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
共青城智晟	指	共青城行远智晟创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州创投	指	苏州苏创新能源投资合伙企业（有限合伙）
苏州致兴	指	苏州产投致兴股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州致盛	指	苏州产投致盛股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州卓璞	指	苏州卓璞永赢创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
中电科研投基金	指	中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业有限合伙，曾为发行人股东
扬州乾益	指	扬州乾益投资合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东
哇牛智新	指	嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东
杭州新同	指	杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东
郑州锦谋	指	郑州锦谋贸易有限公司，曾为发行人持股 5%以上股东
平潭畅祥	指	平潭畅祥投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人陈锦魁控制的企业
广州福商	指	广州福商企业发展有限公司，实际控制人陈锦魁控制的企业
华诚投资	指	华诚投资有限公司，实际控制人陈锦魁控制的企业
锦艺纺织	指	锦艺纺织科技国际有限公司，华诚投资有限公司的全资子公司
汇鼎资本	指	广州汇鼎私募基金管理有限公司，实际控制人陈锦魁控制的企业，曾用名汇鼎资本管理有限公司
平潭锦商	指	平潭锦商投资合伙企业（有限合伙），实际控制人陈锦魁通过汇鼎资本间接控制的企业
平潭汇普安鼎	指	平潭汇普安鼎投资合伙企业（有限合伙），实际控制人陈锦魁通过汇鼎资本间接控制的企业
联瑞新材	指	江苏联瑞新材料股份有限公司（股票代码：688300.SH）
国瓷材料	指	山东国瓷功能材料股份有限公司（股票代码：300285.SZ）
壹石通	指	安徽壹石通材料科技股份有限公司（股票代码：688733.SH）
雅克科技	指	江苏雅克科技股份有限公司（股票代码：002409.SZ）
天马新材	指	河南天马新材料股份有限公司（股票代码：920971.BJ）
台光电子	指	指客户台光电子材料（昆山）股份有限公司、台光电子材料股份有限公司、中山台光电子材料有限公司、台光电子材料（黄石）有限公司、Elite Material（Penang）Sdn. Bhd.、EMD Specialty Materials, LLC 的合并披露主体
台光股份	指	台光电子材料股份有限公司（中国台湾地区上市公司，股票代码：2383）
生益科技	指	广东生益科技股份有限公司（股票代码：600183.SH），包含江西生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司、常熟生益科技有限公司等主体
南亚新材	指	南亚新材料科技股份有限公司（股票代码：688519.SH）、南亚新材料科技（江西）有限公司的合并披露主体

南亚电子	指	南亚塑胶工业股份有限公司、南亚电子材料（惠州）有限公司、南亚电子材料（昆山）有限公司的合并披露主体
南亚塑胶	指	南亚塑胶工业股份有限公司（中国台湾地区上市公司，股票代码：1303）
台燿科技	指	台燿科技（常熟）有限公司、台燿科技（中山）有限公司、台燿科技股份有限公司、Taiwan Union Technology （Thailand） Company Limited 的合并披露主体
台燿股份	指	台燿科技股份有限公司（中国台湾地区上市公司，股票代码：6274）
联茂电子	指	广州联茂电子科技有限公司、东莞联茂电子科技有限公司、江西联茂电子科技有限公司、联茂（无锡）电子科技有限公司、联茂电子股份有限公司的合并披露主体
建滔化工	指	建滔集团有限公司及其下属公司
比亚迪供应链	指	深圳市比亚迪供应链管理有限公司
韩国斗山	指	韩国斗山电子材料公司（Doosan Corporation Electro-Materials）
陶氏化学	指	陶氏化学公司（Dow Chemical Company）及旗下子公司
汉高，汉高集团	指	Henkel，德国汉高集团及旗下子公司
莱尔德	指	Laird PLC，莱尔德科技集团及旗下子公司
恩捷股份	指	上海恩捷新材料科技有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司、珠海恩捷新材料科技有限公司的合并披露主体
金力股份	指	河北金力新能源科技有限公司
阿克苏诺贝尔	指	Akzo Nobel N.V 及其下属公司
立邦	指	立邦涂料（中国）及相关公司
老虎	指	Tiger，老虎涂料公司及相关公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购并进行交易的普通股股票
本招股说明书、招股说明书	指	《苏州锦艺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
本次发行	指	发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）
本次发行上市	指	发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市交易
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
发行人审计机构、容诚、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构、广东联信	指	广东联信资产评估土地房地产股价有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日

二、专业术语

无机非金属材料	指	以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料，是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称
硅微粉	指	以二氧化硅（SiO_2）为主要成分的无机非金属粉体材料，具有低介电、低线性膨胀系数、高耐热、高绝缘等多种优良性能
球硅/球形硅	指	球形硅微粉的简称，指球体形态的二氧化硅粉体
火焰法球硅	指	发行人产品之一，采用火焰熔融的方式球化，并经一系列工序生产而成的球形硅微粉
直燃法球硅	指	发行人产品之一，采用 VMC（Vaporized Metal Combustion）原理进行球化，并经一系列工序生产而成的球形硅微粉
化学法球硅	指	发行人产品之一，采用化学合成的方法进行球化，并经一系列工序生产而成的球形硅微粉
氮化铝（粉）	指	一种高性能导热粉体材料，属类金刚石氮化物，具有高热导、低热膨胀、耐高温且电绝缘等性能特点
氮化硼（粉）	指	一种由硼、氮元素组成的导热粉体材料，具有低介电、低损耗、高导热等功能特性
氧化铝（粉）	指	以三氧化二铝（Al_2O_3）为主要成分的无机导热粉体材料，具有优良的导热、绝缘等性能
电子浆料	指	一种由固体粉末和有机溶剂混合而成的膏状功能性浆料，可实现电气连接和信号传输功能，广泛用于电子电路等领域
有机树脂、有机基材、合成树脂	指	工业中常用的有机树脂多为合成树脂，合成树脂指由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到的树脂产物，如酚醛树脂、聚氯乙烯树脂等，其中合成树脂是塑料的主要成分
印制电路板、PCB	指	Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，是在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其在电子设备中起到支撑、电路组件互联等作用
覆铜板、CCL	指	Copper Clad Laminate，中文名称为覆铜板，将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂基体，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种电子基础材料
刚性覆铜板、无卤型覆铜板	指	刚性覆铜板是指不易弯曲，并具有一定硬度和韧度的覆铜板；无卤型覆铜板指卤素如氯（C1）、溴（Br）等含量分别小于一定标准的覆铜板
高速覆铜板	指	具有高信号传输速度（10-50Gbps）、高特性阻抗精度、低传送信号分散性、低损耗的覆铜板
Megtron，M2、M4、M6、M7、M8、M9、M10	指	源自日本松下的 Megtron 系列高速覆铜板，现在已成为全球高速覆铜板通用性能分级
高频覆铜板	指	应用在高频下具有高速信号、低损耗传输特性的覆铜板
HDI 板	指	High Density Interconnection，HDI 板的中文名称为高密度互联印

		制电路板，是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板
IC 载板、IC 封装基板	指	IC 封装载板，是一种关键专用基础材料，种类有 6PIN、8PIN、双界面以及非接触式封装框架几种
ABF 膜	指	ABF 是一种高度耐用和刚性的薄膜，能抵抗温度变化时的膨胀和收缩，使其成为处理器或 IC 的纳米级和毫米级部件之间的基板
类载板（SLP）	指	Substrate-like PCB，中文简称为类载板（SLP），在 HDI 技术的基础上，采用半加成法（mSAP）制作的印制电路板，相较于传统 HDI 线宽线距更小、线路更加精细化
人工智能、AI	指	Artificial Intelligence，计算机科学的一个分支领域，通过模拟和延展人类及自然智能的功能，拓展机器的能力边界，使其能部分或全面地实现类人的感知（如视觉、语音）、认知功能（如自然语言理解），或获得建模和解决问题的能力（如机器学习等方法）
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，中文名称为集成电路，在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
AI 服务器	指	一种专门为人工智能（AI）应用设计的高性能服务器，采用异构硬件架构，通常集成 GPU、FPGA、ASIC 等加速芯片，与传统的 CPU 协同工作，以满足高吞吐量和复杂计算的需求。AI 服务器支持 AI 算法的训练和推理，可广泛应用于自然语言处理、计算机视觉、机器学习等领域
交换机	指	一种能以高带宽、低延迟转发网络数据，支撑大流量、高并发传输的网络核心设备
光通信	指	一种利用光作为信息载体，通过光纤等介质实现信息传输的通信方式，具有高带宽、低损耗、抗干扰等优点，广泛应用于现代通信网络
光模块	指	光收发一体模块，是实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口等构成
PCIE	指	高速串行计算机扩展总线标准（Peripheral Component Interconnect Express），由英特尔提出的，旨在替代旧的 PCI，PCI-X 和 AGP 总线标准
TGV	指	Through Glass Via，玻璃通孔技术，是一种穿透玻璃基板的垂直互连技术
环氧塑封料、EMC	指	Epoxy Molding Compound，中文名称为环氧塑封料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入二氧化硅粉体等为填料，以及添加多种助剂混配而成的封装材料
液态塑封料、LMC	指	Liquid Molding Compound，中文名称为液态塑封料，是通过将液态树脂挤压到产品中央，在塑封机温度和压力的作用下增强液态树脂的流动性，从而填充满整个晶圆的封装材料
颗粒状环氧塑封料、GMC	指	Granular Molding Compound，中文名称为颗粒状环氧塑封料，是在塑封过程采用均匀撒粉的方式，在预热后变为液态，将带有芯片的承载板浸入到树脂中而成型的封装材料
底部填充胶、UF	指	Underfill 胶，中文名称为底部填充胶，是通过加热固化将芯片底部的空隙大面积填满，从而达到加固目的的封装材料
HBM	指	High Bandwidth Memory、高带宽存储器，是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM（动态随机存取存储器），通过在垂直方向上堆叠多个 DRAM 芯片，采用硅通孔（TSV）和芯片堆叠架构实现高速数据传输与低能耗特性

Chiplet	指	芯粒或小芯片，将复杂的系统级芯片（SoC）分解为多个独立的功能模块，是预先制造、具有特定功能、可组合集成的晶片
CoWoS	指	Chip on Wafer on Substrate，指将芯片堆叠在晶圆上，再将整个结构封装在基板上的先进封装方法
FOWLP	指	扇出型晶圆封装，是对晶圆级封装（WLP）的改进，采用扇出（Fan-out）工艺进行封装，将芯片嵌入塑封材料中，然后在晶圆表面构建高密度重分布层（RDL）并施加焊锡球，形成重构晶圆，得到的实际封装面积要大于芯片面积，在面积扩展的同时也可以增加其它有源器件及无源元件形成系统级封装
FOPLP	指	扇出型板级封装，是将芯片分布在矩形载板上，然后采用扇出（Fan-out）工艺进行封装，与 FOWLP 类似
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging，晶圆级芯片规模封装，是先在整片晶圆上进行封装测试，其后再切割成单个芯片
基站	指	基站即公用移动通信基站，是移动设备接入互联网的接口设备，也是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
MLCC	指	Multi-layer Ceramic Capacitors，片式多层陶瓷电容器
介电常数（Dk）	指	介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数
介质损耗、介电损耗（Df）	指	材料或电介质在交变电场中，由于介质电导和介质极化的滞后效应，使电介质内流过的电流相量和电压相量之间产生一定的相位差，即形成一定的相角，此相角的正切值即介质损耗因子，由介质电导和介质极化的滞后效应引起的能量损耗叫做介质损耗 Df 越高，介质电导和介质极化的滞后效应越明显，电能损耗或信号损失越多 Df 越低，介质电导和介质极化的滞后效应减弱，电能损耗或信号损失越低
CTE，热膨胀系数	指	Coefficient of Thermal Expansion，物质在热胀冷缩效应作用下，几何特性随着温度的变化而发生变化的规律性系数
粒度、粒径	指	粒度指颗粒大小，粒径指颗粒直径
D50	指	中位粒径或中值粒径，即一个样品的累计粒度分布百分数达到 50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占 50%，小于它的颗粒也占 50%
磁性杂质，金属杂质	指	颗粒中的磁性物质，磁性异物越少，杂质元素含量越低，一般磁性杂质多为金属杂质
比表面积	指	固体材料的比表面积是指单位质量或单位体积的固体所具有的表面积
球形度	指	球形度的大小直接影响了颗粒的流动性和堆积性能，球形度越接近于 1，颗粒越接近于球体
球化率	指	球化率表示产品中球形颗粒所占比例，球化率越高，球形硅微粉产品在半导体封装材料的填充性能越好
吸油值	指	吸油值也称树脂吸附量，表示填充剂对树脂吸收量的一种指数，在实际应用中，大多数填料用吸油值这个指标来大致预测填料对树脂的需求量。颗粒相同的填料，带空隙的比不带空隙的填料颗粒吸油值要高，所以油吸附量小的填料在树脂中的用量就可增加。吸油值通常以 100g 颜料所需亚麻油的质量表示（%或 g/100g），即指每 100g 颜料，在达到完全润湿时需要用油的最低用量
导热系数，热导率	指	导热系数是指在稳定传热条件下，1m 厚的材料，两侧表面的温差为 1 度（K，℃），在一定时间内，通过 1 平方米面积传递的热量，

		单位为瓦/米·度 （W/（m·K），此处为 K 可用℃代替）
莫氏硬度	指	莫氏硬度是主要矿物质硬度的度量之一
晶型	指	具有相同化学结构的分子按照一定方式的有序排列
ppm	指	英文名 parts per million，百万分之一
表面改性（剂）	指	表面改性指在保持材料或制品原性能的前提下，赋予其表面新的性能，如亲水性、生物相容性、抗静电性能、染色性能等；表面改性剂是应用于对材料进行表面改性的物质
Prismark	指	Prismark Partners LLC，是一家全球著名的印制电路板（PCB）市场分析机构

注 1：本招股说明书中部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差所致；
注 2：本招股说明书引用的第三方数据来源于行业协会、专业咨询机构或平台公开发布或公开发售的研究报告内容，并已注明资料来源，确保权威、客观、独立并符合时效性要求。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

（一）特别风险提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项：

1、单一客户收入及毛利占比超过 50%的风险

报告期内，公司对第一大客户台光电子的销售收入分别为 20,537.03 万元、35,980.55 万元和 56,489.64 万元，占各期营业收入的比例分别为 39.53%、49.39%和 54.53%；公司来自台光电子的毛利贡献占比分别为 48.54%、64.39%和 75.12%。公司对台光电子的销售收入及毛利额占比超 50%，且报告期内呈现上升趋势，主要系 AI 等下游先进产业爆发式发展，催生出对高等级高速覆铜板的显著应用需求，台光电子作为高速覆铜板龙头企业，相应步入高速发展周期，并带动对公司高性能球硅的显著采购需求，公司对第一大客户销售收入及毛利占比较高，与台光电子行业领先地位、高端化发展定位，以及对发行人采购需求以高端产品为主等特点相匹配。若公司后续不能通过持续的产品升级迭代、技术创新等方式及时满足台光电子的业务需求，或者台光电子经营情况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略，则可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

2、营业收入增速放缓的风险

报告期内，公司营业收入分别为 51,950.91 万元、72,857.24 万元和 103,586.02 万元，2024 年度及 2025 年度，公司营业收入增幅分别为 40.24%、42.18%，呈现快速增长趋势，主要系公司系电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，在全球 AI 发展浪潮的驱动之下，依托高性能球硅等高端产品，紧握 AI 产业变革机遇实现快速发展。当前 AI 产业正处于基础设施集中投资建设期，倘若未来 AI

相关产业技术、发展规划发生不利变化，AI 算力设施资本投入增速放缓、出现收缩或 AI 规模化应用落地不及预期，进而影响到整体市场及公司下游客户的采购需求，则公司将面临营业收入增速放缓的风险。

3、产品迭代与技术创新风险

公司自设立以来坚持高端化发展路线，伴随全球加速进入 AI 时代，公司以高性能球形硅微粉为代表的高端产品，被广泛应用于 AI 算力设施等高阶应用领域。随着 AI 等下游先进产业向更高性能、更高集成化方向快速发展，对公司技术创新能力和迭代升级速度均提出更高要求。若公司不能紧跟下游技术和市场的发展趋势，准确把握下游行业关键技术应用的发展动态、新技术及新产品的研发方向、客户对高性能材料的需求变化，及时调整研发方向、优化产品结构并进行有效的技术储备与迭代，可能导致公司产品技术升级缓慢、竞争力下降，进而对公司经营情况及业务发展产生不利影响。

4、募集资金投资项目的实施风险

公司本次募集资金投资项目拟投入 22.19 亿元，用于电子信息用高性能粉体材料扩产项目、扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目、智能化升级改造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。公司已经对上述募投项目开展全面的必要性、可行性分析，并制定《募集资金管理制度》，配备专业团队，以保障募集资金投资项目顺利实施。但未来如宏观经济环境发生变化、产品技术升级迭代滞后、竞争加剧等市场环境变动、人才储备不足、下游客户需求发生变化等，可能导致募投项目无法实现预期目标，进而对公司未来业务发展、盈利能力等产生不利影响。

5、核心技术泄密及技术人才流失的风险

公司所处的先进无机非金属材料行业，尤其是高端功能性粉体材料领域，具有技术密集型的特点。行业内公司的持续发展依赖于长期自主研发过程中构建的核心技术与知识产权体系，同时，拥有一支稳定、优秀的技术人才团队是支撑公司持续技术创新与竞争力的重要基础之一。未来，如若公司核心技术保密措施不能得到有效执行，或因行业不正当竞争导致核心技术泄密，或因激励政策不能持续吸引技术人才，造成研发人员流失，将对公司的研发创新能力和业务稳定发展造成不利影响。

（二）本次发行相关方作出的重要承诺和说明

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件 1 与投资者保护相关的承诺”。

其中，公司控股股东、实际控制人已针对公司上市当年及之后第二年、第三年，较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上情形的，承诺延长其届时所持股份锁定期限。具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件 1 与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

（三）关于发行上市后利润分配的提示

公司已制定发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体参见“第九节 投资者保护”，请投资者予以关注。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	苏州锦艺新材料科技股份有限公司	**成立日期**	2017 年 2 月 9 日（2021 年 12 月 1 日整体变更设立股份有限公司）
注册资本	16,714.5075 万元	**法定代表人**	陈锦魁
注册地址	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号	**主要生产经营地**	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号
控股股东	广州锦族	**实际控制人**	陈锦魁
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	**在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况**	未在其他交易场所（申请）挂牌或上市
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	国信证券股份有限公司	**主承销商**	国信证券股份有限公司
发行人律师	上海市锦天城律师事务所	**其他承销机构**	无
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	**评估机构**	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系		截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在	

或其他利益关系		直接或间接的股权关系或其他利益关系	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	**收款银行**	**【】**
其他与本次发行有关的机构		验资复核机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 55,715,025 股	**占发行后总股本比例**	不低于 25.00%
其中：发行新股数量	不超过 55,715,025 股	**占发行后总股本比例**	不低于 25.00%
股东公开发售股份数量	无	**占发行后总股本比例**	无
发行后总股本	不超过 222,860,100 股（不含行使超额配售选择权发行的股份）		
每股发行价格	**【】**元		
发行市盈率	**【】**倍（按每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按**【】**年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	**【】**元	**发行前每股收益**	**【】**元
发行后每股净资产	**【】**元	**发行后每股收益**	**【】**元
发行市净率	**【】**倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外）		
承销方式	由承销商采用余额包销方式或监管机构认可的其他方式		
募集资金总额	**【】**万元		
募集资金净额	**【】**万元		
募集资金投资项目	电子信息用高性能粉体材料扩产项目		
	扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目		
	智能化升级改造项目		
	研发中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为**【】**万元，其中： 1、承销及保荐费：**【】**万元； 2、审计及验资费：**【】**万元； 3、评估费：**【】**万元		

	4、律师费：【】万元； 5、发行手续费：【】万元 6、其他费用：【】万元。 注：上述各项发行费用均为不含增值税金额
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	【】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	【】
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司专注于先进无机功能性粉体材料领域创新性技术研发及产业化应用，目前已成长为电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业。公司以高性能球形硅微粉为代表的电子信息功能材料系公司核心产品，对下游应用的关键性能有着重要影响，如在高速覆铜板中，通过添加高性能球形硅微粉，可增强信号传输所需的高速率、低损耗并赋予更优线性膨胀系数和尺寸稳定性等核心关键性能，近年来被广泛应用于英伟达、亚马逊、谷歌、AMD、Meta、英特尔、浪潮等国际知名科技企业的 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星等，并日益成为支撑 AI 算力设施核心性能要求与迭代升级的关键材料之一。

凭借在电子信息领域的多年技术积累和深刻产业化理解，公司逐步构建起兼具创新性技术开发和产业化应用的平台型技术，并锚定具备高附加值、创新性应用前景领域进行拓展性开发，逐步实现平台型技术在导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装等领域的多元化布局。此外，公司在部分由外资主导或下世代前沿领域持续攻关并不断突破，例如电子电路基板领域，公司进一步开发更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等前沿产品，适配 M9、M10

等级等下世代高速覆铜板及类载板（SLP）；在 IC 先进制造领域，公司自主开发的纳米氧化物是构成芯片抛光液的关键原材料之一，已成功应用于先进芯片制程抛光液产品。

（二）经营模式

1、所需主要原材料及重要供应商

报告期内，公司生产所需主要原材料包括有机硅球、氧化铝原料、火焰法球硅原料、氮化铝原料、碎玻璃片、直燃法球硅原粉、玻璃熔块等。公司主要供应商及采购情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、采购情况和主要供应商”。

2、主要生产模式

公司主要采用“以销定产+合理库存备货”的生产模式，由计划中心负责生产任务的统筹与安排。营销中心将客户订单、订单交期及销售预测反馈至计划中心，计划中心对订单进行分解，编制物料需求计划和生产计划，交由制造中心完成生产任务；为确保供应稳定性并提高对客户需求的快速响应能力，公司会结合未来销售订单预测及安全库存量，对需求稳定、供货量较大的主要产品进行适当备货。

3、销售方式、销售渠道及重要客户

公司主要采用直销的销售模式。一般直销模式下，通过客户认证之后，客户直接将订单下达至公司，由公司安排库存和生产以完成供货，公司负责将产品运送至客户指定的仓库或其他收货地点。公司目前以境内销售为主，部分为境外销售。公司主要客户为全球知名覆铜板制造商，包括台光电子、生益科技、南亚新材、台燿科技、联茂电子、南亚电子、华正新材、建滔化工等全球高速覆铜板领先企业，以及以陶氏化学、汉高为代表的导热散热领域知名企业等，详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、销售情况和主要客户”。

（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

先进无机非金属材料行业是新材料产业的重要分支和国家工业战略性新兴产业的重要组成部分，具有产业规模大、市场高度细分等特点。在高性能粉体材

料领域，外资厂商此前长期占据全球主要供应份额，其核心参与者包括日本雅都玛、日本龙森、日本电化株式会社、日本德山、法国圣戈班等。公司凭借长期的研发攻关和技术积淀，不断突破多项核心技术瓶颈，打破外资厂商的主导地位，并在覆铜板用功能性填料领域建立起领先地位，系少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业。2023 年至 2025 年期间，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会证明，在高等级高速覆铜板用球形硅微粉领域，公司全球市场占有率超过 40%，位列第一；根据中国非金属矿工业协会证明，公司在覆铜板用硅微粉领域销售规模位居国内第一。具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况及竞争状况”之“（四）行业竞争情况”。

五、发行人符合创业板定位的说明

（一）公司符合创业板定位相关指标要求

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条第二款相关指标要求，具体如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	公司最近三年累计研发投入金额为 10,424.53 万元，不低于 5,000 万元。
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用[注]	公司最近一年营业收入为 103,586.02 万元，超过 3 亿元，不适用营业收入复合增长率要求。

注：最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，不适用营业收入复合增长率要求。

（二）公司符合创业板定位的具体说明

1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域，自设立以来坚持自主研发和底层创新，经过二十余载耕耘，在以高性能球形硅微粉为代表的高端前沿材料领域持续攻关并不断突破，有力促进了新材料以及 AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算等新一代信息技术、低轨卫星、半导体制造与封装、新能源等新质生产力的发展。

（1）聚焦高性能无机功能性粉体填料进口替代与行业引领，实现多品类高性能产品产业化应用

以高性能球形硅微粉为代表的无机功能性粉体填料是覆铜板制造的关键填充材料，对覆铜板介电性能、尺寸稳定性、耐热性、绝缘性等核心指标有着重要影响。高端粉体填料生产工艺流程较为复杂，涉及粉体合成、粉体微纳加工、表面改性等多个关键核心环节，具有较高的技术壁垒。在高性能粉体材料领域，日本、欧美等外资厂商曾长期占据全球主导地位，内资企业整体处于技术和产品快速追赶阶段。

公司专注于先进无机功能性粉体领域创新性技术研发及产业化应用，经过二十余载的自主研发和创新实践，不断突破多项核心技术瓶颈，掌握粉体合成、微纳加工、表面改性等核心技术群，打破外资厂商的主导地位，并在覆铜板用功能性填料领域建立起领先地位。依托化学法球硅等高性能球形硅微粉制备技术，公司基于在 M6 至 M8 等级高速覆铜板领域的核心优势，针对下世代高速覆铜板应用需求，进一步开发更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等前沿产品，为在高速覆铜板用功能性填料领域持续锁定领先身位奠定坚实基础。此外，公司在 IC 先进制造等高端前沿领域亦不断实现技术突破和下游认证，储备多项前沿高端产品，如应用于先进芯片制程的 CMP 抛光液纳米氧化物、可应用于 2.5D/3D、HBM 等先进封装的液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）、芯片底部填充胶（UF）用功能性材料等，助力补足高端前沿新材料领域“短板”，有力推动新材料战略性新兴产业“强链补链”，促进高端前沿新材料等新质生产力的发展。

（2）公司在国际、国内拥有领先的市场地位

公司是电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，尤其是在应用于 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星的高等级高速覆铜板领域，公司具有业内领先的市场地位。2023 年至 2025 年期间，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会证明，在高等级高速覆铜板用球形硅微粉领域，公司全球市场占有率超过 40%，位列第一；根据中国非金属矿工业协会证明，公司在覆铜板用硅微粉领域销售规模位居国内第一。

公司系少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业，根据中国非金属矿工业协会开具的证明，公司化学合成新工艺“避开了国外的技术封锁，极大地提升我国高端球形硅微粉的加工水平，产品性能指标达到国际领先水平，填补了国内空白”。

2、公司的技术创新性及其表征

公司秉持以研发为先导的经营理念，在研发方面保持高强度投入，报告期各期研发费用分别为 2,793.28 万元、3,420.40 万元和 4,210.85 万元。公司以下游新兴产业技术迭代趋势和客户差异化需求为导向，历经二十余载创新实践，构建了以粉体合成技术群、粉体微纳加工技术群、表面改性技术群为核心，以配方技术、自动化控制系统开发技术为补充的核心技术体系，具体核心技术及其先进性表征详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、公司核心技术及研发情况”之“（一）公司核心技术情况”。

公司已形成较为丰富的科技创新成果，截至本招股说明书签署日，公司及附属子公司已取得有效专利 72 项，其中发明专利 65 项、实用新型 7 项。公司在粉体合成、微纳加工、表面改性、配方等领域的核心技术均应用于生产过程之中，使得公司产品在性能指标、技术水平、品质稳定性等方面具有较强的市场竞争力。同时，针对下世代高速覆铜板、类载板（SLP）、先进封装等前沿场景，公司已开展前瞻性技术储备与产品布局，具体详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、公司核心技术及研发情况”之“（三）公司研发项目情况”。

公司长期坚持自主研发创新，持续推动高端产品及技术的应用落地，获得了多项产品或技术研发相关的荣誉奖项或资质，具体内容详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、公司核心技术及研发情况”之“（二）核心技术的科研实力和成果情况”之“1、公司获得的重要奖项及荣誉”。此外，公司参与了《集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉》（标准号：GB/T 46381-2025）、《集成电路封装用球形氧化铝微粉》（标准号：GB/T 46378-2025）等 2 项已发布国家标准制定，及 1 项已发布的团体标准制定，并承担了“先进封装基板用高性能球形二氧化硅研发及产业化”国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目等重点研发及产业化项目。

3、公司属于现代产业体系及其表征

公司所处的先进无机非金属材料行业下游应用领域包括 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、低轨卫星、半导体制造与封装、新能源等，已成为支撑国家电子信息等产业链自主可控的关键材料。根据国家统计局发布的《战略性新兴产

业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所处行业与主要产品属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.5 矿物功能材料制造”之“3.4.5.4 功能性填料制造”，为国家重点支持和发展的战略性新兴产业。公司专注于先进无机功能性粉体材料领域创新性技术研发及产业化应用，主要产品属于国内新材料产业升级、电子电路产业链自主可控进程中重点扶持与鼓励发展的细分领域，属于现代产业体系。

新材料产业作为支撑国民经济高端制造、战略新兴产业发展的基础性、先导性和战略性产业，受到国家相关政策的大力支持。近年来，我国持续加强对新材料、电子信息等新兴产业的政策扶持，鼓励关键基础材料自主创新与国产替代，为行业发展注入强劲动力。公司所处行业的发展规划与产业政策详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况及竞争状况”之“（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策”。

综上，公司所处行业与业务发展契合国家经济发展战略和产业政策导向，在新材料与电子信息等战略性新兴产业快速发展的背景下，公司作为电子信息领域无机功能性材料行业领先企业，有望持续受益于政策红利，实现业务持续发展。

4、公司的成长性及其表征

2023 年度至 2025 年度，公司营业收入分别为 51,950.91 万元、72,857.24 万元和 103,586.02 万元，最近三年营业收入复合增长率为 41.21%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 6,479.43 万元、8,748.54 万元和 16,354.92 万元，最近三年复合增长率为 58.88%。在全球 AI 浪潮的驱动下，公司以高性能球硅等核心产品为依托，紧握 AI 产业变革机遇，实现快速发展。

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域二十余载，在粉体合成、粉体微纳加工、表面改性、配方技术等核心领域形成深厚的技术沉淀和持续创新能力，打造了覆盖电子信息、导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等多元领域的功能性材料矩阵。公司产品下游应用覆盖 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星、半导体制造与封装等景气度较高的领域，下游终端产业的快速发展，为公司未来业务增长提供了有力支撑。同时，公司依托于深厚的技术底蕴、突出的研发创新能力以及技术迭代优势，在下世代前沿领域持续攻

关，可充分匹配下游高端市场需求，为公司未来业绩增长注入新动能。综合来看，公司下游产业发展前景向好，公司产品尤其是高端前沿产品的市场拓展空间广阔，公司具备较好的成长性。

5、公司符合创业板行业领域及其依据

公司的主营业务为先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。

公司行业分类不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的十二类负面清单行业，不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，亦不属于学前教育、学科类培训、类金融业务行业。

因此，公司所属行业符合创业板定位。

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

根据容诚会计师出具的“容诚审字[2026]215Z0053 号”《审计报告》，发行人最近三年的资产状况和经营业绩如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
资产总额	191,365.14	142,257.67	107,492.15
归属于母公司所有者权益	104,775.07	88,334.82	79,073.88
资产负债率（母公司）	33.77%	32.62%	31.44%
资产负债率（合并）	45.29%	37.91%	26.44%
营业收入	103,586.02	72,857.24	51,950.91
净利润	16,517.17	8,936.38	6,604.20
归属于母公司所有者的净利润	16,602.20	8,946.61	6,609.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	16,354.92	8,748.54	6,479.43
基本每股收益（元/股）	0.99	0.54	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.98	0.53	0.39
加权平均净资产收益率	17.19%	10.69%	8.75%

项目	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	16.94%	10.45%	8.58%
经营活动产生的现金流量净额	19,876.02	6,135.37	-329.74
现金分红	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	4.07%	4.69%	5.38%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日期间，公司经营状况良好，所处行业、生产经营模式未发生重大变化，生产经营的内外部环境未发生重大变化；公司管理层及核心技术人员均保持稳定，未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形；行业政策、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2 条第（一）项标准：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字[2026]215Z0053 号），公司 2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别为 8,748.54 万元和 16,354.92 万元，符合所选择的上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，发行人不存在关于公司治理的特殊安排事项。

十、发行人募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

公司本次拟公开发行不超过 55,715,025 股人民币普通股（A 股），占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%，发行募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
1	电子信息用高性能粉体材料扩产项目	139,405.46	139,405.46
2	扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目	19,685.56	19,685.56
3	智能化升级改造项目	16,537.84	16,537.84
4	研发中心建设项目	31,276.19	31,276.19
5	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		**221,905.05**	**221,905.05**

本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资额，剩余部分公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用。

（二）未来发展规划

未来，公司将加大现有高端产品如化学法球硅等高性能球形硅微粉的生产规模和市场份额，巩固在覆铜板用无机功能粉体材料领域的领先地位。同时，公司将保持氮化铝、氮化硼等高导热氮化物产品的稳步发展，深化高端导热粉体材料领域布局并提升产品的市场渗透率。此外，公司还将围绕电子电路基板、IC 先进制造、先进封装领域不断研发创新，进一步开发更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等下世代高速覆铜板领域前沿产品，推进 AI 用高密度互联及下世代玻璃基板（TGV）用电子浆料、芯片抛光液纳米氧化物、先进封装功能材料等产品的规模化量产和客户推广，持续向功能性材料更低介电常数、超低介电损耗、低线性膨胀系数、高导热、高模量等性能方向迭代创新，不断攻克行业前沿品类技术难点，稳步推进相关技术落地及国产化，逐步形成重点突出、多点突破的战略发展格局。公司将通过不断的研发投入推动发展战略的有效落地，不断巩固和提升公司在无机新材料领域的竞争力和影响力，成为品类丰富、应用行业广泛、技术谱系全面的新材料行业代表企业。

有关本次发行募集资金投资项目及发行人未来发展规划的详细情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价判断本公司股票价值时，除仔细阅读本招股说明书提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。下述各项风险按照不同类型进行归类，同类风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、产品迭代与技术创新风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“3、产品迭代与技术创新风险”。

2、核心技术泄密及技术人才流失的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“5、核心技术泄密及技术人才流失的风险”。

（二）经营风险

1、单一客户收入及毛利占比超过 50%的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、单一客户收入及毛利占比超过 50%的风险”。

2、营业收入增速放缓的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、营业收入增速放缓的风险”。

（三）财务风险

1、应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 20,151.97 万元、29,951.11 万元和 41,260.27 万元，占当期营业收入的比例分别为 38.79%、41.11%和 39.83%。未来

随着公司经营规模持续扩大，预计公司应收账款余额可能进一步增加。若下游客户财务状况出现恶化，可能存在应收账款无法收回的风险，进而对公司未来经营业绩产生不利影响。

2、商誉减值的风险

公司 2019 年收购山东锦艺 100%股权，支付的对价超过可辨认净资产公允价值，形成合并商誉 1,071.12 万元。报告期各期末，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对商誉及相关的资产组进行了减值测试，公司商誉不存在减值的迹象。如果未来宏观经济环境、市场条件、下游客户需求或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，相关资产组无法实现预期的经营业绩，则公司可能面临商誉减值的风险，进而对公司的业绩表现带来不利影响。

3、毛利率波动风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 30.55%、30.87%和 34.04%。公司产品毛利率主要受产品售价、产品结构、原材料价格、规模效应、公司技术水平及商务谈判等多种因素影响，若上述因素发生变化，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

4、税收优惠政策变化风险

公司目前享受了高新技术企业、小型微利企业、西部大开发战略有关企业等多项所得税税收优惠。报告期内，公司享受的上述所得税优惠金额分别为1,167.08 万元、1,076.95 万元和 1,854.16 万元，占利润总额的比例分别为 16.24%、10.72%和 9.80%。如果上述税收优惠政策发生重大变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

（四）内控风险

随着公司主营业务的快速发展，产品结构得到持续的丰富和优化，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩大。与此同时，公司的生产经营管理的难度也将同步增加，对公司的技术研发、市场拓展、产品质量管控、内部控制、财务管理等方面都有了更高标准的要求。如果公司内部管理水平不能与公司业务的迅速扩张较好匹配，组织模式和管理体系不能及时

跟随公司规模的扩大而及时调整，公司将面临规模迅速扩张导致的经营管理和内控风险，最终对公司的盈利能力与业务发展造成不利影响。

（五）股东特殊权利恢复的风险

公司历史上融资引入外部投资人股东时，约定了股份回购权等特殊权利条款。2026 年 2 月 6 日，发行人与股份公司第一次股权转让后的各方股东签订了《关于苏州锦艺新材料科技股份有限公司之股东协议》，以取代此前关于各方股东权利义务分配所达成的任何协议、投资意向书、谅解备忘录、陈述或其他义务中的相关内容，约定了回购权等特殊权利条款自公司提交首次公开发行股票并上市的申报材料的前一日起终止，但附有恢复生效条款。

公司若未能成功上市，部分股东可能会要求回购义务人回购其持有的公司股份，届时公司可能面临股权结构发生变化的风险。

二、与行业相关的风险

（一）行业周期性波动的风险

公司产品主要应用于高等级高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用各类高端覆铜板，以及高导热胶等导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装材料等多个领域，终端应用领域包括 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星、高端消费电子、汽车电子、半导体制造与封装等。该等行业受到宏观经济及电子信息等行业周期的影响，若未来宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓，或电子信息等行业需求出现周期性波动、技术迭代延长，传导至公司所属的上游材料行业，将可能会对公司的经营状况造成不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

随着 AI 人工智能、高速网络通信、云计算等下游应用领域的快速发展与技术迭代，高性能先进无机功能性粉体材料市场需求迎来爆发式增长。在市场需求不断扩张的背景下，同行业竞争对手可能通过融资扩产、技术升级等方式加大对电子信息用高性能粉体材料的业务布局，同时未来可能有更多新进入企业，市场竞争将有所加剧。若公司未来不能及时把握市场发展机遇、精准判断行业技术发展趋势，或未能持续提升产品性能、实现下世代新产品的迭代突破，或未能在品

质管控、客户服务等方面进一步巩固并增强自身优势，将对公司市场份额及盈利水平产生不利影响。

（三）国际贸易摩擦和关税政策风险

报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 13.66%、13.97%和 11.53%，占比较低，且出口主要面向中国台湾地区，暂未受到国际贸易形势变化的重大不利影响。但在全球贸易保护主义抬头的大背景下，国际贸易摩擦和关税贸易保护手段可能扰动全球供应链，欧美等国家仍可能对中国新材料、电子信息、半导体产业部分战略性产品采取加征关税等贸易壁垒措施，可能导致下游行业市场需求减弱或增长不及预期，对公司经营业绩造成不利影响。

三、其他风险

（一）与募集资金相关的风险

1、募集资金投资项目的实施风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“4、募集资金投资项目的实施风险”。

2、募投项目用地尚未取得的风险

公司“电子信息用高性能粉体材料扩产项目”部分项目拟自购土地进行建设，“研发中心建设项目”拟自购房产。截至本招股说明书签署日，发行人尚未取得“电子信息用高性能粉体材料扩产项目”部分用地的土地使用权，发行人与常熟经济技术开发区管理委员会签署《电子信息高性能粉体材料项目投资协议》，约定该项目用地事宜，当地管委会承诺将协调相关载体、地块优先供应给发行人使用，并出具《说明函》：“本单位支持锦艺新材‘电子级高性能粉体材料生产基地项目’用地需求，协调锦艺新材取得相关建设用地，并根据锦艺新材项目建设计划及实际需要依法办理土地出让各项手续，保障项目按计划正常实施”；公司尚未取得“研发中心建设项目”所需房产，发行人已与常熟市信虞科技产业园有限公司签署《购买意向协议书》，明确双方交易意向，并与常熟经济技术开发区管理委员会签署《苏州锦艺研发中心项目投资协议》，当地管委会承诺将协调相关载体优先供应给发行人使用，综合上述情况，预计发行人取得募投用地不存在实质性障碍。

但上述募投项目用地的取得仍存在一定不确定性，若未来募投项目用地的取得时间晚于预期，或由于募投项目用地所在地区国土规划政策调整等原因导致募投项目用地无法落实，则公司本次募投项目可能面临延期或者变更实施地点的风险，从而对募投项目的实施造成不利影响。

3、新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，项目建成后折旧、摊销金额较大。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间，在项目建成初期，新增固定资产折旧费用可能会对公司未来经营业绩将产生较大影响。如果未来市场需求出现改变，则公司可能面临因新增固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。

4、即期回报被摊薄的风险

公司完成本次发行并收到募集资金后，公司的股本总数及净资产规模将会随之大幅增长。发行人募投项目的开展、实施和产出需要一定的时间周期。募投项目的相应收益在项目全部完成实施并投产后才能逐步实现，故公司在短期内存在净资产收益率被摊薄的风险。

（二）发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	苏州锦艺新材料科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Ginet New Material Technology Co., Ltd.
注册资本	16,714.5075 万元
法定代表人	陈锦魁
有限公司成立日期	2017 年 2 月 9 日
股份公司设立日期	2021 年 12 月 1 日
公司住所	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号
邮政编码	215536
联系电话、传真	0512-52653039
互联网网址	http://www.ginet.cn/
电子邮箱	ir@ginet.cn
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和联系方式	董事会办公室、黄云余、0512-52653039

二、发行人设立情况

发行人系于 2021 年 12 月 1 日由锦艺有限整体变更设立。锦艺有限于 2017 年 2 月 9 日设立，设立时曾用名为苏州海旭新材料科技有限公司，2018 年 10 月 22 日更名为苏州锦艺新材料科技有限公司。

（一）有限公司设立情况

发行人前身锦艺有限设立于 2017 年 2 月 9 日，系由重庆市锦艺硅材料开发有限公司投资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 10,000.00 万元，全部由重庆市锦艺硅材料开发有限公司以货币方式认缴。

2017 年 2 月 9 日，苏州海旭取得了常熟市市场监督管理局核发的营业执照，苏州海旭设立时，其股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	股权比例	出资方式
1	重庆锦艺	10,000.00	100.00	货币
合计		**10,000.00**	**100.00**	**-**

苏州海旭成立后，于 2017 年的实收资本情况如下：

2017 年 5 月，苏州东瑞会计师事务所对苏州海旭设立时的注册资本缴纳情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 12 日出具了“东瑞内验（2017）字第 6006 号”验资报告，经审验，截至 2017 年 5 月 8 日，苏州海旭已收到重庆市锦艺硅材料开发有限公司货币缴纳的出资 2,000 万元，全部计入注册资本。

（二）股份公司设立情况

2021 年 9 月 30 日，容诚出具《审计报告》（容诚审字[2021]510Z0108 号），截至 2021 年 7 月 31 日，锦艺有限经审计净资产为 46,522.09 万元。

2021 年 10 月 1 日，广东联信出具《苏州锦艺新材料科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第 A0757 号），截至 2021 年 7 月 31 日，锦艺有限经评估的净资产为 51,074.82 万元。

2021 年 10 月 17 日，锦艺有限召开股东会，同意锦艺有限以整体变更的方式发起设立股份有限公司，以截至 2021 年 7 月 31 日经审计确认的净资产 46,522.09 万元，按照 1：0.327554 的比例折为股份公司总额 15,238.51 万股，每股面值人民币 1 元，折股溢价 31,283.58 万元计入资本公积。同日，全体股东作为发起人签署《苏州锦艺新材料科技股份有限公司发起人协议》。

2021 年 10 月 17 日，公司向全体股东发出《第一次股东大会会议通知》；2021 年 11 月 2 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于设立苏州锦艺新材料科技股份有限公司的议案》等议案，并由全体发起人共同签署《苏州锦艺新材料科技股份有限公司章程》。

2021 年 9 月 30 日，容诚出具《验资报告》（容诚验字 2021510Z0027 号）：经审验，截至 2021 年 9 月 30 日止，股份公司（筹）已收到全体发起人以净资产缴纳的注册资本合计 15,238.51 万元。

2021 年 12 月 1 日，苏州市行政审批局向公司核发了锦艺有限变更为锦艺新材的《营业执照》（统一社会信用代码 91320581MA1NCU5U4T），公司名称变更为“苏州锦艺新材料科技股份有限公司”。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名/发起人名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广州锦族	75,518,850	49.56
2	穗合投资	15,650,268	10.27
3	陈锦魁	14,640,000	9.61
4	远致华信	9,195,402	6.03
5	平潭锦新	9,195,402	6.03
6	哈勃投资	8,620,690	5.66
7	平潭锦材	5,747,127	3.77
8	国投创业基金	4,597,701	3.02
9	哇牛制享	3,386,284	2.22
10	百瑞信托	2,298,851	1.51
11	哇牛智新	2,068,966	1.36
12	欣亿源	1,149,425	0.75
13	苏州时点	229,885	0.15
14	信福汇四号	86,207	0.06
合计		**152,385,058**	**100.00**

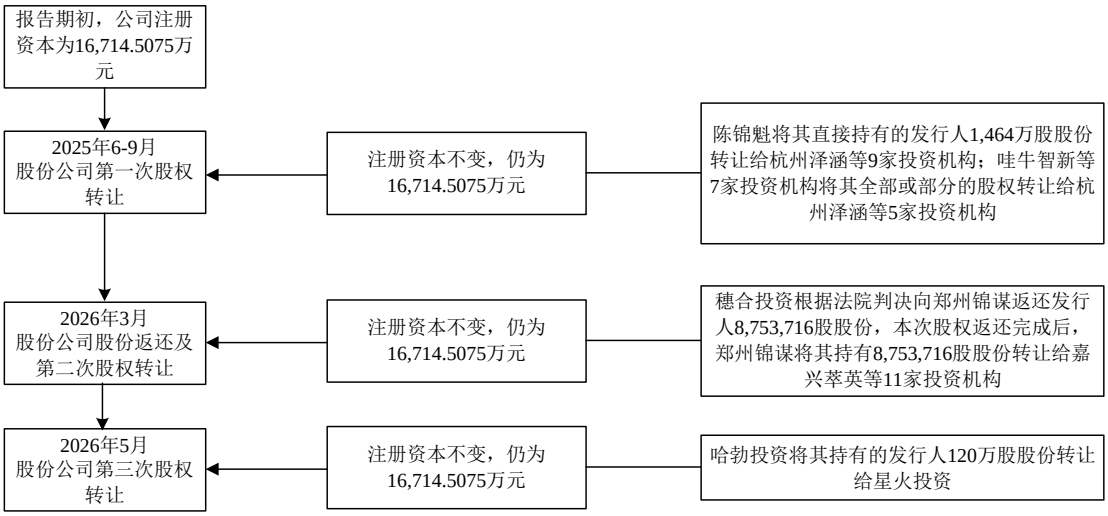
2022 年 8 月 1 日，容诚出具了《关于苏州锦艺新材料科技股份有限公司前期会计差错事项对股改基准日净资产影响的说明》，经复核调整后，锦艺新材于股改基准日的净资产为人民币 460,435,788.26 元，按照 1：0.330958 的比例折合股份 15,238.51 万股，每股面值为人民币 1 元，净资产折合股本后的余额为 308,050,730.26 元转入资本公积。2022 年 9 月 15 日，容诚出具《关于对苏州锦艺新材料科技股份有限公司股改净资产出资到位情况专项复核的报告》（容诚专字[2022]510F0027 号）亦对股份改制及前述复核调整情况进行了复核验资。

本次调整事项调增了股改基准日的净资产，该调整不会导致公司整体变更时发起人出资不实，不改变各发起人的持股数量和持股比例。针对上述净资产调整事项，公司已于 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认股改净资产调整及股改方案调整的方案》，履行了必要程序。

三、发行人报告期内的股本和股东变化情况

（一）发行人报告期内的股本及股东变化概况

报告期初至本招股说明书签署之日，发行人股本及股东变化概况如下：



（二）发行人报告期内的股本和股东变化

报告期初至本招股说明书签署之日公司股本未发生变化，报告期期初公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广州锦族	75,518,850	45.18
2	穗合投资	15,650,268	9.36
3	陈锦魁	14,640,000	8.76
4	远致华信	9,195,402	5.50
5	平潭锦新	9,195,402	5.50
6	哈勃投资	8,620,690	5.16
7	国投创业基金	8,407,327	5.03
8	平潭锦材	5,747,127	3.44
9	晨道投资	3,428,664	2.05
10	哇牛制享	3,386,284	2.03
11	中电科研投基金	2,909,793	1.74
12	百瑞信托	2,298,851	1.38
13	哇牛智新	2,068,966	1.24
14	星火投资	1,523,851	0.91

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
15	常熟经开	1,523,851	0.91
16	欣亿源	1,149,425	0.69
17	杭州新同	761,925	0.46
18	超兴创投	380,963	0.23
19	信福汇十二号	283,436	0.17
20	苏州时点	229,885	0.14
21	扬州乾益	137,908	0.08
22	信福汇四号	86,207	0.05
合计		**167,145,075**	**100.00**

报告期初至本招股说明书签署之日，本公司股东变化情况具体如下：

1、股份公司第一次股权转让

2025 年 6 月至 9 月，陈锦魁陆续将其直接持有的发行人 1,464 万股股份转让给杭州泽涵等 9 家投资机构；哇牛智新等 7 家投资机构将其全部或部分的股权转让给杭州泽涵等 5 家投资机构。具体情况如下：

转让方	受让方	转让股数（股）	占当前股本比例
陈锦魁	杭州泽涵	4,894,068	2.9280%
陈锦魁	华泰渝富	2,043,850	1.2228%
陈锦魁	华泰产发	1,228,155	0.7348%
陈锦魁	南京厚盈	7,995	0.0048%
陈锦魁	君安嘉平	1,253,588	0.7500%
陈锦魁	君安勇诚	2,507,176	1.5000%
陈锦魁	宁波甬诚	1,253,588	0.7500%
陈锦魁	合肥经韬	814,833	0.4875%
陈锦魁	厦门经韬	636,747	0.3810%
哇牛智新	杭州泽涵	2,068,966	1.2378%
杭州新同	杭州泽涵	761,925	0.4558%
远致华信	广发信德	1,033,955	0.6186%
远致华信	成都建鑫	210,693	0.1261%
信福汇十二号	广发信德	34,732	0.0208%
信福汇十二号	成都建鑫	7,078	0.0042%

转让方	受让方	转让股数（股）	占当前股本比例
信福汇四号	广发信德	10,585	0.0063%
信福汇四号	成都建鑫	2,157	0.0013%
中电科研投基金、扬州乾益	尚融投资	2,507,176	1.5000%
	尚融聚鑫	540,525	0.3234%

2、股份公司股权返还及第二次股权转让

2026 年 3 月，穗合投资根据法院判决向郑州锦谋返还发行人 8,753,716 股股份，该等股权系 2021 年 8 月穗合投资由郑州锦谋处受让取得。本次股权返还完成后，郑州锦谋将其持有的 8,753,716 股股份转让给嘉兴萃英等 11 家投资机构。相关变动具体情况如下：

转让方	受让方	转让股数（股）	占当前股本比例
郑州锦谋	嘉兴萃英	1,814,655	1.0857%
	苏州创投	1,215,602	0.7273%
	常熟创投	1,013,000	0.6061%
	福州创科	820,532	0.4909%
	东方富海三号	759,751	0.4545%
	嘉兴经韬	607,801	0.3636%
	苏州致兴	607,801	0.3636%
	苏州致盛	607,801	0.3636%
	福建创盈	547,021	0.3273%
	苏州卓璞	455,851	0.2727%
	共青城智晟	303,901	0.1818%
合计		**8,753,716**	**5.2372%**

3、股份公司第三次股权转让

2026 年 5 月，哈勃投资将其持有的发行人 120 万股股份转让给星火投资。

截至本招股说明书披露之日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	广州锦族	75,518,850	45.1816%
2	平潭锦新	9,195,402	5.5014%
3	国投创业基金	8,407,327	5.0300%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
4	远致华信	7,950,754	4.7568%
5	杭州泽涵	7,724,959	4.6217%
6	哈勃投资	7,420,690	4.4397%
7	穗合投资	6,896,552	4.1261%
8	平潭锦材	5,747,127	3.4384%
9	晨道投资	3,428,664	2.0513%
10	哇牛制享	3,386,284	2.0260%
11	星火投资	2,723,851	1.6296%
12	尚融投资	2,507,176	1.5000%
13	君安勇诚	2,507,176	1.5000%
14	百瑞信托	2,298,851	1.3754%
15	华泰渝富	2,043,850	1.2228%
16	嘉兴萃英	1,814,655	1.0857%
17	常熟经开	1,523,851	0.9117%
18	君安嘉平	1,253,588	0.7500%
19	宁波甬诚	1,253,588	0.7500%
20	华泰产发	1,228,155	0.7348%
21	苏州创投	1,215,602	0.7273%
22	欣亿源	1,149,425	0.6877%
23	广发信德	1,079,272	0.6457%
24	常熟创投	1,013,000	0.6061%
25	福州创科	820,532	0.4909%
26	合肥经韬	814,833	0.4875%
27	东方富海三号	759,751	0.4545%
28	厦门经韬	636,747	0.3810%
29	嘉兴经韬	607,801	0.3636%
30	苏州致兴	607,801	0.3636%
31	苏州致盛	607,801	0.3636%
32	福建创盈	547,021	0.3273%
33	尚融聚鑫	540,525	0.3234%
34	苏州卓璞	455,851	0.2727%
35	超兴创投	380,963	0.2279%
36	共青城智晟	303,901	0.1818%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
37	信福汇十二号	241,626	0.1446%
38	苏州时点	229,885	0.1375%
39	成都建鑫	219,928	0.1316%
40	信福汇四号	73,465	0.0440%
41	南京厚盈	7,995	0.0048%
合计		**167,145,075**	**100.00%**

四、发行人成立以来的重要事件

发行人目前生产经营所在地苏州常熟市地理位置优越，水路交通发达，地处长三角电子信息、集成电路产业集群核心区域，客户集聚度较高，具有明显的区位优势，因此重庆锦艺 2017 年在常熟投资设立锦艺新材并进行规模化产能建设，将发行人定位为管理中心、技术研发中心及核心生产基地。

2018 年发行人与原控股股东重庆锦艺进行同一控制下的资产重组及股权结构调整，发行人取得重庆锦艺相关资产、业务、人员、专利技术等，实际继承并延续重庆锦艺主营业务、产品体系、技术成果、工艺经验、客户资源等，此后重庆锦艺无实质性业务并于 2022 年注销，具体如下：

1、2018 年 10 月，重庆锦艺设立全资子公司云阳锦艺，2018 年 12 月，重庆锦艺将房屋建筑物、土地使用权、机器设备等经营性资产作价人民币 3,330.18 万元向云阳锦艺增资，北京天健兴业资产评估有限公司就上述出资资产出具了《资产评估报告》。同月，重庆锦艺将云阳锦艺 100%股权以原始出资额作价转让给发行人前身锦艺有限。

2、2018 年 12 月，重庆锦艺将其苏州分公司的设备、车辆等经营性资产以 1,477.84 万元的价格出售给锦艺有限，北京天健兴业资产评估有限公司就上述经营性资产出具了《资产评估报告》。同月，重庆锦艺将全部存货以账面价值分别出售给云阳锦艺和锦艺有限。

3、本次重组过程中，重庆锦艺相关人员与锦艺有限重新签署《劳动合同书》，完成人员劳动关系变更，相关商标、专利、技术亦由重庆锦艺转让至锦艺有限。

4、2018 年 12 月，重庆锦艺将其持有的锦艺有限全部股权转让给广州锦族、陈锦魁、郑州锦谋，完成同一控制下的股权结构调整。

本次资产重组完成后，原控股股东重庆锦艺已无实际生产经营活动，全部业务已通过前述资产重组注入锦艺有限，重庆锦艺多年以来构建和积累的技术体系、工艺经验优势、技术成果、核心技术人员等均由锦艺有限实际继承并延续，发行人原控股股东重庆锦艺已于 2022 年 12 月完成注销。本次资产重组未对公司业务发展构成不利影响及实质性变化，亦未导致实际控制人发生变更。

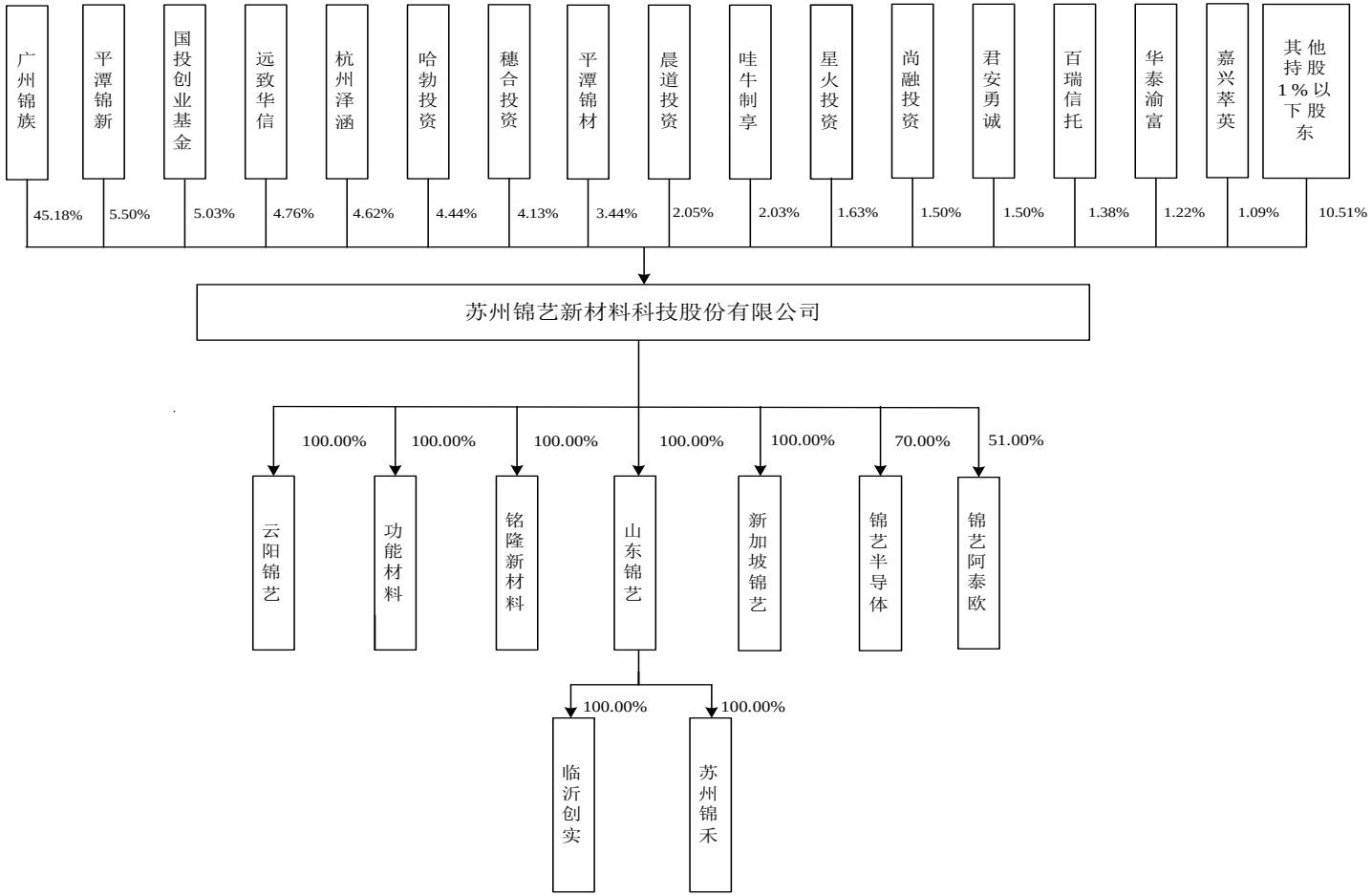
报告期内，发行人未发生重大资产重组行为。

五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

自设立以来，发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。

六、发行人股权结构

截至本招股说明书签署之日，发行人的股权结构图如下：



七、发行人控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署之日，锦艺新材拥有 6 家控股子公司，分别是山东锦艺、云阳锦艺、功能材料、铭隆新材料、锦艺半导体、新加坡锦艺；2 家孙公司，分别是临沂创实、苏州锦禾，1 家参股公司为锦艺阿泰欧。

新加坡锦艺系发行人境外子公司，于 2026 年 3 月设立，项目注册地和主要生产经营地为新加坡罗宾逊路 36 号城市大厦 21 楼 01 号，注册资本为 50 万新加坡元。该公司拟作为发行人海外运营主体，截至本招股说明书签署之日，已取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202501891 号）及苏州市发展和政革委员会出具的《关于苏州锦艺新材料科技股份有限公司在新加坡新建锦艺新材料有限公司项目备案的通知》（苏州发改外[2026]52 号），尚未实际出资或开展经营。其余公司具体情况如下：

（一）发行人的控股子公司及孙公司

截至本招股说明书签署之日，锦艺新材的控股子公司及孙公司具体情况如下：

1、云阳锦艺

公司名称	云阳县锦艺新材料科技有限公司			
统一社会信用代码	91500235MA6051EY5A			
注册地址	重庆市云阳县工业园区人和组团			
主要生产经营地	重庆市云阳县工业园区			
法定代表人	陈锦魁			
注册资本	3,380.18 万元			
实收资本	3,380.18 万元			
公司类型	有限责任公司（法人独资）			
成立时间	2018 年 10 月 30 日			
股东构成及控制情况	一级子公司，锦艺新材持有其 100%的股权			
经营范围	硅材料以及云母、重晶石、高岭土、铝土矿等其他非金属矿的开发设计、研究和深加工（超细粉碎、高纯、精制和改性等）及销售；硅材料以及云母、重晶石、高岭土、铝土矿等其他非金属矿产品和技术的进出口；废旧物资回收			
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	电子信息功能材料等产品的生产平台			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
时间	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**

2025-12-31/ 2025 年度	8,051.71	4,135.22	5,446.54	246.32

注：控股子公司及孙公司财务数据经容诚会计师在合并报表范围内审计，下同。

2、功能材料

公司名称	江苏锦艺功能材料有限公司
统一社会信用代码	91320581MA22L99A02
注册地址	江苏省苏州市常熟市碧溪街道兴港路 17-9 号
主要生产经营地	江苏省常熟市
法定代表人	陈锦魁
注册资本	12,000.00 万元
实收资本	12,000.00 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2020 年 9 月 30 日
股东构成及控制情况	一级子公司，锦艺新材持有其 100%的股权
经营范围	一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；生物化工产品技术研发；电池制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	作为发行人高性能球形硅微粉的生产平台

最近一年主要财务数据（单位：万元）				
时间	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
2025-12-31/ 2025 年度	40,913.67	10,995.18	2,841.78	-334.72

3、山东锦艺

公司名称	山东锦艺新材料有限公司
统一社会信用代码	913201045894411584
注册地址	山东省临沂市临沭县新型工业化实验区光电产业园 10 号、11 号
主要生产经营地	山东省临沂市临沭县
法定代表人	陈锦魁
注册资本	650.00 万元
实收资本	650.00 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2012 年 3 月 22 日

股东构成及控制情况	一级子公司，锦艺新材持有其 100%的股权
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务。
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	作为发行人导热散热功能材料等产品的生产平台

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	9,860.54	-526.01	5,172.44	-478.53

4、铭隆新材料

公司名称	苏州铭隆新材料有限公司
统一社会信用代码	91320581MA27L75G39
注册地址	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号
主要生产经营地	江苏省常熟市
法定代表人	陈锦魁
注册资本	200.00 万元
实收资本	200.00 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2022 年 8 月 22 日
股东构成及控制情况	一级子公司，锦艺新材持有其 100%的股权
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；石墨及碳素制品制造；资源再生利用技术研发
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	作为发行人硅基负极产品的研发、生产平台

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	2,824.06	-1,018.24	61.21	-601.91

5、锦艺半导体

公司名称	锦艺半导体材料（苏州）有限公司
统一社会信用代码	91320581MAELNB8T53
注册地址	江苏省苏州市常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号
主要生产经营地	江苏省常熟市

法定代表人	陈锦魁
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	700.00 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2025 年 5 月 22 日
股东构成及控制情况	一级子公司，锦艺新材持有其 70.00%的股权
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型有机活性材料销售；技术推广服务；表面功能材料销售
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	作为电子浆料产品的研发、生产平台

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	954.61	46.54	8.84	-283.46

6、临沂创实

公司名称	临沂创实新型材料有限公司
统一社会信用代码	913713293446420745
注册地址	山东省临沂市临沭县滨海高新技术产业园区 B-22 号楼（长深高速临沭出入口处路北）
主要生产经营地	山东省临沂市临沭县
法定代表人	黄勇峰
注册资本	500.00 万元
实收资本	500.00 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2015 年 6 月 23 日
股东构成及控制情况	二级子公司，锦艺新材通过山东锦艺持有其 100%的股权
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	曾作为导热散热功能材料等产品的生产平台，目前未开展新材料相关业务

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	3,957.27	816.63	1,502.25	-36.74

7、苏州锦禾

公司名称	苏州锦禾纳米材料有限公司
统一社会信用代码	91320581MA2769BQ72
注册地址	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号
主要生产经营地	江苏省常熟市
法定代表人	陈锦魁
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	1,000.00 万元
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021 年 10 月 8 日
股东构成及控制情况	二级子公司，锦艺新材通过山东锦艺持有其 100%的股权
经营范围	许可项目：餐饮服务。一般项目：新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	暂未开展新材料相关业务

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	1,072.73	898.39	530.38	-4.24

（二）发行人的参股公司

截至本招股说明书签署日，发行人有 1 家参股公司锦艺阿泰欧，具体情况如下：

公司名称	锦艺阿泰欧（苏州）锂电池材料科技有限公司
统一社会信用代码	91320581MA1YQEE095
注册地址	江苏省苏州市常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号 8213 房
主要生产经营地	江苏省常熟市
法定代表人	黄勇峰
注册资本	1,400.00 万元
实收资本	700.00 万元

公司类型	有限责任公司（中外合资）
成立时间	2019 年 7 月 17 日
经营范围	从事锂电池材料（不含危险化学品）的研发、销售、技术咨询、技术转让；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
股东构成及控制情况	锦艺新材持股 51%，Alteo Holding S.A.S 持股 49%，双方对锦艺阿泰欧形成共同控制
发行人入股时间	2019 年 7 月 17 日
主营业务情况、在发行人业务板块中定位	发行人与 Alteo Holding S.A.S 共同成立的合资公司，作为销售平台，将发行人生产加工的锂电池隔膜功能材料产品实现对外销售

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	5,222.84	1,476.00	10,052.17	155.36

注：参股公司财务数据已经江苏华星会计师事务所有限公司会计师审计。

八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东

截至本招股说明书签署之日，陈锦魁先生个人独资的广州锦族持有公司 45.18%的股权，为公司的控股股东。

公司名称	广州锦族新材料投资有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CJ7G362
注册地址	广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路 53 号二楼（部位 202）
主要生产经营地	广州市番禺区
法定代表人	陈锦魁
注册资本	6,500.00 万元
实收资本	6,500.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
成立时间	2018 年 10 月 24 日
经营范围	企业自有资金投资；项目投资，商品批发贸易；商品零售贸易
主营业务及其与发行人主营业务的关系	系发行人控股股东，未开展实质性经营，与发行人不存在同业竞争或上下游关系

最近一年主要财务数据（单位：万元）

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025-12-31/ 2025 年度	10,989.94	7,072.76	-	-8.95

注：本表所列财务数据为控股股东单体口径，已经容诚会计师审计。

2、实际控制人

截至本招股说明书签署之日，发行人的实际控制人为陈锦魁先生。陈锦魁个人独资的广州锦族持有发行人 45.1816%的股权，为公司控股股东。此外，陈锦魁通过发行人员工持股平台间接持有发行人 5.2676%股份，合计持有发行人 50.4493%的股份。

陈锦魁，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 350182197205******，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事”。

（二）其他直接持股 5%以上股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东广州锦族外，直接持有公司 5%以上股份的股东为平潭锦新、国投创业基金、杭州泽涵及君安嘉平。

1、平潭锦新

平潭锦新为公司员工持股平台，截至本招股说明书签署日，平潭锦新直接持有发行人 9,195,402 股，占发行人总股本的 5.50%，其基本情况如下：

公司名称	平潭锦新投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350128MA32C3TX29
执行事务合伙人	黄云余
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	2,000.00 万元
实缴出资额	2,000.00 万元
成立日期	2018 年 12 月 17 日
注册地	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1274
主要生产经营地	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1274
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）
主营业务	实业投资类业务
与发行人主营业务的关系	除持有发行人 5.50%股权外，无其他对外投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系

平潭锦新是发行人设立的员工持股平台，其合伙人除沈美红、谢斯璟为离职

员工外，其他人员均为公司在职员工，具体出资情况如下：

单位：万元、%

序号	合伙人姓名	类别	出资金额	出资比例
1	黄云余	普通合伙人	150.00	7.50
2	陈锦魁	有限合伙人	1,000.00	50.00
3	黄勇峰	有限合伙人	300.00	15.00
4	胡林政	有限合伙人	150.00	7.50
5	林野	有限合伙人	80.00	4.00
6	魏传祯	有限合伙人	75.00	3.75
7	陈林	有限合伙人	75.00	3.75
8	谢斯璟	有限合伙人	50.00	2.50
9	李杰	有限合伙人	25.00	1.25
10	王俊琪	有限合伙人	25.00	1.25
11	尤金蕾	有限合伙人	25.00	1.25
12	沈美红	有限合伙人	25.00	1.25
13	林智睿	有限合伙人	20.00	1.00
合计			**2,000.00**	**100.00**

2、国投创业基金

截至本招股说明书签署日，国投创业基金直接持有发行人 8,407,327 股，占发行人总股本的 5.03%，其基本情况如下：

公司名称	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330203MA2CL80401
执行事务合伙人	国投创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	200,000.00 万元
实缴出资额	200,000.00 万元
成立日期	2018 年 12 月 13 日
注册地	浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号（2-1-013）室
主要生产经营地	浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号（2-1-013）室
经营范围	创业投资、投资管理、创业投资管理、投资咨询（需经中国证券投资基金业协会登记）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目
主营业务	股权投资类业务

与发行人主营业务的关系	主营股权投资类业务，与发行人不存在同业竞争或上下游关系

国投创业基金具体出资情况如下：

单位：万元、%

序号	合伙人名称	类别	出资金额	出资比例
1	国投创业投资管理有限公司	普通合伙人	4,000.00	2.00
2	维科产业投资管理有限公司	普通合伙人	2,000.00	1.00
3	维科控股集团股份有限公司	有限合伙人	98,000.00	49.00
4	中国国投高新产业投资有限公司	有限合伙人	40,000.00	20.00
5	宁波市产业发展基金有限公司	有限合伙人	30,000.00	15.00
6	宁波工投睿丰投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	5.00
7	刘健	有限合伙人	10,000.00	5.00
8	宁波维欣企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,500.00	2.25
9	宁波瀚正企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,500.00	0.75
合计			**200,000.00**	**100.00**

3、杭州泽涵、君安嘉平

杭州泽涵、君安嘉平同为物产中大合并范围内控制主体，杭州泽涵、君安嘉平合计直接持有发行人 5%以上股权，具体情况如下：

序号	股东名称	共同控制方	持股数量（股）	持股比例
1	杭州泽涵	物产中大	7,724,959	4.6217%
	君安嘉平		1,253,588	0.7500%
	小计		**8,978,547**	**5.3717%**

注：发行人股东君安勇诚为双执行事务合伙人，其中执行事务合伙人之一物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司穿透后最终控制方为物产中大，执行事务合伙人之一宁波勇诚资产管理有限公司穿透后最终控制方为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会，截至本招股书签署之日，物产中大持有君安勇诚 12.75%合伙份额，物产中大通过杭州泽涵、君安嘉平及君安勇诚间接持有发行人 5%以上股权。

发行人直接股东杭州泽涵、君安嘉平基本情况如下：

（1）杭州泽涵

截至本招股说明书签署之日，杭州泽涵的基本信息如下：

企业名称	杭州泽涵股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330105MACCEHUT09

注册地和主要经营场所	浙江省杭州市拱墅区武林新村 104 号 1 幢二楼 2276 室
注册资本	50,000.00 万元
实收资本	30,275.00 万元（截至 2025 年 12 月 31 日）
执行事务合伙人	物产中大君泽（杭州）企业管理咨询有限公司
成立时间	2023 年 3 月 22 日
经营期限	2023 年 3 月 22 日至无固定期限
经营范围	一般项目：股权投资；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务	股权投资类业务
与发行人主营业务的关系	主营股权投资类业务，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，杭州泽涵的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	物产中大君泽（杭州）企业管理咨询有限公司	普通合伙人	100.00	0.20
2	物产中大集团投资有限公司	有限合伙人	49,900.00	99.80
合计			**50,000.00**	**100.00**

（2）君安嘉平

截至本招股说明书签署之日，君安嘉平的基本信息如下：

企业名称	君安嘉平（平湖）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330482MAE5JGXR55
注册地和主要经营场所	浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道花园大厦 22 楼 2202-9
注册资本	15,000.00 万元
实收资本	10,000.00 万元（截至 2025 年 12 月 31 日）
执行事务合伙人	嘉兴市嘉睿投资管理有限公司、物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司
成立时间	2024 年 11 月 21 日
经营期限	2024 年 11 月 21 日至 2034 年 11 月 20 日
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务	股权投资类业务
与发行人主营业务的关系	主营股权投资类业务，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，君安嘉平的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	嘉兴市嘉睿投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.67
2	物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.67
3	杭州泽沨股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,400.00	49.33
4	平湖经开创业投资有限公司	有限合伙人	4,500.00	30.00
5	嘉兴嘉国贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,900.00	19.33
合计			**15,000.00**	**100.00**

（三）发行人股份质押或其他权利争议

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他主要股东持有发行人的股份不存在质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况。

九、发行人特别表决权股份或类似安排情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

十、发行人协议控制情况

截至本招股说明书签署日，公司股东不存在通过协议控制公司的情况。

十一、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

截至本招股说明书签署日，公司总股本为 16,714.5075 万股，本次公司拟公开发行新股不超过 5,571.5025 万股，不低于本次公开发行后的总股本的 25%。本次发行前后公司股本结构如下：

序号	名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	广州锦族	7,551.89	45.1816	7,551.89	33.8862
2	平潭锦新	919.54	5.5014	919.54	4.1261
3	国投创业基金	840.73	5.0300	840.73	3.7725
4	远致华信	795.08	4.7568	795.08	3.5676

序号	名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
5	杭州泽涵	772.50	4.6217	772.50	3.4663
6	哈勃投资	742.07	4.4397	742.07	3.3298
7	穗合投资	689.66	4.1261	689.66	3.0946
8	平潭锦材	574.71	3.4384	574.71	2.5788
9	晨道投资	342.87	2.0513	342.87	1.5385
10	哇牛制享	338.63	2.0260	338.63	1.5195
11	星火投资	272.39	1.6296	272.39	1.2222
12	尚融投资	250.72	1.5000	250.72	1.1250
13	君安勇诚	250.72	1.5000	250.72	1.1250
14	百瑞信托	229.89	1.3754	229.89	1.0315
15	华泰渝富	204.39	1.2228	204.39	0.9171
16	嘉兴萃英	181.47	1.0857	181.47	0.8143
17	常熟经开	152.39	0.9117	152.39	0.6838
18	君安嘉平	125.36	0.7500	125.36	0.5625
19	宁波甬诚	125.36	0.7500	125.36	0.5625
20	华泰产发	122.82	0.7348	122.82	0.5511
21	苏州创投	121.56	0.7273	121.56	0.5455
22	欣亿源	114.94	0.6877	114.94	0.5158
23	广发信德	107.93	0.6457	107.93	0.4843
24	常熟创投	101.30	0.6061	101.30	0.4545
25	福州创科	82.05	0.4909	82.05	0.3682
26	合肥经韬	81.48	0.4875	81.48	0.3656
27	东方富海三号	75.98	0.4545	75.98	0.3409
28	厦门经韬	63.67	0.3810	63.67	0.2857
29	嘉兴经韬	60.78	0.3636	60.78	0.2727
30	苏州致兴	60.78	0.3636	60.78	0.2727
31	苏州致盛	60.78	0.3636	60.78	0.2727
32	福建创盈	54.70	0.3273	54.70	0.2455
33	尚融聚鑫	54.05	0.3234	54.05	0.2425
34	苏州卓璞	45.59	0.2727	45.59	0.2045
35	超兴创投	38.10	0.2279	38.10	0.1709

序号	名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
36	共青城智晟	30.39	0.1818	30.39	0.1364
37	信福汇十二号	24.16	0.1446	24.16	0.1084
38	苏州时点	22.99	0.1375	22.99	0.1032
39	成都建鑫	21.99	0.1316	21.99	0.0987
40	信福汇四号	7.35	0.0440	7.35	0.0330
41	南京厚盈	0.80	0.0048	0.80	0.0036
42	社会公众股	-	-	5,571.50	25.0000
合计		**16,714.51**	**100.00**	**22,286.01**	**100.00**

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	广州锦族	75,518,850	45.1816%
2	平潭锦新	9,195,402	5.5014%
3	国投创业基金	8,407,327	5.0300%
4	远致华信	7,950,754	4.7568%
5	杭州泽涵	7,724,959	4.6217%
6	哈勃投资	7,420,690	4.4397%
7	穗合投资	6,896,552	4.1261%
8	平潭锦材	5,747,127	3.4384%
9	晨道投资	3,428,664	2.0513%
10	哇牛制享	3,386,284	2.0260%
合计		**135,676,609**	**81.1730%**

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，本次发行前的前十名股东中不存在自然人股东。

（四）国有股份和外资股份情况

截至本招股说明书签署日，百瑞信托持有公司 2,298,851 股，占公司总股本的 1.37536%，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第 36 号）相关规定，其在中国证券登记结算公司设立的证券账户应标注国有股

东标识（SS）。百瑞信托系已上市公司郑州银行（002936.SZ）股东，根据百瑞信托出具的说明，中国证券登记结算有限责任公司已将百瑞信托证券账户标注为“SS”。除前述股东外，截至本招股说明书签署日，发行人股本中无其他国有股份或外资股份。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据

截至本招股说明书签署日，通过老股转让的方式，公司首次申报前十二个月共新增杭州泽涵等 24 名股东，具体情况如下：

1、首次申报前十二月新增股东的入股原因、入股价格及定价依据

新增股东名称	受让数量（万股）	股权转让方	转让价格（元/股）	定价依据	入股原因
杭州泽涵	489.41	陈锦魁	23.93	综合考虑发行人的历史财务表现及公司所处行业、经营业绩、成长性等因素，协商定价	新股东看好公司发展前景及未来增值价值
华泰渝富	204.39				
华泰产发	122.82				
南京厚盈	0.80				
君安嘉平	125.36				
君安勇诚	250.72				
宁波甬诚	125.36				
合肥经韬	81.48				
厦门经韬	63.67				
杭州泽涵	206.90	哇牛智新	20.94		
杭州泽涵	76.19	杭州新同			
广发信德	103.40	远致华信	22.74		
成都建鑫	21.07				
广发信德	3.47	信福汇十二号			
成都建鑫	0.71				
广发信德	1.06	信福汇四号			
成都建鑫	0.22				
尚融投资	250.72	中电科研投基金、扬州乾益	26.32		
尚融聚鑫	54.05				
常熟创投	101.30	郑州锦谋	29.62		
嘉兴萃英	181.47		32.91		

新增股东名称	受让数量（万股）	股权转让方	转让价格（元/股）	定价依据	入股原因
苏州创投	121.56				
福州创科	82.05				
东方富海三号	75.98				
嘉兴经韬	60.78				
苏州致兴	60.78				
苏州致盛	60.78				
福建创盈	54.70				
苏州卓璞	45.59				
共青城智晟	30.39				

2、首次申报前十二个月新增股东的基本信息

截至本招股说明书签署日，公司首次申报前十二个月新增股东的基本情况如下：

（1）杭州泽涵

截至本招股说明书签署之日，杭州泽涵的基本信息参见本招股说明书本节之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（二）其他直接持股 5%以上股东的基本情况”之“3、杭州泽涵、君安嘉平”。

（2）尚融投资

截至本招股说明书签署之日，尚融投资的基本信息如下：

企业名称	尚融（宁波）投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	913302063405969555
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0003
注册资本	101,500.00 万元
执行事务合伙人	尚融资本管理有限公司
成立时间	2015 年 9 月 7 日
经营期限	2015 年 9 月 7 日至 2035 年 9 月 6 日
经营范围	股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，尚融投资的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	尚融资本管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.99
2	宁波禾元控股有限公司	有限合伙人	84,500.00	83.25
3	上海柯元贸易有限公司	有限合伙人	7,500.00	7.39
4	裕隆控股集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.93
5	郑瑞华	有限合伙人	2,000.00	1.97
6	海南融慧投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,500.00	1.48
合计			**101,500.00**	**100.00**

（3）君安勇诚

截至本招股说明书签署之日，君安勇诚的基本信息如下：

企业名称	君安勇诚（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330110MAEN6F728Q
主要经营场所	浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-8-34
注册资本	30,200.00 万元
执行事务合伙人	宁波勇诚资产管理有限公司、物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司
成立时间	2025 年 6 月 23 日
经营期限	2025 年 6 月 23 日至 2035 年 6 月 22 日
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，君安勇诚的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.33
2	宁波勇诚资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.33
3	浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000.00	49.67
4	宁波城投赋甬股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000.00	49.67
合计			**30,200.00**	**100.00**

（4）华泰渝富

截至本招股说明书签署之日，华泰渝富的基本信息如下：

企业名称	重庆华泰渝富并购私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91500107MAC5MPFL98
主要经营场所	重庆市高新区金凤镇凤笙路 21 号 1 幢
注册资本	100,300.00 万元
执行事务合伙人	华泰紫金投资有限责任公司
成立时间	2022 年 12 月 15 日
经营期限	2022 年 12 月 15 日至无固定期限
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至本招股说明书签署日，华泰渝富的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	华泰紫金投资有限责任公司	普通合伙人	20,000.00	19.94
2	重庆渝富控股集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	39.88
3	重庆渝富资本运营集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	19.94
4	成渝地区双城经济圈发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	19.94
5	徐志枢	有限合伙人	200.00	0.20
6	中新互联互通投资基金管理有限公司	有限合伙人	100.00	0.10
合计			**100,300.00**	**100.00**

（5）君安嘉平

截至本招股说明书签署之日，君安嘉平的基本信息参见本招股说明书本节之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（二）其他直接持股 5%以上股东的基本情况”之“3、杭州泽涵、君安嘉平”。

（6）宁波甬诚

截至本招股说明书签署之日，宁波甬诚的基本信息如下：

企业名称	宁波前湾新区甬诚创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330201MADNMB0X1C
主要经营场所	浙江省宁波前湾新区滨海四路 316 号 1 号楼 A163
注册资本	20,000.00 万元
执行事务合伙人	宁波兴湾启新股权投资有限公司、宁波勇诚资产管理有限公司

成立时间	2024 年 7 月 3 日
经营期限	2024 年 7 月 3 日至 2031 年 7 月 2 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，宁波甬诚的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	宁波兴湾启新股权投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.500
2	宁波勇诚资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.500
3	宁波甬前股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,900.00	49.500
4	宁波城投赋甬股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,880.00	49.400
5	褚慧宁	有限合伙人	10.00	0.050
6	王滨	有限合伙人	6.00	0.030
7	梁相炳	有限合伙人	2.00	0.010
8	宋子豪	有限合伙人	1.00	0.005
9	吕诗奇	有限合伙人	1.00	0.005
合计			**20,000.00**	**100.000**

（7）华泰产发

截至本招股说明书签署之日，华泰产发的基本信息如下：

企业名称	宿迁华泰产发科技股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91321391MAD2BRPJ0D
主要经营场所	宿迁经济技术开发区发展大道 889 号白酒检测中心 10 楼 1002 室
注册资本	50,000.00 万元
执行事务合伙人	华泰紫金投资有限责任公司
成立时间	2023 年 10 月 16 日
经营期限	2023 年 10 月 16 日至永久
经营范围	一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，华泰产发的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	华泰紫金投资有限责任公司	普通合伙人	100.00	0.20
2	宿迁产发科技股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	24,900.00	49.80
3	江苏洋河投资管理有限公司	有限合伙人	12,500.00	25.00
4	南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）	有限合伙人	12,400.00	24.80
5	宿迁产发创业投资有限公司	有限合伙人	100.00	0.20
合计			**50,000.00**	**100.00**

（8）广发信德

截至本招股说明书签署之日，广发信德的基本信息如下：

企业名称	东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91441900MAC59KEF9X
主要经营场所	广东省东莞市凤岗镇三联政通路 1 号 1 号楼 202 室
注册资本	30,000.00 万元
执行事务合伙人	广发信德投资管理有限公司
成立时间	2022 年 12 月 16 日
经营期限	2022 年 12 月 16 日至无固定期限
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，广发信德的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	广发信德投资管理有限公司	普通合伙人	6,000.00	20.00
2	广发乾和投资有限公司	有限合伙人	8,000.00	26.67
3	东莞市产业投资母基金有限公司	有限合伙人	6,000.00	20.00
4	深圳市瑞创未来投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	10.00
5	东莞市凤岗起航投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	10.00
6	东莞汇景塑胶制品有限公司	有限合伙人	2,000.00	6.67
7	广东东箭汇盈投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.33
8	东莞景丰塑胶制品有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.33
合计			**30,000.00**	**100.00**

（9）合肥经韬

截至本招股说明书签署之日，合肥经韬的基本信息如下：

企业名称	合肥经韬睿诚智造创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MADQDJ1E8J
主要经营场所	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科技园 F8 栋 1146 室
注册资本	18,000.00 万元
执行事务合伙人	北京经韬私募基金管理有限公司
成立时间	2024 年 7 月 24 日
经营期限	2024 年 7 月 24 日至 2034 年 5 月 10 日
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本招股说明书签署日，合肥经韬的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	北京经韬私募基金管理有限公司	普通合伙人	30.00	0.17
2	厦门自贸领航接力股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	16.67
3	上海达朗聚新材料有限公司	有限合伙人	3,000.00	16.67
4	嘉兴经韬国器创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,500.00	13.89
5	熊健	有限合伙人	800.00	4.44
6	姜洪峰	有限合伙人	800.00	4.44
7	彭伟铭	有限合伙人	700.00	3.89
8	王澎	有限合伙人	600.00	3.33
9	池正杰	有限合伙人	550.00	3.06
10	汪琦华	有限合伙人	500.00	2.78
11	朱自融	有限合伙人	500.00	2.78
12	郑美娇	有限合伙人	500.00	2.78
13	常州市经韬启远创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	2.78
14	吴才兴	有限合伙人	300.00	1.67
15	陆丽红	有限合伙人	300.00	1.67
16	蒋莉萍	有限合伙人	300.00	1.67
17	武晓华	有限合伙人	300.00	1.67

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
18	赵先锋	有限合伙人	300.00	1.67
19	姜闰	有限合伙人	300.00	1.67
20	马鹏飞	有限合伙人	300.00	1.67
21	余菲	有限合伙人	270.00	1.50
22	陈文霞	有限合伙人	250.00	1.39
23	卢珊	有限合伙人	200.00	1.11
24	祝秋萍	有限合伙人	200.00	1.11
25	刘海洋	有限合伙人	150.00	0.83
26	苏显峰	有限合伙人	150.00	0.83
27	黄雪梅	有限合伙人	100.00	0.56
28	张逸尧	有限合伙人	100.00	0.56
29	俞思远	有限合伙人	100.00	0.56
30	葛小芽	有限合伙人	100.00	0.56
31	王泽国	有限合伙人	100.00	0.56
32	王科艺	有限合伙人	100.00	0.56
33	上海桢昱管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100.00	0.56
合计			**18,000.00**	**100.00**

（10）厦门经韬

截至本招股说明书签署之日，厦门经韬的基本信息如下：

企业名称	厦门经韬睿诚二期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MAEWWMXW8A
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
注册资本	13,000.00 万元
执行事务合伙人	北京经韬私募基金管理有限公司
成立时间	2025 年 9 月 15 日
经营期限	2025 年 9 月 15 日至 2075 年 9 月 14 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至本招股说明书签署日，厦门经韬的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	合伙份额比例（%）
1	北京经韬私募基金管理有限公司	普通合伙人	600.00	4.62
2	付云峰	有限合伙人	1,000.00	7.69
3	王竞贤	有限合伙人	800.00	6.15
4	陈丽雪	有限合伙人	600.00	4.62
5	曾江	有限合伙人	500.00	3.85
6	曹兆华	有限合伙人	500.00	3.85
7	卢珊	有限合伙人	500.00	3.85
8	姜洪峰	有限合伙人	500.00	3.85
9	彭海燕	有限合伙人	500.00	3.85
10	尹剑平	有限合伙人	500.00	3.85
11	常州市经韬启远创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	3.85
12	苏显峰	有限合伙人	300.00	2.31
13	张逸尧	有限合伙人	300.00	2.31
14	熊健	有限合伙人	300.00	2.31
15	王澎	有限合伙人	300.00	2.31
16	刘海洋	有限合伙人	300.00	2.31
17	陆丽红	有限合伙人	300.00	2.31
18	常州得实新技术开发有限公司	有限合伙人	300.00	2.31
19	张波涛	有限合伙人	200.00	1.54
20	祝秋萍	有限合伙人	200.00	1.54
21	宋琬若	有限合伙人	200.00	1.54
22	商早女	有限合伙人	200.00	1.54
23	武晓华	有限合伙人	200.00	1.54
24	姜闰	有限合伙人	200.00	1.54
25	高晓莉	有限合伙人	200.00	1.54
26	庄金庆	有限合伙人	200.00	1.54
27	陈进平	有限合伙人	200.00	1.54
28	徐邦蓉	有限合伙人	200.00	1.54
29	吴才兴	有限合伙人	200.00	1.54
30	言骅	有限合伙人	200.00	1.54

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	合伙份额比例（%）
31	舒涛	有限合伙人	200.00	1.54
32	李潇楠	有限合伙人	150.00	1.15
33	钟全亮	有限合伙人	150.00	1.15
34	汪琦华	有限合伙人	100.00	0.77
35	周峰	有限合伙人	100.00	0.77
36	周晓鸣	有限合伙人	100.00	0.77
37	王芳	有限合伙人	100.00	0.77
38	马莉	有限合伙人	100.00	0.77
39	赵先锋	有限合伙人	100.00	0.77
40	何浩	有限合伙人	100.00	0.77
41	沈小蕙	有限合伙人	100.00	0.77
42	齐皓	有限合伙人	100.00	0.77
43	张钰琪	有限合伙人	100.00	0.77
44	李骏	有限合伙人	100.00	0.77
45	黄宝守	有限合伙人	100.00	0.77
46	严黄红	有限合伙人	100.00	0.77
47	刘方	有限合伙人	100.00	0.77
48	海南华颖私募基金管理有限公司	有限合伙人	100.00	0.77
合计			**13,000.00**	**100.00**

（11）尚融聚鑫

截至本招股说明书签署之日，尚融聚鑫的基本信息如下：

企业名称	尚融聚鑫（宁波）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA2J3KT11B
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 F0418
注册资本	34,340.00 万元
执行事务合伙人	尚融资本管理有限公司
成立时间	2020 年 11 月 30 日
经营期限	2020 年 11 月 30 日至 2030 年 11 月 29 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署日，尚融聚鑫的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	尚融资本管理有限公司	普通合伙人	340.00	0.99
2	王美琴	有限合伙人	17,000.00	49.51
3	王福元	有限合伙人	17,000.00	49.51
合计			**34,340.00**	**100.00**

（12）成都建鑫

截至本招股说明书签署之日，成都建鑫的基本信息如下：

企业名称	成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MADEABMJ36
主要经营场所	成都东部新区养马街道石养路 2 号 13 栋（属简州新城范围内）
注册资本	30,000.00 万元
执行事务合伙人	建信（北京）投资基金管理有限责任公司
成立时间	2024 年 3 月 29 日
经营期限	2024 年 3 月 29 日至 2034 年 3 月 28 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，成都建鑫的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	普通合伙人	100.00	0.33
2	芜湖建享一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,900.00	39.67
3	成都简投企业管理咨询有限公司	有限合伙人	9,000.00	30.00
4	成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,000.00	30.00
合计			**30,000.00**	**100.00**

（13）南京厚盈

截至本招股说明书签署之日，南京厚盈的基本信息如下：

企业名称	南京厚盈科技投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91320106MADA99HQ4M
主要经营场所	江苏省南京市鼓楼区广州路 213 号 2-007 室
注册资本	230.00 万元
执行事务合伙人	贾红刚
成立时间	2024 年 2 月 7 日
经营期限	2024 年 2 月 7 日至无固定期限
经营范围	一般项目：股权投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，南京厚盈的出资人构成及其出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	合伙份额比例（%）
1	贾红刚	普通合伙人	60.00	26.09
2	殷晨昊	有限合伙人	40.00	17.39
3	陈淼	有限合伙人	10.00	4.35
4	陆殷华	有限合伙人	10.00	4.35
5	赵耿龙	有限合伙人	10.00	4.35
6	石丽	有限合伙人	10.00	4.35
7	殷晓磊	有限合伙人	10.00	4.35
8	樊欣	有限合伙人	10.00	4.35
9	李晓童	有限合伙人	10.00	4.35
10	曹群	有限合伙人	10.00	4.35
11	方略	有限合伙人	10.00	4.35
12	张琛	有限合伙人	10.00	4.35
13	崔亮	有限合伙人	10.00	4.35
14	周毓	有限合伙人	10.00	4.35
15	周亦然	有限合伙人	10.00	4.35
合计			**230.00**	**100.00**

（14）常熟创投

截至本招股说明书签署之日，常熟创投的基本信息如下：

企业名称	常熟市常创人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320581MAEWNX0C5X
主要经营场所	常熟市东南街道黄浦江路 280 号

注册资本	30,000.00 万元
执行事务合伙人	常熟市国发创业投资有限公司
成立时间	2025 年 9 月 17 日
经营期限	2025 年 9 月 17 日至 2037 年 9 月 17 日
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，常熟创投的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	苏州人才壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,000.00	40.00
2	常熟市吴越产业投资集团有限公司	有限合伙人	9,500.00	31.67
3	常熟开赢投资控股有限公司	有限合伙人	1,500.00	5.00
4	苏辛（常熟）科技产业发展有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.33
5	常熟大科园昆晟创业投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.33
6	常熟东南股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	3.33
7	常熟市海腾发展投资有限公司	有限合伙人	600.00	2.00
8	常熟市梅李科技创业企业管理服务有限公司	有限合伙人	600.00	2.00
9	常熟市鸿仪投资有限公司	有限合伙人	500.00	1.67
10	常熟市新董建设有限公司	有限合伙人	500.00	1.67
11	常熟市支晟资产经营管理有限公司	有限合伙人	500.00	1.67
12	常熟市尚湖科技创业发展有限公司	有限合伙人	500.00	1.67
13	常熟市东晟嘉和城镇建设有限公司	有限合伙人	500.00	1.67
14	常熟市国发创业投资有限公司	普通合伙人	300.00	1.00
合计			**30,000.00**	**100.00**

（15）福建创盈

截至本招股说明书签署之日，福建创盈的基本信息如下：

企业名称	福建创新创盈投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350427MA8UJW7B4L
主要经营场所	福建省三明市沙县区虬江街道迎宾大道 9 号三明中关村科技园创新中心雨林空间 V07a
注册资本	50,000.00 万元
执行事务合伙人	福建省创新创业投资管理有限公司
成立时间	2022 年 1 月 29 日

经营期限	2022 年 1 月 29 日至 2029 年 1 月 28 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，福建创盈的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	福建省投资开发集团有限责任公司	有限合伙人	49,990.00	99.98
2	福建省创新创业投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.02
合计			**50,000.00**	**100.00**

（16）福州创科

截至本招股说明书签署之日，福州创科的基本信息如下：

企业名称	福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350182MA8RTUDJ4L
主要经营场所	福州市长乐区文武砂街道壶江路 2 号中国东南大数据产业园二期 2 号楼
注册资本	100,000.00 万元
执行事务合伙人	福建省创新创业投资管理有限公司
成立时间	2021 年 3 月 31 日
经营期限	2021 年 3 月 31 日至 2028 年 3 月 30 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，福州创科的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	福建省投资开发集团有限责任公司	有限合伙人	99,990.00	99.99
2	福建省创新创业投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.01
合计			**100,000.00**	**100.00**

（17）嘉兴萃英

截至本招股说明书签署之日，嘉兴萃英的基本信息如下：

企业名称	嘉兴青蒿萃英沛泓股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MAK3RDRJ6Q
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 221 室-82

注册资本	10,030.00 万元
执行事务合伙人	嘉兴青蒿投资有限公司
成立时间	2026 年 1 月 6 日
经营期限	2026 年 1 月 6 日至无固定期限
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署日，嘉兴萃英的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	嘉兴青蒿投资有限公司	普通合伙人	1.00	0.01
2	徐云虹	有限合伙人	212.00	2.11
3	金宇星	有限合伙人	318.00	3.17
4	贾灵	有限合伙人	318.00	3.17
5	丁敏	有限合伙人	318.00	3.17
6	谢牧夫	有限合伙人	318.00	3.17
7	赵宏智	有限合伙人	318.00	3.17
8	姜润泽	有限合伙人	318.00	3.17
9	张牧	有限合伙人	365.00	3.64
10	湖南高新创业投资管理有限公司	有限合伙人	500.00	4.99
11	湖南高新纵横资产经营有限公司	有限合伙人	500.00	4.99
12	谢润清	有限合伙人	530.00	5.28
13	深圳糯瑞科技有限公司	有限合伙人	530.00	5.28
14	欧阳坚	有限合伙人	742.00	7.40
15	陆浩东	有限合伙人	742.00	7.40
16	阳泉高新投资集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	9.97
17	湖南银城发展二期股权投资合伙企业	有限合伙人	1,000.00	9.97
18	湖南高创鑫阳创业投资基金合伙企业	有限合伙人	2,000.00	19.94
合计			**10,030.00**	**100.00**

（18）嘉兴经韬

截至本招股说明书签署之日，嘉兴经韬的基本信息如下：

企业名称	嘉兴经韬睿诚锦辉创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91330402MAK6G7N36Y
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼222室-69
注册资本	13,000.00万元
执行事务合伙人	北京经韬私募基金管理有限公司
成立时间	2026年2月5日
经营期限	2026年2月5日至无固定期限
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署日，嘉兴经韬的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	有限合伙人	4,000.00	30.77
2	付云峰	有限合伙人	3,000.00	23.08
3	张钰琪	有限合伙人	2,000.00	15.38
4	北京经韬私募基金管理有限公司	普通合伙人	1,500.00	11.54
5	江苏天辰智控科技有限公司	有限合伙人	1,000.00	7.69
6	海南华颖私募基金管理有限公司	有限合伙人	500.00	3.85
7	姜洪峰	有限合伙人	500.00	3.85
8	卢珊	有限合伙人	500.00	3.85
合计			**13,000.00**	**100.00**

（19）东方富海三号

截至本招股说明书签署之日，东方富海三号的基本信息如下：

企业名称	东方富海精选三号（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320505MAK48X3U51
主要经营场所	苏州高新区华陀路99号金融谷商务中心11幢
注册资本	52,500.00万元
执行事务合伙人	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：陈玮）
成立时间	2025年12月18日
经营期限	2025年12月18日至2035年12月18日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，东方富海三号的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	1,000.00	1.90
2	常德开源产业投资基金有限公司	有限合伙人	10,000.00	19.05
3	湖南财鑫资本管理有限公司	有限合伙人	9,000.00	17.14
4	湖南津城投资发展建设集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	3.81
5	津市嘉山产业发展投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	1.90
6	深圳市利为资本投资有限公司	有限合伙人	500.00	0.95
7	深圳正寅投资有限公司	有限合伙人	500.00	0.95
8	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	19,000.00	36.19
9	刘世生	有限合伙人	500.00	0.95
10	任浩	有限合伙人	3,000.00	5.71
11	彭子青	有限合伙人	1,000.00	1.90
12	蒋卫东	有限合伙人	1,000.00	1.90
13	王君艳	有限合伙人	1,000.00	1.90
14	李书锋	有限合伙人	500.00	0.95
15	黄珊珊	有限合伙人	500.00	0.95
16	郑玉萍	有限合伙人	500.00	0.95
17	陈泉君	有限合伙人	500.00	0.95
18	李树辉	有限合伙人	500.00	0.95
19	石雷	有限合伙人	500.00	0.95
合计			**52,500.00**	**100.00**

（20）共青城智晟

截至本招股说明书签署之日，共青城智晟的基本信息如下：

企业名称	共青城行远智晟创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MAC3A1EH7X
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
注册资本	5,000.00 万元
执行事务合伙人	上海易津创业投资管理有限公司（委派代表：陈安金）
成立时间	2022 年 10 月 18 日

经营期限	2022 年 10 月 18 日至 2032 年 10 月 17 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，共青城智晟的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	上海易津创业投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.02
2	上海博玺电气股份有限公司	有限合伙人	1,801.00	36.02
3	博雷顿科技股份公司（01333.HK）	有限合伙人	1,098.00	21.96
4	张晓晖	有限合伙人	800.00	16.00
5	上海达朗聚新材料有限公司	有限合伙人	800.00	16.00
6	陈耀民	有限合伙人	500.00	10.00
合计			**5,000.00**	**100.00**

（21）苏州创投

截至本招股说明书签署之日，苏州创投的基本信息如下：

企业名称	苏州苏创新能源投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320581MAD2R46A0P
主要经营场所	常熟经济技术开发区通港路 88 号七层
注册资本	100,000.00 万元
执行事务合伙人	苏州国发创业投资控股有限公司（委派代表：陈越）、常熟市国发创业投资有限公司（委派代表：陈越）
成立时间	2023 年 10 月 17 日
经营期限	2023 年 10 月 17 日至无固定期限
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，苏州创投的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	苏州创新投资集团有限公司	有限合伙人	49,800.00	49.80
2	常熟市吴越产业投资集团有限公司	有限合伙人	37,300.00	37.30
3	常熟经开聚源旭航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,500.00	12.50
4	苏州国发创业投资控股有限公司	普通合伙人	200.00	0.20

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
5	常熟市国发创业投资有限公司	普通合伙人	200.00	0.20
合计			**100,000.00**	**100.00**

（22）苏州致兴

截至本招股说明书签署之日，苏州致兴的基本信息如下：

企业名称	苏州产投致兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320505MAK4WPC81K
主要经营场所	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 5 幢
注册资本	1,010,000.00 万元
执行事务合伙人	苏州产业投资私募基金管理有限公司（委派代表：薛苏明）、工银资本管理有限公司（委派代表：刘韬）
成立时间	2025 年 12 月 31 日
经营期限	2025 年 12 月 31 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，苏州致兴的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	江苏社保科创股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000,000.00	99.01
2	苏州产业投资私募基金管理有限公司	普通合伙人	7,000.00	0.69
3	工银资本管理有限公司	普通合伙人	3,000.00	0.30
合计			**1,010,000.00**	**100.00**

（23）苏州致盛

截至本招股说明书签署之日，苏州致盛的基本信息如下：

企业名称	苏州产投致盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320581MAK5FMC9XW
主要经营场所	江苏省苏州市常熟市东南街道状元堤 8 号 1 幢 307
注册资本	1,010,000.00 万元
执行事务合伙人	苏州产业投资私募基金管理有限公司（委派代表：薛苏明）、工银资本管理有限公司（委派代表：刘韬）

成立时间	2025 年 12 月 31 日
经营期限	2025 年 12 月 31 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，苏州致盛的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	江苏社保科创股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000,000.00	99.01
2	苏州产业投资私募基金管理有限公司	普通合伙人	7,000.00	0.69
3	工银资本管理有限公司	普通合伙人	3,000.00	0.30
合计			**1,010,000.00**	**100.00**

（24）苏州卓璞

截至本招股说明书签署之日，苏州卓璞的基本信息如下：

企业名称	苏州卓璞永赢创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320508MA27GPA30W
主要经营场所	苏州卓璞永赢创业投资合伙企业（有限合伙）
注册资本	16,000.00 万元
执行事务合伙人	苏州卓璞投资基金管理有限公司（委托代表：邹杨）
成立时间	2021 年 11 月 26 日
经营期限	2021 年 11 月 26 日至 2031 年 11 月 21 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，苏州卓璞的出资人构成及其出资比例如下：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资份额比例（%）
1	苏州资产管理有限公司	有限合伙人	9,900.00	61.88
2	苏州苏润投资发展有限公司	有限合伙人	6,000.00	37.50
3	苏州卓璞投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.63
合计			**16,000.00**	**100.00**

3、首次申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关联关系

截至本招股说明书签署日，发行人首次申报前十二个月新增股东与其他股东之间的关联关系参见本招股说明书本节之“（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例”。

发行人首次申报前十二个月新增股东与发行人董事、监事（取消监事会前）、高级管理人员及本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

4、首次申报前十二个月新增股东存在的股份代持情形

公司首次申报前十二个月新增股东获取发行人股份的资金来源均系其自有资金，新增股东所持发行人股份不存在股份代持情形。

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系，以及关联股东的各自持股比例如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例	关联关系及一致行动关系
1	广州锦族	75,518,850	45.1816%	控股股东广州锦族系实际控制人陈锦魁个人独资企业，陈锦魁分别在员工持股平台平潭锦新、平潭锦材持有 50.00%和 73.20%财产份额
	平潭锦新	9,195,402	5.5014%	
	平潭锦材	5,747,127	3.4384%	
2	远致华信	7,950,754	4.7568%	信福汇四号、信福汇十二号拥有同一执行事务合伙人深圳市信福汇投资有限公司；信福汇四号、信福汇十二号系远致华信的跟投平台
	信福汇四号	73,465	0.0440%	
	信福汇十二号	241,626	0.1446%	
3	哇牛制享	3,386,284	2.0260%	哇牛制享执行事务合伙人为苏州工业园区哇牛投资有限公司，苏州工业园区哇牛投资有限公司法人、董事长、总经理系潘异，潘佼系苏州时点的实际控制人，潘异与潘佼系兄妹关系
	苏州时点	229,885	0.1375%	
4	杭州泽涵	7,724,959	4.6217%	杭州泽涵为物产中大全资的合伙企业，君安勇诚、君安嘉平拥有同一执行事务合伙人物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司为物产中大全资子公司；
	君安勇诚	2,507,176	1.5000%	
	君安嘉平	1,253,588	0.7500%	

序号	名称	持股数量（股）	持股比例	关联关系及一致行动关系
	宁波甬诚	1,253,588	0.7500%	物产中大同时控制杭州泽涵、君安嘉平并间接持有君安勇诚 12.75%合伙份额；宁波甬诚、君安勇诚另拥有同一执行事务合伙人宁波勇诚资产管理有限公司及同一有限合伙人宁波城投赋甬股权投资合伙企业（有限合伙）。
5	尚融投资	2,507,176	1.5000%	尚融投资、尚融聚鑫拥有同一执行事务合伙人尚融资本管理有限公司
	尚融聚鑫	540,525	0.3234%	
6	华泰渝富	2,043,850	1.2228%	华泰渝富、华泰产发拥有同一执行事务合伙人华泰紫金投资有限责任公司，南京厚盈系华泰渝富、华泰产发跟投平台
	华泰产发	1,228,155	0.7348%	
	南京厚盈	7,995	0.0048%	
7	合肥经韬	814,833	0.4875%	合肥经韬、厦门经韬、嘉兴经韬拥有同一执行事务合伙人北京经韬私募基金管理有限公司
	厦门经韬	636,747	0.3810%	
	嘉兴经韬	607,801	0.3636%	
8	福州创科	820,532	0.4909%	福州创科、福建创盈拥有同一执行事务合伙人福建省创新创业投资管理有限公司，且有限合伙人均为福建省投资开发集团有限责任公司
	福建创盈	547,021	0.3273%	
9	苏州致兴	607,801	0.3636%	苏州致兴、苏州创投均拥有相同执行事务合伙人苏州产业投资私募基金管理有限公司、工银资本管理有限公司，且有限合伙人均为江苏社保科创股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）
	苏州致盛	607,801	0.3636%	
10	苏州创投	1,215,602	0.7273%	苏州创投、常熟创投拥有同一执行事务合伙人常熟市国发创业投资有限公司，并拥有同一有限合伙人常熟市吴越产业投资集团有限公司
	常熟创投	1,013,000	0.6061%	

（七）公开发售股份对公司的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行不涉及原有股东的公开发售股份，对发行人的控制权、治理结构及生产经营不会产生影响。

（八）对赌协议或其他特殊权利条款及其解除情况

1、对赌或其他特殊权利安排条款情况

2026 年 2 月 6 日，股份公司第一次股权转让后的各方股东签订了《关于苏州锦艺新材料科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），已取代此前关于各方股东权利义务分配所达成的任何协议、投资意向书、谅解备忘录、陈述或其他义务中的相关内容，且《股东协议》（包括其修改协议或修正，

以及未来可能签署的其他交易文件）包含了各方就协议项下事项的唯一和全部协议。《股东协议》约定了回购权、新增注册资本的优先认缴权、反稀释、优先购买权、股份变动知情权等特殊权利。股份公司股份返还及第二次股权转让新加入的股东不存在特殊权利安排。

2、其他特殊权利安排条款协议的解除情况

前述《股东协议》约定：自公司向经投资方认可的上海证券交易所、深圳证券交易所或北京证券交易所递交合格的首次公开发行股票并上市的申报材料的前一日起终止，相应条款对各方不再具有约束力。

3、恢复条款

根据《股东协议》，若公司在 2026 年 12 月 31 日之前未完成向投资方认可的上海证券交易所、深圳证券交易所或北京证券交易所提交合格上市申请并被受理，或公司在 2026 年 12 月 31 日之前完成向上海证券交易所、深圳证券交易所或北京证券交易所提交合格上市申请并被受理，但在 2028 年 12 月 31 日之前因任何原因未完成合格上市，则相应特殊权利自上市申请未获批准之日或公司撤回申请材料之日自动恢复效力。

4、发行人对赌协议或其他特殊权利条款可能存在的影响

根据《股东协议》，前述回购权不涉及业绩对赌的约定，且股东的特殊权利条款自公司提交首次公开发行并上市申报材料前一日全部终止履行。满足相关条件可自动恢复的特殊权利条款中，执行义务人不涉及发行人，不存在可能导致公司控制权变化的约定，不与市值挂钩，不涉及发行人的具体经营活动，且不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的相关要求。

（九）私募投资基金等金融产品持有发行人股份情况及金融产品纳入监管情况

1、“三类股东”持股的情形

截至本招股说明书签署日，公司直接股东中不存在三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）。

2、发行人私募基金备案与管理人登记情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 41 名机构股东，其中 29 名机构股东已完成私募基金备案，具体情况如下：

序号	名称	基金编号	备案日期	管理人	管理人登记日期	管理人编号
1	国投创业基金	SGG209	2019 年 4 月 25 日	国投创业投资管理有限公司	2016 年 6 月 28 日	P1032006
2	远致华信	SY8576	2017 年 12 月 18 日	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司	2017 年 7 月 17 日	P1063671
3	晨道投资	SQM734	2021 年 5 月 12 日	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 10 月 13 日	P1065227
4	哇牛制享	SNX406	2021 年 2 月 7 日	苏州工业园区哇牛投资有限公司	2018 年 2 月 1 日	P1067232
5	尚融投资	SD8155	2016 年 1 月 27 日	尚融资本管理有限公司	2015 年 12 月 2 日	P1028564
6	君安勇诚	SBAX05	2025 年 7 月 10 日	物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司	2024 年 1 月 8 日	P1074762
7	星火投资	SQZ967	2021 年 9 月 30 日	深圳市远致创业投资有限公司	2021 年 5 月 24 日	P1071984
8	常熟经开	SND493	2020 年 11 月 4 日	常熟经开瑞赢私募基金管理有限公司	2025 年 5 月 20 日	P1074978
9	君安嘉平	SARE86	2024 年 12 月 12 日	物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司	2024 年 1 月 8 日	P1074762
10	宁波甬诚	SANX98	2024 年 10 月 10 日	宁波勇诚资产管理有限公司	2015 年 8 月 13 日	P1020538
11	欣亿源	SJG083	2019 年 11 月 27 日	常州欣源宸投资管理有限公司	2019 年 7 月 15 日	P1070003
12	合肥经韬	SANP28	2024 年 9 月 5 日	北京经韬私募基金管理有限公司	2015 年 7 月 30 日	P1019359
13	厦门经韬	SBGG98	2025 年 9 月 26 日	北京经韬私募基金管理有限公司	2015 年 7 月 30 日	P1019359
14	成都建鑫	SAJX64	2025 年 2 月 28 日	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	2014 年 4 月 22 日	P1001087
15	华泰渝富	SZF501	2023 年 3 月 30 日	华泰紫金投资有限责任公司	2015 年 10 月 27 日	PT2600011618
16	华泰产发	SACH73	2023 年 12 月 21 日	华泰紫金投资有限责任公司	2015 年 10 月 27 日	PT2600011618
17	广发信德	SZC398	2023 年 2 月 7 日	广发信德投资管理有限公司	2015 年 11 月 3 日	PT2600011589
18	尚融聚鑫	SNL923	2021 年 5 月 6 日	尚融资本管理有限公司	2015 年 12 月 2 日	P1028564

序号	名称	基金编号	备案日期	管理人	管理人登记日期	管理人编号
19	常熟创投	SBLT91	2025 年 12 月 24 日	常熟市国发创业投资有限公司	2017 年 1 月 4 日	P1060794
20	福建创盈	SVA954	2022 年 5 月 17 日	福建省创新创业投资管理有限公司	2014 年 4 月 23 日	P1001347
21	福州创科	SQM098	2021 年 5 月 20 日	福建省创新创业投资管理有限公司	2014 年 4 月 23 日	P1001347
22	嘉兴萃英	SBSC25	2026 年 3 月 3 日	嘉兴青蒿投资有限公司	2020 年 8 月 18 日	P1071207
23	嘉兴经韬	SBRR92	2026 年 2 月 28 日	北京经韬私募基金管理有限公司	2015 年 7 月 30 日	P1019359
24	东方富海三号	SBPH16	2026 年 1 月 12 日	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	2014 年 4 月 22 日	P1001075
25	共青城智晟	SB4147	2023 年 7 月 4 日	上海易津创业投资管理有限公司	2015 年 11 月 12 日	P1026928
26	苏州创投	SADU71	2023 年 12 月 7 日	苏州国发创业投资控股有限公司	2014 年 5 月 20 日	P1002237
27	苏州致兴	SBNC12	2026 年 2 月 3 日	苏州产业投资私募基金管理有限公司	2025 年 8 月 26 日	P1075023
28	苏州致盛	SBNC26	2026 年 2 月 3 日	苏州产业投资私募基金管理有限公司	2025 年 8 月 26 日	P1075023
29	苏州卓璞	STJ426	2022 年 1 月 11 日	苏州卓璞投资基金管理有限公司	2019 年 4 月 15 日	P1069738

3、其他境内股东

广州锦族、平潭锦新、平潭锦材、穗合投资、苏州时点、超兴创投、哈勃投资、百瑞信托、杭州泽涵、信福汇十二号、信福汇四号、南京厚盈不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金或聘请基金管理人进行投资管理的情形，亦不存在担任私募基金管理人的情形、计划或安排，不需要按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况

1、董事

截至本招股说明书签署日，发行人董事会共由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员构成、提名人及任期情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任职期限
1	陈锦魁	董事长	发起人股东	2024.12.02-2027.12.01
2	郑家强	副董事长	发起人股东	2024.12.02-2027.12.01
3	张乐伟	董事	董事会	2025.8.29-2027.12.01
4	黄云余	董事	发起人股东	2024.12.02-2027.12.01
5	贾波	职工代表董事	职工代表大会	2024.12.02-2027.12.01
6	唐靖炎	独立董事	董事会	2024.12.02-2027.12.01
7	杨毅	独立董事	董事会	2024.12.02-2027.12.01
8	赵晓明	独立董事	董事会	2024.12.02-2027.12.01

现任董事简历如下：

（1）陈锦魁

陈锦魁，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，苏州市第十七届人大代表，曾任福州市第十三届政协常务委员。1994 年 8 月至 2005 年 4 月，担任福州华冠针纺织品有限公司销售部副经理；2007 年 4 月至 2021 年 10 月，担任重庆锦艺董事长；2021 年 10 月至 2022 年 11 月，担任重庆锦艺执行董事兼经理。2017 年 2 月至 2021 年 10 月，担任锦艺有限董事长；2021 年 11 月至今，担任发行人董事长；2025 年 3 月至今，担任发行人总经理。兼职情况参见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系”。

（2）郑家强

郑家强，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约理工学院工商管理专业，硕士学历。1990 年 9 月至 2003 年 3 月，在中国银行福建省分行任职，历任支行信贷科副科长、副行长；2003 年 3 月至 2005 年 7 月，

担任招商银行股份有限公司福州分行人事部经理；2007 年 4 月至 2021 年 10 月，历任重庆锦艺副总经理、总经理、董事；2018 年 12 月至 2022 年 5 月，任锦艺置业集团有限公司董事。2017 年 2 月至 2021 年 10 月，担任锦艺有限董事；2021 年 11 月至 2022 年 6 月，担任发行人董事；2022 年 6 月至今，担任发行人副董事长、常务副总经理。

（3）黄云余

黄云余，男，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计专业背景。2001 年 2 月至 2015 年 6 月，担任福州华冠针纺织品有限公司财务经理；2015 年 7 月至 2018 年 12 月，担任重庆锦艺财务总监。2018 年 12 月至 2021 年 10 月，历任锦艺有限财务总监、董事；2021 年 11 月至今，担任发行人董事、财务总监、董事会秘书。兼职情况参见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系”。

（4）张乐伟

张乐伟，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有法律职业资格。2008 年本科毕业于青岛大学材料学专业，2011 年硕士研究生毕业于浙江理工大学材料学专业。2011 年 3 月至 2017 年 9 月，就职于中国节能海东青新材料集团有限公司，任研发部经理；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，就职于上海市锦天城律师事务所，任项目成员；2018 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于申万宏源证券有限公司，任项目经理；2020 年 3 月至 2021 年 12 月，就职于兴业证券股份有限公司，任项目经理；2022 年 2 月至今，任职物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司，任总经理助理。2025 年 8 月至今，担任公司董事。

（5）贾波

贾波，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆大学材料化学专业，本科学历。2009 年 12 月至 2010 年 7 月，担任新疆天业集团中控操作员；2010 年 10 月至 2018 年 12 月，担任重庆锦艺、重庆锦艺苏州分公司研发工程师。2018 年 12 月至 2019 年 7 月，担任苏州锦艺苏州分公司研发工程师；2019 年 8 月至 2021 年 10 月，历任锦艺有限研发工程师、研发中心产品开发部

项目经理；2021 年 11 月至今，担任发行人研发中心产品开发部项目经理；2024 年 12 月至今，担任公司职工代表董事。

（6）唐靖炎

唐靖炎，男，1956 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，博士学历。1982 年 9 月至 1990 年 1 月，历任国家建材局苏州非金属矿工业设计研究院助理工程师、工程师；1990 年 2 月至 1993 年 7 月，担任国家建材局苏州非金属矿工业设计研究院研究所副所长、高级工程师；1993 年 8 月至 1996 年 11 月，担任国家建材局苏州非金属矿工业设计研究院党委书记、副院长；1996 年 12 月至 2006 年 3 月，担任国家建材局苏州非金属矿工业设计研究院党委书记、院长、教授级高工；2006 年 4 月至 2016 年 7 月，担任中材科技股份公司副总裁、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长、总经理；2016 年 8 月至今，担任中国非金属矿工业协会专职副会长、中国建筑材料联合会专家委员会非金属矿学部主任；2019 年 10 月至今，担任浙江长安仁恒科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。

（7）杨毅

杨毅，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，博士学历。2003 年 4 月至 2006 年 3 月，担任南京理工大学化工学院讲师；2006 年 4 月至 2011 年 7 月，担任南京理工大学化工学院副研究员；2011 年 8 月至 2014 年 4 月，担任南京理工大学环生学院副研究员；2011 年 11 月至 2014 年 7 月，兼任南京理工大学连云港研究院，副院长；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，担任江苏省第六批科技镇长团、江苏省东海经济开发区，挂职副主任；2014 年 5 月至今，担任南京理工大学环生学院研究员，博士生导师；2014 年 9 月至 2020 年 8 月，兼任南京理工大学辐射防护与核安全系主任；2021 年 4 月至 2024 年 10 月，担任苏颗粒科技南京有限公司执行董事；2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。

（8）赵晓明

赵晓明，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士学历，中国注册会计师。1989 年 6 月至 1994 年 9 月，历任京粤

汉字电脑技术研究开发中心计划经营办公室副主任、总裁办公室主任；1994 年 10 月至 2005 年 12 月，担任仲恺农业工程学院经济管理学院教师；2006 年 1 月至 2010 年 3 月，担任仲恺农业工程学院监察处副处长、审计处副处长；2010 年 4 月至 2012 年 12 月，担任仲恺农业工程学院审计处处长；2013 年 1 月至 2019 年 6 月，担任仲恺农业工程学院财务处处长；2019 年 7 月至 2024 年 11 月，担任仲恺农业工程学院基建处正处级干部；2022 年 1 月至今，担任广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任润本生物技术股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。

2、监事及审计委员会成员

截至监事会取消前，公司监事由林智睿、庄雨、李泽惠组成。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法规要求，公司于 2025 年 11 月召开 2025 年第二次临时股东会，决议不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。截至本招股说明书签署之日，公司审计委员会设置情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	赵晓明	赵晓明、唐靖炎、杨毅

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司共有高级管理人员 6 名，高级管理人员的构成、职务及任期情况如下：

序号	姓名	职务	任职期限
1	陈锦魁	总经理	2025.3.18-2028.3.17
2	郑家强	常务副总经理	2025.3.18-2028.3.17
3	黄勇峰	副总经理	2025.3.18-2028.3.17
4	胡林政	副总经理	2025.3.18-2028.3.17
5	佟刚	副总经理	2025.3.18-2028.3.17
6	黄云余	财务总监、董事会秘书	2025.3.18-2028.3.17

（1）陈锦魁先生的个人简历请参见本节之 “（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事”。

（2）郑家强先生的个人简历请参见本节之 “（一）董事、监事、高级管理

人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事”。

（3）黄云余先生的个人简历请参见本节之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事”。

（4）黄勇峰

黄勇峰，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学工商管理专业，硕士学历。1995 年 4 月至 1998 年 8 月，担任福建闽东本田发动机组有限公司销售部科长；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，担任凯撒空压机（上海）有限公司销售经理。2005 年 12 月至 2021 年 10 月，历任重庆锦艺销售总监、董事、总经理；2019 年 7 月至今，兼任锦艺阿泰欧董事、总经理。2017 年 2 月至 2021 年 10 月，担任锦艺有限董事、总经理；2021 年 11 月至 2025 年 3 月，担任发行人总经理；2021 年 11 月至 2025 年 8 月，担任发行人董事；2025 年 3 月至今，担任发行人副总经理。兼职情况参见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系”。

（5）胡林政

胡林政，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南工学院无机非金属材料专业，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 5 月，担任北京高强混凝土有限公司技术员；2001 年 5 月至 2002 年 5 月，担任苏州大利发贸易有限公司销售工程师；2002 年 6 月至 2009 年 2 月，担任国巨电子（中国）有限公司任工程部 R-Chip 工程部副经理；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，担任西安康弘新材料科技有限公司制造中心副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 3 月，担任厦门柏恩氏电子有限公司制造部前段（生产兼工程）经理工作；2012 年 3 月至 2014 年 10 月，担任南京萨特科技发展有限公司研发部总监；2014 年 10 月至 2018 年 12 月，担任重庆锦艺研发总监。2018 年 12 月至 2021 年 10 月，历任锦艺有限研发总监、副总经理；2021 年 11 月至今，担任发行人副总经理、研发中心总监。

（6）佟刚

佟刚，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学机械设计及理论专业，硕士学历。2007 年 7 月至 2009 年 9 月，担任无锡小天

鹅股份有限公司洗衣机事业部及技术研发中心经理；2009 年 10 月至 2011 年 1 月，历任无锡小天鹅股份有限公司洗衣机事业部、品质管理部、测试中心经理；2011 年 1 月至 2013 年 9 月，历任无锡小天鹅股份有限公司洗衣机事业部、品质管理部部长；2013 年 9 月至 2016 年 7 月，担任无锡小天鹅股份有限公司洗衣机事业部及工程部部长；2016 年 10 月至 2019 年 3 月，担任苏州天鹏电源股份有限公司制造中心总监。2019 年 7 月至 2021 年 10 月，历任锦艺有限制造中心总监、副总经理；2021 年 11 月至今，担任发行人副总经理、制造中心总监。

4、其他核心人员

公司综合考虑其他核心人员的职务、学历背景、从业经验、研究经历及对主要知识产权的贡献程度等多方面因素，认定胡林政、罗艳玲、沈晓燕、贾波 4 名其他核心人员，该等人员具体情况如下：

（1）胡林政的个人简历请参见本节“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“3、高级管理人员”。

（2）罗艳玲

罗艳玲，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于日本国立奈良女子大学共生自然科学专业，博士学历。自博士期间开始做导电高分子复合材料的研究，毕业后先后在日本 Nanomizer（株），日本 Harima Chemical Group（株）从事铜浆，铝钎焊浆料等新产品的研发。归国后，2015 年 3 月至 2016 年 12 月，在浙江中科立德科技有限公司担任研发部主管，负责 PEDOT：PSS 高分子导电油墨产品的研发项目以及锂电池正极浆料的研发项目；2016 年 4 月至今，担任千穗（贸易）上海有限公司总经理。2021 年 1 月至 2021 年 10 月，担任锦艺有限开发专家；2021 年 11 月至 2025 年 6 月，担任发行人开发专家；2025 年 7 月至今，担任发行人子公司锦艺半导体总经理。兼职情况参见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系”。

（3）沈晓燕

沈晓燕，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学应用化学专业，硕士学历。2011 年 6 月至 2014 年 3 月，担任苏州博卡金属

颜料有限公司研发工程师；2014 年 4 月至 2017 年 4 月，担任苏州金瑞晨科技有限公司研发经理；2017 年 5 月至 2018 年 7 月，担任重庆锦艺研发工程师。2018 年 8 月至 2021 年 10 月，历任锦艺有限研发工程师、研发中心预研部项目经理；2021 年 11 月至今，担任发行人研发中心预研部经理。

（4）贾波

贾波先生的个人简历请参见本节之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事”。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系

截至本招股说明书签署日，公司无监事，公司董事、高级管理人员及其他核心人员除在发行人及子公司任职外，兼职情况如下：

姓名	身份	对外兼职单位（不包括发行人全资或控股子公司）	职务	兼职单位与发行人的其他关联关系
陈锦魁	董事长、总经理	广州福商	执行董事	与发行人无其他关联关系
		广州锦族	执行董事	发行人控股股东
		锦艺阿泰欧	副董事长	发行人合营企业
		达安金控控股集团有限公司	董事	与发行人无其他关联关系
		华诚投资	董事	与发行人无其他关联关系
		汇鼎资本	监事	与发行人无其他关联关系
		辽宁汇润网络科技有限公司	监事	与发行人无其他关联关系
黄勇峰	副总经理	上海爵众企业管理咨询有限公司	监事	与发行人无其他关联关系
		锦艺阿泰欧	董事、总经理	发行人合营企业
黄云余	董事、财务总监、董事会秘书	平潭锦新	执行事务合伙人	发行人股东、员工持股平台
唐靖炎	独立董事	浙江长安仁恒科技股份有限公司	独立董事	与发行人无其他关联关系
		中国非金属矿工业协会	专职副会长	与发行人无其他关联关系
		中国建筑材料联合会专家委员会	非金属矿学部主任	与发行人无其他关联关系
杨毅	独立董事	南京理工大学环生学院	研究员、博士生导师	与发行人无其他关联关系

姓名	身份	对外兼职单位（不包括发行人全资或控股子公司）	职务	兼职单位与发行人的其他关联关系
		中国颗粒学会	青年理事会副主任	与发行人无其他关联关系
		中国核学会	核环保分会理事	与发行人无其他关联关系
		全国颗粒表征与分检标准化技术委员会	委员兼副秘书长	与发行人无其他关联关系
		江苏省颗粒学会	副理事长	与发行人无其他关联关系
		江苏省环境科学学会	常务理事	与发行人无其他关联关系
		江苏晶材颗粒科技有限公司	执行董事	与发行人无其他关联关系
赵晓明	独立董事	广东朝阳电子科技股份有限公司	独立董事	与发行人无其他关联关系
		润本生物技术股份有限公司	独立董事	与发行人无其他关联关系
罗艳玲	锦艺半导体总经理	千穗贸易（上海）有限公司	执行董事	与发行人无其他关联关系

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司无监事，发行人董事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的有关协议及履行情况

截至本招股说明书签署日，公司无监事，在公司任职的内部董事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签署了劳动合同、知识产权保护协议，并就保密、竞业限制等事项签署了相关协议，进行了详细约定。

自签署协议签订以来，相关董事、高级管理人员及其他核心人员均严格履行合同及协议约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近二年变动情况

1、董事变动情况

最近两年，公司董事变动情况如下：

时间	董事会构成	变动情况	变动原因
2024 年 1 月-2024 年 12 月	陈锦魁、郑家强、黄勇峰、黄云余、姜达才、唐靖炎、杨毅、赵晓明	-	-
2024 年 12 月至 2025 年 8 月	陈锦魁、郑家强、黄勇峰、黄云余、贾波、姜达才、唐靖炎、杨毅、赵晓明	增选贾波为职工代表董事	增选职工代表董事
2025 年 8 月至 2026 年 4 月	陈锦魁、郑家强、黄云余、贾波、张乐伟、姜达才、唐靖炎、杨毅、赵晓明	董事黄勇峰辞任，增补张乐伟为公司第二届董事会非独立董事	增补外部董事
2026 年 4 月至今	陈锦魁、郑家强、黄云余、贾波、张乐伟、唐靖炎、杨毅、赵晓明	董事姜达才辞任	退休辞任

公司最近两年董事变化系根据法规增选职工代表董事、机构委派外部董事或董事退休辞任，没有发生重大不利变化，未对公司重大事项、生产经营的决策与执行构成实质性影响。

2、监事、审计委员会委员变动情况

最近两年，公司监事变动情况如下：

时间	监事会构成	变动情况	变动原因
2024 年 1 月至 2025 年 11 月	林智睿、庄雨、李泽惠	-	-
2025 年 11 月至今	/	/	公司于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会，决议通过《关于取消监事会的议案》，不设监事会，由审计委员会行使监事会相关职能

上述变动系根据相关法规要求对公司治理结构进行调整，未对公司构成重大不利影响。最近两年，公司董事会审计委员会成员未发生变动。截至目前，公司审计委员会成员由赵晓明、唐靖炎、杨毅 3 位董事担任委员，赵晓明担任召集人。

3、高级管理人员变动情况

最近两年，公司高级管理人员变动情况如下：

时间	高级管理人员	变动情况	变动原因
2024 年 1 月 -2025 年 3 月	总经理：黄勇峰 副总经理：郑家强、胡林政、佟刚 董事会秘书、财务总监：黄云余	-	-
2025 年 3 月至今	总经理：陈锦魁 副总经理：郑家强、黄勇峰、胡林政、佟刚	聘任陈锦魁为总经理，黄勇峰担任副总经理	内部职务调整

时间	高级管理人员	变动情况	变动原因
	董事会秘书、财务总监：黄云余		

公司最近两年高级管理人员发生变化主要系因内部分工变动，未发生重大不利变化。

4、其他核心人员变动情况

最近两年，公司其他核心人员为胡林政、罗艳玲、沈晓燕、贾波，未发生重大不利变化。

（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司无监事，除发行人及其子公司以外，公司现任董事、高级管理人员及其他核心人员其他直接对外投资情况如下：

单位：万元、%

序号	姓名	公司职务	对外投资企业	认缴出资额	出资比例
1	陈锦魁	董事长、总经理	广州锦族	6,500.00	100.00
			广州福商	950.00	95.00
			平潭锦材	915.00	73.20
			平潭锦新	1,000.00	50.00
			天津金健智投资合伙企业（有限合伙）	1,365.00	39.00
			北京亮马骏程投资管理有限公司	25.00	25.00
			福建德生源投资管理有限公司	295.00	22.78
			广州汇力贸易有限公司	60.00	20.00
			汇鼎资本	4,200.00	70.00
			泰州瑞中盛世投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	30.00
			华诚投资	4,393.00 美元	87.86
2	郑家强	副董事长、常务副总经理	河南商水农村商业银行股份有限公司	344.74	0.88
			汇鼎资本	600.00	10.00
3	黄勇峰	副总经理	平潭锦新	300.00	15.00
			上海爵众企业管理咨询有限公司	27.50	55.00
4	黄云余	董事、财务总监、董事会秘书	平潭锦新	150.00	7.50

序号	姓名	公司职务	对外投资企业	认缴出资额	出资比例
5	胡林政	副总经理、研发中心总监	平潭锦新	150.00	7.50
6	罗艳玲	锦艺半导体总经理	千穗（贸易）上海有限公司	70.00	70.00

平潭锦新、平潭锦材系发行人员工持股平台，陈锦魁等公司部分董事、高级管理人员通过员工持股平台间接持有发行人股份。

董事长陈锦魁持有发行人控股股东广州锦族股份，进而间接持有发行人股份。

截至本招股说明书签署日，除上述情况外，发行人董事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他与发行人及其业务相关的对外投资，上述人员的其他对外投资与发行人不存在利益冲突情形。

（七）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况

1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

截至本招股说明书签署日，公司无监事，公司董事、高级管理人员及其他核心人员均未直接持有发行人股份，间接持股情况如下：

单位：%

序号	姓名	在本公司任职	间接持股比例
1	陈锦魁	董事长、总经理	50.45
2	黄勇峰	副总经理	0.83
3	黄云余	董事、财务总监、董事会秘书	0.41
4	胡林政	副总经理、研发中心总监	0.41

陈锦魁间接持股部分通过广州锦族、平潭锦新和平潭锦材持有，其他人员间接持股部分通过平潭锦新持有。除上述情况外，无其他董事、高级管理人员、其他核心人员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

2、近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属未持有公司股份。

3、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员所持有的公司股份均不存在质押或被冻结的情况。

（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司建立了完善的薪酬制度，公司内部董事、监事（取消监事会前）及高级管理人员的薪酬由基本工资、奖金、津贴和社保福利等构成，其中基本工资及社保福利按月发放，由劳动合同进行约定；奖金根据员工绩效考核、项目业绩及公司经营业绩确定。其他核心人员的薪酬由人力资源部依据公司的薪酬管理制度决定。公司独立董事领取固定津贴；未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）、监事（取消监事会前）不在公司领取报酬。

公司董事、监事（取消监事会前）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬及考核管理制度》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重

报告期内，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	1,034.73	850.14	734.11
利润总额	18,923.67	10,050.62	7,185.30
占比	5.47	8.46	10.22

3、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况

报告期内，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	在本公司任职	2025 年度薪酬（税前）
1	陈锦魁	董事长、总经理	154.76
2	郑家强	副董事长、常务副总经理	154.84
3	黄云余	董事、财务总监、董事会秘书	102.10
4	姜达才	董事（2026 年 4 月辞任）	-
5	张乐伟	董事	-
6	唐靖炎	独立董事	8.00
7	杨毅	独立董事	8.00
8	赵晓明	独立董事	8.00
9	林智睿	取消监事会前监事会主席	32.54
10	庄雨	取消监事会前职工监事	42.13
11	李泽惠	取消监事会前监事	-
12	黄勇峰	副总经理	107.32
13	胡林政	副总经理、研发中心总监	109.29
14	佟刚	副总经理、制造中心总监	109.57
15	沈晓燕	研发中心预研部经理	51.88
16	贾波	职工代表董事、研发中心产品开发部项目经理	65.01
17	罗艳玲	锦艺半导体总经理	81.28

截至本招股说明书签署之日，除与公司无劳动关系的董事、监事外，其他人员均不存在在关联企业中领薪的情况。

十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）发行人员工持股情况

1、员工持股平台的基本情况

为增加核心员工对公司的认同感、充分调动员工积极性，公司于 2018 年 12 月成立了员工持股平台平潭锦新、平潭锦材。员工持股以平潭锦新、平潭锦材向公司按照 2.175 元/注册资本增资认缴 1,494.2529 万元注册资本的形式实施，员工通过享有持股平台份额而间接享有相应权益。员工离职后按合伙协议仍可继续持有合伙企业的份额。截至本招股说明书签署日，平潭锦新直接持有公司股份 5.50%，平潭锦材直接持有公司股份 3.44%。

平潭锦新的人员构成等基本情况详见“第四节 发行人基本情况”之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况” 之“（二）其他直接持股5%以上股东的基本情况”之“1、平潭锦新”的相关内容。平潭锦材的具体情况和出资结构如下：

公司名称	平潭锦材投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350128MA32BWL808
执行事务合伙人	林花英
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	1,250.00 万元
实缴出资额	1,250.00 万元
成立日期	2018 年 12 月 14 日
注册地	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1273
主要生产经营地	平潭综合实验区井湾片区
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）
主营业务	实业投资类业务
与发行人主营业务的关系	除持有发行人 3.44%股权外，无其他对外投资，与发行人主营业务无关

平潭锦材是发行人设立的员工持股平台，出资人均为公司员工，具体出资情况如下：

单位：万元、%

序号	合伙人姓名	类别	出资金额	出资比例
1	林花英	普通合伙人	75.00	6.00
2	陈锦魁	有限合伙人	915.00	73.20
3	夏古俊	有限合伙人	75.00	6.00
4	高健	有限合伙人	50.00	4.00
5	王静	有限合伙人	25.00	2.00
6	冉琼	有限合伙人	25.00	2.00
7	陈宝荣	有限合伙人	25.00	2.00
8	刘建明	有限合伙人	25.00	2.00
9	杨显成	有限合伙人	12.50	1.00
10	陈帅	有限合伙人	12.50	1.00
11	张海涛	有限合伙人	10.00	0.80

序号	合伙人姓名	类别	出资金额	出资比例
合计			**1,250.00**	**100.00**

林花英为普通合伙人，其余 10 名持股员工为有限合伙人，截至目前，合伙企业出资额为 1,250.00 万元。

2、员工持股平台的锁定期

平潭锦新、平潭锦材持有发行人股份的锁定期承诺请参见本招股说明书“附件 1 与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

3、对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响

核心员工持股有助于建立健全公司和员工的风险共担、利益共享的有效机制，推动骨干团队以公司利益为本开展生产经营，实现股东、公司和员工利益的趋同，确保公司发展战略和经营目标的实现，此外还有利于公司实现吸纳人才、留住人才、合理使用人才的需要，通过充分激发员工的创新力和价值创造力，提升公司的核心竞争力。

平潭锦新和平潭锦材入股发行人时的增资价格确定为每 1 元注册资本 2.175 元，该次增资价格根据协商确定，为公允价格，不构成股份支付。员工持股平台增资前后，公司控制权未发生变化。

（二）发行人制定的拟在上市后实施的期权计划

发行人存在首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划，具体情况如下：

1、制定激励计划的程序

2022 年 8 月 5 日，发行人第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）的议案》，并提交发行人董事会审议。2022 年 8 月 11 日，发行人第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）的议案》。2022 年 9 月 6 日，发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过《苏州锦艺新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》。

2022 年 9 月 13 日，发行人第一届董事会第六次会议审议通过《关于向激励

对象授予股票期权的议案》，决定以 2022 年 10 月 31 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 210.5 万份股票期权。公司独立董事就本次授予相关事宜发表了明确的独立意见。2022 年 9 月 14 日，公司与本次股票期权激励计划的全部激励对象签署了《股票期权授予协议书》，正式授予公司股票期权。2026 年 5 月 15 日，公司股东会审议通过《关于延长 2022 年股票期权激励计划有效期的议案》，将上述股票期权激励计划的有效期延长 48 个月，即自原授权期限届满之日起延长 48 个月。除上述授权期限调整外，上述股票期权激励计划其他内容均保持不变。

2、期权激励计划的基本内容

（1）期权激励计划的激励对象

本激励计划授予股票期权涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、重要岗位人员、以及董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的相关人员，授予时总计 48 人。本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条第二款所述的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 8.4.2 条的规定。

（2）行权价格

本次期权的行权价格为 8.7 元/股，期权授予前一次融资时每股估值 13.12 元/股，2021 年末，经审计的每股净资产为 4.01 元/股。本次期权的行权价格高于最近一年经审计的每股净资产，差异原因主要系行权价格为综合考虑发行人经营业绩、成长前景、本次期权激励计划激励效果等因素。

（3）授予期权股票总量

本激励计划向激励对象授予 210.5 万份股票期权，激励对象每份股票期权之行权将获得公司向激励对象定向发行的 1 股公司股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，全部行权所获公司股票占本激励计划制定时公司股本总额 16,714.5075 万股的 1.2594%，未设置预留权益，期权行权不会导致公司实际控制人发生变化。激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。截至报告期末，共有 35 名激励对象持有于上市后行权的期权合计 161.80 万份。

若在股票期权计划审议通过当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

（4）等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权日起计算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。其中，第一期股票期权对应的等待期为自授予日起 12 个月（“第一个等待期”）；第二期股票期权对应的等待期为第一个等待期加上第一个等待期届满后 12 个月（“第二个等待期”）。

若公司于第一个等待期内向证券交易所递交上市申请，且截至第一个等待期届满时公司尚未上市的，则第一个等待期顺延至公司上市之日届满，公司于中国证券登记结算有限责任公司完成股票期权授予登记之日为第一个行权期起始日，第二期股票期权的等待期及行权期相应顺延。

2025 年度，公司对预计上市时间进行了重新估计，并按照最新预计调整等待期，调整后第一个等待期满为 2027 年 6 月，第二个等待期满为 2028 年 6 月。

公司根据财政部颁布的《股份支付准则应用案例——以首次公开募股成功为可行权条件》中基于等待期变动的要求，将截至期末累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额，作为当期应确认的股权激励费用，公司在 2025 年度冲减股份支付 161.95 万元。

（5）行权安排

股票期权自各等待期届满次日开始进入行权期，在行权期内采取分期行权：自第一个等待期届满后次日起 12 个月内为第一个行权期，行权上限为激励对象获授股票期权总额的 50%；自第二个等待期届满后次日起 12 个月内为第二个行权期，行权上限为激励对象获授股票期权总额的 50%。每期股票期权的行权期为 12 个月，第二个行权期的起算日不得早于第一个行权期的届满日。

在公司上市时累计可行权的部分可在公司上市之日起 12 个月内行权，后续等待期在公司上市之日起 12 个月后延续计算。

（6）减持承诺

激励对象已承诺行权后取得的发行人股票，自行权日起三年内不减持，同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

3、对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响

本次股票期权计划基于公司未来长远发展考虑，对公司中高层管理人员和核心业务骨干形成有效激励，有助于公司长期稳定发展。

本次期权激励计划实施后，公司将根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。股份支付费用的会计处理详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、重要的会计政策和会计估计”之“（二）主要会计政策和会计估计”之“11、股份支付”。报告期内，公司因股票期权激励确认的股份支付费用为 420.99 万元。本次股权激励成本在公司经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。同时，公司向激励对象发行股份所募集的资金将用于补充公司流动资金，进一步促进企业经营发展。

根据本激励计划的授予股票期权总量，发行人不会因上市后期权行权而导致公司实际控制人发生变化，不会影响实际控制人稳定。

十四、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工情况

1、人数及变化情况

报告期各期末，公司及子公司员工人数和变化情况如下：

日期	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
员工人数	741	621	535

2、专业分工结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司员工专业结构如下：

岗位	员工人数	比例
销售人员	44	5.94%
行政管理人员	137	18.49%
研发人员	91	12.28%
生产人员	469	63.29%
合计	**741**	**100.00%**

3、教育结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司教育结构如下；

学历	员工人数	比例
博士	2	0.27%
硕士	68	9.18%
大专及本科	299	40.35%
高中及以下	372	50.20%
合计	**741**	**100.00%**

4、年龄结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司年龄结构如下；

年龄层次	员工人数	比例
50 岁以上	49	6.61%
41-50 岁	121	16.33%
31-40 岁	323	43.59%
30 岁及以下	248	33.47%
合计	**741**	**100.00%**

（二）报告期社会保险和住房公积金缴纳情况

报告期内，公司及下属子公司为其员工缴纳社会保险及住房公积金的基本情况如下：

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
员工总人数	741	621	535

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
社会保险缴纳人数	733	611	525
住房公积金缴纳人数	731	609	522
缴纳社保人数占境内员工总人数比例	98.92%	98.39%	98.13%
缴纳住房公积金人数占境内员工总人数比例	98.65%	98.07%	97.57%

公司及下属子公司严格执行国家劳动用工和劳动保护的相关法律法规和规章制度，与员工均签订了劳动合同。公司及下属子公司已按照相关法律法规为员工缴付养老、医疗、工伤、失业、生育保险金及住房公积金，未缴纳原因主要有三类：1、退休返聘员工无需公司缴纳社会保险及住房公积金，根据《中华人民共和国劳动合同法》及《中华人民共和国劳动合同法实施条例》的相关规定，劳动者在退休后与原用人单位劳动关系已经终止，被用人单位返聘所形成的关系不再属于劳动关系，发行人无需为其缴纳社会保险与住房公积金；2、新员工当月入职暂未缴纳；3、外籍人员未缴纳住房公积金，根据《住房公积金管理条例》和《建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理几个具体问题的通知》（建金管[2006]52 号）的规定，《住房公积金管理条例》所称“在职职工”不包括外方及港、澳、台人员，因此发行人未为外籍人员缴纳住房公积金未违反法律法规的规定。

根据苏州市公共信用信息中心 2026 年 1 月 8 日出具的《苏州市企业专用信用报告》，报告期内，未查询到公司有社保、住房公积金欠缴记录，亦未查询到公司有人力资源社会保障类或住房公积金类的行政处罚记录。

为进一步保障公司及员工利益，公司实际控制人陈锦魁先生已出具承诺，若公司及其控股子公司因本次发行上市前的经营活动存在应缴未缴的各项社会保险金和住房公积金或缴费基数调整事由而被有关政府部门或司法机关依法认定需要补缴或者被追缴的，或因此被有关部门处以罚款、滞纳金或被追究其他法律责任，承诺人承诺将承担由此产生的所有补缴款项、罚款、滞纳金及其他支出，并承诺此后不向公司及其控股子公司追偿。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务及主要产品情况

（一）发行人主营业务、主要产品情况

1、主营业务情况

公司专注于先进无机功能性粉体材料领域创新性技术研发及产业化应用，历经二十余载耕耘，逐步探索出一条从致力于国产替代突破至实现自主技术引领的发展路径，目前已成长为电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，并以电子信息领域为技术原点构建起平台型技术，针对具有技术同源性的多种材料进行拓展性开发，打造电子信息功能材料、导热散热功能材料和其他新兴功能材料三大产品矩阵，实现以电子信息领域为核心，辐射导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等领域的多元业务布局。

公司以高性能球形硅微粉为核心的电子信息功能材料，系高等级高速覆铜板，以及高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用高端覆铜板的核心填充材料，下游客户已覆盖台光电子、联茂电子、台燿科技、生益科技、南亚新材、华正新材、南亚电子、建滔化工、韩国斗山、日本松下等全球前十大高速覆铜板制造商（CR10>90%），近年来随着 AI 人工智能的迅速发展，被广泛应用于英伟达、亚马逊、谷歌、AMD、Meta、英特尔、浪潮等国际知名科技企业的 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星等。2023 年至 2025 年期间，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会证明，在高等级高速覆铜板用球形硅微粉领域，公司全球市场占有率超过 40%，位列第一；根据中国非金属矿工业协会证明，公司在覆铜板用硅微粉领域销售规模位居国内第一。公司系少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业，根据中国非金属矿工业协会开具的证明，公司化学合成新工艺“避开了国外的技术封锁，极大地提升了我国高端球形硅微粉的加工水平，产品性能指标达到国际领先水平，填补了国内空白”。

公司依托多年来在电子信息领域的技术积累和产业化理解，逐步构建起可覆盖多维技术体系、多元产品矩阵的平台型技术，并锚定高附加值、创新性应用前景领域进行拓展性开发，逐步实现平台型技术在导热界面材料、锂电池隔膜材料、

先进涂料等领域的多元化应用，并成功进入多个行业龙头客户供应链体系，目前与陶氏化学、汉高等导热散热领域知名企业，恩捷股份、金力股份等锂电池隔膜行业龙头，阿克苏诺贝尔、立邦等涂料代表性企业建立深厚的合作关系。其中，在导热散热功能材料领域，氮化铝、氮化硼等高端导热粉体材料曾长期被海外厂商占据主导地位，公司依托平台型技术的深厚基底，持续研发攻坚与自主创新，实现氮化铝、氮化硼产品的国产化量产，打破国外垄断，随着 AI 算力设施、先进封装等超高功耗、高热流密度场景的迅速发展，高端导热散热材料作为保障芯片性能和 AI 算力设施稳定运行的重要材料，被批量应用于 AI 服务器散热模组，存储芯片、手机芯片等半导体封装领域，迎来高速发展周期。

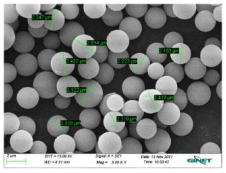
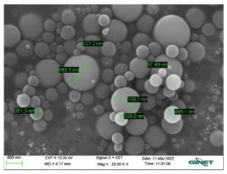
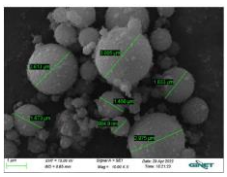
此外，公司致力于成为功能性材料科技创新引领者，在部分由外资主导或下世代前沿领域持续攻关并不断突破。例如电子电路基板领域，以高速覆铜板为代表的高性能覆铜板，作为印制电路板（PCB）的核心基材，已成为 AI 等算力设施的“性能基石”，基于在 M6 至 M8 等级高速覆铜板的优势基础，公司进一步开发更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等前沿产品，适配 M9、M10 等级等下世代高速覆铜板及类载板（SLP）；公司战略性将产品矩阵扩展至 AI 用高密度互联 PCB、下世代玻璃基板（TGV）用电子浆料范畴，进一步夯实电子信息领域行业引领地位并不断拓展优势产品边界。在 IC 先进制造领域，公司自主开发的纳米氧化物是构成芯片抛光液的关键原材料之一，已成功应用于先进芯片制程抛光液产品；在可应用于 2.5D/3D、HBM 等先进封装的液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）、芯片底部填充胶（UF）功能材料领域，公司亦进行了多项技术储备。

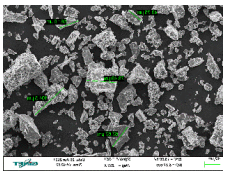
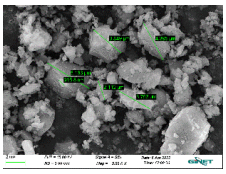
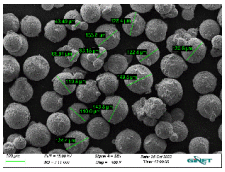
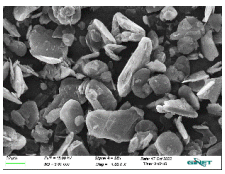
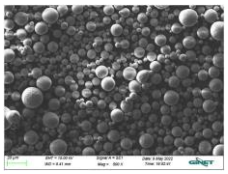
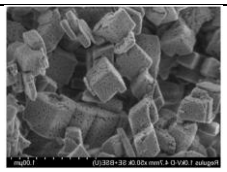
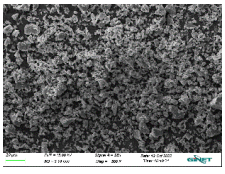
根据国家工信部组织的评比结果，公司获批为国家级专精特新（重点）小巨人企业、第四批专精特新小巨人企业。公司承担了“先进封装基板用高性能球形二氧化硅研发及产业化”国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目。公司化学法球形硅微粉获中国非金属矿科学技术奖科技进步类一等奖（国科奖社字 0301 号）。根据江苏省工业和信息化厅认定工作结果，公司高性能球形硅微粉产品被认定为 2021 年度省级专精特新产品。此外，公司还获批 2025 年度全国非金属矿产品及制品领域标准化工作先进单位、中国非金属矿工业协会先进封装矿物粉体材料行业重点实验室、江苏省电子信息功能粉体工程技术中心、江苏省企业

技术中心等，以主要完成单位获得江苏省材料学会科学技术一等奖、江苏省颗粒学会科技创新奖等。截至本招股说明书签署日，公司已拥有 72 项授权专利，其中发明专利 65 项，参与制定了 2 项已发布的国家标准、1 项已发布的团体标准。

2、公司主要产品介绍

基于自主研发和底层创新构筑的平台型技术，公司紧密结合战略新兴和高端前沿领域应用需求图谱，成功开发电子信息功能材料、导热散热功能材料和其他新兴功能材料，打造出以电子信息领域为核心，辐射导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等多元应用领域的产业体系，并在电子信息领域确立相关行业地位，成为高等级高速覆铜板用球形硅微粉市占率第一的企业，以及国内覆铜板用硅微粉领域销售规模第一的企业，随着 AI 等先进产业的快速兴起，公司产品被广泛应用于 AI 算力设施、低轨卫星、半导体制造与封装等新兴领域。公司不同业务板块主要产品、性能特点及应用领域如下表所示：

业务板块	主要产品		性能特点	应用领域
电子信息功能材料	高性能球形硅微粉-化学法球硅		更高纯度（99.99%）、球化率高（接近100%）、粒度分布窄、填充率高；单分散均匀颗粒，流动性好；介电性能好、热膨胀系数低，同粒径下比表面积最小	**直接应用：**高速覆铜板（主要为 M7 及以上等级，包含 M8、M9 等级的新一代高速覆铜板） **终端应用：**AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等
	高性能球形硅微粉-直燃法球硅		纯度高（>99.5%）、球化率高（>99%）、粒度分布窄、填充率高；大球及空心球含量低，流动性好、易分散；介电性能好、热膨胀系数低，同粒径下比表面积较小	**直接应用：**高速覆铜板（M6 及以上等级）、HDI 基板、IC 载板、类载板（SLP） **终端应用：**AI 服务器、高阶通用服务器、旗舰级手机和电脑设备、自动驾驶及智能化座舱等
	高性能球形硅微粉-火焰法球硅		纯度高（>99.5%）、球化率高（>95%）、填充率高、流动性好；介电性能好、热膨胀系数低	**直接应用：**高速覆铜板（以 M6 等级为主）、HDI 基板、BT 载板 **终端应用：**AI 服务器、高阶通用服务器、低轨卫星、旗舰级手机和电脑设备、自动驾驶及智能化座舱等

业务板块	主要产品		性能特点	应用领域
	软性复合填料		莫氏硬度低、粒度范围可调、多种表面改性、磁性异物含量少、尺寸稳定性好、耐热性好	**直接应用：**白色家电、一般车规级和其他普通 PCB 用覆铜板 **终端应用：**汽车电子、消费电子、白色家电等
	熔融硅微粉		较低介电常数和热膨胀系数、粒度范围可调、多种表面改性、磁性异物含量少、尺寸稳定性好、耐热性好	**直接应用：**一般等级高速覆铜板、HDI 基板 **终端应用：**消费电子、汽车电子、传统服务器
导热散热功能材料	氮化铝		导热系数高（填充在导热界面材料中导热系数达 8-16W/（m·k）左右）、粒径分布可控、结晶度高、形貌规整、吸油值低、流动性高、填充率高、双重耐水解处理、耐储存	**直接应用：**导热凝胶、导热垫片、导热硅脂、导热胶膜等导热界面材料 **终端应用：**AI 服务器、存储芯片、手机芯片、通信基站、汽车域控制器等高导热场景
	氮化硼		导热性能好（填充在导热界面材料中导热系数达 1-5W/（m·k）左右）、低介电常数、低介电损耗、低莫氏硬度、高稳定性、质轻可降低界面材料密度	**直接应用：**导热胶等导热界面材料，导热 PI（聚酰亚胺）膜，高频高速高导热覆铜板 **终端应用：**AI 设备、通信基站、信号天线、卫星通讯模组、新能源汽车功率模组等
	导热氧化铝	 （以球形氧化铝为例）	导热性能好（填充在导热界面材料中导热系数达 1-6W/（m·k）左右）、纯度高；角形结晶度高，球形球化率高（95%）、填充率高、流动性及分散性好	**直接应用：**导热凝胶、导热垫片、导热硅脂、导热灌封胶等导热界面材料 **终端应用：**新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）
其他新兴功能材料	锂电池隔膜功能材料	 （以隔膜超细氧化铝为例）	纯度高、结晶度高；粒径分布可控，可实现低吸油值、高填充率、低水分等效果；浸润性好、含液量高，可形成薄涂层	**直接应用：**锂电池隔膜 **终端应用：**新能源汽车动力电池、储能电池
	涂料功能材料		低光泽、高硬度、高透明、耐刮擦、耐水煮、耐候性、耐腐蚀性、绿色环保	**直接应用：**消光、增硬等粉末涂料或液体涂料 **终端应用：**建筑、高铁、金属型材以及部分工业设备外层等
	高端前沿领域代表性产品	芯片抛光液纳米氧化物	球形度好、高硬度、高纯度、粒径均一，可实现芯片金属栅极平整抛光	**直接应用：**芯片 CMP 抛光液材料 **终端应用：**半导体先进制程、高端芯片

业务板块	主要产品		性能特点	应用领域
		芯片封装功能材料	球形率高、流动性好、易分散、多种表面改性、低杂质、低磁性异物、低放射性、大颗粒卡断优异	**直接应用：**环氧塑封料（EMC）、液态塑封料（LMC）、颗粒状塑封料（GMC）、底部填充胶（UF）等封装材料 **终端应用：**2.5D/3D、HBM 等半导体芯片封装
		电子浆料	导电性好、体积电阻率低、抗压和抗弯折能力强；低温 200 -220℃烧结、空气气氛烧结（无需惰性气氛环境）	**直接应用：**玻璃基板 TGV 通孔、高密度互联板通孔金属化 **终端应用：**下世代玻璃基板（TGV）、AI 服务器

上述产品中，电子信息功能材料、导热散热功能材料销售收入占比合计超过 85%，系公司主要产品：

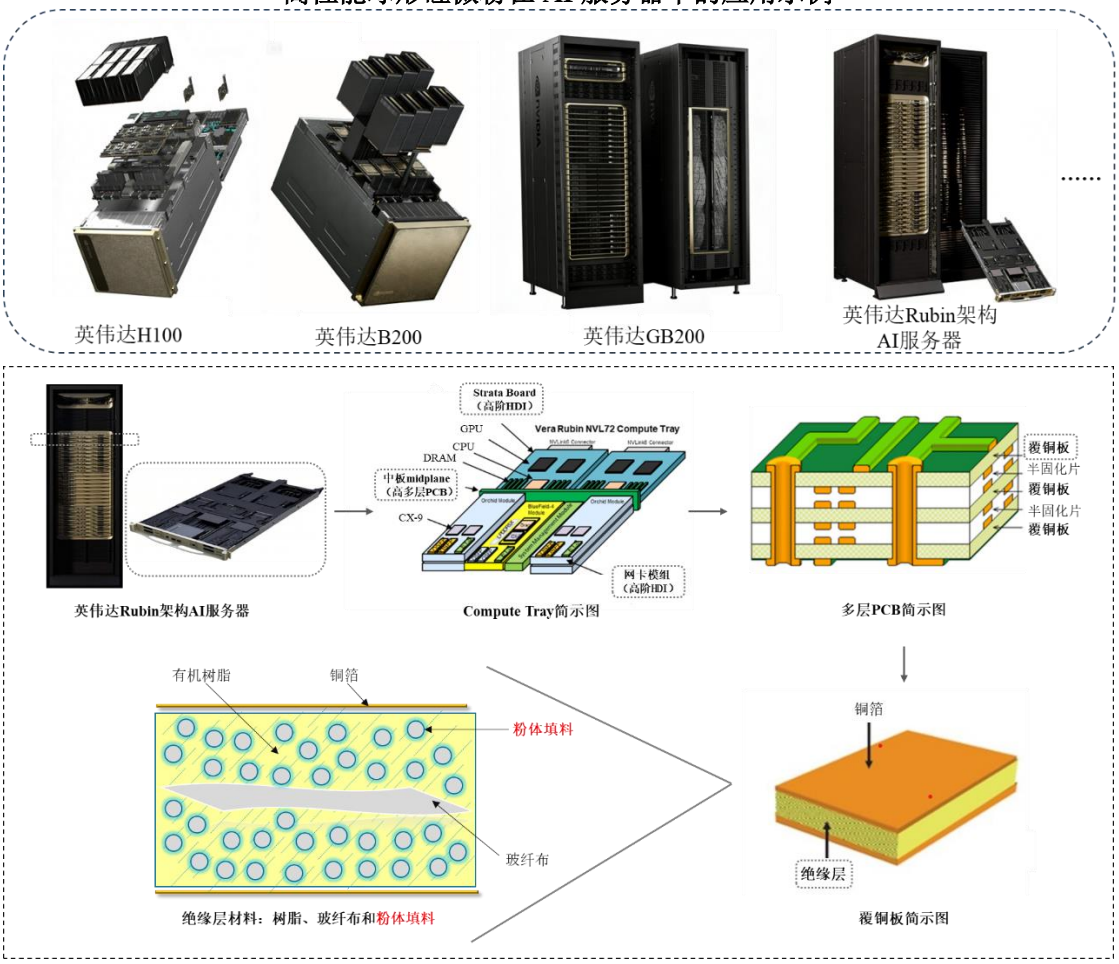
（1）电子信息功能材料

公司电子信息功能材料产品主要是以二氧化硅（SiO_2）为主要成分的无机非金属粉体材料，具体包括化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅等高性能球形硅微粉，以及软性复合填料、熔融硅微粉等角形硅微粉产品，可广泛应用于高速覆铜板，以及高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用各类覆铜板，主要应用方式是作为填充材料与半液态的有机树脂混合后、以玻纤布为附着物形成绝缘层，为覆铜板提供更优介电性能、尺寸稳定性、耐热性、绝缘性等关键性能，目前，无机功能粉体填料已成为覆铜板中除铜箔、树脂、玻纤布之外的第四大关键原材料。

公司电子信息功能材料核心产品为高性能球形硅微粉，其最为主要的终端应用场景为 AI 算力设施。印制电路板（PCB）承担着芯片等电子元器件支撑以及高密度电路集成、高速率信号传输等关键功能，被誉为“电子电路之母”，高等级高速覆铜板系 AI 用 PCB 核心基材，已成为 AI 算力设施的“性能基石”。以英伟达 AI 服务器为例，GPU OAM 加速卡、UBB 板、CPU 主板、交换机主板，以及最新 Rubin 架构系列中新增的正交背板、中板（Midplane），均以高等级高速覆铜板为核心基材。公司高性能球形硅微粉作为高等级高速覆铜板的核心填充材料，可增强信号传输所需的高速率、低损耗并赋予更优线性膨胀系数和尺寸稳定性等核心关键性能，随着 AI 的快速发展，带动对电路传输速率、传输损耗、热

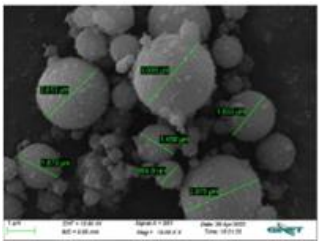
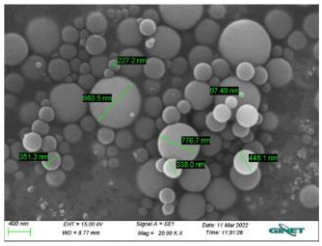
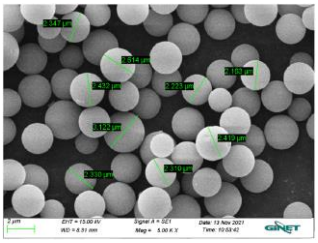
稳定性、散热效率的要求持续升级，日益成为支撑 AI 算力设施核心性能要求与迭代升级的关键材料之一。

高性能球形硅微粉在 AI 服务器中的应用示例



①高性能球形硅微粉

雅都玛等日系厂商曾长期占据高端球形硅微粉市场的技术主导地位，公司凭借长期的研发攻关和技术积淀，不断突破多项核心技术瓶颈，打破外资厂商的主导地位，并在覆铜板用功能性填料领域建立起领先地位，成为少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业。公司高性能球形硅微粉包括火焰法球硅、直燃法球硅和化学法球硅三类产品，性能和单价依次上升，产品形态及性能差异对比如下：

火焰法球硅	直燃法球硅	化学法球硅
		
①微米级颗粒，与直燃法球硅、化学法球硅相比，粒径分布较宽；②有小颗粒表面黏附和不规则颗粒	①亚微米级颗粒，粒径分布窄、填充率高、大球及空心球含量低、流动性好、易分散；②球形度和球化率较火焰法球硅高	①微米、亚微米到纳米级颗粒，单分散均匀颗粒，无团聚；②球形度和球化率接近100%

公司三类高性能球形硅微粉产品制备技术路线、核心性能指标及下游应用场景存在明显差异：火焰法球硅因采用天然矿物粉体高温熔融球化工艺，在粒径分布等指标方面存在技术上限，无法单独满足 M6 等级或以上级别高速覆铜板的性能要求，通常需与直燃法球硅或化学法球硅配合使用。直燃法球硅通过金属硅粉与氧气燃烧气化凝结而成，具有粒径分布窄、填充率高、大球及空心球含量低、流动性好、易分散等特性，适配高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）等对高密度互联和轻薄化要求较高的领域。在 M8、M9 及以上高等级高速覆铜板中，对粉体材料的性能要求进一步跃升，需实现低介电常数、超低介质损耗、极窄分布、超高球形度、高球化率，因火焰法球硅粒径分布相对较宽、易产生非球形不规则颗粒，直燃法球硅难以精准调控亚微米或纳米级粉体粒径等局限，与该等高端应用场景的适配性有限，而化学法球硅依托前端原料合成技术予以性能突破，可实现球形度、球化率、纯度近 100%的高技术标准，成为适配于 M8、M9 及以上等级的新一代高速覆铜板性能需求的核心关键材料之一。

②角形硅微粉

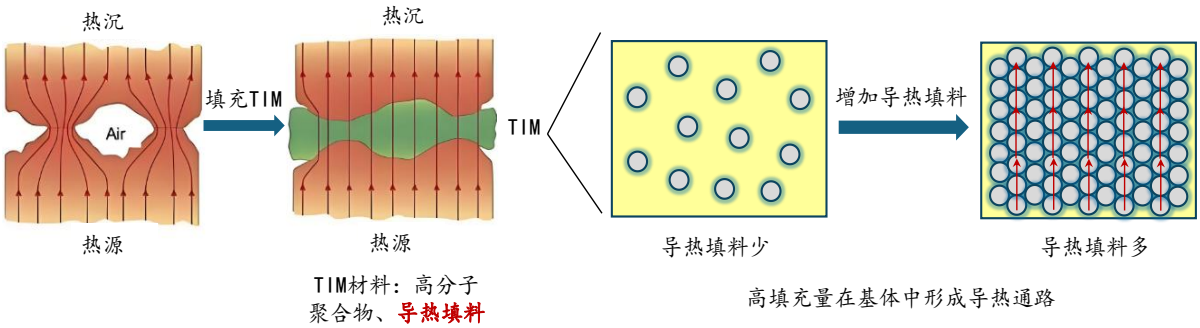
公司软性复合填料、熔融硅微粉等角形硅微粉产品由玻璃熔块、碎玻璃片、熔融石英等原材料，经过超细研磨、精密分级、表面改性等工艺制造而成，其中，软性复合填料具有莫氏硬度低、磁性异物含量少、尺寸稳定性好、耐热性好等特点，主要应用于白色家电、一般车规级和其他普通 PCB 用覆铜板；熔融硅微粉介电常数及介质损耗低，主要用于 M2 至 M4 等级的高速覆铜板、低阶 HDI 用覆铜板等领域。公司依托微纳加工、表面改性等技术优势构建领先产品性能，并积极推进角形硅微粉产品的跨领域应用布局，致力于通过价值赋能提升成熟产品的

溢价空间。

（2）导热散热功能材料

公司导热散热功能材料产品主要包括氮化铝、氮化硼等高导热氮化物，以及球形氧化铝、角形氧化铝等导热氧化铝产品，主要应用方式是以粉体形态均匀填充至以有机高分子聚合物为基底的导热界面材料中，如导热凝胶、导热垫片、导热硅脂、导热灌封胶等，从而在聚合物中形成热流的传导路径，使热量能够沿着导热网络从热源传递到散热器，提升整体导热性能。导热界面材料通常涂敷在散热器件与发热器件之间，用于排除界面空气、降低接触热阻、建立高效热流通道，是实现热管理的关键材料。公司以高导热氮化物为代表导热散热功能材料因具有高导热系数、高流动性、高填充率等特点，已成为导热界面材料的核心原材料。

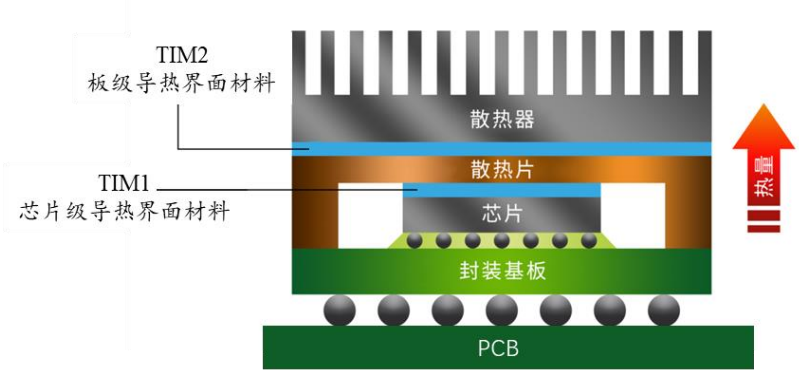
导热粉体填料在导热界面材料中的应用场景



①氮化铝

氮化铝粉体是高性能导热材料，适配于 8-16W/（m k）及以上的高导热场景。随着 AI 算力设施、先进封装、5G/5G-A 通讯等超高功耗、高热流密度场景的迅速发展，氮化铝被广泛应用于 AI 服务器散热模组，存储芯片、手机芯片等半导体封装领域以及通讯基站、汽车域控制器等高端散热场景，迎来广阔发展前景。以 AI 服务器为例，填充氮化铝的高导热凝胶适配 GPU 等高端芯片散热结构，有效降低界面热阻并显著提升整体导热散热性能。

导热界面材料在 AI 设备芯片散热领域的应用



资料来源：Heraeus、根据公开信息整理

高性能氮化铝粉体市场此前长期由日本、欧美等外资厂商主导，公司依托表面改性技术优势，创新性应用双重改性工艺，较早攻克了氮化铝易水解的行业应用难题，实现了国产高端氮化铝产品的批量供应，有效打破了国外垄断。立足于对行业应用的深度洞察，公司持续向高性能氮化铝技术领域深入探索，已掌握造粒氮化铝制备技术。同时，随着下游应用领域对性能需求的持续提升，大单晶氮化铝凭借单晶尺寸大、导热系数高、粘度低等优异性能，已成为下一代高性能氮化铝材料的主流发展方向，此前仅日本厂商掌握相关技术工艺，技术壁垒较高。公司通过对配方体系、烧结助剂的精准调控及烧结工艺的系统性优化，不断突破合成端一次性长晶核心技术瓶颈，已储备导热性能优于造粒氮化铝的大单晶氮化铝产品。此外，为匹配下游应用领域对材料高导热、高模量等性能需求，公司亦同步开展特殊形态氮化铝等前沿产品探索，进一步实现在高端材料领域的延伸拓展。

②氮化硼

氮化硼粉体核心优势在于“低介电、低损耗、高导热”特性，其理论热导率可高达 300 W/（m k），同时耐高温、质轻密度低、化学稳定性优异，是一类兼具低介电性能与高导热性能的高端导热散热材料。公司依托持续的研发攻坚与自主创新，实现高性能氮化硼产品的国产化量产，有效推进了高性能氮化硼材料的国产替代进程。公司氮化硼产品主要用于低介电导热胶等导热界面材料、导热 PI（聚酰亚胺）膜和高频高速高导热覆铜板领域，在导热界面材料中，氮化硼既可高效传输热量，又可避免信号干扰；在高频高速高导热覆铜板领域，其与有机树脂复合，可满足高频高速信号传输和高导热的性能要求；在导热 PI 膜领域，

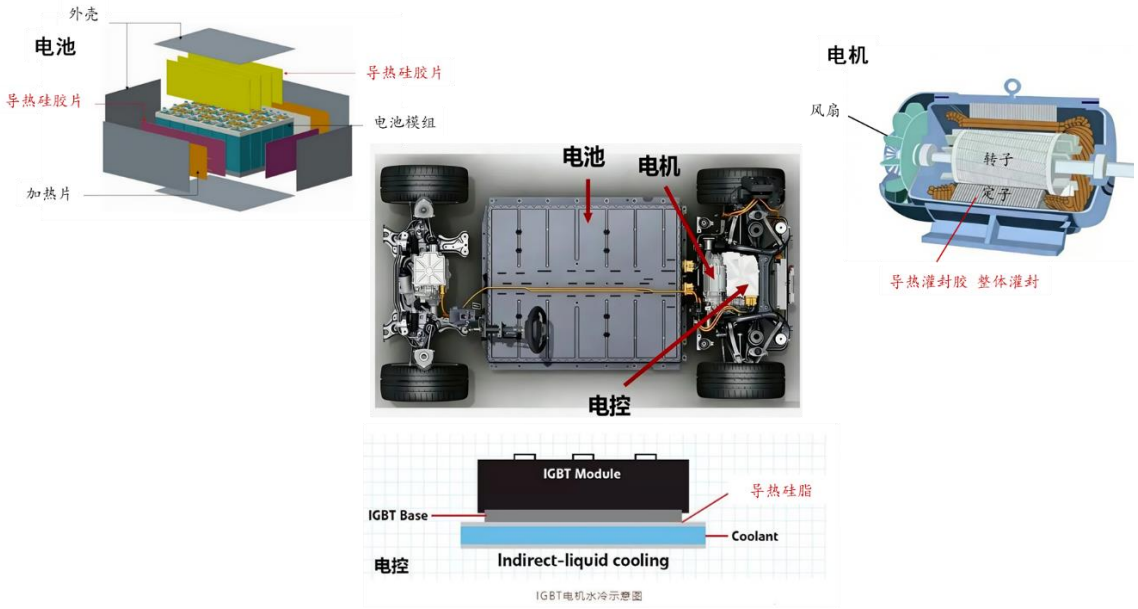
氮化硼凭借片状结构拉伸优势，可制备柔性 PI 导热膜，最终实现低介电、低损耗、高导热、高绝缘等功能，终端用于 AI 设备、5G/5G-A 通讯基站、信号天线、卫星通讯模组等高端应用场景。

氮化硼的结晶分子结构决定其典型的片层状形貌特征，容易引发填充率下降、基材表面附着力差等问题。针对这一应用瓶颈，为匹配下游领域对兼具高速信号传输性能与高导热特性的先进材料的技术迭代与产品升级需求，公司通过持续研发攻关，逐渐突破纳米化、晶相精准调控等技术难点。针对覆铜板领域“低介电、低损耗、低热膨胀系数、高导热、高模量”的核心迭代需求，对标下世代高速覆铜板的严苛应用性能要求，公司进一步实现技术突破，不仅开发多元形貌的氮化硼功能粉体，更在行业内创新性开发共晶型复合导热材料等高端产品。

③导热氧化铝

导热氧化铝粉体是一种适配于中档导热需求领域的无机导热粉体材料，主要应用于新能源汽车、消费电子、通信基站等领域。以新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）散热需求为例，导热氧化铝粉体通常被填充至导热凝胶、导热垫片、导热硅脂、导热灌封胶等导热界面材料中，涂抹于电池热管理模块、电控单元 IGBT 模组与散热结构的接触界面，或对驱动电机定子铁芯等核心发热部件进行整体灌封，进而降低界面热阻、构建热传导路径，使热量更高效地从热源传递到散热介质，保障其长期安全稳定运行。随着新能源汽车、消费电子、通信基站等下游应用领域技术持续迭代，核心器件及模组的功率密度与集成度不断攀升，使得设备运行过程中热量快速积聚，进而催生出更高导热需求。公司球形氧化铝产品球化率达 95%，同时经过表面改性处理填充率显著提升，填充在导热胶等导热界面材料中，导热系数可达到 1-6W/（m ｋ）左右，具有较好的导热性能，可精准适配该等中档应用领域的进阶散热需求。

导热界面材料在新能源汽车中的应用



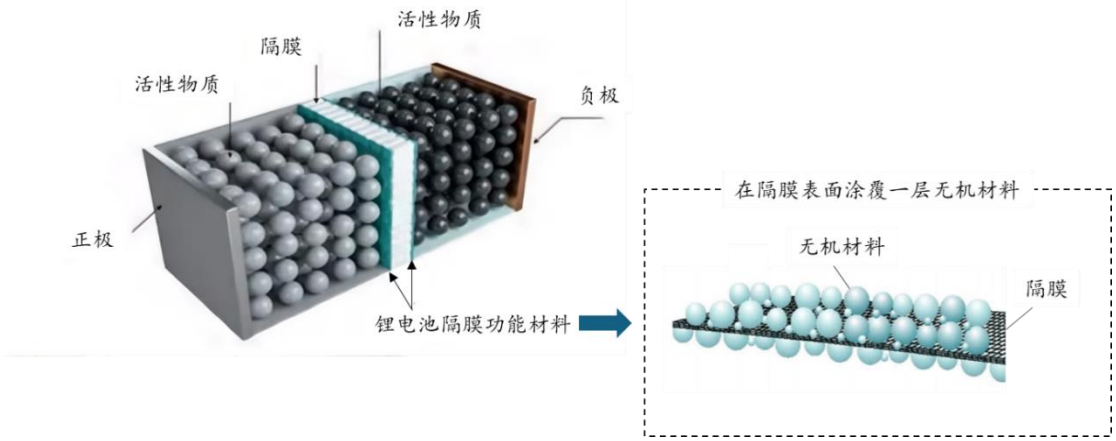
资料来源：粉体圈、山西证券研究所、根据公开信息整理

（3）其他产品

①锂电池隔膜功能材料

锂电池隔膜是锂电池的核心功能组件之一，其核心作用是物理隔离电池正负极以防止短路，同时形成锂离子传输通道，保障电解液中锂离子的顺畅迁移，是维系电池充放电循环的关键屏障。公司锂电池隔膜功能材料同时适配干法与湿法隔膜工艺，通过对隔膜基材进行表面涂覆，可以显著提升隔膜的热稳定性、安全性、浸润速度、电解液吸收能力及离子传导效率。此外，公司前瞻性储备介孔氧化铝产品，该产品凭借纳米级介孔结构（孔径 2-50 nm）所赋予的高比表面积、可调孔道结构及优异热稳定性，可有效拓宽电解液的扩散通道，对于低温环境下锂电池的动学性能有较大提升。公司依托长期形成的平台技术积淀与工艺积累，可聚焦下游锂电领域龙头客户需求，持续迭代并推出适配性新产品，具备差异化竞争优势。

锂电池隔膜功能材料在隔膜涂覆中的应用



资料来源：观研天下、ResearchGate、根据公开信息整理

②涂料功能材料

涂料在金属、建材、机械等各类基材表面形成连续的保护膜，其防腐、防锈、耐磨等核心功能的实现，很大程度上取决于涂料配方体系中添加的功能性材料。从性能提升角度来看，传统有机添加剂难以兼顾涂层的机械强度、耐候性、化学稳定性、安全环保等多维度指标，而公司较早实现无机功能性粉体在涂料领域的创新性应用，自主开发的涂料功能材料凭借低光泽、高硬度、高透明、耐刮擦、耐腐蚀等性能优势，可有效替代有机消光剂，在改善并增强涂料消光性能的同时，赋予涂料增硬、防腐等特殊性能，且具有安全环保优势，适配先进涂料应用场景，为涂料材料拓展应用边界、突破性能瓶颈提供了材料支撑，亦为公司基于技术同源性，将无机功能性粉体拓展至其他创新性应用场景的典型示例。

③其他高端前沿领域代表性产品

公司其他高端前沿领域代表性产品包括芯片抛光液纳米氧化物、芯片封装功能材料、电子浆料等，上述产品具体情况如下：

产品名称	产品介绍	产品应用及产业化情况
芯片抛光液纳米氧化物	芯片抛光液纳米氧化物是针对芯片化学机械抛光（CMP）工艺需求，作为核心研磨颗粒添加于抛光液中的功能性材料，属于芯片先进制程抛光液的关键原材料。	公司自主开发的芯片抛光液纳米氧化物已成功应用于先进芯片制程抛光液产品，报告期内已实现小规模销售。 根据客户确认，公司系国内首家通过其认证的企业，公司产品各项性能处于国际领先水平。
芯片封装功能材料	作为功能性填料填充至环氧树脂等有机基材中，用于降低封装材料的热	公司针对液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）等高端环氧塑

产品名称	产品介绍	产品应用及产业化情况
	膨胀系数与固化收缩率，避免芯片在温度变化时因应力过大而引发的翘曲、开裂等失效风险，同步提升封装材料的介电性能和导热性能。	封料及底部填充胶（UF）等先进封装领域应用需求，已进行多项技术储备并陆续完成龙头厂商的认证。
电子浆料	电子浆料产品主要填充于微通孔中以构建起垂直互联的导电通道，实现电气连接和信号传输功能。	公司电子浆料产品已应用于高密度互联 PCB 板和下世代玻璃基板（TGV）通孔的金属化，报告期内已实现小规模销售。

3、主营业务收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类型的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、电子信息功能材料	**78,181.81**	**75.75**	**53,524.84**	**73.72**	**37,031.51**	**71.52**
高性能球形硅微粉	56,983.06	55.21	35,497.12	48.89	19,241.19	37.16
角形硅微粉	18,071.46	17.51	15,571.47	21.45	15,385.36	29.71
其他电子信息功能材料	3,127.28	3.03	2,456.24	3.38	2,404.96	4.64
二、导热散热功能材料	**13,126.16**	**12.72**	**10,602.26**	**14.60**	**7,682.41**	**14.84**
高导热氮化物	6,828.31	6.62	3,346.65	4.61	1,415.42	2.73
导热氧化铝	5,363.15	5.20	6,522.84	8.98	5,117.69	9.88
其他导热散热功能材料	934.70	0.91	732.77	1.01	1,149.31	2.22
三、其他新兴功能材料	**11,898.55**	**11.53**	**8,477.52**	**11.68**	**7,066.10**	**13.65**
合计	**103,206.52**	**100.00**	**72,604.62**	**100.00**	**51,780.03**	**100.00**

（二）发行人主要经营模式

1、研发模式

公司坚持以自主研发和底层创新为核心驱动力，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，秉持创新性技术研发与产业化应用相结合的理念，为市场提供匹配高端前沿技术路线的功能性材料解决方案。一方面公司深入龙头客户产品开发前端，紧跟下游技术迭代节奏，持续推进公司产品、技术、工艺、应用适配等创新升级，另一方面，公司基于对行业技术发展趋势的主动研判，围绕前沿技术、新兴产品领域开展前瞻性研究与储备，同时，公司深度挖掘平台型技术的拓展潜力，锚定高附加值、创新性应用前景领域进行横向延展。

经过多年技术研究和产业实践，公司已建立较为完善的自主研发体系，构建起平台型技术为核心基底，又各具目标分工明确的研发组织结构，组建起一支专业背景多元且经验丰富的研发队伍，同时，公司建立了规范的研发项目管理制度和研发设计流程，并较早启动 RDM 研发管理系统，对研发立项、方案策划、小样、中试、量产等关键环节进行流程管控，将持续的技术创新作为公司保持核心竞争力与高速发展的重要支撑。

2、采购模式

公司主要原材料包括有机硅球、氧化铝原料、火焰法球硅原料、氮化铝原料、碎玻璃片、直燃法球硅原粉、玻璃熔块等。公司主要采用“以销定产、以产定购”与合理备货相结合的采购模式，由采购部门统一管理采购事项。公司计划中心定期报送并动态更新物料需求计划，采购部门根据物料需求，结合销售订单、订单预测、现有库存及安全库存等因素综合研判，制定相应采购计划并实施采购，采购到货后经质量中心检验合格后入库。公司主要采用询价和比价的形式向供应商下达采购订单，同时与部分规模较大的主要原材料供应商签订了年度采购框架协议，可有效保证交付稳定性并控制成本。

公司建立了完善的合格供应商管理体系，综合评估考核供应商的经营规模、产品质量、产品价格、资金实力、生产资质等因素，经评审合格后方可进入合格供应商名录；对已合作的供应商，公司实行定期考核与动态管理，以此确保供应商体系稳定可靠，为公司生产经营与物料供应提供有力保障。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产+合理库存备货” 的生产模式，由计划中心负责生产任务的统筹与安排。营销中心将客户订单、订单交期及销售预测反馈至计划中心，计划中心对订单进行分解，编制物料需求计划和生产计划，交由制造中心完成生产任务；为确保供应稳定性并提高对客户需求的快速响应能力，公司会结合未来销售订单预测及安全库存量，对需求稳定、供货量较大的主要产品进行适当备货。质量中心根据公司产品质量技术要求，负责对产成品进行质量检验与品质监督，保障产品高质量交付。

公司生产任务以自主生产为主，同时为合理配置资源、解决下游产业高速发

展带来的自有产能不足等瓶颈，公司个别生产工序以外协加工方式作为产能补充，公司以自主拥有的核心技术，以及长期以来积累的工艺制备经验，对相关外协加工环节进行技术指导，实现对外协环节的工艺技术管控。

4、销售模式

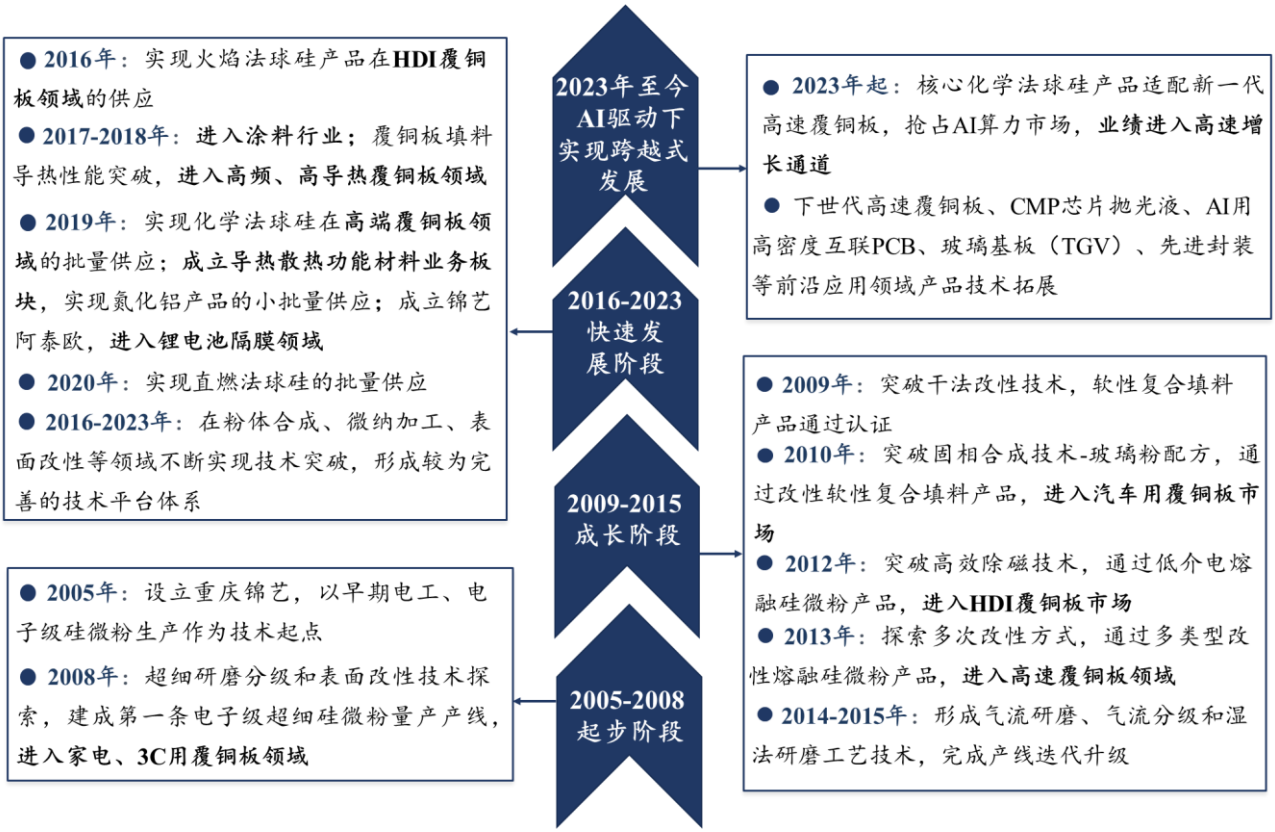
公司主要采用直销的销售模式。一般直销模式下，通过客户认证之后，客户直接将订单下达至公司，由公司安排库存和生产以完成供货，公司负责将产品运送至客户指定的仓库或其他收货地点。公司目前以境内销售为主，部分为境外销售。

公司组建了覆盖多应用领域的专业化市场服务团队，搭建起体系完善、运行高效的营销网络，能够精准洞察客户需求并提供定制化解决方案。公司坚持以下游客户需求为导向，依托具有深厚积淀和良好延展性的平台型技术，以及对粉体材料应用的深刻理解，可快速响应不同领域客户的差异化需求，同步适配新兴前沿技术领域产品性能的持续迭代升级需求，与下游应用领域龙头客户建立了长期稳定的合作关系。下游客户普遍对供应商建立了严格的认证准入机制，出于保障自身产品性能稳定性和一致性的考虑，客户在完成供应商遴选并经过长期验证合作后，通常不会轻易更换供应商。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

报告期内，公司系根据国家产业政策、市场及客户需求情况、产品生产特点以及行业惯例等情况采取目前的经营模式。公司自成立以来，一直专注于先进无机非金属粉体材料产品的研发、生产及销售。报告期内公司的主营业务、主要经营模式及前述公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计公司未来的经营模式不会发生重大变化。

（三）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况



1、第一阶段（2005-2008 年）：起步于电工级、普通电子级硅微粉产品，奠定提纯、研磨、分级等技术和工艺基底

公司的业务发展最早可以追溯至 2005 年成立的业务前身重庆锦艺。2005 年，伴随中国经济的蓬勃发展，手机、电脑等 3C 电子与家电产品在中国市场得到快速应用与渗透，硅工业产业市场热度较高。陈锦魁先生看好石英矿开采价值及硅工业发展前景，敏锐抓住这一发展契机，于 2005 年投资设立重庆锦艺从事硅料开采及深加工业务。重庆锦艺成立初期以电工级、普通电子级硅微粉产品起步，初步奠定了矿物提纯、研磨、分级等技术和工艺基础，为公司后续在电子信息领域硅微粉产品技术和业务发展积累了相关技术工艺、生产经验。

2008 年，公司在已有生产制造与技术工艺的基础上，通过研发团队的集中技术攻关，在超细研磨分级和表面改性方面取得一定突破。公司自主设计并组建了第一条用于生产电子级超细硅微粉的超细研磨、分级产线，同时结合对表面改性技术的初步探索成果，建成了国内为数不多的电子信息领域超细粉体改性生产线并实现量产，相关产品正式进入覆铜板用无机功能粉体填料赛道，主要配套家

电及常规 3C 产品用覆铜板的生产需求。

2、第二阶段（2009-2015 年）：深耕覆铜板用无机功能粉体填料领域，丰富产品技术体系，向覆铜板较高技术等级方向迭代发展

2009 年，公司在干法改性技术方面取得关键性突破，同时自主开发的软性复合填料产品正式通过客户认证。2010 年，公司在固相合成技术的玻璃粉配方领域取得突破，结合干法改性技术成果，开发出改性软性复合填料产品，并以此产品为切入点正式进入汽车用覆铜板市场。2012 年，公司在高效除磁技术领域取得突破，成功研制出兼具高纯度、小粒径、低磁性异物、低介电性能的熔融硅微粉产品，凭借该产品正式进入 HDI 覆铜板领域。为满足高速覆铜板多样化树脂体系与性能需求，2013 年，公司通过探索多次改性工艺路径，构建起适配高速覆铜板多元树脂体系的多类型的改性熔融硅微粉产品，成功进入高速覆铜板领域，相关技术成果亦为后续复配改性工艺研发奠定了技术基础。2014 年至 2015 年，公司在原有球磨生产线基础上，逐步构建气流研磨、气流分级及湿法研磨等工艺技术，完成产线的迭代升级。

公司重点围绕微纳加工、表面改性等技术群进行研发攻坚，依托持续增强的技术创新能力，公司不断推出多种规格产品以满足细分领域客户差异性需求，逐步进入车规级覆铜板、HDI 覆铜板、高速覆铜板等较高技术等级的覆铜板市场，与台光电子、联茂电子、台燿科技、日本松下等覆铜板领域龙头客户建立合作关系，实现快速成长。

3、第三阶段（2016-2023 年）：搭建完善的技术平台体系，深化高端化发展，锚定高附加值领域实现多元化布局

2016 年起，依托于关键核心技术的长期攻关，公司在高性能球形硅微粉产品领域不断突破，开发化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅产品，成为少数同时掌握三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业。公司高性能球形硅微粉产品性能达到行业领先水平，满足高等级高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用高端覆铜板性能指标要求。其中，发行人直燃法球硅产品已实现对日资份额的进口替代，火焰法球硅、化学法球硅为聚焦于覆铜板领域的创新性应用适配或创新性技术开发，具有国产替代与行业领先优势。

公司以电子信息领域相关产品为起点，对具有技术同源性的多种无机非金属材料在其他领域的应用需求进行拓展性开发，锚定高附加值应用领域，逐步实现多元化产品布局。2017 年，公司以特化导热性能的覆铜板用无机功能粉体产品进入高频、高导热应用方向覆铜板用无机功能粉体领域，并在已取得的导热技术成果的基础上持续发力，逐步开发出导热氧化铝、氮化铝、氮化硼等多款产品，并于 2019 年与汉高、莱尔德等国际知名导热界面材料厂商建立合作关系，正式成立导热散热功能材料业务板块。结合先进涂料、锂电新能源等领域的原材料需求，公司产品技术亦拓展至涂料、锂电等多个行业。

随着高端应用场景对无机功能粉体材料性能要求的持续升级，仅对粉体进行微纳加工、表面改性等后端工艺处理，已逐步接近产品性能提升的极限，亟需向难度系数更高的原料开发端进行技术延伸，依托粉体合成技术实现产品性能的突破。公司深耕主业的同时，不断夯实技术平台建设，构建了覆盖粉体合成、微纳加工、表面改性的完善核心技术体系。凭借全链条技术优势，公司积极配合下游客户产品迭代与产品性能升级，不断巩固在多领域、多行业的创新性拓展应用与市场竞争力，实现业务规模的快速发展。

4、第四阶段（2023 年至今）：紧握行业发展机遇，积极储备下世代技术产品，在 AI 驱动下实现跨越式发展

2023 年被誉为“生成式 AI 元年”，在全球科技产业向智能化、高性能化、集成化演进的背景下，新型 AI 应用的快速兴起，推动以 AI 服务器为代表的算力基础设施市场高速发展，高等级高速覆铜板、高阶 HDI 用覆铜板需求大幅攀升。伴随 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等算力设施持续向高传输速率、低信号衰减方向迭代，对上游功能性粉体材料的使用需求朝着更高规格等级、更高填充比例不断演进，公司化学法球硅产品适配高等级高速覆铜板性能要求，凭借多年来在高性能球形硅微粉领域构建的领先优势，公司紧握 AI 产业变革机遇，业绩实现高速增长，并在高等级高速覆铜板用功能性填料领域建立起领先地位。

公司依托自身平台型技术积淀与市场资源能力，锚定下游高附加值、高端前沿领域持续深耕。例如在电子电路基板领域，针对下世代高速覆铜板性能需求，公司进一步开发更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等前沿产品，同时战略性

储备 AI 用高密度互联 PCB、下世代玻璃基板（TGV）用电子浆料等产品，为进一步夯实在电子信息领域的行业地位奠定坚实基础。在 IC 先进制造与封装领域，公司已布局先进制程芯片抛光液纳米氧化物、2.5D/3D、HBM 领域先进封装功能材料等产品，不断强化产品技术升级与场景适配能力。公司构建起覆盖多技术赛道、多应用场景的产品矩阵，不仅有效拓宽了业务边界，亦为进一步巩固行业地位并实现跨越式发展提供了核心驱动力。

（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

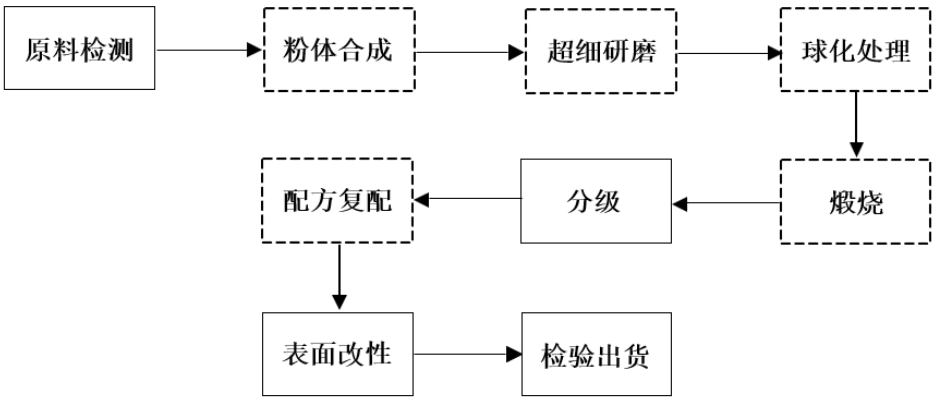
公司主要从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售。报告期各期，公司营业收入分别为 51,950.91 万元、72,857.24 万元和 103,586.02 万元，近三年复合增长率为 41.21%，公司主要业务经营情况良好，经营业绩呈现快速增长趋势。

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域，经过二十余载自主研发和创新实践，构建了以粉体合成技术群、粉体微纳加工技术群、表面改性技术群为核心，以配方技术、自动化控制系统开发技术为补充的核心技术体系。公司主要产品的生产制造均运用了自主研发的核心技术，报告期各期应用核心技术实现的产品收入分别为 51,416.02 万元、71,655.46 万元和 100,838.03 万元，占主营业务收入的比例分别为 99.30%、98.69%和 97.71%，公司核心技术产品收入占比较高且保持稳定，公司核心技术已充分实现产业化。

（五）主要产品的工艺流程图

公司产品生产过程主要涉及粉体合成、微纳加工及表面改性三大关键工艺环节。其中，粉体合成工序从原料端实现粉体性能突破或原料自给；微纳加工工序通过球化、研磨、分级等处理，在微米、纳米级范畴精准调控粉体形貌、粒径（如球形/角形、粒径大小、分布）等物理表征；表面改性工序则用于解决无机粉体与有机基材的界面结合力与相容性问题。发行人产品系由多段生产工序组合生产而成，因具有技术同源性，不同产品部分生产工序相同或相似，同时又因下游应用场景及性能需求的不同，不同细分产品在具体生产工序及核心技术应用上亦存在一定差异。

公司主要产品工艺流程如下：



公司主要生产工序及技术特点如下：

序号	工序名称	主要内容	技术特点
1	粉体合成	针对性应用化学合成、水热合成、自蔓延燃烧、固相合成、超临界合成等技术合成不同类型粉体原料。	公司是业内少数同时掌握化学合成、水热合成、自蔓延燃烧、固相合成、超临界合成等多项粉体合成技术的无机功能粉体供应商，可依托粉体合成技术在原料端实现产品性能突破或原材料自给及降本增效。
2	超细研磨	应用不同研磨技术对大颗粒粉体进行粉碎、研磨等加工处理，使粉体粒径大小在微米、纳米级范畴符合既定需求水平，并在研磨过程中，通过自主设计的特定设备持续除磁。	①公司掌握球磨、气流磨、蒸汽磨等多种高效研磨技术，可针对不同性质、形态、粒度、硬度的材料进行研磨处理； ②相较于业内一般的微米级研磨技术，公司具备更高精密度的纳米级研磨技术能力； ③除磁后，公司产品磁性杂质水平能够达到＜1ppm 级别。
3	球化处理	应用不同球化处理技术，制备出具备球形/球状形态的粉体颗粒。	①公司是业内少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业，产品性能达到行业领先水平： 火焰法球化环节通过改进的球化工艺控制及超细干粉超分散等处理，使得粉体纯度高、球化率高、收率高、比表面积可控、流动性好； 直燃法球化环节通过燃烧器和冷凝器的特殊设计，结合特殊改性与分级技术，能够有效减少空心球、大球含量，并解决粉体表面羟基较多、易团聚等问题； 应用化学法制备的粉体纯度高、球化率高，且粉体粒径分布窄、分散度高。 ②公司制备的氮化铝球形颗粒，具有球化率高、收率高、分布窄、含水量低等性能优势。
4	煅烧	通过应用特定煅烧技术对粉体进行煅烧处理，去除粉体表面有机基团，使其转变为无机粉体；或去除粉体表面水分、	①运用自主研发的梯度煅烧技术，使得粉体转变为无机粉体，并解决粉体表面不光滑有缺陷等问题；另一方面高效脱除粉体表面极性水分、羟基及杂质，优化粉体性能；

序号	工序名称	主要内容	技术特点
		可燃性杂质；或进行特定的排胶、氮化保护等处理，使得粉体致密化并提高纯度。	②通过特定煅烧技术促进粉体的致密化、提高纯度、优化晶体结构，进而提高氮化铝粉体的导热性能；且煅烧工艺温度均匀性控制好，产出物料的一致性高。
5	分级	通过应用特定分级技术去除大颗粒粉体，并实现小粒径粉体的分离，以收得粒径分布更窄的粉体。	具备气流分级、蒸汽分级等多种分级技术，可实现精密度更高的亚微米级、纳米级精密分级能力。
6	配方复配	将不同品类、不同粒径的粉体通过特定配方进行混合搭配，以提升粉体填充率，实现更优粉体性能。	公司掌握多种粒径、多元粉体复配配方技术，使产品在下游应用中实现高填充、高导热、低粘度、高稳定等优异性能。
7	表面改性	使用带有特殊基团的改性剂，搭配特定改性配方及改性工艺技术，在粉体表面赋予特殊的功能性基团，进而提升无机粉体与有机体系的界面结合力和相容性。	公司掌握超过 30 种改性反应机理，对超过 10 种树脂配方体系有着深刻理解，拥有干法改性、湿法改性、蒸汽改性、气相改性、复配改性多种改性技术路线，可有效改善粉体的流变性、高纯度、高分散性等性能，提升无机粉体与有机基材的相容性，并满足不同应用领域的定制化改性需求。

（六）报告期各期具有代表性的业务指标及变动分析

根据公司所处行业及自身业务特点，营业收入、净利润、毛利率和研发费用是具有代表性的业务指标，报告期各期具体指标数据及变动如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入（万元）	103,586.02	72,857.24	51,950.91
营业收入增长率	42.18%	40.24%	/
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	16,354.92	8,748.54	6,479.43
扣非归母净利润增长率	86.94%	35.02%	/
综合毛利率	34.04%	30.87%	30.55%
研发费用（万元）	4,210.85	3,420.40	2,793.28
研发费用增长率	23.11%	22.45%	/

公司业务指标变动分析分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”、“（四）毛利及毛利率分析”、“（五）期间费用分析”。

（七）公司主营业务和产品符合产业政策和国家经济发展战略的情况

1、属于国家重点支持的新材料产业，符合国家产业政策

公司主要从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售，公司主营业务和产品属于国家重点支持的新材料产业，多款产品符合国家及相关主管部门颁布的重点新材料产业指引名录和政策文件，具体情况详见本节之“二、公司所处行业的基本情况及竞争状况”之“（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策”之“2、行业主要法律法规政策”。

2、深耕 AI 算力上游关键原材料，赋能新质生产力高质量发展

随着 AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算等新兴产业的快速发展，算力基础设施建设持续提速，AI 算力中心等超高速、高密度、高功率应用场景快速落地，带来上游关键材料的结构性升级。高等级高速覆铜板、高阶 HDI 用覆铜板等高性能板材作为电子电路的核心基材，是保障 AI 算力设施高速运行的“性能基石”；同时伴随高密度、高功率算力终端持续扩容，高导热电子导热胶等导热界面材料对于算力集群高效散热与稳定运行至关重要。公司先进无机功能性粉体材料是上述高端覆铜板、高导热界面材料的核心原材料，其中，公司化学法球硅产品可在当前最高规格等级的 M8 及以上高等级高速覆铜板中得到广泛应用，终端应用于英伟达、亚马逊等国际知名科技企业的 AI 服务器、高阶通用服务器等 AI 算力基础设施；公司高导热氮化物产品已实现国产化量产，打破高端导热材料国外垄断，可批量应用于 AI 服务器，存储芯片、手机芯片用半导体封装等先进产业领域。公司基于技术同源性，亦将无机功能性粉体材料横向拓展至锂电新能源、半导体制造与封装等多个新兴应用场景，为下游产业链的稳定发展提供关键材料保障。

公司立足 AI 算力等先进产业链上游核心环节，以关键材料性能突破、国产化批量供应为根基，为 AI 人工智能等新质生产力的高质量发展与迭代升级提供重要材料支撑，符合国家创新驱动发展战略。

二、公司所处行业的基本情况及竞争状况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司的主营业务为先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售。根据国家

统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司业务属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.5 矿物功能材料制造”之“3.4.5.4 功能性填料制造”。根据国家发改委颁布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，公司主营业务和产品属于“先进基础材料”之“四 先进无机非金属材料”之“（三）先进陶瓷粉体及制品”。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策

1、行业主管部门、自律组织及监管体制

发行人所在行业主管部门为国家发展和改革委员会与工业和信息化部。国家发展和改革委员会的主要管理职责和内容为综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控。工业和信息化部的主要管理职责和内容为负责工业行业和信息化产业的监督管理，组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

公司所属行业大类非金属矿物制品业的行业自律组织是中国非金属矿工业协会（CNMIA）。中国非金属矿工业协会于 1987 年 8 月经中华人民共和国民政部批准成立，是全国非金属矿生产加工、研究开发、科技教育、服务贸易以及相关业务组成的行业性社会组织，主要负责配合政府作好宏观调控政策的组织实施和跟踪工作，积极推进行业结构调整；开展行业基本情况动态调查研究，组织行业订立行规行约，建立行业自律机制；参与制订、修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范，组织推进和贯彻实施。

行业内企业一般也会加入与下游应用领域相关的行业协会。中国电子材料行业协会（CEMIA）成立于 1991 年，是从事电子材料行业相关的企事业单位和社会组织自愿结成的全国性、行业性社会团体，主要职责为：进行电子材料相关行业调查，掌握行业状况；提供电子材料行业相关信息咨询等服务；协助政府部门

推动行业质量管理和监督；帮助企业开拓市场，开展国内外经济技术合作与交流活动；加强行业自律工作；经有关部门批准组织新产品鉴定、科研成果评审，对企业和个人的业务能力水平评价等。中国电子材料行业协会下设覆铜板材料分会等十余个分会。

2、行业主要法律法规政策

发行人所处行业、主要产品属于国家战略性新兴行业、国务院和国家发改委重点支持的产业以及行业主管部门重点支持的品类。相关文件和条款如下：

序号	文件名称	颁布单位	颁布时间	相关条款原文
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	全国人大常委会	2026 年 3 月	加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展。 高端新材料：加快高端特殊钢、高品质高温合金、超高纯金属、先进陶瓷、高纯石英材料、生物基材料、先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、结构功能一体化材料等创新突破。
2	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	中国共产党中央委员会	2025 年 10 月	培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
3	新材料中试平台建设指南（2024—2027 年）	工信部、发改委	2024 年 9 月	新材料中试平台建设重点领域 4.无机非金属 关键共性技术：高性能人工晶体生长及加工技术、高纯石英制品先进合成技术、高性能陶瓷粉体制备及烧结技术、功能性超硬材料制备关键技术等。关键材料：特种陶瓷材料、高纯石英砂及高性能石英玻璃制品等
4	工业重点行业领域设备更新和技术改造指南	工信部办公厅	2024 年 5 月	电子元器件和电子材料行业设备更新目标：重点针对电路类元器件、连接类元器件、机电类元器件、传感类元器件、光通信器件、关键电子材料等细分领域，推动更新主要生产检测设备。争取到 2027 年，部分领域行业龙头企业的设备水平达到世界一流。

序号	文件名称	颁布单位	颁布时间	相关条款原文
5	工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见	工信部、科技部、国务院国资委等	2024 年 1 月	推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。
6	重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）	工信部	2023 年 12 月	序号 142- 电子级超细高纯球形二氧化硅
				序号 137-高纯氧化铝及球形氧化铝粉：（1） 高纯氧化铝（4N）；（2） 高纯氧化铝（5N） ；（3）球形氧化铝粉（4）高导热氧化铝粉体
				序号 138-氮化铝粉体、 陶瓷件及基板：（1） 高纯氮化铝粉体（2） 氮化铝陶瓷件（3） 高导热氮化铝基板
7	产业结构调整指导目录（2024 年本）	发改委	2023 年 12 月	将“半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”列为鼓励类； 将“高纯纳米级球形硅微粉、中空球形硅微粉、高导热纳米及大单晶陶瓷材料、锂电池隔膜用纳米陶瓷粉体材料” 列为鼓励类。
8	工业战略性新兴产业分类目录（2023）	工信部	2023 年 8 月	3.4.5.4 功能性填料制造：电子级硅微粉功能填料；芯片级硅微粉功能填料
				3.6.4.2 无机纳米材料制造：氮化合物纳米粉体原料（氮化硼）
				3.4.2.2 功能陶瓷制造：高导热陶瓷
				3.3.5.4 电池膜制造：锂电池隔膜
9	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	十三届全国人大四次会议	2021 年 3 月	推动高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破。
				聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
10	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长	发改委、科技部、工信部、财政部	2020 年 9 月	二、（四）加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，

序号	文件名称	颁布单位	颁布时间	相关条款原文
	点增长极的指导意见》			加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
11	《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》	工业和信息化部办公厅	2020年9月	无机非金属新材料：重点形成集计算、实验、数据为一体的材料研发设计以及智能分级、改性、生长、加工、应用等集成系统解决方案提纯。
12	战略性新兴产业分类（2018）	国家统计局	2018年11月	3.新材料产业 之 3.4 先进无机非金属材料 之 3.4.5 矿物功能材料制造 之 3.4.5.4 功能性填料制造
				1.2.3 高储能和关键电子材料制造 之 3985 电子专用材料制造 之 高端专用陶瓷材料
				3.4.2.2 功能陶瓷制造-3073 特种陶瓷制品制造-高导热陶瓷
				3.3.7.1 涂料制造 2641* 涂料制造-粉末涂料
13	新材料关键技术产业化实施方案（发改办产业[2017]2063号）	国家发改委	2017年12月	序号13-电子信息用关键材料-氮化铝粉体材料：粉体粒度分布D10≤0.65μm、D50≤1.3μm、D90≤3.0μm、比表面积≥3.0m2/g，纯度O≤0.85wt%、C≤300ppm、杂质总含量≤1.00wt%。
14	关于印发“十三五”材料领域科技创新专项规划的通知（国科发高[2017]92号）	科技部	2017年4月	（二）战略性先进电子材料，……抢占先进电子材料技术的制高点……前沿交叉电子材料……有机\无机集成电子材料和器件
				（五）先进结构与复合材料 9. 金属与陶瓷复合材料。先进铝基、钛基、铁基等金属基复合材料，金属层状复合材料，碳化硅、氧化铝、氮化硅和氮化硼纤维及复合材料，耐高温陶瓷基复合材料，低成本碳/陶复合材料等。
15	《<信息产业发展指南>解读：基础电子》	工业和信息化部	2017年2月	二、重点领域，“十三五期间，基础电子产业将优先发展基于重要整机需求和夯实自身根基等目标的相关领域，包括……新型印制电路板及覆铜板材料和光刻机、PECVD、丝网印刷设备、电池涂覆/卷绕/分切设备、显示成套设备等。”
16	战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）（国家发改委公告2017年第1号）	国家发改委	2017年1月	通信系统用高频覆铜板及相关材料
				2.7.3 新型结构陶瓷材料：透明氧化铝材料，高纯氧化锆材料，新型超硬材料（氮化硅、氮化硼、碳化硼）
				2.6.2 新型功能陶瓷材料..超导电陶瓷材料，高导热陶瓷材料…
17	战略性新兴产业	国家发改委	2017年1月	3.1.2 新型功能陶瓷材料 热电陶瓷

序号	文件名称	颁布单位	颁布时间	相关条款原文
	重点产品和服务指导目录（2016年版）			材料，压电陶瓷材料，铁电陶瓷材料，介电陶瓷材料，超导电陶瓷材料，高导热陶瓷材料
18	《新材料产业发展指南的通知》	工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部	2016年12月	发展新材料要发展先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料，要紧紧围绕新一代信息技术产业、高端装备制造业等重大需求，以高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、新型能源材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用，研究氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化铝、氮化硅等陶瓷粉末、片材制备方法，提高材料收得率与性能一致性。

3、对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等方面的主要影响

发行人所属的先进无机非金属材料行业是国家重点鼓励发展的先进基础材料产业，国家产业政策对促进行业的积极发展具有重要作用。目前，《新材料中试平台建设指南（2024—2027 年）》《战略性新兴产业分类（2018）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》等一系列国家、地方和行业政策的推出，对多层次、多领域的新材料产业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，以及全方位、全产业链的指导，为发行人及其所属行业的经营发展带来了积极影响。

公司所属的先进无机非金属材料行业具有产业规模大、市场高度细分等特点。在高性能粉体材料领域，日本雅都玛、日本龙森、日本电化株式会社、日本德山、法国圣戈班等外资厂商此前长期占据全球主要供应份额。相比而言，我国先进无机非金属材料行业起步较晚，在技术先进性、产业链自主化水平、专业人才储备等方面与国际头部企业仍存在一定差距。现阶段，国家、地方、行业等多维度政策支持，为新材料产业的快速发展创造广阔机遇，同时对发行人等具备自主创新能力、掌握关键核心技术的企业未来的高速发展提供强有力支撑。

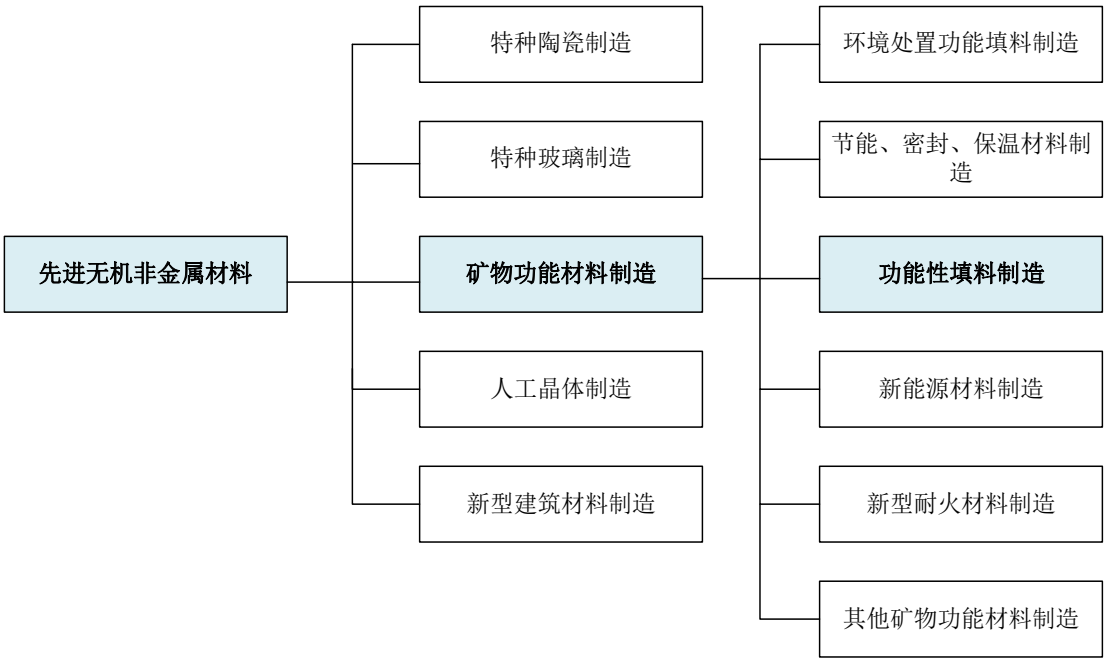
（三）行业发展概况

1、公司所处行业发展概况及发展趋势

（1）先进无机非金属材料行业

无机非金属材料是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料，是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料品种和名目繁多、用途各异，通常分为传统无机非金属材料和先进无机非金属材料两大类，其中，传统无机非金属材料包括水泥、耐火材料、玻璃材料以及陶瓷材料等，是工业和基本建设所必需的基础材料；先进无机非金属材料是经先进制备技术加工而成，具备高性能和特殊光、电、热等性能和用途的新型材料。

先进无机非金属材料作为新材料产业的重要组成部分，凭借其高绝缘、高强度、高硬度、耐腐蚀的特点以及在导电性、导热性、磁学特性、光传输性等方面的性能优势，已成为支撑国家电子信息、新能源、高端装备制造、国防现代化等战略性新兴领域发展和新技术、新产业、传统工业技术升级的关键材料基础。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，先进无机非金属材料产业可分为特种玻璃制造、特种陶瓷制造、人工晶体制造、新型建筑材料制造和矿物功能材料制造五大领域，其中发行人所属行业为矿物功能材料制造领域中的功能性填料制造行业。



近年来，伴随国家对于新材料等战略性新兴产业的大力支持，叠加 AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算、低轨卫星、半导体制造与封装、新能源等领域蓬勃发展所引领的技术迭代创新和新一轮产业变革，下游市场对新材料产品需求呈现“高端化、高性能化”趋势，包括先进无机非金属材料产业在内的新材料领域迎来重要的发展机遇期。根据工业和信息化部数据，2023 年我国新材料产业总产值达到 7.9 万亿元，2024 年产业总产值突破 8 万亿元，2025 年将突破 10 万亿元大关，连续 15 年保持两位数增长。根据中国报告大厅《2025-2030 年全球及中国新材料行业市场现状调研及发展前景分析报告》预测，2030 年我国新材料产业总产值将进一步攀升至 18.5 万亿元。

先进无机非金属材料在我国新材料产业快速发展的总体背景下，同样保持了良好的市场规模增长态势。在新一代信息技术、新能源、高端装备制造等新质生产力加速发展以及与传统产业快速融合的背景下，材料基础研究、技术创新和推广应用的重要性日益突显，下游高端应用场景的发展为先进无机非金属材料产业发展注入新动能，推动高性能先进无机非金属材料的增量需求。目前，先进无机非金属材料下游应用领域已从传统的建材、陶瓷领域延伸扩展至 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、低轨卫星、半导体制造与封装、新能源等战略性新兴产业，未来市场空间广阔。

（2）电子信息功能材料相关行业

1）覆铜板用无机功能粉体填料行业

①覆铜板用无机功能粉体填料介绍

覆铜板用无机功能粉体填料是一类以二氧化硅等无机矿物质为原料，经提纯、研磨、分级等加工工序制成的粉体材料，主要添加至有机树脂胶液中，为覆铜板提供更优介电性能、尺寸稳定性、耐热性、绝缘性等关键性能，目前已成为覆铜板中除铜箔、树脂、玻纤布之外的第四大关键原材料。无机功能粉体填料体系中，硅微粉是以二氧化硅（SiO_2）为主要成分的无机非金属粉体材料，具有低介电、低线性膨胀系数、高耐热、高绝缘等多种优良性能，已成为覆铜板领域应用最为广泛的一类材料。硅微粉等无机功能粉体填料在覆铜板树脂体系中的用量占比通常达到 30%，部分高端产品用量占比可达 50%-60%或更高，作为在覆铜板内填

充比例较高的材料，其与树脂等有机基材的结合效果对覆铜板的介电性能、尺寸稳定性、耐热性、绝缘性等性能存在较大影响，是保障覆铜板适配电子电路性能需求的关键材料之一。

②无机功能粉体填料与不同等级覆铜板的适配关系

常规覆铜板（如 FR-4、中低端通用型基板）的填充环节，普遍采用软性复合填料、熔融硅微粉等角形硅微粉材料，该类材料主要通过研磨、分级、表面改性等工艺制备而成，产品成本较低，能够满足覆铜板基本的介电性能、热稳定性等性能要求。随着电子信息产业持续升级，覆铜板行业逐步向高频高速传输、高密度互联（HDI）以及轻薄化、小型化方向发展，传统覆铜板所用填料在介电常数（Dk）、介质损耗（Df）、热膨胀系数（CTE）等关键指标方面难以满足高频高速及低损耗的信号传输需求，因此，针对硅微粉等填充材料的性能优化与迭代升级成为覆铜板技术演进的主要路径之一。

当应用场景进入高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用高端覆铜板领域时，对硅微粉的性能要求达到新高度，此类高端基板不仅要求填料具备极低的介电常数与介质损耗（Low Dk/Df）、低热膨胀系数（Low CTE），还需具备高导热、在高填充率下保持良好的流动性与分布均匀性，以适配板材轻薄化、高密度布线、低信号衰减、热稳定性等核心需求，此时，球形硅微粉成为更优选择方案。依托球化处理、超细加工、表面改性等工艺技术，球形硅微粉在粒径大小、粒径分布、粉体形貌及纯度等关键指标方面具有显著优势，进而赋予其更优异的介电性能、尺寸稳定性、耐热性等性能。因此，高速覆铜板以及高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用等较高技术等级的覆铜板一般选用高性能球形硅微粉作为填充材料，以实现对更高速率信号传输与更低传输损耗的核心性能。

各类硅微粉与覆铜板的迭代关系具体如下：

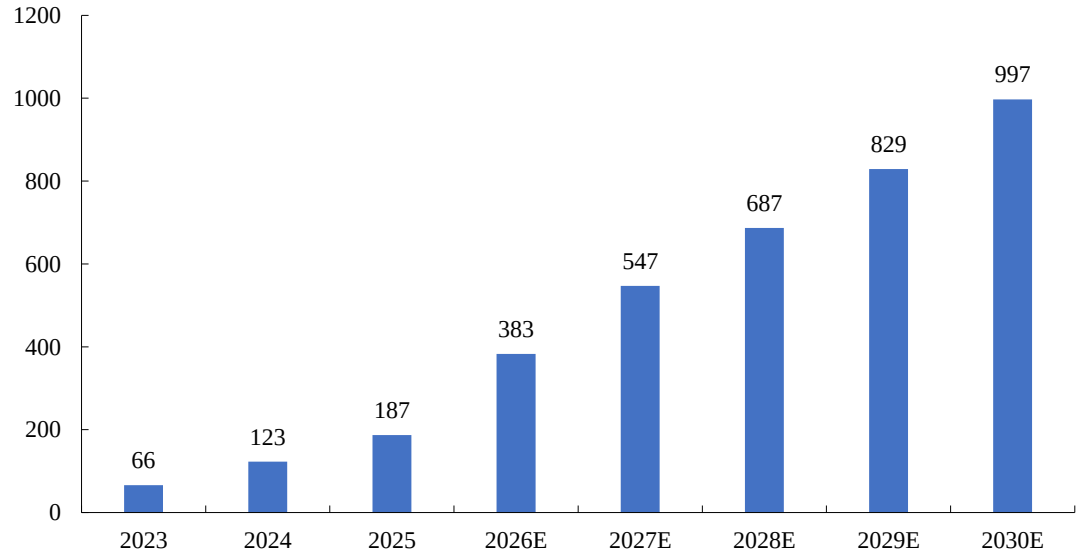
项目	覆铜板领域
技术迭代路径	高速覆铜板：Dk 和 Df 要求逐级升高，如日本松下 M2-M4-M6-M7-M8-M9-M10（下一代储备技术）； 高频覆铜板：天线、功率放大器等不同功能模块对频率、功率有不同升级要求； HDI 基板：由低到高为一阶、二阶、三阶、Any layer； IC 载板及类载板（SLP）：半加成工艺、改良型半加成工艺；BT 类到 ABF 类；载板高速一体化趋势

项目	覆铜板领域
对硅微粉的指标要求	在不同的升级路径上均要求硅微粉的粒径、介电性能和表面处理能够跟上技术升级、迭代的速度
不同类别硅微粉迭代路径	普通角形硅微粉-复合填料-熔融硅微粉-火焰法球形硅微粉-直燃法球形硅微粉-化学法球形硅微粉

③覆铜板用无机功能粉体填料市场容量

AI 技术的快速兴起催生对高性能计算、大数据处理的爆发式需求，AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等先进应用场景发展迅猛，带动 PCB、高速覆铜板、高性能粉体填料等产业链各个环节迅速起量；同时，随着电子信息产业向更加高精尖方向发展，高频高速、HDI 基板、IC 封装基板等较高技术等级的覆铜板对于高性能粉体材料的填充比例不断增加，促进硅微粉市场尤其是高性能球形硅微粉市场需求持续增长。根据贝哲斯咨询数据，2024 年中国硅微粉市场需求量为 41.8 万吨，预计 2025 年中国硅微粉需求量将达 47.3 万吨，同比增长 13.2%。Mordor Intelligence 预测，2027 年全球硅微粉市场规模将达到 53.3 亿美元。根据 Prismark 数据，2023 年全球高等级高速覆铜板用球形硅微粉市场规模达到 66 百万美元，2024 年及 2025 年该市场规模分别达到 123 百万美元和 187 百万美元，2024 年和 2025 年分别高速增长 86.4%和 51.2%，预计到 2030 年 M6+高等级高速覆铜板用球形硅微粉市场规模达到 997 百万美元，2025-2030 期间年复合增长率（CAGR）达 39.8%。

全球高等级高速覆铜板用球形硅微粉市场规模（百万美元）



资料来源：Prismark

2）覆铜板行业

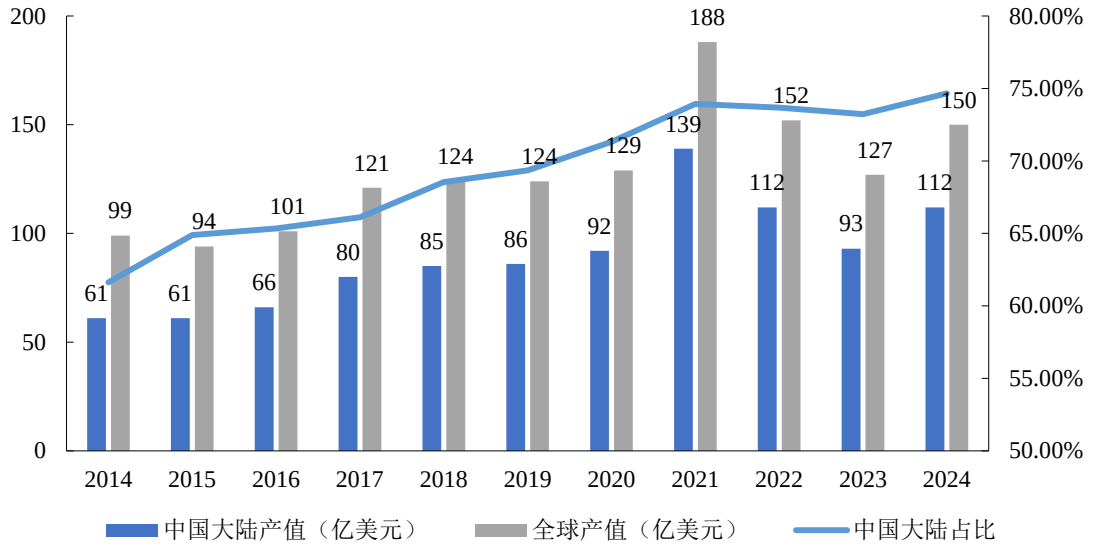
①覆铜板行业介绍及市场空间

公司电子信息功能材料产品的直接下游行业为覆铜板行业。覆铜板（CCL）是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以有机树脂等基材，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，在印制电路板（PCB）中主要承担导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定下游电子设备的信号传输速率和长期可靠性，在电子电路产业链中发挥着承上启下的关键作用，是制作 PCB 的关键基础材料。覆铜板种类较多，按照机械刚性可分为刚性覆铜板、挠性覆铜板，其中全球覆铜板市场以刚性覆铜板为主；根据终端应用对性能需求的不同，覆铜板可分为应用于家电、汽车等终端设备的普通覆铜板，以及高速覆铜板、高频覆铜板、IC 载板用覆铜板、HDI 用覆铜板和类载板（SLP）用覆铜板等高端品类。各板材类别、关键特性和应用领域如下：

板材类别	关键特性	应用领域
普通覆铜板、车规级 PCB 用覆铜板	低加工难度，兼顾成本与稳定性	普通电器、白色家电，一般汽车用电路板等
高速覆铜板	信号传输速度和损耗，低介电常数（Low Dk）、低介质损耗（Low Df）	AI 服务器、交换机、光模块、低轨卫星、高速通信、大数据处理设备等
高频覆铜板	低介电常数（Low Dk）、低介质损耗（Low Df）、高稳定性	通信基站、射频天线、雷达、军工、航空航天等
IC 载板用覆铜板	低热膨胀系数（LowCTE）、高耐热、高稳定性、高精高密、小型、轻薄化	CPU、GPU 等高端逻辑芯片、存储芯片
HDI 用覆铜板	多层、高密度可加工性	AI 服务器等算力基础设施、高性能便携设备等消费电子、汽车电子、通信设备
类载板（SLP）用覆铜板	低传输损耗、高可靠性、高精度、高平整、低翘曲、接近封装基板性能	光模块、芯片载板替代方案、高性能移动终端、轻薄化智能硬件

覆铜板行业市场需求与下游电子信息行业发展状况紧密关联，近年来呈现波动上升趋势。受益于人工智能、高性能计算、高速通信等相关产业爆发带来的高端市场强劲增量，覆铜板行业重回高速增长态势。根据电子信息领域权威机构 Prismark 数据，2024 年全球刚性覆铜板市场规模为 150.13 亿美元，较 2023 年同比增长 17.9%，其中中国大陆刚性覆铜板市场规模为 112.26 亿美元，占比约 75%，位居全球首位。

2014年-2024年全球刚性覆铜板产值规模

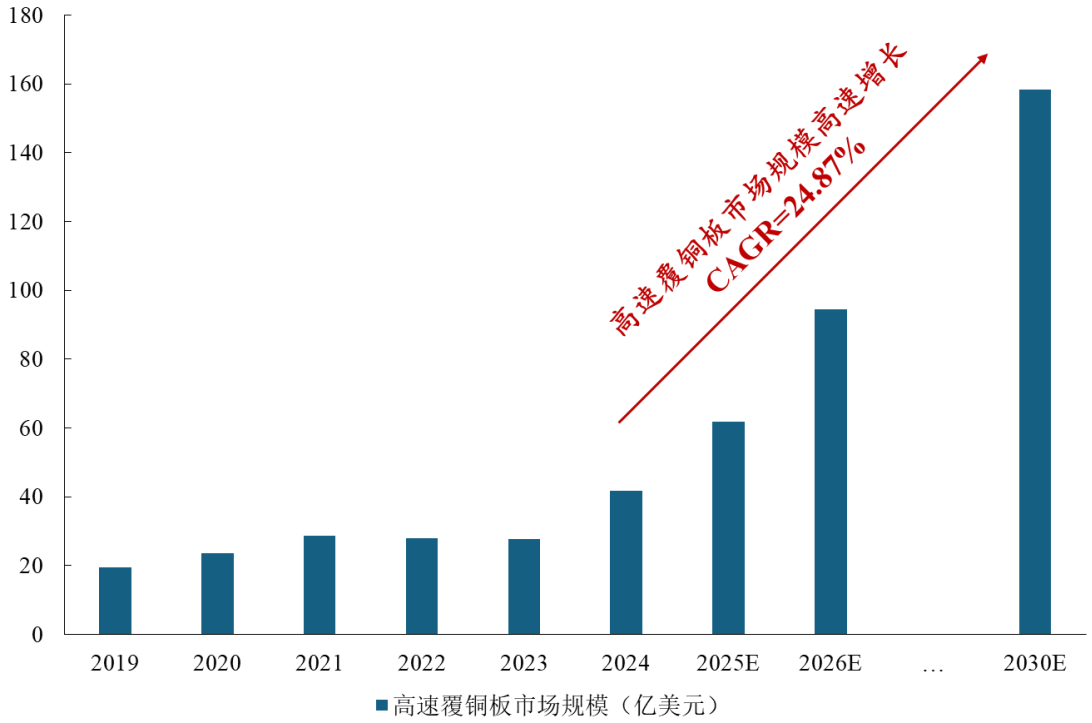


资料来源：Prismark

②高端覆铜板市场规模及主要厂商

AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算等高端应用市场持续渗透，下游终端设备对于数据传输速率、信号损耗、通讯频率等性能要求不断提高，推动覆铜板向“高频高速化、轻薄化、高导热”方向迭代升级，高端覆铜板市场规模呈现快速增长趋势，保持较高景气度。在刚性覆铜板中，高速覆铜板、IC 载板用覆铜板、高频覆铜板三大类特殊覆铜板，属于生产制造过程技术难度和下游应用领域性能要求较高的高端覆铜板板材。根据 Prismark 数据，2024 年全球三大类特殊刚性覆铜板的总销售额为 56.65 亿美元，总销售量为 142.0 百万平米，销售额和销售量较 2023 年分别增长 38.2%和 23.7%，呈现快速增长趋势。其中，高速覆铜板销售占比达 75%，增长幅度最大，2024 年高速覆铜板（有卤和无卤高速覆铜板合计）销售额达 41.80 亿美元，同比增长 50.2%，无卤高速覆铜板销售额达 26.56 亿美元，同比增长 51.8%，创历史新高；Prismark 预计到 2030 年全球高速覆铜板市场规模将达 158.43 亿美元，2024-2030 年期间年复合增长率（CAGR）达 24.87%。2024 年全球 IC 载板用覆铜板、高频覆铜板销售额分别达 9.37 亿美元和 5.48 亿美元，亦实现 13.8%和 10.9%的快速增长。

全球高速覆铜板市场规模及未来预测



注 1：数据来源：Prismark；
注 2：统计口径包含有卤高速覆铜板、无卤高速覆铜板。

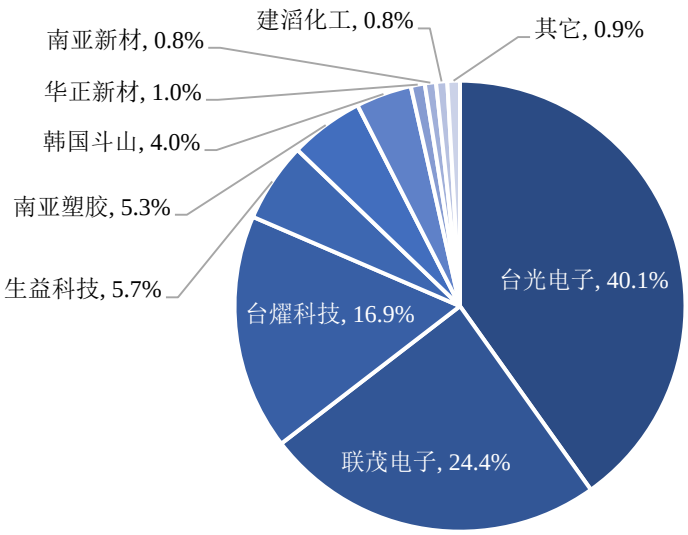
2024 年全球前十大高速覆铜板代表性厂商销售额合计约占全球高速覆铜板总销售额的 95%以上。无卤高速覆铜板得益于其良好的环保性能、电性能等性能优势，业内普遍认为其为高等级高速覆铜板未来发展趋势，2024 年全球无卤高速覆铜板市场前五大厂商分别为台光电子、联茂电子、台燿科技、生益科技、南亚塑胶，CR5 达 92.4%。全球高速覆铜板代表性厂商及市场份额情况具体如下：

2024 年全球高速覆铜板主要生产企业及市场份额					
无卤高速 CCL			**高速 CCL（有卤+无卤）**		
排名	**公司名称**	**份额**	**排名**	**公司名称**	**份额**
1	台光电子	40.1%	1	台光电子	29.9%
2	联茂电子	24.4%	2	联茂电子	16.7%
3	台燿科技	16.9%	3	台燿科技	15.5%
4	生益科技	5.7%	4	日本松下	10.9%
5	南亚塑胶	5.3%	5	韩国斗山	6.1%
6	韩国斗山	4.0%	6	生益科技	6.0%
7	华正新材	1.0%	7	南亚塑胶	3.9%

2024 年全球高速覆铜板主要生产企业及市场份额					
无卤高速 CCL			高速 CCL（有卤+无卤）		
排名	公司名称	份额	排名	公司名称	份额
8	南亚新材	0.8%	8	建滔化工	3.1%
9	建滔化工	0.8%	9	Isola	2.2%
10	其它	0.9%	10	南亚新材	1.7%
合计		100%	合计		96%

资料来源：Prismark

2024年全球无卤高速覆铜板主要厂商市场份额



资料来源：Prismark

③覆铜板行业技术发展方向

随着 AI 人工智能的爆发式增长，并带动高速网络通信、集成电路领域交互式高速发展，AI 算力设施等应用终端向更高数据吞吐量、更快数据处理速率、更优信号传输与交互、更低功耗等技术方向持续迭代，对 PCB 加工工艺、面积、层数和材料要求持续提升，算力 PCB 向“高频高速、高多层、高阶 HDI”方向演进。覆铜板作为电子电路的核心基材，直接决定了 PCB 的性能上限，在 AI 基础设施算力密度、集成度持续突破及信号传输速率不断提升的驱使下，覆铜板正加速向高频高速化、轻薄化、高导热三大方向演进，对覆铜板材料的低介电常数、低介质损耗、低热膨胀系数、高导热、高模量等技术指标要求更为严格。

A.高频高速化成为下游电子终端设备信号传输升级的核心需求

以 AI 算力设施核心载体 AI 服务器为例，从产业链技术升级角度来看，AI 服务器传输速率与技术复杂度显著提升，对覆铜板材料需求呈现高频高速化趋势。相较于搭载 CPU 的通用服务器，AI 服务器架构在传统 CPU 的基础上增加了 GPU 层以支持更多的矩阵运算功能，GPU 可兼容训练和推理，与 CPU 相比可以实现 10-100 倍的吞吐量，更加适配 AI 模型训练推理和矩阵计算功能。一般 AI 服务器会增配 4-8 颗 GPU 形成 GPU 模组，将大幅增加 GPU 板的用量，其中 GPU Board Tray 包含加速卡板（OAM）和模组板（UBB），对高性能 PCB 的用量、层数以及 CCL 的性能需求和用量均有显著增加。英伟达 Rubin 系列架构采用无缆化互连设计，将 GPU 与 Switch 间的高速传输由传统铜缆连接转向中板（Midplane）、正交背板等 PCB 连接方案，这一转变对信号完整性与传输稳定性提出更高要求，进一步推动 PCB 设计与材料体系向高端化方向演进。

AI 服务器的快速迭代对数据处理与运算能力要求达到新高度。英伟达 AI 服务器从 A100、H100、B100 到 GB200、GB300，以及 Rubin CPX、Rubin Ultra 的快速升级，其芯片在面积、连接方式、带宽及内存容量方面均有显著提升，例如 GB200 计算能力为 H100 的 3 倍，并且在内存和带宽方面亦大幅超越前代产品。AI 服务器传输速率的提升对信号完整性要求不断升级，要求覆铜板材料具有更低介电常数和超低介电损耗。根据联茂电子信息，AI 服务器由传统的 CPU 升级至 GPU，PCB 板层数由 14-24 层升级到 20-30 层甚至更高层，对覆铜板的要求从 Very Low Loss 材料升级到 Ultra Low Loss、Extreme Low Loss 及以上等级材料。

AI 服务器主要结构对 PCB、CCL 的要求					
项目	计算托盘（Compute Tray）			交换托盘（Switch Tray）	正交背板
	GPU 加速卡（OAM）	GPU 模组板（UBB）	CPU 主板		
定义	GPU 加速卡（OAM），即 Open Accelerator Module，是基于开放标准定义的加速模块，主要由 GPU 芯片、内存芯片、电源模块、散热器等部件组成，执行 AI 计算任务，可以插入 GPU 模组板（UBB），通过 PCB 板来连接和传输信号。	GPU 模组板（UBB），即 Universal Base Board，是一种用于搭载多个 GPU 加速卡模组的 PCB 板。UBB 的主要功能是连接多个 GPU 加速卡以实现 GPU 之间的高带宽通信，并与 CPU 主板通信。	CPU 主板在 AI 服务器中承载 CPU、内存、存储等核心部件，可以实现 CPU 与其他部件之间的高速数据传输。	交换托盘（Switch Tray）是高速通信枢纽，搭载专用高速交换芯片（如 NVSwitch），核心功能是实现机柜内多个计算托盘 GPU 之间的高速通信与数据交换。	正交背板是英伟达针对下一代 AI 服务器（如 Rubin Ultra NV 576）中超高密度、高带宽互联需求，而提出的创新性 PCB 设计方案，旨在替代传统的高速铜缆连接方案。在服务器机柜内部，正交背板用于垂直连接前部的计算托盘（Compute Tray）和后部的交换托盘（Switch Tray），实现 GPU 与 NVSwitch 芯片之间的高速电信号互联。
对 PCB 的要求	先进的 GPU 加速卡需要使用高多层、高密度、高可靠性的 HDI 板来连接 GPU 芯片、内存芯片等各个部件。Blackwell 架构（GB300）服务器 OAM 使用 5 阶 22 层 HDI 板；Rubin 架构中，VR200 计算托盘使用 6 阶 26 层 HDI 板，Rubin Ultra 计算托盘预计将升级至 7 阶 M9 等级材料的 HDI 板。	UBB 用于连接多个 GPU 加速卡并与 CPU 主板通信，为了实现高速、高效、高可靠的数据传输和图形处理，UBB 需要使用高多层板作为载体，一般在 20-30 层以上。例如 Blackwell 架构 GB300 NVL72 服务器 UBB 为 M8 等级材料的 22L 高多层板，Rubin 架构（VR200）UBB 预计将升级至 34L。	CPU 主板用于连接 CPU、内存、存储等核心部件，并通过 PCIe 通道或 PCIe Switch 实现与 GPU 主板的高速数据互联。在 DGX/HGX H100/200 服务器中，CPU 主板使用的 PCB 一般为 16-18 层通孔板。	Switch Tray 通过集成多颗 NVSwitch 芯片，构建低延迟、高带宽的 GPU 通信网络，需使用高多层板或高阶 HDI 板。例如 Blackwell 架构（GB200/GB300）服务器 Switch 板规格为 22 层高多层 PCB 或 6 阶 24 层 HDI 板；Rubin 架构（VR200）Switch 板升级至 32 层高多层 PCB 或 7 阶 26 层 HDI 板。	Rubin Ultra 方案单机柜增加 4 块正交背板，正交背板将计算板与交换板垂直插接，支持多达 576 个 GPU 的直接互联，预计为 78 层（3×26L）或 104 层（4×26L）或其他设计的高多层结构。

AI 服务器主要结构对 PCB、CCL 的要求					
项目	计算托盘（Compute Tray）			交换托盘（Switch Tray）	正交背板
	GPU 加速卡（OAM）	GPU 模组板（UBB）	CPU 主板		
对 CCL 的要求	以英伟达为例，其 Blackwell 架构服务器 OAM 板主要采用 M7、M8 等级材料，Rubin 架构升级至 M8、M9 等级材料，具体要求： ①高频高速性能：GPU 加速卡需要处理大量的数据和信号，要求 CCL 具有更低介电常数（Dk）、介质损耗（Df）； ②导热性能：GPU 加速卡的功耗较高，会产生大量热量，要求 CCL 具有较高导热系数、更低的热膨胀系数； ③可靠性：较高的玻璃化转变温度（Tg）、较低的水分吸收率（MOT）、较强的机械强度和耐化学腐蚀性。	以英伟达为例，其 Blackwell 架构 UBB 板主要采用 M7、M8 等级材料，Rubin 架构升级至 M8、M9 等级材料，具体要求： ①高频高速性能：UBB 板需要支持高速数据传输和信号处理，要求使用更低介电常数（Dk）、介质损耗（Df）的 CCL 以减少信号的衰减和失真，提高信号的完整性和可靠性； ②导热性能：UBB 板需要承受较高的功耗和发热量，要求 CCL 具有较高导热系数、更低的热膨胀系数； ③加工性能：由于 UBB 板需要实现较多的通孔连接不同层次的电路线路，并且需要实现较大的面积和厚度，因此需要使用具有较好加工性能的 CCL，以满足 THB（高温高湿测试）的要求，提高 PCB 的质量和良率。	以英伟达为例，在 DGX/HGX H100/200 服务器中，CPU 主板为 M6 等级材料，具体要求： ①高频高速性能：对于高频、高速的 CPU 主板来说，需要选择低介电常数（Dk）和低介质损耗（Df）的 CCL，以保证信号的完整性和质量； ②导热性能：对于高温、高功率的 CPU 主板来说，需要选择热导率较高、热膨胀系数与铜箔相近的 CCL，以有效散热，并且避免因为热应力导致的层间分离或过孔开裂等缺陷。 ③相较于 OAM、UBB 高速互联模块，CPU 主板信号传输要求较低，相应对 CCL 性能要求不及两类高速互联模块严苛。	Blackwell 架构（GB200/GB300）服务器交换板主要采用 M8 等级材料，Rubin 及 Rubin Ultra 交换板预计使用 M8.5、M9 等级 CCL，具体要求： ①高频高速性能：交换板需要支持多节点间的高速数据交换和长距离信号传输，要求使用更低介电常数（Dk）、介质损耗（Df）的 CCL，以降低高速信号在传输过程中的衰减； ②导热性能与可靠性：交换芯片及光模块接口功耗较高，要求 CCL 具备较高的导热系数与更低的热膨胀系数； ③加工性能：交换板通常层数较多，板材面积较大，CCL 需与交换板复杂制造工艺兼容，要求具有良好的尺寸稳定性与钻孔加工性能。	需采用 M9 或更高等级的超低损耗 CCL 材料，具体要求： ①高速低损耗性能：核心电气性能指标要求为超低介电常数（Dk）≤3.0、超低介质损耗（Df）≤0.0007，适配长距离高速信号传输需求，降低信号衰减，保障信号完整性与可靠性； ②导热与热稳定性能：要求 CCL 适配高功率 AI 集群的散热需求，同时热膨胀系数（CTE）严格控制在≤7ppm/℃，保障 PCB 在热应力下的尺寸稳定性； ③加工性能：需适配 78 层超高多层板的层压、超高深宽比钻孔等极限制造工艺要求，保障 PCB 的加工良率与结构稳定性。

资料来源：根据 Prismark、高盛、Semianalysis、中金公司等机构的研究报告及相关公开信息整理。

通用服务器方面，伴随 Intel、AMD 等 CPU 架构的不断升级，PCB 板向更高层数方向发展，由 8-12 层增加至 18-22 层以上，对于覆铜板性能要求亦进一步提高，覆铜板材料的损耗要求从 Mid Loss 过渡到 Very Low Loss、Ultra Low Loss 级别，并向更低损耗等级不断演进。为了满足高速高频性能需求，减少信号在传输过程中的介质损耗，覆铜板介电常数（Dk）、介质损耗（Df）进一步下降，未来下游市场对于 Ultra Low Loss 及以上级别的板材需求量将进一步提升。

不同服务器平台升级对覆铜板材料需求的变化情况如下：

伴随服务器平台迭代，覆铜板材料等级不断升级						
Intel	**项目**	**Purley**	**Whitley**	**Eagle Stream**	**Birch Stream**	**Oak Stream**
	总线标准	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	主板层数	8-12	12-16	16-20	18-22	20-24
	覆铜板材料级别	Mid Loss	Low Loss	Very /Ultra Low Loss	Very /Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	对标松下产品型号	M2 以上	M4 及以上	M6 及以上	M6 及以上	M7 及以上
AMD	**项目**	**Zen**	**Zen2 Zen3**	**Zen4**	**Zen5**	**Zen6**
	总线标准	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0
	主板层数	8-12	12-16	16-20	18-22	20-24
	覆铜板材料级别	Mid Loss	Low Loss	Very /Ultra Low Loss	Very /Ultra Low Loss	Ultra Low Loss
	对标松下产品型号	M2 以上	M4 及以上	M6 及以上	M6 及以上	M7 及以上

资料来源：联茂电子、福邦投顾（中国台湾地区电子、半导体领域知名研究机构）
注：较长时间以来，日本松下 Megtron 系列为高速覆铜板领域分级标杆，历年发布的不同等级高速覆铜板依次为 Megtron2、Megtron4 等（简称为 M2、M4）。覆铜板业内其他厂商会发布基本技术等级处于同一水平的对标产品，近年来，中国台湾及大陆地区相关领域厂商也逐渐加快了高端产品技术升级和迭代的速率。

交换机方面，AI 集群网络架构升级推动交换机端口速率加速向 800G、1.6T 演进，带动高多层 PCB 及高等级覆铜板的需求。为实现 25.6T 总带宽，交换机需采用约 30 层、Ultra Low Loss 等级的覆铜板；而达到 51.2T 带宽则要求使用 38-46 层、Extreme Low Loss 等级的覆铜板。伴随算力升级背景下 800G、1.6T 交换机市场的不断渗透，对高多层、高性能的 PCB，以及 M7、M8、M9 及更高等级的高速覆铜板需求将不断攀升。

交换机端口速率升级，对覆铜板材料性能要求升高				
交换机	**100G**	**400G/800G**	**800G/1.6T**	**1.6T 及以上**
覆铜板损耗等级	Very Low Loss	Ultra Low Loss	Extreme Low Loss	Super Extreme Low Loss
介质损耗 Df	0.005~0.006	~0.003	~0.002	~0.001
频率	13Ghz（NRZ）	13Ghz（PAM4）	28Ghz（PAM4）	56Ghz（PAM4）
对标松下产品型号	M6	M7	M8	M9

资料来源：福邦投顾（中国台湾地区电子、半导体领域知名研究机构）

B.终端应用集成化对布线密度要求日益提高，高密度互连（HDI）技术成为主流应用

AI 服务器等终端应用对布线密度和信号传输能力的要求日益提高，推动 PCB 向“高层数、高密度、细线路、小孔径”方向发展。HDI 板具有更小的尺寸、更高的元件密度、改进的信号完整性和增强的电气性能，在功能集成和空间利用方面优势显著，适用于集成化和轻薄化设计，已从智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子领域拓展应用至 AI 高速通信领域。

AI 高速通信设备板载信号量大，互连结构复杂程度和芯片集成度进一步提升，高密度互连技术可以显著提高布线密度、空间利用率和散热效果，并且具有更高的可靠性，符合 AI 服务器高性能规格要求。以英伟达 AI 服务器为例，NVIDIA GB200 NVL72 系统对高阶 HDI 板用量进一步提升，其计算托盘（Compute Tray）中主板、网卡板以及数据处理器（DPU）板均采用高阶 HDI 方案；其每个交换托盘（Switch Tray）包含 1 块 NVLink 交换机模组板，采用高多层或者 HDI 方案。HDI 用覆铜板作为高密度互联的核心基材，在有限的面积内实现更多的电路互连点，满足 AI 终端中高性能芯片、存储、接口等组件的高密度集成需求，因此，在 AI 等终端应用集成化趋势驱动下，HDI 用覆铜板成为主流发展趋势。

随着 PCB 向高阶 HDI、AnyLayer HDI 方向升级，盲孔、埋孔等高密度互联结构的孔径微型化与纵横比持续提升，传统电镀金属化工艺难以在微小孔内实现均匀、无空洞沉积。采用铜浆等导电电子浆料进行孔内填充导通，可有效规避电镀深镀受限问题，进而推动高性能电子浆料在高密度互联 PCB 领域的市场需求增长。

C.终端设备高算力需求及快速升级使得功耗、发热量大幅增加，催生覆铜板

高导热、高热稳定性（Low CTE）需求

覆铜板作为 PCB 的基础材料，其导热性能对电路系统的热传导效率至关重要，催生了对覆铜板导热性能和热稳定性的刚性需求。下游电子终端设备的海量数据运算与高速信号传输需求，要求覆铜板在保持低介电常数和低介质损耗的同时，亦具有较好的热性能，即具备高热导率以降低高速运行产生的热量、低热膨胀系数以保证电子设备在长期使用中的高可靠性和稳定性。

具体而言，以 AI 服务器为例，由于其超高的运算能力，其热设计功耗进一步提升。根据 Trend Force 数据，NVIDIA GB200 NVL72 机柜因运算密度大幅提升，每柜热设计功耗（TDP）达 125kW 至 130kW；更高性能的 GB300 NVL72 机柜系统功耗预计将提升至 135kW 至 140kW 间，从而进一步增加对散热性能的要求。AI 服务器的核心组件如 GPU、TPU 等算力芯片，在大模型训练与推理过程中处于高负载运行状态，单位面积的功耗与发热量呈指数级增长，单台设备的功率较传统服务器大幅增长，若热量无法及时传导并散出，不仅会导致芯片降频、算力衰减，还可能引发电路稳定性问题，缩短设备使用寿命。

随着 PCB 向高密度化、高集成化方向发展，尤其是在 IC 封装载板领域，芯片与基板因热膨胀系数（CTE）不匹配易引发的翘曲问题。根据《AI 对覆铜板及其原材料的要求》（沈宗华，第二十五届中国覆铜板技术研讨会，2024 年），PCB 主板的 CTE 值高于芯片载板，若 PCB 主板的 CTE 从 22ppm/℃降低至 14ppm/℃，其耐受的温循次数能提高 72%。因此，为了应对芯片基板和 PCB 基板的热膨胀系数失配引发的热机械应力问题，覆铜板还应满足 Low CTE 特性，需要选用低热膨胀系数（Low CTE）填充材料，以提升下游应用系统级可靠性。

④覆铜板行业发展趋势对上游填料市场的影响

覆铜板在下游 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、低轨卫星、高端消费电子、汽车电子等多重引擎的发展驱动下，正加速向高频高速、高密度互联、高多层、高导热等高端化方向升级，高频高速、IC 封装、HDI 等领域的高端覆铜板对于上游功能性填料的性能指标要求更为严格，对粉体材料的使用需求朝着更高规格等级、更高填充比例不断演进，同时下游板材朝着高多层发展带动对粉体用量的进一步提升，共同推动高端粉体填料市场需求快速增长。

具体来看，覆铜板提升电性能的核心路径在于对介电常数的精准调控与介质损耗的有效降低，为减少信号传输过程中出现衰减、时延等问题，需优先选用超低介电常数与介质损耗的适配材料，以确保其使用的稳定性与传输效率。与此同时，先进封装技术持续迭代，HDI 板向更高层数、更细线路方向演进，对粉体填料精准粒径控制、高纯度、低损耗等性能要求不断提高，填充比例持续提升，粉体用量亦持续增长。此外，下游终端设备功耗与发热量显著提升，对粉体填料高热导率、低热膨胀系数等导热性能也提出更高要求。以高性能球形硅微粉为代表的高端粉体填料适配下游高端覆铜板性能迭代需求，已成为下游高性能应用场景的主流解决方案，未来市场空间广阔。

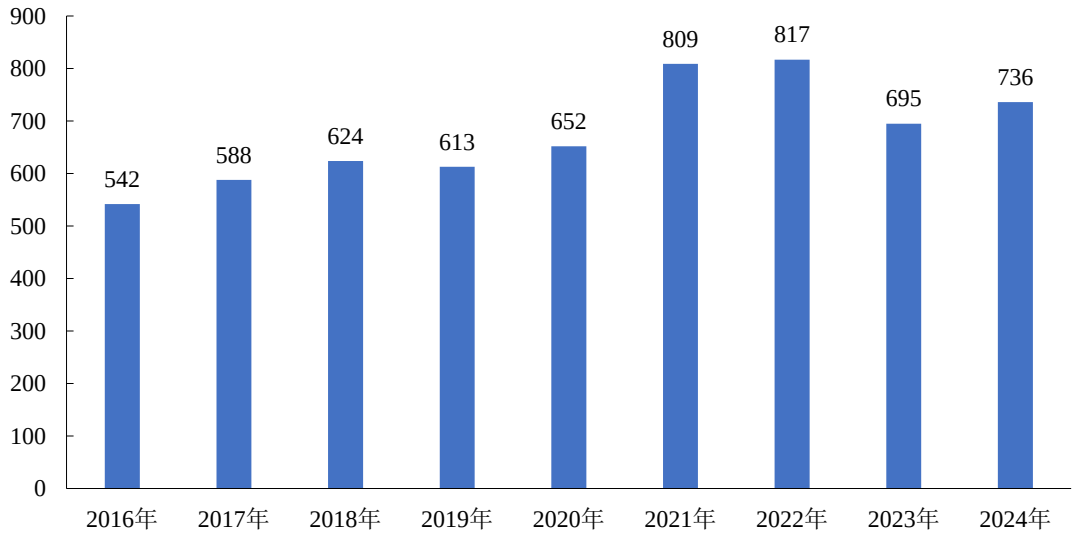
3）印制电路板行业

①PCB 介绍及市场空间

覆铜板行业的直接下游行业为印制电路板（PCB）行业。印制电路板是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，其主要功能是在为电路中各元器件提供机械支撑的同时将各元器件组按照特定电路进行连接，并传输电信号。PCB 是电子元器件的支撑体，其制造品质不仅直接影响电子信息产品的可靠性，而且影响电子元器件之间信号传输的完整性。

近年来，PCB 行业市场规模有所波动，整体呈现上涨态势。根据全球 PCB 行业权威统计机构 Prismark 数据，2023 年全球 PCB 产值为 695 亿美元，2024 年受益于 AI 算力、高速通信等下游应用领域的强劲需求，全球 PCB 市场景气度回升，总产值达 736 亿美元，同比增长 5.8%，其中中国大陆是全球最大的 PCB 生产基地，2024 年 PCB 市场产值达 412 亿美元，占比 56%。预计到 2029 年，全球 PCB 市场将以 5.2%的年复合增长率稳健扩张，市场规模将突破 950 亿美元，其中，中国大陆 PCB 市场规模将达到 508 亿美元。

2016-2024年全球PCB市场规模（亿美元）

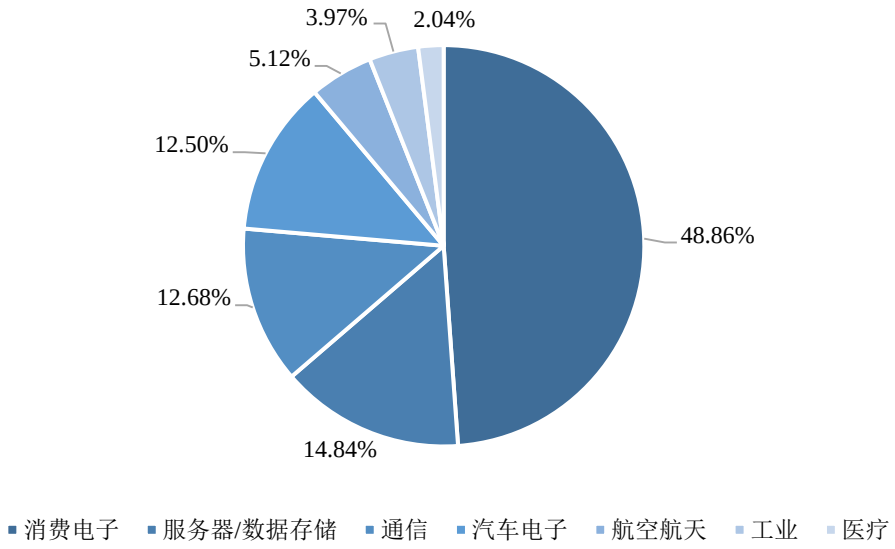


资料来源：Prismark

②AI 先进应用场景下，高端 PCB 成为行业发展主要驱动力

从下游应用的角度，根据全球 PCB 行业权威统计机构 Prismark 的数据，2024 年全球 PCB 各类应用中，消费电子（含手机、PC、其他消费电子）领域占比 48.86%，排名第一；服务器/数据存储领域占比 14.84%，排名第二；通信领域占比 12.68%，排名第三；汽车电子领域占比 12.50%，排名第四。近年来服务器/数据存储作为成长最快的领域，在 PCB 下游应用占比快速提升，预计未来将占据更高份额。

2024年全球PCB下游应用领域占比



资料来源：Prismark

从 PCB 类型来看，在全球 AIDC 建设热度高涨的背景下，18 层及以上的高多层板、高密度互连板（HDI）作为高端 PCB，市场需求有望迎来爆发式增长：

18 层及以上的高多层板主要用于 AI 服务器、交换机、光模块等领域，下游 AI 硬件设备升级推动高端 PCB 需求激增。以英伟达 AI 服务器为例，其核心模组（如 UBB、OAM 加速板）需采用高多层板，单机 PCB 价值量显著高于传统服务器。交换机与光模块方面，国内主流的数据中心交换机端口速率正在向 400G、800G 升级演进，光模块亦向 800G、1.6T 速率加速渗透，高速率传输性能要求带来高端 PCB 需求大幅增长。根据 Prismark 的数据，2024 年全球高多层板产值为 24.21 亿美元，同比大幅增长 40.2%；中国市场方面，中国高多层板产值增长率引领全球，2024 年高多层板产值达到 10.58 亿美元，同比增长 67.4%，预计 2024 年至 2029 年，全球 18 层以上高多层板市场将以 15.7%的年复合增长率快速扩张。

同时，伴随电子终端产品对 PCB 的高密度化、高集成化、轻薄化要求更为突出，未来以 HDI 为主的多层板市场将迅速扩张。根据 Prismark 的数据，2024 年全球 HDI 产值为 125.18 亿美元，同比增长 18.8%；中国 HDI 产值达到 78.49 亿美元，同比增长 21%。受益于 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、低轨卫星、高端消费电子和汽车电子等多重因素的推动，尤其是 AI 服务器 GPU 主板、OAM 加速卡、网卡板未来均有望升级到 HDI，未来 HDI 市场将实现持续增长，根据 Prismark 预计，2023-2028 年 HDI 的年复合增长率（CAGR）将达到 16.3%，是增速最快的细分品类。

长期来看，AI 终端将成为 PCB 需求增长的主要动能。根据 Prismark 数据，2023 年和 2024 年服务器用 PCB 市场规模分别为 82 亿美元和 109 亿美元，预计 2029 年服务器/数据存储将成为 PCB 下游第一大应用领域，全球服务器/数据存储领域 PCB 市场总需求将达到 189 亿美元，2024 年-2029 年期间复合增长率（CAGR）将达 11.6%。有线侧网通（含交换机、光模块等）领域用 PCB 市场规模将于 2029 年达到 80 亿美元，2024-2029 年期间复合增长率（CAGR）达 5.4%，高于行业整体增速。

（3）导热散热功能材料相关行业

1）导热粉体材料行业

①导热粉体材料介绍

导热粉体是具有较高热导率、用于改善材料导热性能的粉末状材料，广泛应用于导热凝胶、导热垫片、导热灌封胶等导热界面材料和封装材料领域，核心作用是在各类基体中构建导热通路，从而有效降低器件的热阻、提高散热效率，以实现热量的快速传递。

导热粉体材料包括金属类导热粉体、陶瓷类导热粉体和碳系类导热粉体三大类，其中，金属类导热粉体代表材料为银粉、铜粉、铝粉等，该类材料导热效率较高，但存在非绝缘、易氧化等问题，主要用于特定高导热且对绝缘性要求不高的场景；陶瓷类导热粉体代表材料为氧化铝、氮化铝、氮化硼等，具有绝缘性能优、导热性能好、化学稳定性强等优势，是电子设备、新能源领域的主流选择；碳系类导热粉体代表材料为石墨烯、碳纳米管、石墨粉等，导热率高于金属类和陶瓷类，但存在导电性、非绝缘以及难分散等问题，应用场景受限。

综合来看，虽然金属类和碳系类导热粉体本身具有较高的导热系数，能显著地提高聚合物材料的热导率，然而在高负载时却易破坏材料的绝缘性能，且碳材料如石墨烯或碳纳米管在基体中不易分散，不利于形成有效的导热通路，在电子设备和新能源领域的应用较为有限。因此，以氧化铝、氮化铝、氮化硼为代表的陶瓷类导热粉体凭借在电绝缘性、导热性、稳定性方面的优势，已成为应用最广泛的导热粉体材料。

②导热粉体材料行业市场空间

导热粉体材料是决定下游导热界面材料导热性能的关键，在下游导热界面材料中的填充占比通常超过 90%，最高可达 95%，市场空间广阔。导热粉体材料以氧化铝、氮化铝和氮化硼等粉体为主，细分产品领域市场空间及竞争格局情况如下：

氧化铝市场方面，以球形氧化铝粉体为例，QY Research 数据显示，2024 年及 2025 年全球球形氧化铝填料市场规模大约为 29.38 亿元和 31.89 亿元，预计 2031 年全球市场规模将达到约 54.9 亿元，2025-2031 年期间年复合增长率（CAGR）

为 9.5%。从市场竞争格局角度，过去导热用球形氧化铝的核心生产技术主要集中在日本电化株式会社（Denka）和日本昭和电工（Resonac）等海外企业，国内导热用球形氧化铝厂商中，以锦艺新材、联瑞新材、百图股份等为代表的企业较早突破了球形氧化铝制备技术。

氮化铝市场方面，根据 QY Research 数据，2025 年全球氮化铝粉体市场规模为2.2 亿美元，预计 2032 年将达到4.08 亿美元，2026-2032 年复合增长率（CAGR）为 9.4%。氮化铝行业技术壁垒较高，全球市场主要由日本、德国、美国等海外厂商主导，主要生产商有日本德山（Tokuyama）、美国 Surmet Corp、德国 H.C. Starck 等企业，其中日本德山垄断全球高纯氮化铝粉体市场约 75%的份额。中国氮化铝行业起步较晚，随着国内产业技术不断升级，涌现出一批以锦艺新材、百图股份、厦门钜瓷等为代表的国内氮化铝代表性厂商，逐渐实现高导热氮化铝粉体的进口替代。

氮化硼市场方面，根据 QY Research 数据，2025 年全球氮化硼粉体市场规模为 25.84 亿元，预计 2032 年全球市场规模将达 36.66 亿元，2026-2032 年复合增长率（CAGR）为 5.2%。氮化硼市场主要参与者为欧美、日本等外资厂商，主要包括法国圣戈班、3M 公司、迈图、Resonac、Denka 等，其中法国圣戈班占据较大市场份额。目前我国氮化硼市场未形成明显的竞争格局，代表性企业有锦艺新材、百图股份等。

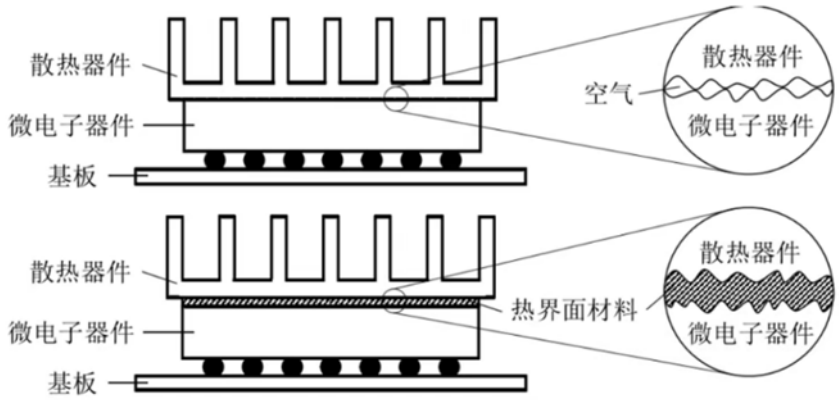
2）导热界面材料行业

①导热界面材料介绍

公司导热散热功能材料产品的直接下游行业为导热界面材料行业。导热界面材料（Thermal Interface Materials，TIM）是一种以高分子材料为基体、以具有绝缘、导热性能的粉体为填料，经过交联或硫化制成的聚合物复合材料。导热界面材料的聚合物基体本身导热性能较差，是热的不良导体，主要通过物理共混的方法将作为高导热填料的导热粉体加入到聚合物基体中，以提高聚合物的热导率。常见的导热界面材料包括导热凝胶、导热垫片、导热硅脂、导热相变材料等。

导热界面材料主要用于填充发热器件与散热结构之间微小缝隙、降低接触热阻，以构建高效导热通路、提升热量传递效率，核心作用是解决固体界面间“接

触不充分”导致的散热瓶颈。导热界面材料的主要功能和应用情况如下：

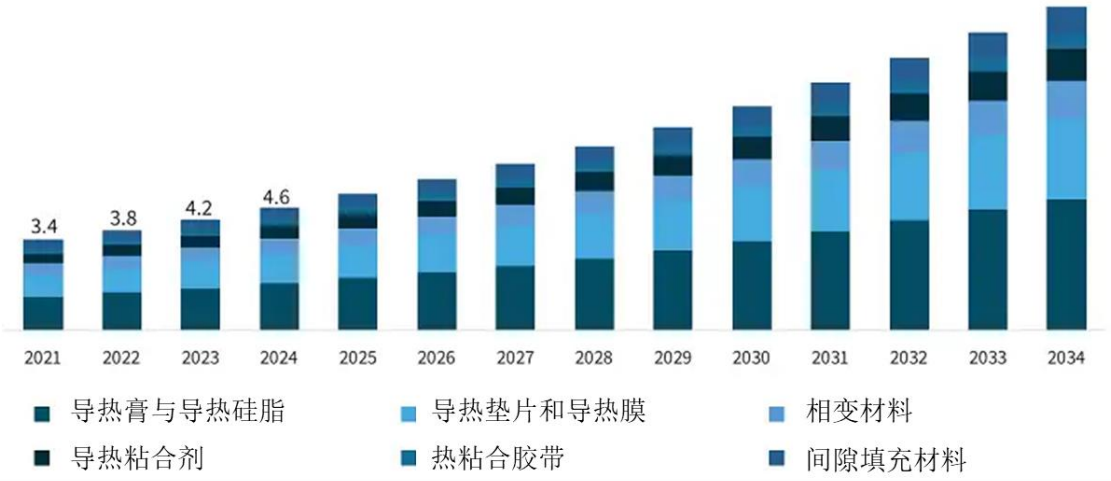


资料来源：艾邦智造官网

②导热界面材料市场空间及竞争格局

伴随下游应用领域对于导热散热需求的日益提升，导热界面材料市场规模迅速增长。根据 Global Market Insights 数据，2024 年全球导热界面材料市场规模约 46 亿美元，同比增长 37.9%，预计到 2034 年全球导热界面材料市场规模将达到 122 亿美元，年均复合增长率超 10%。伴随国内新能源汽车、数据中心等新兴应用领域的快速发展，中国导热界面材料市场规模呈现上涨态势，根据 Future Market Insights 预测，中国导热界面材料市场规模 2024 年至 2034 年期间的年复合增长率达 11.3%。

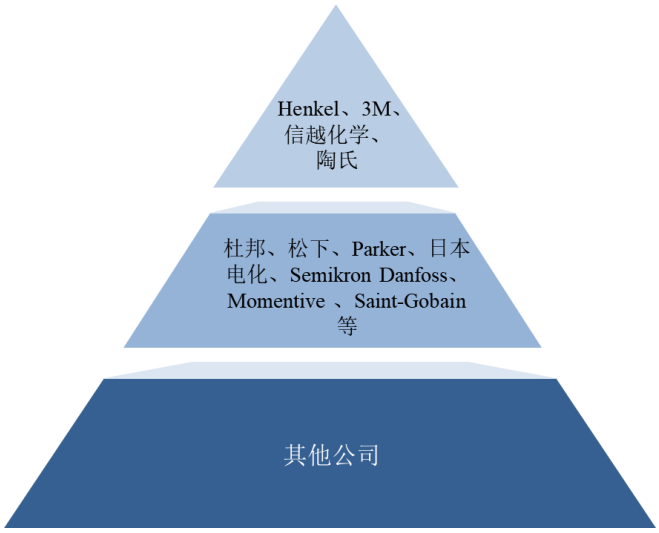
2021年-2034年全球导热界面材料市场规模（十亿美元）



资料来源：Global Market Insights

全球导热界面材料行业呈现出国际头部厂商与本土企业并存、高端市场集中度较高且以海外企业为主的竞争格局，国产化趋势未来可期。根据华经情报网数据，汉高、3M、信越化学、陶氏化学等企业为导热界面材料行业第一梯队企业，其全球产品收入超过 1 亿美元，约占据 45%-50%的市场份额；杜邦、松下、日本电化等企业年收入在 1 千万至 1 亿美元之间，约占据 30%-40%的市场份额。国内市场起步较晚，智研咨询数据显示，当前我国导热界面材料国产化率不足 30%，主要参与者包括飞荣达、中石科技、苏州天脉等，随着下游市场不断扩大，国产化率有望逐步提升。

全球热界面材料市场竞争格局



资料来源：华经情报网

③导热材料行业应用场景及发展前景

作为连接发热元件与散热系统的关键材料，导热界面材料在 AI 数据中心、高速网络通信、芯片封装、消费电子、新能源汽车等领域应用广泛。目前，热管理市场的主要增长点集中在 AI 算力、HBM 存储、高性能消费电子、新能源汽车热管理带来的散热需求。导热粉体材料作为提升热界面材料导热率、实现终端设备高效散热、保障器件稳定性的核心功能性填料，在 AI 算力中心等多个高导热需求驱动下，未来市场空间广阔。

A.算力芯片

伴随 AI 大模型训练与推理需求的指数级增长，AI 服务器向高密度高功率方向演进，AI 算力芯片的功耗不断攀升，单芯片功耗已从传统 CPU 的百余瓦提

高至千瓦级且向更高水平持续跃升，对导热材料的导热系数、热稳定性等性能指标提出更高标准。以英伟达 AI 芯片演进为例，从 2024 年搭载 Blackwell 架构的 GB200 芯片（功耗 1200W）到 2026 年预计推出的 VR200 芯片（功耗 2300W），单 GPU 功耗三年内增长近一倍；而到 2027 年 Rubin 架构的 VR300 芯片功耗预计达到 3600W，呈现指数级跃升。系统层面，AI 服务器最大机柜功率从 GB200 时代的约 120kW，预计将迅速增长至 VR300 对应的约 730kW，增幅超过 6 倍，因此，高密度算力场景对散热要求不断提升，直接带动了高端导热材料性能升级与市场需求高增。

芯片散热主要包括外部系统散热技术与导热界面材料（TIM）两方面，其中导热界面材料可分为 TIM1、TIM1.5 和 TIM2。TIM1 是芯片裸晶与金属顶盖（IHS）之间的第一层散热介质，用于连接芯片与均热板，由于与发热量极大的芯片直接接触，通常要求导热系数达到 15W/（m·K）或更高，且具有低热阻、与硅片匹配的热膨胀系数，导热填料包括氮化铝等。TIM1.5 位于裸芯片和散热器之间，主要包括导热硅脂、导热凝胶。TIM2 用于均热板与散热器间，因 IHS 已分摊部分热量，导热系数低于 TIM1。AI 芯片的高散热需求直接带动了高端导热界面材料的市场需求。

B.存储芯片

随着 AI 算力需求增加，AI 服务器对芯片内存容量和传输带宽的要求相应提高，存储芯片向 HBM 高带宽堆叠、高密度化及先进 2.5D/3D 封装方向演进，对于导热粉体提出更严格的要求：一方面，高带宽存储（HBM）多层 DRAM 芯片垂直堆叠架构使其热流密度大幅提升，带来更严重的热耦合现象，进一步打开了高端 TIM 材料的增量市场空间，要求粉体同时具备高导热、高填充、低线性膨胀系数、低介电特性；另一方面，HBM 具有多层堆叠、高密度、高集成特性，极易受封装材料中微量放射性元素产生的 α 粒子影响而出现软错误、数据翻转，进而催生了 Low-α 球形氧化铝等低放射性粉体材料的刚性需求，形成了 AI 产业驱动下的又一增长曲线。

C.手机芯片

在 AI 技术赋能消费电子的浪潮下，智能手机正加速向轻薄化、高性能方向

升级，其核心芯片需应对大模型推理与计算带来的持续高负载，导致功耗与发热同步快速增长，对散热技术和导热材料提出更高要求。数据显示，过去手机主芯片的热设计功耗（TDP）约为 5-6W，当前旗舰级手机 AI 芯片的峰值功耗已突破 15W、热流密度突破 15W/cm²。手机芯片的高能耗将导致设备内部热量积聚，需依靠高导热性能的热界面材料快速传导热量，而其核心性能主要依赖高纯度、高高导热粉体材料（如高导热氮化铝等）构建高效导热通路，因此，导热粉体已成为手机散热方案中不可或缺的关键材料，在智能手机加速迈入高算力的背景下，未来增长空间广阔。

D.新能源汽车

导热界面材料主要应用于新能源汽车三电系统、智能驾驶、激光雷达、LED 大灯等。在动力电池中，导热界面材料在电池单元之间提供良好的导热路径，导热系数要求通常在 0.4-2W/（m Ⱪ），以导热氧化铝为主要填料；电机系统主要应用高导热胶对驱动电机内产生旋转磁性的定子进行整体灌封；电控系统方面，IGBT 模组与冷面之间的刚性界面涂抹导热硅脂以减少热阻隔，随着电控系统从 Si IGBT 过渡到 SiC MOSFET，对高性能 TIM 需求增加。智能驾驶方面，ADAS 系统芯片算力与功耗攀升将增加对 TIM 材料需求。激光雷达方面，远距离及水平和垂直方向的大视场角探测使得主动光源的功率大幅增加，散热需求较高。

（4）其他新兴功能材料相关行业

1）锂电池隔膜行业

公司锂电池隔膜功能材料产品的直接下游行业为锂电池隔膜行业。锂电池隔膜是锂电池的“心脏瓣膜”，发挥着隔离电池正负极、防止短路、通过多孔结构允许锂离子自由穿梭以维持电化学反应的重要作用，直接关系到锂电池能否高效、安全、长寿命运行，是锂电池的四大关键材料之一。

中国在全球锂电池隔膜市场中占据主导地位，随着汽车电动化、智能化发展的不断深入，以及储能行业的快速发展，锂电池行业仍有较为广阔的市场增长空间，带动锂电池隔膜行业持续发展。根据锂电产业链知名研究机构 EV Tank 数据，2024 年中国锂离子电池隔膜出货量达 227.5 亿平方米，同比增长 28.6%，占全球比重 79.4%；2025 年中国锂离子电池隔膜出货量达 328.5 亿平方米，同比增长

44.4%，其中湿法隔膜出货量 265.2 亿平方米，占比达到 80.7%。锂电池隔膜市场呈现高度集中的竞争格局，根据 EV Tank 数据，2025 年中国锂电池隔膜出货量排名前五的企业分别为恩捷股份（30.1%）、金力股份（15.8%）、星源材质、中材科技、厚生新能源，公司锂电池隔膜功能材料产品客户覆盖前五大厂商中的恩捷股份、金力股份、中材科技，其中恩捷股份已连续八年位居中国锂电池隔膜市场首位。

按照技术路线划分，锂电池隔膜可分为干法隔膜及湿法隔膜，湿法隔膜在性能上优于干法隔膜，但也存在热稳定性较低等缺陷。为进一步提升锂电池隔膜材料的机械性能、热稳定性等关键性能，目前普遍采用的方法是通过在其表面涂覆材料以实现基膜性能的提升，锂电池“湿法+涂覆”已是业界公认的隔膜发展方向。隔膜涂覆材料是提升锂电池安全性的核心关键，伴随下游新能源汽车锂电池行业的快速发展，市场规模不断攀升。

目前主流的锂电池涂覆材料包括以氧化铝和勃姆石为主的无机材料、以聚偏氟乙烯和芳纶为主的有机材料以及无机有机兼有的复合材料三大类。现阶段，以氧化铝和勃姆石为主的无机涂覆材料应用较为广泛。根据 QY Research 的统计及预测，2024 年全球锂电池隔膜氧化铝市场销售额达到了 28.35 亿美元，预计 2031 年将达到 121.8 亿美元，年复合增长率为 23.3%。

2）涂料行业

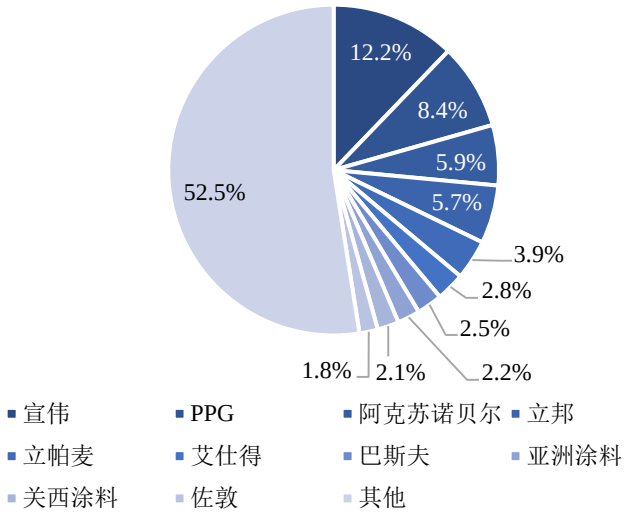
公司涂料功能材料产品是以电子信息功能材料相关产品为起点，结合功能性涂料市场和客户应用端需求，进行创新研发，能够在填充后赋予涂料更强性能的一类材料。该类产品直接下游为涂料行业，但并非市场上同一应用领域的通用性产品，且非涂料行业的传统原材料，而系公司针对该领域的创新性开发或应用。发行人该等产品的市场规模与下游涂料市场发展趋势直接相关，且直接取决于该类产品在下游涂料行业的创新性推广应用。

近年来全球涂料市场规模保持稳健增长，根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）统计，2024 年全球涂料销售额达 1,888 亿美元。根据中国涂料工业协会，2023 年全球涂料需求约 470 亿升，市场规模约 1,970 亿美元，预计到 2027 年将增长至 530 亿升，年复合增长率 3.1%，市场规模约 2,470 亿美元，年复合增

长率 5.8%。从区域市场格局来看，中国是全球第一大涂料生产消费国，涂料产量占全球 25%以上。根据中国涂料工业协会数据，2024 年中国涂料行业市场规模约为 4,089.03 亿元，同比增长 1.56%。

竞争格局方面，涂料行业主要由外资企业占据主导地位，全球排名前十大涂料企业市场份额合计约占 47.5%，其中，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔是 2016-2024 年全球市场排名前三的涂料企业，2024 年合计营业收入超过 500 亿美元，累计市场占有率达到 26.50%，领跑全球涂料行业。国际龙头企业除占据整体涂料市场的较大份额外，在功能涂料、特种涂料等中高端市场也具有显著优势。

2024年全球涂料竞争格局



资料来源：中外涂料网

3）IC 制造之芯片抛光液行业

化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程的关键工序，其工作原理是指在一定压力和抛光液的作用下，借助纳米磨料的机械研磨作用和化学试剂的腐蚀作用，实现对晶圆表面缺陷的去除和高度平坦化。化学机械抛光的效果直接影响到最终芯片的性能和成品率，已成为 0.35μm 以下制程不可或缺的平坦化工艺。化学机械抛光材料主要包括抛光液、抛光垫、清洗液等，其中抛光液在 CMP 工艺中至关重要，占 CMP 材料成本的 50%以上。CMP 抛光液的核心作用是在化学机械抛光过程中与晶圆发生化学反应，使其表面产生一层钝化膜，并借助抛光液中研磨颗粒的机械力将反应物去除，以实现晶圆表面的平坦化。

CMP 抛光液的核心组分包括研磨颗粒、pH 调节剂、分散剂、氧化剂功能性添加剂及高纯度去离子水，其中，研磨颗粒是 CMP 抛光液的关键原材料，主要起到机械研磨作用，以实现晶圆表面多余材料的高效去除和全局纳米级平坦化。研磨颗粒的硬度、粒径、形状和浓度对抛光效率、抛光质量起到直接决定性影响，根据材料种类的不同，研磨颗粒可分为二氧化硅、氧化铝、氧化铈等种类，不同研磨颗粒的性能特点和应用情况如下：

研磨颗粒类别	性能特点	应用情况
二氧化硅（SiO_2）	硬度适中（莫氏硬度约 7），与硅片硬度接近；分散性好，在水中形成稳定的硅溶胶；机械作用与化学作用并重，通过形成可溶性硅酸盐实现温和去除	应用最广泛的磨料，主要用于硅衬底粗抛和精抛，介质层和软金属抛光
氧化铝（Al_2O_3）	硬度高（莫氏硬度 9），多为棱角分明的块状或片状，机械去除能力强	常用于钨、铜等等金属互连层快速去除，蓝宝石、碳化硅等硬质衬底抛光，以及多层布线中金属凸块的平坦化
氧化铈（CeO_2）	硬度适中（莫氏硬度 7-8），高选择比；多呈规则多面体，切削刃口锋利，不易破碎；化学作用主导，通过 Ce-O-Si 键形成加速材料去除，抛光效率高	半导体工艺中的浅槽隔离和层间介质抛光

全球 CMP 抛光液市场呈现高度集中的竞争格局，市场份额长期为美国和日本等外资厂商所占据，包括 CMC Materials（卡博特，Entegris 旗下公司）、Versum Materials（Merck 旗下公司）、Hitachi（日立化成，已合并为 Resonac）、富士美（Fujimi）、陶氏（Dow）、杜邦（DuPont）等，2023 年前二大厂商 CMC Material 和 Fujimi 占据 50%以上的全球市场份额。目前，我国抛光液领先企业为安集科技、鼎龙股份等，但在高端先进抛光液技术领域受限，与国际头部厂商仍存差距，亟需化解“卡脖子”风险，推动国产替代进程。

在半导体芯片制程向先进技术节点持续演进的过程中，芯片结构多层化、集成化以及布线微细化发展趋势，使得 CMP 抛光液与研磨颗粒不断向高端化方向发展，对纳米级均一粒径、精准形貌及优异分散性等性能指标提出更高要求。在 7nm 以下半导体先进制程的 CMP 抛光中，金属栅极抛光作为铜等金属布线精细加工的关键环节，对研磨颗粒的“精准研磨”与“低损伤”特性提出严格要求，纳米氧化铝凭借其高硬度、稳定的晶体结构等性能，可实现物理研磨的高效性与一致性，已成为该场景的重要适配选项。目前，国内虽在中低端 CMP 抛光液材

料领域实现突破，但高端 CMP 抛光液研磨颗粒仍主要依赖进口，国产替代需求强劲。

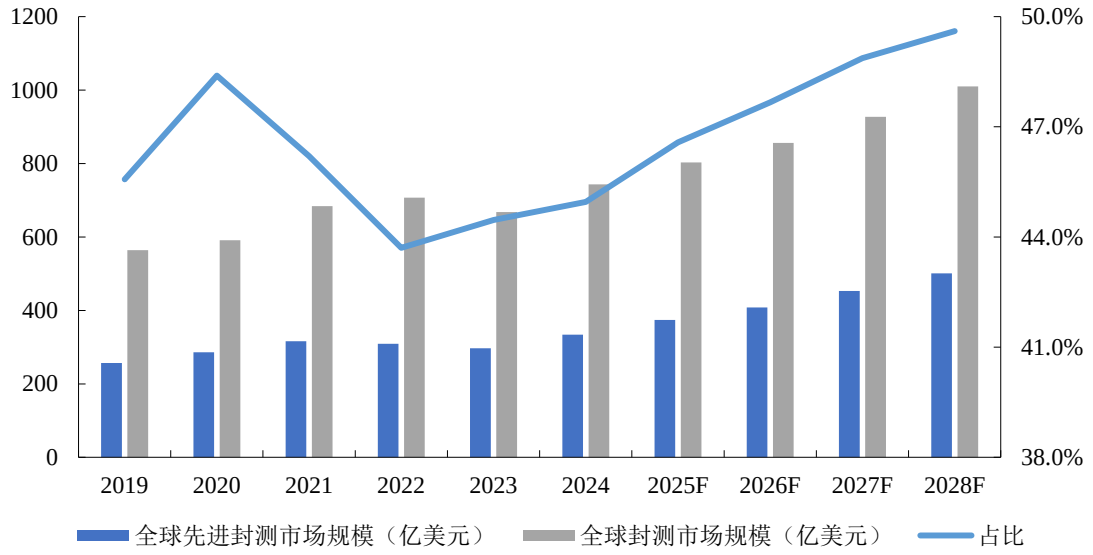
伴随半导体芯片制程向 7nm 以下先进技术节点迈进，晶圆制造需要更多次的 CMP 抛光步骤以实现极致的平坦化，直接带动抛光液和研磨颗粒需求的快速提升。例如，14nm 以下的逻辑芯片抛光次数超过 20 次，7nm 以下的逻辑芯片抛光次数甚至达 30 次，远超 28nm 制程的 12-13 次，同时，存储芯片向 3D NAND 的技术演进趋势亦使得抛光次数成倍提升。根据 TECHCET 数据，2024 年全球半导体 CMP 抛光材料市场规模为 34.2 亿美元，其中抛光液占比近 60%，预计到 2028 年全球半导体 CMP 抛光材料市场规模将达到 44 亿美元，2024-2028 年复合增长率（CAGR）为 5.6%。

4）封装材料行业

半导体封装是指用特定材料和工艺对芯片及其他半导体元器件进行放置、固定及密封，并将芯片的接点连接到封装外壳上，实现芯片内部功能的向外延伸，同时发挥对芯片的物理保护、可靠性提升、导热散热等作用。伴随 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、大数据、物联网等技术的快速发展与应用，全球半导体产业持续繁荣，芯片封装测试市场需求快速增长。根据赛迪顾问数据，2024 年全球封装测试市场规模达 743 亿美元，较 2023 年增长 11.3%，预计到 2028 年市场规模将突破 1,000 亿美元。

随着先进制程发展的需要，通过先进封装技术实现提升芯片密度与连接性能成为后摩尔时代的重要技术路径。先进封装在传统封装的基础上，通过高密度集成、异构集成等技术，大幅提升芯片的集成度和功能密度，同时提升信号传输效率，以满足新兴产业对高端芯片性能不断提升的需要，成为芯片封装产业未来主流的发展方向。根据 Yole 及赛迪顾问数据，2024 年全球先进封测市场规模达到 334 亿美元，占整体市场的 44.9%，预计未来占比将进一步提升，到 2028 年先进封测市场占比约 50%。

2019-2028年全球先进封装测试行业市场规模及占比



资料来源：Yole、赛迪顾问

封装材料是半导体产业的关键基础，位于半导体封装的上游环节。封装材料主要包括包封材料、芯片粘结材料、键合材料等，其中，包封材料作为芯片封装中直接包裹芯片的核心材料，是芯片与外界环境之间的关键屏障，其性能优劣直接决定了芯片封装的基础防护能力、结构稳定性与应用性能，并且不同封装形式对包封材料的热学、电学、力学特性有着差异化要求，高性能包封材料是先进封装技术落地的重要物质基础。根据 SEMI 数据，2024 年全球包封材料市场规模预计达到 35 亿美元，较 2023 年增长 4.79%。

包封材料按照所用种类的不同分为金属封装、陶瓷封装和塑料封装，其中塑料封装因其成本低、工艺较成熟等特点，占整个封装市场的 90%以上。塑料封装材料中，环氧塑封料（EMC）是当前主流包封材料，占比超过 90%，广泛应用于传统封装中。伴随封测行业向先进封装不断迭代的发展趋势，传统固态 EMC 在大面积成型、薄型化封装中面临流动性不足、翘曲控制难等挑战，催生环氧塑封料向高性能高附加值产品结构迭代，高端封装材料如液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）逐步实现在扇出型晶圆级封装（FOWLP）、系统级封装（SiP）以及高带宽内存堆叠封装（HBM）等先进封装工艺中应用。

从竞争格局来看，全球 EMC 生产厂商主要集中在亚洲地区，根据国金证券研报，按照销量口径，2024 年全球环氧塑封料市占率前五的厂商及市占率分别

为住友电工（日本）28%、Resonac（日本）16%、衡所华威（中国，已被华海诚科并购）9%、华海诚科（中国）9%及长春封塑料（中国）8%；按照收入口径，2024 年全球环氧塑封料市占率前五的厂商均为日本企业，包括住友电工、Resonac、松下、京瓷及信越化学。由此可见，我国自主生产环氧塑封料虽具有一定出货量，但产品相对低端，单价及附加值较低。国内基础封装材料市场，内资厂商已占据主导地位，但在 LMC、GMC 等高性能类环氧塑封料方面，国产化率仅为 10%-20%，先进封装类环氧塑封料基本被国外厂商垄断，进口替代空间广阔。

功能性填料是环氧塑封料的关键原材料，主要为降低热膨胀系数、降低收缩率、提高机械强度、提升介电性能和导热性等关键作用，填充率一般达到 70%-90%。二氧化硅粉体具备高绝缘、低介电、低热膨胀系数、高耐热和导热性好等特点，是环氧塑封料中最主要的功能性填料，并且高端产品球形硅微粉同样应用于先进封装用液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）、底部填充胶（UF）。

伴随 AI 大模型、高性能计算、高速通信等先进终端应用场景的爆发式发展，先进封装技术向以 2.5D/3D、Chiplet、HBM 为代表的高集成度、异构架构方向持续迭代，CoWoS、FOWLP、FOPLP、WLCSP 等先进封装市场需求增长强劲，对 LMC、GMC、UF 等先进封装材料的综合性能要求达到新高度，带动具有更低 Cut 点、低放射性（Low α）、低介电、高填充率、高流动性的球形硅微粉等功能性填料市场需求快速增长。根据 QY Research 调研数据，2024 年全球集成电路封装用球形硅微粉市场规模大约为 1.81 亿美元，预计 2031 年将达到 3.77 亿美元，2025-2031 期间年复合增长率（CAGR）为 11.2%。

2、下游主要终端行业发展概况

（1）AI 算力中心（算力层）

1）AI 服务器

服务器是一种高性能计算机，作为网络的节点可存储、处理 80％以上的网络数据。与普通计算机相比，服务器运行更快、负载更高、价格更贵，具有高速 CPU 运算能力、更高的可靠性、更强的 I/O 外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。在 AI 算力需求的推动下，全球服务器市场规模呈现快速增长趋势。IDC 数据显示，2024 年全球服务器市场规模为 2,442 亿美元，较 2023 年大幅增长 73%，预

计到 2029 年全球服务器市场规模将达到 5,186 亿美元，近五年（2024-2029）复合增速达到 16.3%。

AI 服务器指专为人工智能应用设计的高性能计算机设备，相较于传统服务器，AI 服务器采用异构计算架构以提升服务器的数据处理能力，异构方式包括 CPU+GPU/TPU/ASIC/FPGA，目前 AI 服务器大多采用 CPU+GPU 架构，由于需要承担大量的矩阵运算功能，一般配置四块及以上的 GPU。AI 服务器凭借其强大的并行处理能力和高效的异构计算架构，成为满足大规模数据处理、模型训练和推理计算需求的核心设备，在全球生成式 AI 技术迅猛发展的大背景下，AI 服务器迎来广阔发展机遇。根据 Trend Force 数据，2026 年 AI 服务器出货量预计将突破 200 万台，2022 年-2026 年年复合增长率为 26%。根据 IDC 数据，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1,251 亿美元，2025 年将增至 1,587 亿美元，预计 2028 年将达到 2,227 亿美元，年复合增长率高达 15.51%；生成式人工智能服务器占比将从 2025 年的 29.6%提升至 2028 年的 37.7%。中国市场方面，2024 年中国人工智能服务器市场规模达到 190 亿美元，2025 年将达到 259 亿美元，同比增长 36.2%，2028 年将达到 552 亿美元。AI 服务器市场增长显著，相关增量未来也将带动服务器关键原材料之一的高速覆铜板及上游高性能填料领域相应增长。

2）高阶通用服务器

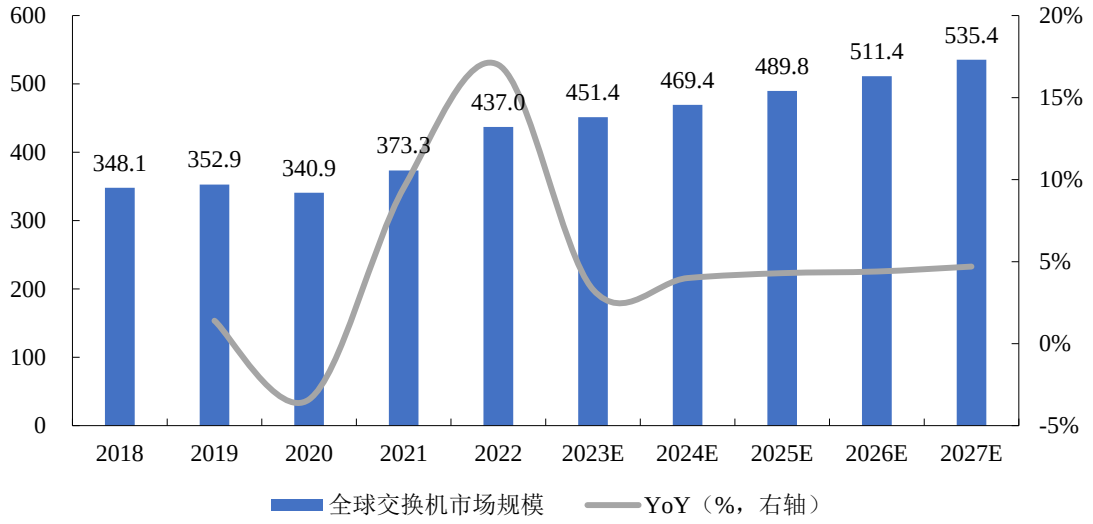
基于不同应用场景，AI 算力除可采用 AI 服务器机柜外，亦可应用通用服务器以支撑推理前后的运算和存储需求。通用服务器基于多核 CPU，主要服务于云计算、数据库及企业通用计算场景。AI 推理服务产生庞大运算负荷，带动高阶通用服务器进入替换与扩张周期，例如 Meta 建成新数据中心，对通用服务器需求显著增加。随着以 Intel 为代表的通用服务器历经从 Purley、Whitley、Eagle Stream 到 Birch Stream、Oak Stream 的持续迭代，总线标准从 PCIe 3.0 升级至 PCIe 5.0/6.0，驱动服务器 PCB 向高多层、高频高速、高密度互联等方向升级，同时带动 M6、M7 或更高等级的高速覆铜板材料需求。

（2）AI 高速网络通信（算力互联）

1）交换机

交换机是搭建计算机网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围、为子网络提供更多的连接端口、实现网络内部快速准确的数据转发，尤其在分布式计算加速训练过程中多个互连节点的信息传输，以及提高网络扩展能力和大量节点处理能力方面发挥关键作用。伴随 AI 算力产业的渗透率的不断提升，交换机市场发展前景广阔，出货量呈现稳步增长态势。根据 IDC 数据，2023 年全球交换机市场规模达 451 亿美元，且预计未来将保持 4%左右的稳定增速，预计 2027 年规模将达到 535 亿美元。

2018年-2027年全球交换机市场规模（亿美元）



资料来源：IDC

AIGC 带动高速数据中心交换机市场需求，数据中心交换机成为交换机行业增长主要驱动力。随着互联网网间流量急剧增长、企业业务上云以及数据中心云化建设成为发展趋势，互联网公司、金融行业、运营商和智能制造企业不断加大数据中心网络投资，数据中心交换机增速高于行业整体增速，成为行业增长主要驱动力。根据 IDC 统计预测，2023-2026 年全球 AI 数据中心网络交换机的收入复合年增长率将达到 55%；Arista 预计 2027 年全球数据中心交换机市场规模有望超过 350 亿美元。网络交换机正快速向 800Gbps 端口规格升级，IDC 预计 2026 年 800Gbps 端口将占数据中心交换机收入的 28%；Dell' Oro Group 预计 2025 年 800G 交换机占比将超过 400G 交换机，2027 年近一半的数据中心交换机端口将

由 400Gbps 及更高的速度驱动。随着 800G 及以上高速交换机市场渗透率的不断提高，高速多层级 PCB 板及上游高端覆铜板、高性能填料市场将会有显著发展空间。

2）光通信

①光模块

光模块是光通信系统的核心器件之一，主要用于实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能，为数据中心和高性能计算系统提供高速、大容量的数据传输服务。AI 算力需求的爆发以及超大规模数据中心建设热潮共同推动光通信产业进入升级关键期，光模块作为光通信系统中实现光电信号转换的核心器件，在 AI 大模型训练和推理应用对海量并行数据运算需求提升与大规模数据中心建设的推动下，市场需求迎来爆发式增长。

AI 训练集群内部 GPU 之间需要进行海量的数据交换（即“东西向流量”），进而对网络带宽和延迟提出极致要求，以 NVIDIA DGX H100 服务器集群为例，单个机柜需要超过 500 个高速光模块来满足其高达 4.8Tbps 的互联带宽需求。随着高性能计算系统和数据中心在 AI 智能设备中的广泛应用，光模块加速从 800G 向 1.6T 演进，预计未来 1.6T 乃至更高速率的光模块将成为配合更大带宽、更高算力 GPU 需求的关键器件。根据 Light Counting 数据，2023 年全球数通光模块市场规模达到 62.5 亿美元，预计到 2029 年有望达到 258 亿美元，2023-2029 年年复合增长率（CAGR）为 26.7%。未来高速光模块将成为数通市场光模块的主要增长驱动力，根据 Light Counting 预测，2025 年 800G 以太网光模块市场规模将超过 400G，随着高速光模块的快速导入，预计 2029 年 800G 和 1.6T 光模块的整体市场规模将超过 160 亿美元。

②光通信技术演进——NPO、CPO

伴随 AI 算力与高速互联需求爆发，光通信产业以可插拔光模块为基石，加速向 NPO（近封装光学）、CPO（共封装光学）等高速光互连技术方向演进。

NPO（近封装光学）技术将光引擎紧密集成在交换芯片附近，极大地缩短了电信号走线长度，显著降低了高频信号衰减，相较传统可插拔模块降低 50%以上功耗；同时，NPO 保留了光引擎的可拆卸性，避免了与交换芯片绑定封装带来

的良率与运维成本高问题。NPO 作为 CPO 技术的过渡方案，成为下一代超高速全光互联的核心技术路线，已率先实现产业化落地，如阿里云已成功点亮全球首款基于 OIF 标准封装的 3.2T NPO 光模块。根据 Global Technology Research 信息，下一代 AI 数据中心 GPU 旗舰产品 NVIDIA Rubin Ultra 机柜 Canister 之间的互联介质将采用 3.2Tbps 速率的 NPO 光引擎实现，这种光互连方案通过将电信号转换为光信号，突破了铜缆在传输距离和带宽密度上的物理限制。NPO 技术将光引擎封装于高性能 PCB 板，对基板的高密度、低损耗、高层数特性提出严苛要求，未来随着 NPO 大规模产业化落地，将推动高速多层级 PCB 板，以及上游超低损耗高速覆铜板、高性能填料市场需求。

CPO（共封装光学）技术将光引擎与交换芯片共同封装在同一基板上，将高频电信号的物理走线距离缩短至毫米级、亚毫米级，大幅降低功耗及信号传输衰减。根据博通与 Meta 的数据，CPO 方案可将 800G 光互联功耗从传统可插拔模块的 15W 降至 5.4W，系统能耗降低 65%以上；根据英伟达数据，CPO 可将每端口功耗从 30W 降至 9W，信号完整性提升 64 倍。目前，CPO 正加速从技术验证期向商业化过渡，如英伟达在 2026 年 GTC 大会上宣布其搭载 CPO 技术的 Spectrum-X 以太网交换机已携手台积电实现量产。CPO 光引擎与交换 ASIC 共封装集成方案对基板高速低损耗、更精细的线宽/线距、更高层数、更好散热能力要求更高，推动对高等级高速覆铜板需求，且该技术方案催生对 CoWoP 去载板化及类载板（SLP）需求，高性能填料市场将会有显著发展空间。

（3）低轨卫星

低轨卫星指运行在距离地面 200 至 2,000 公里轨道高度的人造卫星，是 6G“空天地一体化”网络的关键基础设施。近年来低轨卫星已成为全球航天发展的焦点，各国正加紧抢占轨道资源，星座部署迈入高峰期，截至 2025 年末，全球在轨运行卫星数量为 16,943 颗。我国在卫星通信技术方面快速追赶，并启动 GW 星座（国网星座）、千帆星座（G60 星链）等大型低轨卫星互联网星座。

随着全球加速进入 AI 时代，算力面临能源瓶颈，全球主要经济体（除中国外）电网修建缓慢、电力产出停滞，与指数级增长算力需求供需错配。基于第一性原理，将算力中心推向太空成为解决方案之一，国外商业航天龙头为年发射 1 万次、远期 2-3 万次进行准备，计划五年内向轨道输送 100GW 太阳能与算力载

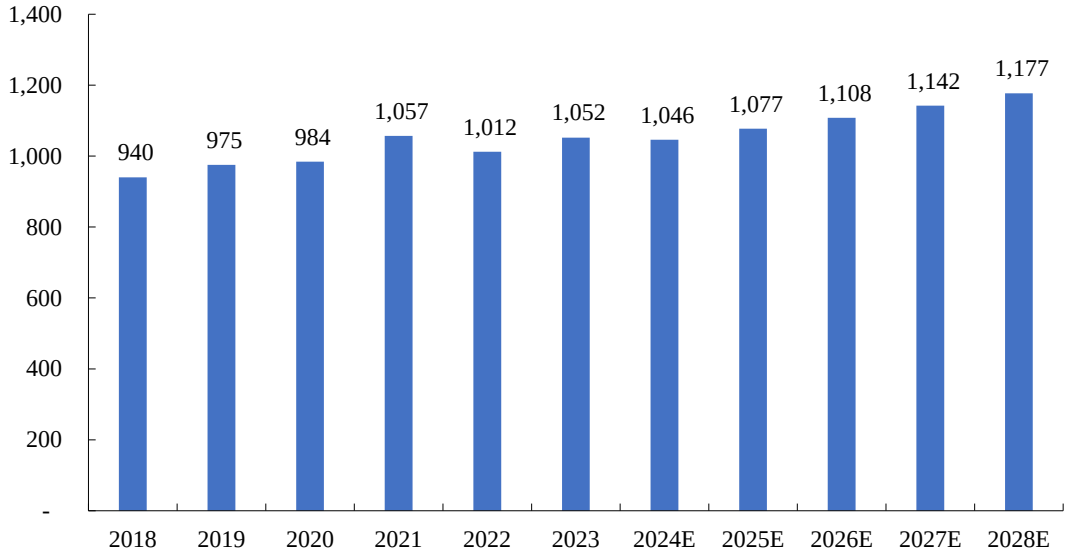
荷，太空算力正成为竞争新赛道，低轨算力网未来将进入工程化阶段。

由于卫星通讯主要使用 6GHz 以上较高频段，低轨卫星通信产品对高频特性、耐受性、稳定性等规格标准要求更高，低轨卫星地面终端设备的设计和制造均涉及高频高速覆铜板等高端板材。随着全球卫星产业加速成长，卫星设备、地面接收站、用户终端设备等需求随之高增，带动高端覆铜板市场需求增长。

（4）消费电子行业

全球消费电子市场规模整体呈现持续性增长趋势，伴随 AI 端侧应用加速渗透，以及虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子终端产品的融合，AI 手机、AI PC、折叠机等消费电子产品更新换代周期有所缩短，AI+创新形态消费电子产品的推出和渗透使得消费电子行业整体保持稳定增长态势。根据 Statista 数据，2024 年全球消费电子市场规模为 1.046 万亿美元，预计 2028 年将快速增长至 1.177 万亿美元。消费电子市场空间广阔，消费电子用覆铜板需求及上游粉体填料市场规模有较大的增长空间。

2018年-2028年全球消费电子市场规模（十亿美元）



资料来源：Statista，国海证券研究所

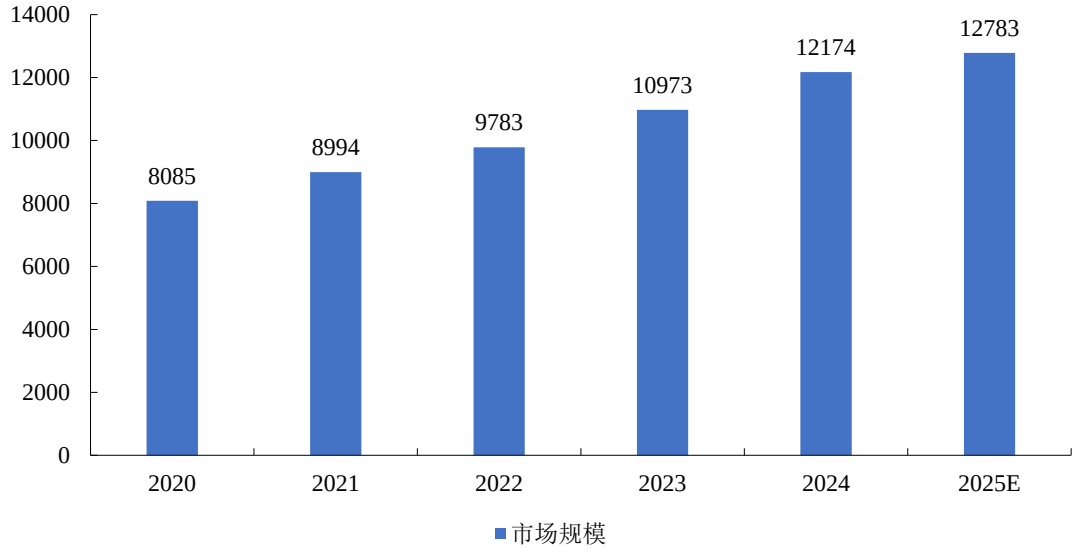
在 AI 技术的创新驱动和催化作用下，AI 手机、AI PC 等创新产品为消费电子市场注入强劲增长动能，引领 PCB、CCL 新需求。AI 技术的加速应用和快速渗透实现了对消费电子设备的功能性重构，智能手机、PC 等端侧应用加速 AI 大模型与硬件、生态的协同，AI 大模型与智能手机、PC 的结合将驱动新一轮的

换机周期，同时芯片算力升级、端侧模型的精简应用进一步推动 AI 技术向中端价位渗透，AI 消费硬件产品市场渗透率将持续提升。IDC 数据显示，2024 年全球 AI 手机出货量达 2.34 亿部，同比大幅增长 364%，预计 2025 年 AI 手机出货量进一步增长 73.1%。Canalys 数据显示，2023 年全球 AI 手机渗透率约为 5%，2025 年快速增长至 34%，预计到 2028 年有望提升至 54%，2023-2028 年复合增长率（CAGR）将达到 63%。AI PC 市场方面，IDC 数据显示，2025 年 AI PC 出货量预计突破 1 亿台，占 PC 总出货量的 30%；Canalys 预计到 2027 年 AI PC 出货量占比将达到 60%以上，成为主流的 PC 产品。伴随 AI 手机、AI PC 等消费电子终端的快速发展，下游市场对 HDI 板、高频高速覆铜板的需求激增。

（5）汽车电子行业

我国汽车产业向电动化、智能化、网联化方向不断升级，汽车电子化水平日益提高。近年来，我国新能源汽车产销规模持续增长，根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量从 2019 年的 120.6 万辆，快速增长至 2024 年的 1,285.8 万辆，2025 年将达到 1,650 万辆，增长速度接近 30%；新能源汽车市场渗透率亦从 2019 年的 4.7%大幅提升至 55%以上。根据中国汽车工业协会、中商产业研究院数据，我国汽车电子市场规模呈现快速增长趋势，2024 年我国汽车电子市场规模约为 1.22 万亿元，较 2023 年同比增长 10.95%，2025 年将达到 1.28 万亿元，主要增长驱动力来自自动驾驶、无人驾驶以及车载信息化技术的应用渗透。在人工智能加速赋能汽车产业链的大背景下，预计汽车电子行业增长潜力将得到进一步释放，进而带动车规级覆铜板技术升级与需求增长。

2020-2025年中国汽车电子市场规模（亿元）



资料来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

3、行业技术水平及特点

（1）高端功能性粉体材料需多类核心技术协同复合，技术门槛较高

高端功能性粉体材料的性能突破与产品迭代，贯穿原料端、加工端、应用端全产业链环节，需依托粉体合成、微纳加工、表面改性等多类技术体系的协同复合，具备较高技术门槛。伴随 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、半导体制造与封装等下游新兴产业对上游材料性能要求持续升级，行业技术演进已从后端微纳加工、表面改性工艺，向前端基础材料底层研究延伸。当前高端粉体材料的性能瓶颈，仅依靠后段工艺优化已难以实现跨越式突破，亟需从原材料端切入，开展粉体合成机理、配方体系、晶型结构等高难度基础研究，通过粉体合成技术打破产品性能上限，因此要求企业同时掌握粉体合成、微纳加工、表面改性等多类核心技术能力，并实现各技术环节之间的协同赋能，技术难度较高。

（2）多体系材料协同应用与下游配方差异化需求，定制化门槛高

在下游应用场景中，无机功能粉体材料并非单独使用，而是与多体系材料构成组合式应用配方。以覆铜板应用为例，无机功能粉体材料与树脂、玻纤布、铜箔等材料搭配使用，基于终端应用场景的差异，不同客户或同一客户不同产品的关键指标需求会因搭配使用的其他原材料性质和客户自身工艺技术而存在较大差异，例如部分客户由于自身树脂体系的原因对粉体表面改性水平要求较高，部

分客户需要超低介电粉体以实现对树脂或玻纤布介电性能上限的有效补偿。这种组合体系的复杂性、客户方案的多样性以及功能需求的多元性，使得产品定制化门槛较高。同时，伴随终端应用性能的持续迭代，无机粉体材料供应商与下游客户建立合作关系后，需深度适配不同客户的技术体系，紧跟下游技术迭代节奏开展协同创新，进而对无机粉体产品的创新升级能力提出了更高维度的定制化需求。

（3）高端应用要求严苛且高速迭代，研发创新需持续攻坚

下游以 AI 为代表的先进产业保持高速迭代频率，并持续向更高阶迈进，在对上游原材料提出更高性能要求的同时，亦驱动上游保持较高研发强度。以高速覆铜板为例，一方面，AI 算力等对高带宽、低时延、低损耗和高可靠性持续提出更高要求，高速覆铜板逐步迈向 M8、M9、M10 等级极低介电损耗序列，驱动功能性填料介电性能逼近极致，同时，还需兼顾低热膨胀系数、高导热、高模量等多维要求，而材料性能指标之间通常存在相互制约及复杂耦合关系，单项性能的提升可能会带来其他性能的抵减，或带来其他多项性能指标的复杂变化，因此同时实现多种性能的最优值，研发难度通常会显著提升；另一方面，为紧跟下游快速升级步伐，粉体材料企业不仅需保持高强度技术创新节奏，亦需具备自主研发和前瞻性布局能力，以确保在产业链中持续保持竞争力，这对于研发创新能力及研发投入强度均有着较高要求。

4、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

公司所处的先进无机非金属材料行业为研发驱动、技术密集型行业，呈现跨学科多领域、专业化程度高、研发投入大、研发周期长的特征，行业内企业需依托持续的研发投入和深厚的技术沉淀，以满足下游多样化定制需求。同时，随着 AI 等下游终端应用领域快速迭代、产品功能持续升级，对上游无机非金属材料的介电性能、导热性能、热稳定性等指标要求更为严格，并对企业技术水平与产品迭代速度提出更高标准。当前仅依靠粉体微纳加工调控粒径、形貌等物理特征，以及表面改性解决粉体与有机基材相容性等应用难题，已逐步接近产品性能提升的极限，还需结合原料端粉体合成技术予以突破。在此技术演进趋势下，在微纳加工、表面改性、粉体合成三大技术领域均有较强技术能力的厂商，才能稳固占

据行业竞争高地，然而上述技术均需要长期研发积淀与工艺积累，短期内难以被复制模仿，因此对新进入者构筑了较高技术壁垒。

（2）客户准入壁垒

公司主要产品作为关键功能性填料填充于覆铜板、导热界面材料等，用于增强下游基材的介电性能、尺寸稳定性、耐热性、导热性等核心性能，近年来被广泛应用于 AI 算力设施等高阶应用场景，为保障 AI 算力设施等稳定运行，在对上游原材料提出较高性能要求的同时，对品质可靠性和稳定性亦提出严格要求。同时，粉体材料在应用过程中具有较强的定制化属性，需针对性适配不同下游客户的产品设计与配方体系，且下游产业技术保持高速迭代频率，粉体供应商亦需紧跟下游快速升级步伐，保持高强度研发创新节奏。整体来看，下游客户基于产品性能、品质可靠性与稳定性、对特定配方体系的适配性以及持续迭代升级能力等多方位因素考虑，对粉体供应商的遴选和认证过程极为严苛，新进入者通常难以在短期内完成客户认证或获取市场份额，面临较高的客户准入壁垒。

（3）人才壁垒

公司所处的先进无机非金属材料行业涉及材料科学、界面化学、电化学、电子学、工程学科群等多学科领域，行业技术迭代速度快，具有显著的人才密集型特征。为匹配下游多元应用场景对材料性能的差异化需求，以及高端应用领域技术迭代对材料性能与前沿技术的更高要求，行业内企业需要大批扎实掌握材料学科知识、对材料应用具有深刻理解与认知、研发实践丰富的专业人才，以持续跟踪市场发展方向与技术迭代趋势，实现工艺技术层面的不断创新。上述专业人才相对稀缺，且专业技术人才培养周期长、投入成本高，因此，本行业具备较高的人才壁垒。

5、行业面临的机遇与挑战

（1）行业机遇

1）国家产业政策的支持有利于行业持续发展

先进无机非金属材料行业是国家重点鼓励发展的先进基础材料产业，近年来被广泛应用于 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、低轨卫星、半导体制造与封装、新能源等战略新兴领域，已成为支撑国家电子信息等产业链自主可控的关

键材料，其发展受到国家产业政策的大力支持。目前，《新材料中试平台建设指南（2024—2027 年）》《战略性新兴产业分类（2018）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》等一系列国家产业政策的推出，为多层次、多领域的先进无机非金属材料，提供良好的制度和政策保障，将促进行业持续健康发展。

2）AI 等先进产业爆发式发展带来快速增长机遇

AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算、半导体制造与封装等新兴应用领域的快速发展和技术突破，催生功能性材料行业新需求，进一步释放了高性能功能性填料市场的增长潜力。例如，在全球 AI 产业浪潮下，AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等先进应用场景发展迅猛，以高等级高速覆铜板为代表的高性能覆铜板，作为印制电路板（PCB）的核心基材，已成为 AI 服务器等算力设施的“性能基石”，高性能球形硅微粉系高端覆铜板的核心功能性填料，伴随 AI 爆发式发展带来的显著应用需求，以及 AI 等产业技术持续升级，带动对上游功能性粉体材料的使用需求朝着更高规格等级、更高填充比例不断演进，共同驱动高性能功能性粉体市场迎来高速增长。同时，随着 AI 算力设施、先进封装、5G/5G-A 通讯等超高功耗、高热流密度场景的迅速发展，热管理问题由此成为保障芯片性能和 AI 算力设施等稳定运行的重要课题，高端导热散热功能性材料作为电子元件热管理系统的重要组成部分，亦迎来高速增长机遇。整体来看，下游产业革新为高端功能性粉体材料行业发展注入强劲动力。

3）高端无机非金属材料进口替代空间广阔

长期以来，全球高端功能性填料市场主要由日本、欧美等外资厂商主导，如高端球形硅微粉领域，曾主要由日资厂商占据市场技术高地，而内资厂商中，能够在产品性能、技术水平、高端前沿布局方面与国际头部企业看齐的企业相对较少。此外，氮化铝、氮化硼等高端导热粉体材料曾长期依赖进口，先进制程芯片抛光液、先进封装等前沿新材料领域也面临国产化率较低、亟需国产替代突破的局势。上述高性能功能性材料作为影响下游终端产品核心性能的关键基础材料，属于国外垄断程度较高的细分行业，在国家对先进无机非金属材料及下游行业政策的大力支持下，进口替代空间广阔。

（2）行业挑战

1）下游行业高端产品迭代迅速，带来较高的研发创新与资金压力

近年来，AI 人工智能爆发式发展，并带动高速网络通信、云计算、半导体制造与封装等行业交互式高速发展，下游产业性能迭代迅速，牵引上游无机粉体供应商持续进行技术探索升级，因此企业在更高级别技术和产品创新层面面临着较大挑战。另一方面，无机非金属材料领域具有前期高投入，且需要经历较长的研发与产品技术迭代过程的特点，该等过程需要企业投入大量资金，且周期相对较长并伴随一定市场风险。因此，行业内企业将受到研发创新和资金的双重压力。

2）高端专业人才储备相对不足

先进无机非金属粉体材料行业是典型的技术密集行业，对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。虽然经过我国新材料行业多年发展，新材料领域特别是无机材料行业的从业人员逐步增多，但专业研发人才供不应求的情况依然存在。另外，由于新材料行业人才培养周期相对较长，高端、专业、跨学科领域的复合型人才仍然紧缺。

6、行业周期性、季节性和区域性特征

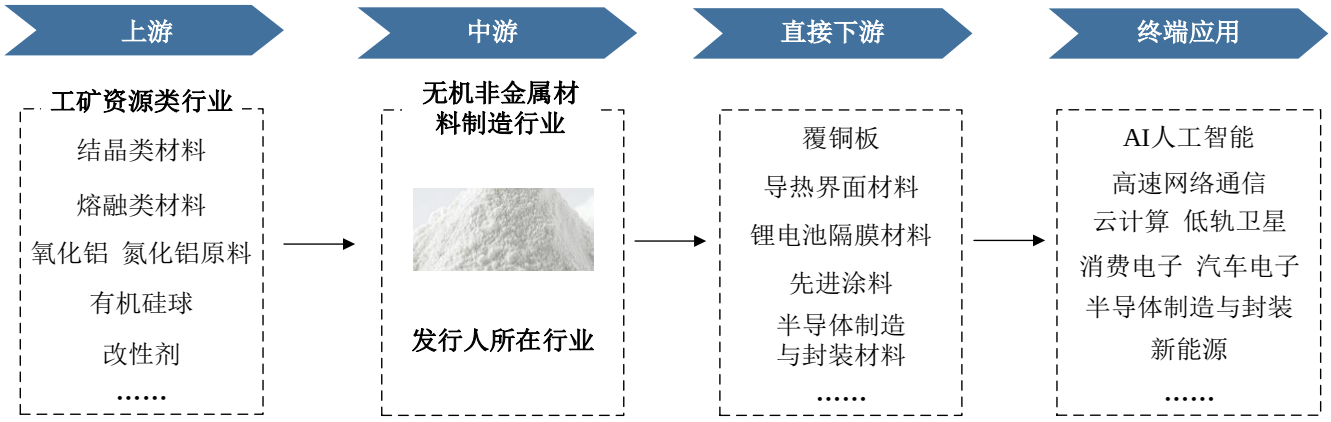
公司所处行业的周期性、季节性与其下游行业如 AI 人工智能、高速网络通信（光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算、低轨卫星、高端消费电子、汽车电子、半导体制造与封装、新能源等行业的景气度密切相关。由于行业下游应用领域较为广泛，下游单一行业周期性、景气度对先进无机非金属粉体材料行业的影响程度有限，且随着 AI 人工智能、高速网络通信、云计算等行业的快速发展，下游市场对功能性材料存在大量新兴需求，公司所处行业不具有明显的周期性和季节性。

无机非金属粉体材料生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。下游客户（尤其是高端领域客户）区位分布更贴近经济发达的长三角和珠三角地区，该等地区高端应用领域客户对高性能粉体材料需求量较大。近年来我国无机非金属粉体材料生产企业大多集中于华东地区，行业内企业销售区域主要来自华东和华南地区。

7、发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

公司主要从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售，公司所处的无机非金属材料制造行业为产业链中不可或缺的重要组成部分，对下游产品的关键性能具有重要影响。公司所属行业的上游行业主要为工矿资源类行业，包括石英砂等结晶类材料、熔融石英和玻璃类等熔融类材料、氧化铝原料、氮化铝原料、有机硅球、改性剂等，我国矿物资源较为丰富，国内产能供应充足、市场竞争充分，国内厂商可以保证原材料的基本需求。公司所属行业的直接下游包括覆铜板、导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装材料等行业，终端应用于 AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算、低轨卫星、高端消费电子、汽车电子、半导体制造与封装、新能源等行业，下游行业的市场需求和发展前景将直接影响本行业产品的需求，同时 AI 人工智能等新兴产业的快速崛起对 PCB、覆铜板的介电性能、导热性能，以及集成电路制程与封装提出更高要求，也将充分带动高性能功能性材料行业的技术迭代与快速发展。

公司所属行业在产业链中的地位和作用



（四）行业竞争情况

1、行业竞争格局

先进无机非金属材料行业是新材料产业的重要分支和国家工业战略性新兴产业的重要组成部分，具有产业规模大、市场高度细分等特点。在高性能先进无机非金属材料领域，日本和欧美等外资厂商曾长期占据全球主导地位。

我国先进无机非金属材料行业起步较晚，绝大部分国内厂商囿于资金技术实力，止步于中低端无机功能粉体材料市场，仅少数国内市场参与者成功实现产品创新和技术突破，在细分领域实现多款高端产品的进口替代，跻身头部厂商行伍。随着国内厂商持续的技术突破与产业升级，外资厂商对高性能粉体材料及前沿技术材料等关键细分领域的主导地位已被逐步打破。

2、发行人市场地位

（1）公司是覆铜板用无机功能粉体填料市场领先企业，占据下游龙头客户的重要供应地位

公司是电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，尤其是在应用于 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星的高等级高速覆铜板领域，公司具有业内领先的市场地位。2023 年至 2025 年期间，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会证明，在高等级高速覆铜板用球形硅微粉领域，公司全球市场占有率超过 40%，位列第一；根据中国非金属矿工业协会证明，公司在覆铜板用硅微粉领域销售规模位居国内第一。公司系少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业，根据中国非金属矿工业协会开具的证明，公司化学合成新工艺“避开了国外的技术封锁，极大地提升了我国高端球形硅微粉的加工水平，产品性能指标达到国际领先水平，填补了国内空白”。

基于突出的产品性能优势，公司已全面覆盖高速覆铜板龙头客户供应链并占据重要供应地位。根据全球 PCB 行业权威统计机构 Prismark 公布数据，2024 年高速覆铜板主要厂商有台光电子、联茂电子、台燿科技、生益科技、南亚电子、韩国斗山、华正新材、南亚新材、建滔化工、日本松下，其销售额合计占全球总销规模的 90%以上，发行人客户已全部覆盖该等高速覆铜板龙头厂商，并在多个龙头客户中取得重要供应地位。

（2）公司坚持以自主研发和底层创新为驱动，致力于成为功能性材料科技创新引领者

公司自设立以来坚持以自主研发和底层创新为驱动，致力于成为功能性材料科技创新引领者，依托在电子信息领域的深厚积淀所构筑的平台型技术，公司逐

步实现在高端化、前沿化产品战略方向的纵横发展。一方面，公司基于平台型技术的同源性和横向拓展性，成功实现多类高端粉体材料的横向布局，如在导热散热材料领域，公司自主开发的高导热氮化铝、氮化硼产品，打破日本、欧美等外资厂商的主导地位，实现了国产高端氮化铝、氮化硼产品的批量供应，广泛应用于 AI 算力中心、先进封装、5G/5G-A 基站等高端应用场景。另一方面，公司已前瞻性布局下世代高速覆铜板（M9、M10 等级）用硅微粉填料、AI 用高密度互联 PCB 及下世代玻璃基板（TGV）用电子浆料、集成电路先进制程芯片抛光液纳米氧化物，以及液态塑封料（LMC）、颗粒状环氧塑封料（GMC）、芯片底部填充胶（UF）用功能材料等高端前沿产品，为在电子信息用功能性粉体材料领域持续锁定领先身位奠定坚实基础，不断实现纵深发展。

3、行业内主要企业及发行人与同行业可比公司的比较情况

（1）行业内主要企业

功能性材料领域主要参与者包括日本雅都玛、日本龙森、日本电化株式会社、日本德山、法国圣戈班等外资厂商，以及发行人、国瓷材料、雅克科技、联瑞新材、天马新材、壹石通等国内企业。

上述外资厂商普遍具有业务布局多元、经营规模较大的特点，其中，日本雅都玛、日本龙森主要从事球形二氧化硅等功能性粉体材料业务，日本电化株式会社、日本德山、法国圣戈班为全球集团性企业，业务领域广泛。国内企业中，国瓷材料、雅克科技为综合性粉体材料企业，业务范围较广；联瑞新材、天马新材、壹石通、百图股份聚焦于功能性材料细分领域。

公司所处行业的主要企业具体如下：

地区	公司名称	公司简介
境外	Admatechs.（日本雅都玛公司）	日本雅都玛专注于球形二氧化硅、球形氧化铝等氧化物陶瓷粉及其加工产品的研发、生产与销售，产品应用于超薄半导体用塑封料、LCD 和 PDP 等平板显示设备的隔膜密封材、汽车零部件为首的工程塑料、食品和医疗用品的包装薄膜等。
	Tatsumori（日本龙森）	日本龙森公司专业从事二氧化硅填料及其他功能性填料的开发、制造和销售，主要产品包括高纯度结晶性石英粉、高纯度熔融石英粉、高纯度真球状石英粉等，产品主要应用于半导体

地区	公司名称	公司简介
		封装等领域。
	Denka（日本电化株式会社）	日本电化株式会社是全球性化学集团，业务涵盖无机化学品、有机化学品、电子材料、医药等领域，旗下设尖端机能材料部、电子零件材料部、多机能薄膜部和粘合剂综合方案部，其中电子/尖端产品板块主要产品包括二氧化硅粉体、球形氧化铝等，主要应用于电子、半导体封装等领域。
	Tokuyama（日本德山）	日本德山是一家综合化学公司，业务涵盖化学品、电子与先进材料、生命科学、环境产品等多个领域，其电子材料产品包括高纯度氮化铝粉体。
	Saint-Gobain（法国圣戈班）	法国圣戈班业务涵盖高新材料、陶瓷材料、胶粘剂、汽车玻璃、建筑材料、磨料磨具等领域，其陶瓷材料业务板块产品之一为氮化硼。
境内	国瓷材料（300285.SZ）	国瓷材料主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料在内的六大业务板块。
	雅克科技（002409.SZ）	雅克科技为综合性粉体材料企业，主营业务包括电子材料、LNG 保温复合材料、阻燃剂三大板块，其中电子材料产品涵盖半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统（LDS）等。
	联瑞新材（688300.SH）	联瑞新材主要从事功能性先进粉体材料的研发、制造和销售，主要产品包括角形二氧化硅、球形二氧化硅、球形氧化铝等，产品主要应用于半导体封装材料、电子电路基板、导热材料等行业。
	天马新材（920971.BJ）	天马新材主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。
	壹石通（688733.SH）	壹石通主要产品包括无机功能粉体材料和聚合物材料两大类，其中，无机功能粉体材料主要包括勃姆石、二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，主要应用于锂电池隔膜涂覆、电子芯片封装、电子印刷线路板领域。
	百图股份（875029.NQ）	百图股份从事先进无机非金属导热粉体材料的研发、生产和销售，主要产品包括球形氧化铝、氮化物、亚微米氧化铝等功能性粉体材料，产品应用于新能源汽车、网络通信、消费电子、人工智能等领域。

（2）发行人与同行业可比公司的比较情况

发行人主要从事先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售，产品包括高

性能球形硅微粉、角形硅微粉等电子信息功能材料，高导热氮化物、导热氧化铝等导热散热功能材料及其他新兴功能材料。发行人综合考虑业务产品相似度、经营规模可比性、财务数据可获取性等因素，选取 A 股上市公司联瑞新材（688300.SH）、国瓷材料（300285.SZ）、雅克科技（002409.SZ）、天马新材（920971.BJ）、壹石通（688733.SH）作为同行业可比公司。发行人与同行业可比公司在主要产品、应用领域、技术实力、关键指标等方面的对比情况如下：

公司名称	经营情况	市场地位	技术实力	关键指标
联瑞新材	联瑞新材主要产品包括角形二氧化硅、球形二氧化硅、球形氧化铝等，产品主要应用于半导体封装材料、电子电路基板、导热材料等行业	半导体封装领域功能性粉体材料领先企业	截至 2025 年末，联瑞新材已获授权发明专利 76 项	2025 年度营业收入为 11.16 亿元，归属于上市公司股东的扣非后净利润为 2.64 亿元
国瓷材料	国瓷材料主要产品包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料等，产品主要应用于电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷等领域	大型综合型企业，MLCC 介质粉体领先企业	截至 2025 年末，国瓷材料已获授权境内发明专利 156 项	2025 年度营业收入为 45.83 亿元，归属于上市公司股东的扣非后净利润为 6.05 亿元
雅克科技	雅克科技主要产品包括电子材料、液化天然气（LNG）保温绝热板材、阻燃剂等	大型综合型企业，电子材料领先厂商	截至 2025 年末，雅克科技已获授权境内发明专利 18 项	2025 年度营业收入为 86.11 亿元，其中硅微粉产品收入为 2.88 亿元；归属于上市公司股东的扣非后净利润为 9.54 亿元
天马新材	天马新材主要产品包括电子陶瓷用粉体材料、电子及光伏玻璃用粉体材料、高压电器用粉体材料等，产品主要应用于电子陶瓷、高压电器、电子及光伏玻璃、锂电池隔膜、研磨抛光、高导热材料和耐火材料等领域	我国精细氧化铝领域先进企业	截至 2025 年末，天马新材已获授权发明专利 8 项	2025 年度营业收入为 2.74 亿元，归属于上市公司股东的扣非后净利润为 0.20 亿元
壹石通	壹石通主要产品包括无机功能粉体材料、聚合物材料等，产品主要应用于锂电池涂覆材料领域、电子通信功能填充	锂电用勃姆石领域领先企业	截至 2025 年末，壹石通已获授权发明专利 101 项	2025 年度营业收入为 6.30 亿元，归属于上市公司股东的扣非后净利润为 -0.56 亿元

公司名称	经营情况	市场地位	技术实力	关键指标
	材料等领域			
发行人	发行人主要产品包括球形硅微粉、高导热氮化物等，产品应用于高等级高速覆铜板，高阶HDI板、IC载板、类载板（SLP）用各类高端覆铜板，导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装材料等领域	电子信息领域覆铜板用无机功能粉体领先企业	截至本招股说明书签署日，发行人已获授权发明专利65项	2025年度营业收入为10.36亿元，归属于母公司所有者的扣非后净利润为1.64亿元

注：同行业可比公司信息来源于其公开披露的招股说明书、募集说明书、年度报告及企查查信息；国瓷材料、雅克科技年度报告中未披露其拥有的专利数量，表格中的专利数量系根据企查查公开信息统计。

4、发行人的竞争优势与劣势

（1）竞争优势

1）领先优势：较早实现高端产品规模化供应，紧握 AI 算力领域功能性材料发展先机

公司在电子信息功能粉体材料领域具备先发优势与核心竞争力，依托长期自主研发和底层创新所积累的深厚技术经验与研发优势，较早攻克了高性能粉体合成、微纳加工、表面改性等核心技术难关，打破了外资厂商对高端功能性粉体的技术封锁与市场主导，并在覆铜板用功能性填料领域建立起领先地位，系少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业。公司与下游高速覆铜板领域龙头客户构建了多维度、全谱系的深度合作，以深厚的研发实力为根基，基于在M6至M8等级高速覆铜板的优势基础，持续匹配下游客户开展产品技术的迭代更新，较早储备更低损耗、空心结构、特殊异形硅微粉等前沿产品，为在M9、M10等下世代高速覆铜板领域持续锁定领先身位奠定坚实基础。

公司依托成熟的平台型技术实现产品快速迭代升级，持续紧跟客户需求优化产品性能，以高性能球形硅微粉等高端产品的批量、稳定供应能力为核心优势基础，积极把握AI算力产业的爆发式增长机遇，高效应对下游市场对高性能功能粉体材料持续快速增长的需求，为筑牢核心竞争壁垒与行业领先地位奠定坚实基础。

2）技术优势：自主研发构建无机功能性粉体材料全链条核心技术体系

公司长期深耕高性能无机功能性粉体材料领域，经过二十余载的自主研发和创新实践，构建了以粉体合成技术群、粉体微纳加工技术群、表面改性技术群为核心，以配方技术、自动化控制系统开发技术为补充的核心技术体系。目前绝大部分国内供应商主要具备粉体微纳加工能力，且多集中于相对成熟的微米级研磨、分级技术，较难突破技术门槛较高的纳米级研磨、分级以及球形制备技术；表面改性技术可有效解决无机粉体与有机基材的适配应用难题，但仅依靠微纳加工与表面改性已逐步逼近粉体性能提升上限，亟需粉体合成端的技术突破。

公司同时掌握原料合成、粉体加工及应用适配全链条技术环节，具有领先的技术优势。如在粉体合成技术领域，公司是行业中少数同时掌握化学合成、水热合成、固相合成、自蔓延燃烧、超临界合成等多项粉体合成技术的无机功能粉体供应商，可依托粉体合成技术在原料端实现产品性能突破或原材料自给及降本增效；在粉体微纳加工技术领域，公司是少数同时掌握化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅三种高端粉体制备技术，并较早在覆铜板领域实现规模化应用的企业，并且公司研磨和分级技术达到业内先进水平（D50＜0.4μm，D100＜1.4μm）；在表面改性技术领域，公司自主研发干法改性、湿法改性、蒸汽改性、气相改性及复配改性等多项改性技术，掌握 30 余种改性剂反应机理。此外，公司基于已有核心技术优势进行多线扩展布局，并在前沿技术领域积极探索储备，进一步高筑技术与产品力的护城河。

3）产品优势：产品体系布局多元，高端、前沿产品性能突出

公司构建了电子信息功能材料、导热散热功能材料、其他新兴功能材料的多元化功能性材料矩阵，产品体系丰富且布局前瞻，可广泛应用于高等级高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用各类高端覆铜板，以及高导热胶等导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装材料等多个新兴领域，可匹配不同应用场景下客户的差异化、定制化需求，具备较强的产品品类优势。

产品性能方面，公司多种高性能粉体材料性能优势突出，如公司高性能球形硅微粉广泛应用于当前最高技术规格等级的 M8 等级高速覆铜板、IC 载板，并

适配下世代高速覆铜板、类载板（SLP），目前已在高等级高速覆铜板领域确立相关领先地位；公司已实现氮化铝、氮化硼等高导热粉体的国产化量产，打破了国外垄断；前沿产品领域，公司自主开发的先进制程芯片抛光液纳米氧化物、高密度互联 PCB 板和下世代玻璃基板（TGV）用电子浆料等产品，性能达到领先水平。公司高性能球形硅微粉、高导热氮化铝等核心产品的关键性能指标已达到或超过工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》、国家发改委《新材料关键技术产业化实施方案》所载技术标准，并获得行业协会、下游龙头客户对于产品性能优势方面的认可。

4）客户优势：拥有稳定合作的行业龙头客户资源

公司始终坚持以下游客户需求为导向，依托产品性能优势和技术优势，已进入电子信息、导热散热、锂电新能源、先进涂料等多个行业龙头客户供应链体系。在电子信息领域，公司客户已覆盖台光电子（高速覆铜板市占率第一）、联茂电子、台燿科技、生益科技、南亚新材、华正新材、南亚电子、建滔化工、韩国斗山、日本松下等全球前十大高速覆铜板制造商（CR10>90%），终端客户覆盖英伟达、亚马逊、谷歌、AMD、Meta、英特尔、浪潮等国际知名科技企业；在导热业务板块，公司客户包括陶氏化学、汉高、迈图、莱尔德、瓦克化学、洛德、比亚迪、苏州天脉、博恩新材等知名企业；在锂电新能源领域，公司终端客户包括恩捷股份、金力股份、中材科技等锂电池隔膜行业龙头企业；在涂料应用领域，公司已与涂料市场代表性企业如阿克苏诺贝尔、立邦、老虎、PPG 等建立稳定合作关系。公司拥有稳定且优质的客户资源，有利于公司的持续性发展，同时，借助龙头客户标杆效应，有助于公司进行客户拓展，为公司持续提升市场份额打下坚实的基础。

5）质量管理优势：质量管理体系完善，产品品质稳定

公司无机功能性粉体材料产品位于产业链的上游位置，其质量及品质稳定性将直接影响下游产品的关键性能。以 AI 算力设施应用场景为例，AI PCB 厂商对覆铜板性能稳定性和一致性的极高要求，向上游传导至对无机功能性粉体材料品质的极高标准。公司高度重视产品质量水平，设立专门质量控制部门，建立健全完善的品质管理体系与全过程质量控制措施，在生产过程中严格执行质量控制程序，并配备先进的品质检测设备，实现对研发、生产、检验、销售等全业务链

条的严格质量管理。依托高效严格的质量控制体系，公司产品品质稳定性与品控一致性表现突出，为公司在先进无机功能性粉体材料领域保持较强的市场竞争力提供了有力保障。

（2）竞争劣势

1）资金融资劣势

公司所处的先进无机非金属材料行业具有资金密集型特征，一方面，随着市场的快速发展和技术持续迭代升级，行业内企业需要投入大量资金以进行新产品、新技术的研发创新；另一方面，为了实现产品规模化、稳定化生产，新产房建设、生产设备购置等产能扩建活动均需要资金量支持，这将给公司带来一定的资金压力。现阶段，公司发展主要依赖于股东投入及银行贷款，融资渠道较为单一，不利于公司的长期快速发展。

2）产能瓶颈制约

近年来，受益于下游 AI 等新兴产业对先进无机功能性粉体材料需求不断提升，以及公司产品种类、应用领域的不断拓展，公司销售规模快速增长，现有产能已逐渐难以满足未来日益增长的市场需求。面对下游 AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算等终端市场快速发展与持续迭代带来的先进功能性材料广阔需求市场，产能成为制约公司高速发展的因素之一，公司产能规模亟待进一步扩张。

三、销售情况和主要客户

（一）主要产品的规模及收入情况

1、主要产品销售收入

报告期内，公司主营业务收入主要来源于电子信息功能材料、导热散热功能材料以及其他新兴功能材料三大业务板块，具体构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电子信息功能材料	78,181.81	75.75%	53,524.84	73.72%	37,031.51	71.52%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
导热散热功能材料	13,126.16	12.72%	10,602.26	14.60%	7,682.41	14.84%
其他新兴功能材料	11,898.55	11.53%	8,477.52	11.68%	7,066.10	13.65%
合计	**103,206.52**	**100.00%**	**72,604.62**	**100.00%**	**51,780.03**	**100.00%**

2、主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司主要业务板块销售平均价格变动情况如下：

单元：元/吨

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	平均价格	变动比例	平均价格	变动比例	平均价格
电子信息功能材料	19,009.19	23.34%	15,412.00	43.49%	10,741.16
导热散热功能材料	22,077.89	10.81%	19,924.85	25.06%	15,932.15
其他新兴功能材料	9,115.70	9.68%	8,311.14	18.22%	7,030.32

3、主要产品产能、产量和销售情况

公司产品品类丰富、生产工序各异，且由多道工序组合生产而成，并存在部分产线共用情形，难以逐一统计单个产品的产能及产能利用率。因此，公司选取报告期内产销规模较大的代表性产品作为标准产品，根据标准产品在瓶颈生产工序的产能、产量情况，并将同类其他规格产品对照标准产品进行折算，据此汇总折算后的产能、产量并计算产能利用率。

报告期内，公司主要产品的产能、产量及产能利用率情况如下：

单位：吨

产品系列	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
高性能球形硅微粉	折合产能	5,382.08	4,149.18	3,281.72
	折算后产量	5,234.80	3,375.12	2,012.20
	产能利用率	97.26%	81.34%	61.32%
角形硅微粉	折合产能	40,670.39	38,985.70	38,805.16
	折算后产量	38,658.78	35,622.95	35,330.54
	产能利用率	95.05%	91.37%	91.05%
高导热氮化物	折合产能	56.94	42.71	14.24
	折算后产量	53.08	30.88	10.92
	产能利用率	93.21%	72.30%	76.72%

注 1：上表中纳入统计范畴的产品系列包括高性能球形硅微粉、角形硅微粉和高导热氮化物，其中，高性能球形硅微粉主要包括化学法球硅、直燃法球硅和火焰法球硅，角形硅微粉主要包括软性复合填料、熔融硅微粉，高导热氮化物以氮化铝为主，其销售收入占比合计超 70%；上表中统计产品未区分其下游应用领域，涵盖电子信息、导热散热及其他新兴应用领域，下同。

注 2：高性能球形硅微粉、角形硅微粉、高导热氮化物各选取代表性产品，折合产能=标准产品瓶颈生产工序产能，产量则按照一定折合系数将同类产品不同型号换算成标准产品后得到，折算后产量=Σ同类产品不同规格产品的产量*单个产品折标系数。其中，单个产品折标系数系标准产品与同系列其他规格产品在瓶颈生产工序上的单位产能差异折算值。

报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

单位：吨

产品系列	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
高性能球形硅微粉	产量	7,085.71	4,088.42	2,541.54
	销量	6,948.77	4,135.19	2,364.83
	产销率	98.07%	101.14%	93.05%
角形硅微粉	产量	37,114.12	33,152.76	33,313.72
	销量	38,327.20	33,490.41	34,361.73
	产销率	103.27%	101.02%	103.15%
高导热氮化物	产量	79.82	38.26	22.67
	销量	85.03	30.80	18.66
	产销率	106.53%	80.50%	82.30%

注 1：上表系按照产品实际产量、销量统计，未按照标准产品进行折算。

注 2：报告期内，公司主要产品产销情况良好，部分产品的产销率超过 100%，主要系上期库存在当期实现销售所致。

（二）主要客户情况

报告期内，公司对前五大客户销售情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户	主要产品	金额	占比
2025 年度	1	台光电子	高性能球形硅微粉、角形硅微粉等	56,489.64	54.53%
	2	锦艺阿泰欧	隔膜超细氧化铝等	5,855.30	5.65%
	3	生益科技	角形硅微粉、其他电子信息功能材料、高性能球形硅微粉等	4,665.05	4.50%
	4	南亚新材	高性能球形硅微粉、角形硅微粉、其他电子信息功能材料	3,546.86	3.42%
	5	台燿科技	角形硅微粉、高性能球形硅微粉等	2,677.32	2.58%
	合计			**73,234.16**	**70.70%**
2024 年度	1	台光电子	高性能球形硅微粉、角形硅微	35,980.55	49.39%

年度	序号	客户	主要产品	金额	占比
			粉等		
	2	锦艺阿泰欧	隔膜超细氧化铝等	4,135.53	5.68%
	3	生益科技	角形硅微粉、高性能球形硅微粉等	3,681.99	5.05%
	4	汉高集团	导热氧化铝、氮化铝等	3,001.77	4.12%
	5	南亚新材	高性能球形硅微粉、角形硅微粉等	2,357.94	3.24%
	合计			**49,157.78**	**67.47%**
2023 年度	1	台光电子	高性能球形硅微粉、角形硅微粉等	20,537.03	39.53%
	2	生益科技	角形硅微粉、高性能球形硅微粉等	3,975.66	7.65%
	3	锦艺阿泰欧	隔膜超细氧化铝等	3,485.28	6.71%
	4	比亚迪供应链	导热氧化铝、其他导热散热功能材料	2,300.46	4.43%
	5	南亚新材	角形硅微粉、高性能球形硅微粉等	2,213.05	4.26%
	合计			**32,511.47**	**62.58%**

注：归属于同一集团公司的客户的销售情况以合并口径列示。

报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占各期营业收入的比重分别为62.58%、67.47%和 70.70%。其中公司第一大客户台光电子各期销售额占营业收入的比例分别为 39.53%、49.39%和 54.53%，销售收入占比较高，主要系台光电子系高速覆铜板、HDI 用覆铜板领域技术和市场龙头，伴随 AI 的爆发式发展迎来快速增长，发行人对台光电子的销售情况，与 AI 等产业终端发展情况，以及台光电子的行业领先地位、高端产品定位、业绩增长情况相匹配。截至 2025 年 12 月 31 日，除锦艺阿泰欧系公司合营企业外，公司 5%以上的股东、董监高人员、核心技术人员与以上其他客户不存在关联关系，其终端客户主要为恩捷股份、金力股份等锂电池隔膜行业龙头企业。

四、采购情况和主要供应商

（一）主要采购情况

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司生产所需主要原材料包括有机硅球、氧化铝原料、火焰法球硅原料、氮化铝原料、碎玻璃片、直燃法球硅原粉、玻璃熔块等。主要原材料采

购金额及占原材料采购总金额比重如下：

单位：万元、%

物料类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
有机硅球	14,554.89	32.50	9,410.57	29.74	5,167.26	24.03
氧化铝原料	7,490.61	16.72	6,226.12	19.68	3,323.86	15.45
火焰法球硅原料	4,000.45	8.93	913.38	2.89	473.61	2.20
氮化铝原料	2,933.01	6.55	1,759.03	5.56	1,208.48	5.62
碎玻璃片	2,793.04	6.24	1,618.90	5.12	1,319.61	6.14
直燃法球硅原粉	2,601.54	5.81	2,187.09	6.91	1,697.57	7.89
玻璃熔块	1,819.03	4.06	1,963.43	6.21	1,897.61	8.82
合计	**36,192.57**	**80.78**	**24,078.52**	**76.11**	**15,088.00**	**70.15**

报告期内，公司原材料的采购价格变动主要受原材料类型和市场价格变化影响，采购价格变动如下：

单位：元/吨、%

物料类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	采购单价	变动比例	采购单价	变动比例	采购单价	变动比例
有机硅球	53,319.06	-9.23	58,739.01	-8.64	64,292.22	/
氧化铝原料	7,995.19	-0.74	8,055.05	16.54	6,911.91	/
火焰法球硅原料	19,706.39	-11.65	22,304.68	11.60	19,986.57	/
氮化铝原料	297,374.93	-16.31	355,337.98	-3.74	369,160.04	/
碎玻璃片	1,650.75	17.12	1,409.48	5.31	1,338.35	/
直燃法球硅原粉	36,130.73	-1.38	36,634.81	-14.24	42,717.79	/
玻璃熔块	1,104.28	11.31	992.07	2.31	969.71	/

2、主要能源使用情况

公司主营产品生产所需的主要能源为电力。报告期内，公司的能源消耗情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
采购量（万度）	4,753.89	3,930.27	3,287.36
金额（万元）	3,223.08	2,794.08	2,382.86
平均价格（元/度）	0.68	0.71	0.72

（二）主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商[注1]	主要采购内容	金额	占营业成本比重
2025年度	1	惠源（上海）化工有限公司[注2]	有机硅球	9,211.52	13.48%
	2	连云港航阔新材料有限公司[注2]	火焰法球硅原料	6,963.69	10.19%
	3	长兴特殊材料（珠海）有限公司	有机硅球	5,206.05	7.62%
	4	青岛三锐佰德新材料有限公司	直燃法球硅原粉	2,463.78	3.61%
	5	宁夏艾森达新材料科技有限公司	氮化铝原料	2,326.81	3.41%
	合计			**26,171.85**	**38.31%**
2024年度	1	长兴特殊材料（珠海）有限公司	有机硅球	5,660.28	11.24%
	2	惠源（上海）化工有限公司	有机硅球	3,960.89	7.86%
	3	连云港航阔新材料有限公司	氧化铝原料、火焰法球硅原料	3,447.94	6.85%
	4	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	火焰球化加工服务	2,739.57	5.44%
	5	青岛三锐佰德新材料有限公司	直燃法球硅原粉	2,187.09	4.34%
	合计			**17,995.77**	**35.73%**
2023年度	1	长兴特殊材料（珠海）有限公司	有机硅球	3,698.21	10.25%
	2	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	火焰球化加工服务	3,220.80	8.93%
	3	青岛三锐佰德新材料有限公司	直燃法球硅原粉	1,698.14	4.71%
	4	惠源（上海）化工有限公司	有机硅球	1,546.06	4.29%
	5	连云港航阔新材料有限公司	熔融石英	1,442.98	4.00%
	合计			**11,606.19**	**32.17%**

注 1：供应商采购金额包括原材料、委托加工采购金额。

注 2：惠源（上海）化工有限公司、上海艺科迈新材料有限公司系同一控制；连云港航阔新材料有限公司、连云港锐智新材料有限公司和安徽正锐新材料科技有限公司系同一控制；对于上述同一控制供应商，本表合并列示其采购金额。

报告期内，公司不存在向单个原材料供应商的采购比例超过总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 5%以上股东、董监高人员、核心技术人员与以上供应商不存在关联关系。

五、发行人主要资产情况

（一）主要固定资产情况

1、固定资产分类情况

公司及附属子公司主要固定资产为开展生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。截至 2025 年 12 月 31 日，主要固定资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	38,611.32	35,380.20	91.63%
机器设备	42,620.92	29,870.32	70.08%
运输设备	627.90	284.78	45.35%
电子设备及其他	1,529.74	692.79	45.29%
合计	**83,389.87**	**66,228.09**	**79.42%**

2、自有房屋及建筑物情况

截至本招股说明书签署日，公司及附属子公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	权利人	证号编号	房屋坐落	建筑面积（㎡）	房屋用途	他项权利
1	锦艺新材	苏（2020）常熟市不动产权第 8100328 号	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号	20,765.31	工业	-
2	锦艺新材	苏（2024）常熟市不动产权第 8129926 号	常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号	32,281.45	工业	抵押
3	功能材料	苏（2026）常熟市不动产权第 8100862 号	常熟市碧溪街道兴港路 17-9 号	20,997.15	工业	抵押
4	云阳锦艺	渝（2019）云阳县不动产权第 000209742 号	云阳县人和工业园区	5,734.69	工业	-
5	云阳锦艺	渝（2019）云阳县不动产权第 000210478 号	云阳县人和工业园区	3,650.50	工业	-
6	云阳锦艺	渝（2019）云阳县不动产权第 000212100 号	云阳县人和工业园区	7,285.12	工业	-

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司及附属子公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	权利人	证号编号	用途	土地座落	面积（㎡）	取得方式	有效期至	是否抵押
1	锦艺新材	苏（2020）常熟市不动产权第8100328号	工业用地	常熟市碧溪街道兴港路25-1号	36,220.00	出让	2067-07-26	否
2	锦艺新材	苏（2024）常熟市不动产权第8129926号	工业用地	常熟市碧溪街道兴港路25-1号	32,696.00	出让	2069-09-10	是
3	功能材料	苏（2026）常熟市不动产权第8100862号	工业用地	常熟市碧溪街道兴港路17-9号	66,554.00	出让	2071-04-25	是
4	云阳锦艺	渝（2019）云阳县不动产权第000209742号	工业用地	云阳县人和工业园区	9,377.00	出让	2056-08-15	否
5	云阳锦艺	渝（2019）云阳县不动产权第000210478号	工业用地	云阳县人和工业园区	10,448.52	出让	2056-08-15	否
6	云阳锦艺	渝（2019）云阳县不动产权第000212100号	工业用地	云阳县人和工业园区	17,515.68	出让	2056-08-15	否

2、专利

截至本招股说明书签署日，公司及附属子公司已取得有效专利 72 项，其中发明专利 65 项、实用新型 7 项。

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日期	专利期限	取得方式	他项权利
1	玻璃微粉及其制备方法	ZL201210060697.2	锦艺有限	发明专利	2012-3-9	20 年	受让取得*	无
2	软性玻璃微粉及其制备方法	ZL201210081369.0	锦艺有限	发明专利	2012-3-26	20 年	受让取得*	无
3	覆铜板用无机填料的制备方法	ZL201310540105.1	锦艺有限	发明专利	2013-11-5	20 年	受让取得*	无
4	低介电常数覆铜板及其制作方法	ZL201510593839.5	锦艺有限	发明专利	2015-9-17	20 年	受让取得*	无
5	一种覆铜板用填料的制备方法、覆铜板用树脂组合物以及覆铜板	ZL201510815912.9	锦艺有限	发明专利	2015-11-23	20 年	受让取得*	无
6	一种树脂组合物及其制作的覆铜板	ZL201510884060.9	锦艺有限	发明专利	2015-12-3	20 年	受让取得*	无
7	一种覆铜板用填料、树脂组合物及其在覆铜板中的应用	ZL201610156705.1	锦艺有限	发明专利	2016-3-18	20 年	受让取得*	无
8	一种耐离子迁移填料及覆铜板	ZL201611121869.7	锦艺有限	发明专利	2016-12-8	20 年	受让取得*	无
9	粉末涂料用消光改性剂及其应用、以及含有其的消光粉末涂料	ZL201611197904.3	锦艺有限	发明专利	2016-12-22	20 年	受让取得*	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日期	专利期限	取得方式	他项权利
10	用石墨烯涂覆的焊丝及其制备方法	ZL201710578556.2	锦艺有限	发明专利	2017-7-14	20 年	原始取得	无
11	石英玻璃填料、树脂组合物以及覆铜板	ZL201710864647.2	锦艺有限	发明专利	2017-9-22	20 年	原始取得	无
12	一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法	ZL201710864798.8	锦艺有限	发明专利	2017-9-22	20 年	原始取得	无
13	一种粉末涂料用耐冲击复合材料及改性粉末涂料	ZL201710879976.4	锦艺有限	发明专利	2017-9-26	20 年	原始取得	无
14	有机硅烷化合物、填料、树脂组合物及覆铜板	ZL201710927127.1	锦艺有限	发明专利	2017-10-3	20 年	原始取得	无
15	一种碳化硅纳米线的制备方法	ZL201810325080.6	锦艺有限	发明专利	2018-4-12	20 年	受让取得*	无
16	一种含氰基的硅烷化合物、填料及其制备方法和覆铜板	ZL201811586285.6	锦艺有限	发明专利	2018-12-25	20 年	原始取得	无
17	一种纳米氧化锆空心球的制备方法	ZL202010841560.5	锦艺有限	发明专利	2020-8-20	20 年	原始取得	无
18	一种 β 相锂霞石陶瓷粉体、制备方法及其应用	ZL202010983734.1	锦艺有限	发明专利	2020-9-18	20 年	原始取得	无
19	导电性能稳定的铜浆制备方法	ZL202110358491.7	锦艺有限	发明专利	2021-4-1	20 年	原始取得	无
20	一种正钛酸锌粉体的制备方法	ZL202110509293.6	锦艺有限	发明专利	2021-5-11	20 年	原始取得	无
21	一种锂离子吸附剂及吸附剂前驱体的制备方法	ZL202110893834.X	锦艺有限	发明专利	2021-8-5	20 年	原始取得	无
22	硅微粉生产用双筒式处理机构	ZL202111132354.8	锦艺有限	发明专利	2021-9-27	20 年	原始取得	无
23	一种白炭黑表面改性用装置	ZL202111238700.0	锦艺有限	发明专利	2021-10-25	20 年	原始取得	无
24	一种硅微粉提纯装置	ZL202111238830.4	锦艺有限	发明专利	2021-10-25	20 年	原始取得	无
25	一种球形硅微粉的生产工艺	ZL202111251306.0	锦艺有限	发明专利	2021-10-27	20 年	原始取得	无
26	石英玻璃填料、树脂组合物以及覆铜板	ZL202010741649.4	锦艺新材	发明专利	2017-9-22	20 年	原始取得	无
27	一种锂离子电池	ZL202010629566.6	锦艺新材	发明专利	2017-9-22	20 年	原始取得	无
28	低介电空心二氧化硅微球的制备方法	ZL202010557720.3	锦艺新材	发明专利	2020-6-18	20 年	原始取得	无
29	一种介孔棒状二氧化硅的制备方法	ZL202011262123.4	锦艺新材	发明专利	2020-11-12	20 年	原始取得	无
30	一种钨酸锆粉体的制备方法	ZL202011463300.5	锦艺新材	发明专利	2020-12-14	20 年	原始取得	无
31	一种金红石型二氧化钛及其制备方法和应用	ZL202011561119.8	锦艺新材	发明专利	2020-12-25	20 年	原始取得	无
32	一种正钛酸锌粉体及其制备方法	ZL202110398800.3	锦艺新材	发明专利	2021-4-14	20 年	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日期	专利期限	取得方式	他项权利
33	一种球形二氧化硅的制备方法	ZL202111006258.9	锦艺新材	发明专利	2021-8-30	20 年	原始取得	无
34	一种用于球形二氧化硅的蒸汽分级加工设备	ZL202111334696.8	锦艺新材	发明专利	2021-11-11	20 年	原始取得	无
35	一种球形硅微粉的分级提纯装置	ZL202111334688.3	锦艺新材	发明专利	2021-11-11	20 年	原始取得	无
36	一种硅微粉的生产后处理设备	ZL202210049402.5	锦艺新材	发明专利	2022-1-17	20 年	原始取得	无
37	硅微粉分级加工生产设备	ZL202210082931.5	锦艺新材	发明专利	2022-1-25	20 年	原始取得	无
38	一种用于硅微粉表面改性的生产装置	ZL202210117126.1	锦艺新材	发明专利	2022-2-8	20 年	原始取得	无
39	一种硅微粉生产用粒度调控设备	ZL202210136616.6	锦艺新材	发明专利	2022-2-15	20 年	原始取得	无
40	四方晶型透锂长石粉体的制备方法	ZL202210521486.8	锦艺新材	发明专利	2022-5-13	20 年	原始取得	无
41	一种球形氮化铝造粒粉及填料粉的制备方法	ZL202210559389.8	锦艺新材	发明专利	2022-5-23	20 年	原始取得	无
42	一种 SiO_2 微米球及前驱物的制备方法	ZL202211203813.1	锦艺新材	发明专利	2022-9-29	20 年	原始取得	无
43	一种厚壁 SiO_2 空心微米球的制备方法	ZL202211598991.9	锦艺新材	发明专利	2022-12-12	20 年	原始取得	无
44	一种 α 相片状纳米氧化铝的制备方法	ZL202211599803.4	锦艺新材	发明专利	2022-12-12	20 年	原始取得	无
45	陶瓷电容器用导电浆料及制备方法	ZL202310249465.X	锦艺新材	发明专利	2023-3-15	20 年	原始取得	无
46	高介电纤维材料、粉末涂料组合物及制备方法	ZL202310374801.3	锦艺新材	发明专利	2023-4-10	20 年	原始取得	无
47	一种低温烧结导电银浆及其制备方法和应用	ZL202310763087.7	锦艺新材	发明专利	2023-6-27	20 年	原始取得	无
48	一种中空二氧化硅的制备方法	ZL202311428620.0	锦艺新材	发明专利	2023-10-31	20 年	原始取得	无
49	一种黑色球形二氧化硅及其制备方法和黑色覆铜板	ZL202410572433.8	锦艺新材	发明专利	2024-5-10	20 年	原始取得	无
50	纳米钛酸钡及其制备方法、评价方法和应用	ZL202410731673.8	锦艺新材	发明专利	2024-6-6	20 年	原始取得	无
51	一种电池隔膜用多孔氧化铝、电池隔膜、电池、用电设备	ZL202411525868.3	锦艺新材	发明专利	2024-10-30	20 年	原始取得	无
52	一种用于锂离子电池的多孔氧化铝粉末、电池隔膜、电池、用电设备	ZL202411525867.9	锦艺新材	发明专利	2024-10-30	20 年	原始取得	无
53	一种多孔氧化铝、电池隔膜、电池、用电设备	ZL202411525869.8	锦艺新材	发明专利	2024-10-30	20 年	原始取得	无
54	汽化粉体燃烧装置、纳米高纯球形氧化物粉体及其制备方法	ZL202511086985.9	锦艺新材	发明专利	2025-8-5	20 年	原始取得	无

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日期	专利期限	取得方式	他项权利
55	电池电极用多孔氧化铝、电池电极、电池、用电设备	ZL202511187537.8	锦艺新材	发明专利	2025-8-25	20 年	原始取得	无
56	有机硅微粉及其制备方法和应用	ZL202511196120.8	锦艺新材	发明专利	2025-8-26	20 年	原始取得	无
57	一种金红石型氧化钛长纤维的制备方法	ZL202311522232.9	锦艺新材	发明专利	2023-11-15	20 年	原始取得	无
58	一种中空二氧化硅微球及其制备方法	ZL202410255376.0	锦艺新材	发明专利	2024-3-6	20 年	原始取得	无
59	中空二氧化硅颗粒及复合粉体、组合物、应用和包装方法	ZL202511697421.9	锦艺新材	发明专利	2025-11-19	20 年	原始取得	无
60	大粒径球形二氧化硅及其制备方法和覆铜板	ZL202411086878.1	锦艺新材	发明专利	2024-8-8	20 年	原始取得	无
61	一种低温烧结铜浆及其制备方法和应用	ZL202310748870.6	锦艺新材	发明专利	2023-6-25	20 年	原始取得	无
62	透明漆用无机材料填料及其制备方法	ZL201410294253.4	云阳锦艺	发明专利	2014-6-27	20 年	受让取得*	无
63	一种多孔钛酸锶钡粉体的制备方法	ZL201610648817.9	山东锦艺	发明专利	2016-8-9	20 年	受让取得	无
64	一种离子交换溶剂热法制备钛酸盐纳米粉体的方法	ZL201410055601.2	山东锦艺	发明专利	2014-2-18	20 年	受让取得	无
65	一种曲面导向格栅快速沉降槽	ZL201610453491.4	山东锦艺	发明专利	2016-6-21	20 年	受让取得	无
66	皮带输送自动除铁装置	ZL201822028565.7	锦艺有限	实用新型	2018-12-5	10 年	原始取得	无
67	一种提高反应分散度的反应装置	ZL202121161636.6	锦艺有限	实用新型	2021-5-27	10 年	原始取得	无
68	用于二氧化硅煅烧的煅烧炉和用于生产二氧化硅的生产系统	ZL202421134753.7	锦艺新材	实用新型	2024-5-23	10 年	原始取得	无
69	具有辅助下料结构的料仓和粉料加工设备	ZL202421537736.8	锦艺新材	实用新型	2024-7-1	10 年	原始取得	无
70	一种用于勃姆石粉末的下料系统	ZL202422390041.8	锦艺新材	实用新型	2024-9-29	10 年	原始取得	无
71	一种手动夹袋装置	ZL202422974416.5	锦艺新材	实用新型	2024-12-2	10 年	原始取得	无
72	用于火焰法制备高球度粉体的燃烧装置	ZL202620246284.0	锦艺新材	实用新型	2026-3-2	10 年	原始取得	无

注：上表标注*号的专利均系自发行人原控股股东重庆锦艺受让，山东锦艺名下所属专利系自南京航空航天大学受让。

3、商标

截至本招股说明书签署日，公司及下属子公司拥有境内注册商标 9 项，具体情况如下：

序号	注册号	分类号	商标图像	权利人	注册日	截止日	取得方式
1	5525473	第 1 类		锦艺新材	2019-10-14	2029-10-13	受让取得*
2	5525472	第 9 类		锦艺新材	2019-11-14	2029-11-13	受让取得*
3	5528364	第 35 类		锦艺新材	2020-3-21	2030-3-20	受让取得*
4	83693038	第 1-6 类、第 9 类、第 14 类、第 17 类、第 19 类、第 40 类、第 42 类		锦艺新材	2025-11-14	2035-11-13	原始取得
5	83675892	第 1-6 类、第 14 类、第 17 类、第 19 类、第 40 类、第 42 类		锦艺新材	2025-12-14	2035-12-13	原始取得
6	83686681	第 1 类、第 40 类		锦艺新材	2025-12-14	2035-12-13	原始取得
7	83700366	第 1 类、第 9 类、第 40 类		锦艺新材	2025-12-21	2035-12-20	原始取得
8	84304576	第 1 类		锦艺新材	2025-12-21	2035-12-20	原始取得
9	84316706	第 1 类		锦艺新材	2026-2-28	2036-2-27	原始取得

注：上表标注*号的商标均系自原控股股东重庆锦艺受让。

4、域名

截至报告期末，公司及下属子公司拥有 2 项域名，具体情况如下：

序号	域名	权利人	网站备案证号	注册时间	到期时间
1	ginet.cn	锦艺新材	苏 ICP 备 18038063 号-1	2006.06.26	2029.06.26
2	ginettms.com	锦艺新材	苏 ICP 备 18038063 号-2	2025.10.15	2030.10.15

（三）主要租赁房产情况

截至本招股说明书签署日，公司及下属子公司主要房屋租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	租赁期间	用途	面积（㎡）
1	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司	发行人	常熟经济技术开发区碧溪兴港路 25 号 1 号、2 号标准厂房	2024.10.1-2027.9.30	生产及相关办公用房	8,279.87
2			常熟经济技术开发区碧溪兴港路 25 号 3 号标准厂房	2025.4.25-2028.4.24	生产及相关办公用房	4,724.73
3	临沭利城文旅产业投资集团有限	山东锦艺	临沭县临沭街道西盘村光电产业园的	2024.5.15-2034.5.15	工业厂房	23,044.88

序号	出租方	承租方	地址	租赁期间	用途	面积（㎡）
	公司		第 10 号、11 号两栋厂房			
4	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司	铭隆新材料	常熟经济技术开发区碧溪兴港路 25 号 4 幢一层、二层标准厂房	2026.4.1-2027.3.31	生产及相关办公用房	4,724.73
5	常熟神州通智能科技有限公司	发行人	常熟市碧溪街道电厂路 13 号 2#仓库一层 3 分区	2026.1.1-2026.6.30	仓储	5,498.00

截至本招股说明书签署日，发行人上述房屋租赁合同均未办理备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条等相关规定，未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。上述房屋租赁合同均未约定以办理房屋租赁登记备案为合同的生效条件，公司及子公司不会因该等租赁合同未办理租赁登记备案手续而无法继续使用该等房产。因此，房屋租赁合同未办理备案手续不会对公司的生产经营产生重大不利影响，亦不构成本次发行上市的法律障碍。

另外，发行人子公司山东锦艺第 3 项租赁厂房所在地为集体建设用地，针对租赁事项，临沭县临沭街道办事处西盘村村民委员会已出具证明，确认相关房产出租给山东锦艺不存在违反相关法律法规或集体决策事项的情况。出租方临沭利城文旅产业投资集团有限公司已提供不动产权证等材料，并承诺由于厂房土地等产权问题引起的纠纷，由其负责处理，如导致山东锦艺无法正常生产，其应返还当年租金并赔偿山东锦艺相关损失。综上，发行人子公司山东锦艺承租相关厂房已取得必要的审批，相关房产为合法建筑，因相关租赁活动被处罚的风险较低，不会构成本次发行上市的法律障碍，不会对发行人持续经营构成重大不利影响。

（四）业务资质情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的业务经营资质如下：

序号	主体	证书名称	编号	核发单位	核发/登记日期	有效期
1	锦艺新材	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码：3214963932 检验检疫备案号：3206100101	常熟海关	2021.12.08	长期
2	锦艺新材	对外贸易经营者备案登记表	04243586	对外贸易经营者备案登记（江苏常熟）	2021.12.16	长期
3	锦艺新材	高新技术企业证书	GR202532003477	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务	2025.11.18	3 年

序号	主体	证书名称	编号	核发单位	核发/登记日期	有效期
				总局江苏省税务局		
4	锦艺新材	排污许可证	91320581MA1NCU5U4T001Z	苏州市生态环境局	2025.10.29	2030.10.28
5	锦艺新材	固定污染源排污登记回执	91320581MA1NCU5U4T002Y	-	2025.03.13	2030.03.12
6	锦艺新材	环境管理体系认证证书	016SH25E30878R1M	新世纪检验认证有限责任公司	2025.06.13	2028.06.12
7	锦艺新材	质量管理体系认证证书	016SH25Q31058R1M	新世纪检验认证有限责任公司	2025.06.13	2028.06.20
8	锦艺新材	汽车行业质量管理体系认证证书	2021-0062	上海天祥质量技术服务有限公司	2024.04.25	2027.04.24
9	锦艺新材	知识产权管理体系认证证书	165IP250240R0M	中知（北京）认证有限公司	2025.06.23	2028.06.22
10	锦艺新材	温室气体管理体系认证证书	AAC24THC110557	上海申西认证有限公司	2024.10.22	2027.10.21
11	锦艺新材	职业健康安全管理体系认证证书	11424S20555R0M	北京东方纵横认证中心有限公司	2024.01.15	2027.01.14
12	锦艺新材	危险化学品经营许可证	苏（苏）危化经字（常经开）00392	常熟经济技术开发区管理委员会	2024.09.23	2027.09.22
13	锦艺新材	危险化学品登记证（进口企业）	32052600447	江苏省化学品登记中心、应急管理部化学品登记中心	2026.01.15	2029.01.14
14	锦艺新材	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	L21927	中国合格评定国家认可委员会	2024.11.14	2030.11.13
15	云阳锦艺	环境管理体系认证证书	00125E32632R2M/5000	中国质量认证中心	2025.08.01	2028.07.21
16	云阳锦艺	质量管理体系认证证书	00125Q35327R2M/5000	中国质量认证中心	2025.07.29	2028.08.07
17	云阳锦艺	固定污染源排污登记回执	91500235MA6051EY5A001W	-	2026.01.30	2031.01.29
18	云阳锦艺	职业健康安全管理体系认证证书	016CQ23S31107R0M	新世纪检验认证有限责任公司	2023.06.20	2026.06.19
19	山东锦艺	排污许可证	913201045894411584001U	临沂市生态环境局	2025.12.12	2030.12.11
20	山东锦艺	环境管理体系认证证书	83126E00004R000	斯坦德认证（青岛）有限公司	2026.04.08	2029.04.07
21	山东锦艺	质量管理体系认证证书	83126Q00007R000	斯坦德认证（青岛）有限公司	2026.04.08	2029.04.07
22	功能材料	排污许可证	91320581MA22L99A02001V	苏州市生态环境局	2025.05.23	2030.05.22
23	铭隆新材料	固定污染源排污登记回执	91320581MA27L75G39001X	-	2024.05.28	2029.05.27

序号	主体	证书名称	编号	核发单位	核发/登记日期	有效期
24	铭隆新材料	质量管理体系认证证书	18424Q20074R0S	北京中交远航认证有限公司	2024.09.03	2027.09.02
25	锦艺半导体	质量管理体系认证证书	17325Q21186R0S	北京中交远航认证有限公司	2025.09.29	2028.09.28
26	锦艺半导体	环境管理体系认证证书	18425E20072R0S	北京中交远航认证有限公司	2025.09.29	2028.09.28
27	苏州锦禾	固定污染源排污登记回执	91320581MA2769BQ72001W	-	2023.06.14	2028.06.13

（五）固定资产、无形资产等资源要素与公司产品的内在联系以及对公司持续经营的影响

公司拥有的固定资产、无形资产等资源要素系公司开展经营活动的必要基础。截至本招股说明书签署日，公司所拥有的主要固定资产和无形资产不存在纠纷及潜在纠纷，亦不存在对公司持续经营产生重大不利影响的情况。

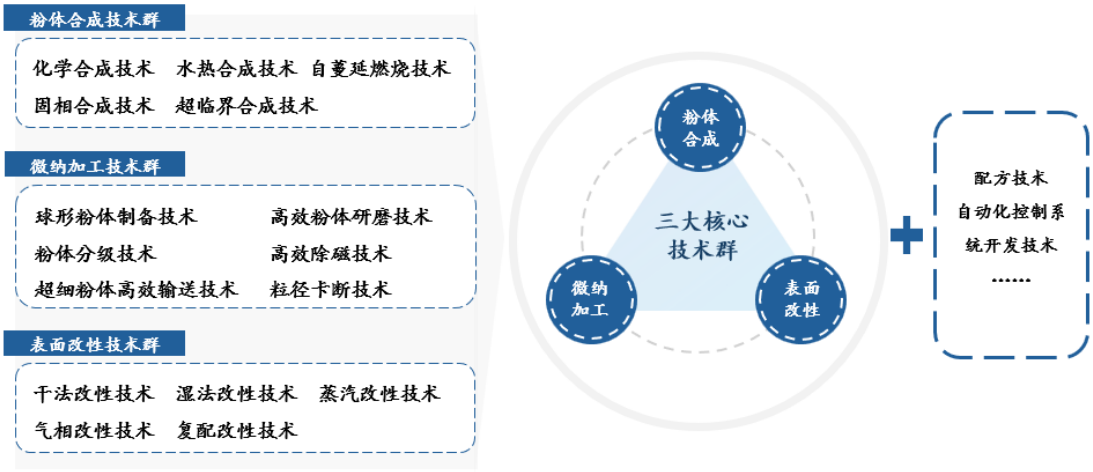
六、公司核心技术及研发情况

（一）公司核心技术情况

1、公司主要核心技术及其来源

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域，经过二十余载自主研发和创新实践，在技术原理、工序工艺、产线设备、软件系统等关键层次实现自主创新和多点突破，并在体系层面进行多点组合创新，构建以粉体合成技术群、粉体微纳加工技术群、表面改性技术群为核心，以配方技术、自动化控制系统开发技术为补充的核心技术体系，并通过多个技术支点的综合运用，实现“原料合成-粉体加工-应用适配”的全链条覆盖。

公司核心技术体系图



公司各技术环节之间形成深度协同赋能机制。公司无机功能粉体材料主要添加于树脂等有机基材中结合使用，用于增强下游基材介电性能、尺寸稳定性、耐热性、导热性等多种核心关键性能。一方面，粉体粒径大小、粒径分布、粉体形貌（球形/角形等）等物理表征直接影响粉体性能。无机功能粉体材料高端市场曾长期被外资企业占据主导地位，绝大部分国内供应商主要参与粉体的微纳加工环节，并止步于较为成熟的微米级研磨、分级技术，较难突破更高精密度的纳米级领域，以及技术门槛较高的球形制备（尤其是化学法、直燃法球形制备技术）、粒径卡断技术。公司在粉体微纳加工技术方面优势明显，系业内少数同时掌握三种球形粉体制备技术，且较早在覆铜板领域实现规模应用的企业，并掌握精密分级、高效研磨、粒径卡断等多项核心技术，可精准控制粒径大小、粒径分布、粉体形貌及纯度等，对于改善粉体性能至关重要。

另一方面，无机粉体与有机基材的复合使用并非简单的物理混合，而是涉及界面化学等复杂作用机制，常带来有机-无机界面分离、结合力弱、相容性差等问题，直接影响整个复合材料体系的介电性能、热导率等关键指标。表面改性技术能有效解决上述应用化难题，依托改性剂作为接桥，改性剂一端的官能团与有机基材结合，另一端与无机粉体表面羟基形成共价键，有效增强界面的结合力，改善有机基材对无机粉体的浸润性和相容性。而无机粉体表面改性技术需针对复杂有机基材体系，进行改性配方、改性工艺等多维度综合性调整适配，具有较高的技术门槛。公司掌握 30 余种改性剂反应机理，并拥有干法改性、湿法改性、蒸汽改性、气相改性及复配改性等多项改性技术，具有领先的表面改性技术优势。

伴随下游 AI 人工智能、高速网络通信、云计算等先进产业的高速发展，带动更高信号传输速率、低传输损耗、高散热效率、热稳定性等关键性能需求，驱动无机功能粉体材料性能要求持续跃升，仅通过微纳加工以及表面改性处理已逐步趋于产品性能提升的极限，亟需迈向原料开发端开展基础材料研究，结合粉体合成技术改善原材料性能进而突破产品整体性能瓶颈。例如，更高球形度、特殊空心结构、异形形貌粉体需要在粉体原料端通过化学合成技术实现，无法仅通过后段的微纳加工或表面改性处理予以突破，因而要求企业在粉体合成领域具备深厚的技术沉淀。公司是行业中少数掌握化学合成、水热合成、固相合成、自蔓延燃烧、超临界合成等多项粉体合成技术的无机功能性粉体供应商，亦是业内少数同时掌握粉体合成、微纳加工、表面改性三大核心技术群的供应商。

此外，配方技术、自动化控制系统开发技术作为重要技术补充，贯穿于粉体合成、粉体微纳加工与表面改性全链条核心环节，通过与三大核心技术群的深度融合，共同构筑起坚实的核心技术壁垒。公司核心技术具体情况如下：

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
1	粉体合成技术	化学合成技术	公司在原酸性水解-碱性缩聚分步合成工艺的基础上，自主研发形成了碱性水解缩聚一步合成技术，一步合成的有机硅球粒度均一度高、球形度高、合成反应时间短、结晶性好，同时由于没有酸催化剂产生的元素残留，因此成品杂质含量低，有利于后续加工及进一步降低煅烧后的介质损耗，最终制备的微米级至纳米级球形粉体能够达到单分散、粒度更均匀； 根据中国非金属矿工业协会开具的证明，公司化学合成新工艺“避开了国外的技术封锁，极大地提升了我国高端球形硅微粉的加工水平，产品性能指标达到国际领先水平，填补了国内空白”。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过12项发明专利予以保护
2	粉体合成技术	水热合成技术	公司通过自主改良设计的水热高温混合连续反应装置，直接合成多元复杂体系的陶瓷粉体，解决水热合成过程中易出现中间产物，造成产物中含有杂质等问题；应用特殊有机溶剂作为反应介质，进行水热-溶剂热反应，在较低的碱性溶液条件下得到高结晶性陶瓷粉体，并对其晶型结构进行精修，自主形成水热高温混合法合成亚微米粉体的技术；公司水热合成的粉体粒度均匀、粒径分布更窄、杂质含量低、结晶性更好。	自主研发	小批量生产	其他新兴功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过11项发明专利予以保护
3	粉体合成技术	自蔓延燃烧技术	公司自主研发掌握自蔓延合成配方，并自主设计自动化自蔓延反应设备及相关产线，通过实时监控温度曲线、反应时间、设备真空度及氧含量等关键参数，搭配持续优化的配方，有效解决燃烧不充分、反应产物纯度低、氧含量高等问题； 公司应用自蔓延燃烧技术合成的高纯陶瓷粉体，晶相良好（可达100%），纯度可达99.5%以上。	自主研发	大批量生产	导热散热功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过1项发明专利予以保护
4	粉体合成技术	固相合成技术	公司自主研发掌握单元固相烧结和多元固相烧结的制备技术以及高温熔融配方技术，通过对烧结温度曲线的精准调控及配方粉体多相均匀分散，可制备得到晶型完整、粒度均匀的粉体材料；同时结合客户对粉	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、其他新兴功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过14项发明专

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			体材料高/低介电、软硬度等方面的性能要求，开展配方自主设计，可制备多种高介电陶瓷粉体、负膨胀系数陶瓷粉体等新兴产品。				利予以保护
5	粉体合成技术	超临界合成技术	公司通过对超临界反应体系关键参数（温度、压力、pH 值及反应物浓度）的精确调控，结合下游客户对粉体材料的特定性能需求（如纳米级粒径、高结晶度、特定晶型及纯度等），自主研发设计合成配方与工艺路径，可制备技术难度较高的芯片抛光液用高端纳米陶瓷粉体。	自主研发	小批量生产	其他新兴功能材料（芯片抛光液纳米氧化物）	主要以非专利技术秘密形式予以保护
6	粉体微纳加工技术	火焰球硅球铝制备技术	公司在行业成熟的火焰熔融球化工序基础上改进球化工艺控制，通过自主研发形成的火焰熔融原料的干粉超分散、球形粉体级配、表面改性等技术，同时优化火焰熔融产线、自主设计火焰法制备球形粉体的燃烧装置，形成了具有一定性能优势的体系化火焰球硅、球铝制备技术，应用该技术制备得到的粉体纯度高、球化率高、收率高、比表面积可控、流动性好。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
7	粉体微纳加工技术	直燃球硅制备技术	公司较早突破基于 VMC 原理的直燃法球硅制备技术，系国内较早批量供应直燃法球硅的厂商，并实现对日资供应份额的国产替代； 公司通过自主设计的燃烧器和冷凝器特殊装置，有效解决球化过程中空心球较多的问题；通过自主研发的除大球和除羟基技术，有效减少空心球、大球含量及粉体表面羟基含量；针对性自主开发纳米物理隔离改性技术，有效解决亚微米级粉体易团聚难题，最终制备得到的产品具有纯度高、球化率高、大球及空心球含量低、流动性好、易分散等性能优势。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 3 项发明专利予以保护
8	粉体微纳加工技术	化学法球硅制备技术	公司较早掌握纳米级高纯化学法球硅制备工艺技术，运用自主研发的梯度煅烧技术，创新性将有机球硅转变为满足覆铜板领域低介电、低损耗要求的无机粉体，可有效避免有机硅球笼状结构内部有机基团排除	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 12 项，发明

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			不充分、碳化或表面缺陷的问题，保证粉体比表面积无变化，球化率最高达 100%；通过自主研发形成的高压解聚技术，有效解决煅烧后的纳米级粉体易粘连、易团聚等问题； 应用化学法球硅制备技术生产的球形硅微粉，具有纯度高（可达 99.99%）、球化率高（可达 100%）、粒度分布窄和分散度高等性能优势，满足高等级高速覆铜板、高阶 HDI 基板、IC 载板、类载板（SLP）、芯片底部填充胶、ABF 膜等高端电子领域应用需求。				专利予以保护
9	粉体微纳加工技术	高效粉体研磨技术	依托于自主设计调整、自主搭建或改良的高效无磁球磨系统、高温空气内循环流化床气流磨系统、分级研磨一体高温蒸汽系统、盘式气流磨产线系统，公司掌握球磨、气流磨、蒸汽磨等多种高效研磨技术，可针对不同性质、形态、粒度、硬度的材料进行研磨处理，实现粉体材料的高效研磨； 相较于业内一般的微米级研磨技术，公司具备更高精密度的纳米级研磨技术能力。	自主研发	大批量生产	全系列产品	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 3 项发明专利予以保护
10	粉体微纳加工技术	高效除磁技术	结合物料在产线中流动的特性，在进料、回料、出料等多个关键节点处，自主设计添加不同除磁原理的除磁部件，实现全产线流程中对磁性杂质的精细控制； 使用高磁通强力纳米除磁技术，有效去除粉体中的弱磁性物质以及被粉体包裹的磁性物质，进一步降低粉体磁性杂质； 公司产品磁性杂质水平能够达到＜1ppm 级别，优于行业内平均的 10ppm 水平；在有特殊低磁性要求的场景下，除磁后粉体中的金属杂质比例接近 0，达到行业先进水平。	自主研发	大批量生产	全系列产品	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
11	粉体微纳加工技术	气流分级技术	公司凭借多年工艺经验积累，对研磨气流分级设备进行多种改造优化，自主开发设计二次风管道、主动气密封，自主搭建分级系统，可将特定尺寸的粉体颗粒	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			进行有效分级，且分级粒度更小、更均匀，实现对大颗粒的精准管控，提升分级的效率及稳定性。				过 1 项发明专利予以保护
12	粉体微纳加工技术	蒸汽分级技术	公司创新性引入并重新设计高温蒸汽研磨分级系统，掌握蒸汽分级解聚技术，可实现各类超细粉体的分级，分级能力可达 D50＜0.4μm、D100＜1.4μm，达到行业先进水平；独立重新设计喷射装置，能够根据不同比重物料的流体学计算结果调整参数，适配不同的粉体，提升分级能力和效率；自主设计蒸汽管路加温装置和收料装置，通过高温高压条件下蒸汽分级技术，减少水分降低超细粉体团聚，实现小粒径粉体的分离。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
13	粉体微纳加工技术	超细粉体高效输送技术	公司针对不同粉体流动性存在差异的特点设计了不同的物料和管道输送装置，如自主改良进出料口、卸料阀、出料篦板结构、辅助下料结构的料仓和物料输送装置，自主设计超细粉体管道输送装置等，可有效保证进出料的流畅稳定和整体生产系统的流畅运行。	自主研发	大批量生产	全系列产品	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 2 项发明专利予以保护
14	粉体微纳加工技术	粒径卡断技术	公司自主研发并搭建气相分级、液相分级、精密过滤等多种工艺技术及设备系统，利用离心力、重力、物理筛分原理，对大颗粒进行有效管控，实现粉体粒径从微米级卡断（5-75μm cut）、亚微米级卡断（0.8-1μm cut），到纳米级卡断的精准控制，可满足下游客户对粉体大颗粒管控的需求。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料等	主要以非专利技术秘密形式予以保护
15	表面改性技术	干法改性技术	公司自主研发形成了成套干法改性技术，如自主设计加压喷雾装置，能够实现良好的改性剂雾化效果；自主设计多段控温技术和相关加热系统，能够根据不同改性剂水解缩合的反应特性，进行自主控温，提高改性效率，改善包覆率；自主设计排气系统，能够实现改性中及改性后无副产物残留，解决改性产品的后团聚问题； 经过干法改性处理后粉体羟基含量显著降低，对于粉	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 12 项发明专利予以保护

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			体流变性有较大改善。				
16	表面改性技术	湿法改性技术	公司自主研发掌握应用于球硅浆料的湿法改性工艺及改性配方，通过应用湿法改性技术，可大幅提升改性粉体或浆料在应用时的流变性能，使球硅浆料满足IC 载板的要求，且流变性可达 10^4（mPa s）级别。	自主研发	小批量生产	电子信息功能材料	主要以非专利技术秘密形式予以保护
17	表面改性技术	蒸汽改性技术	公司在高温蒸汽研磨分级系统基础上，自主创新设计适配的改性剂雾化装置，可实现高温高压气体沸腾状态下的表面改性，改性包覆率和反应性进一步提高，改善了亚微米粉体的改性效果，实现改性粉体 0 团聚。	自主研发	大批量生产	电子息功能材料、导热散热功能材料等	主要以非专利技术秘密形式予以保护
18	表面改性技术	气相改性技术	公司自主研发形成成套气相改性技术，采用气固相表面反应工艺，自主设计可编程气氛与温控的反应装置，通过对反应物浓度、反应温度与停留时间的精密协同调控，在高温气相环境下实现单分子层级的超薄均匀包覆，且反应充分彻底，进而显著提升纳米粉体的高纯度、高活性与高分散性。	自主研发	小批量生产	电子信息功能材料	主要以非专利技术秘密形式予以保护
19	表面改性技术	复配改性技术	公司自主研发形成多重改性配方，以及冷热复配、多次改性、无机-有机结合等改性技术，形成了完整的复配改性体系，能够满足下游客户对于粉体表面性质的多功能要求。	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材料等	以非专利技术秘密形式予以保护，同时通过 1 项发明专利予以保护
20	配方技术	原料配方技术	公司构建了原料选型与独特配方技术，掌握不同原料组分间的相互作用、配比关系及对产品性能的影响规律，熟练运用粉体、浆料配方体系与生产工艺路径的协同适配技术，能够根据客户多样化性能要求设计出最优配方，实现介电性、导热性、热稳定性、流动性、填充率、纯度等性能突破，生产出满足电子、导热、锂电、涂料、封装等不同领域客户差异性需求的产品。	自主研发	大批量生产	全系列产品	主要以非专利技术秘密形式予以保护
21	配方技术	级配分散技术	基于“界面自由能匹配-粒径级配-表面化学协同”三元耦合技术，公司通过 Furnas 模型计算与实验验证相结合的方式，精准确定多元颗粒的最优配比，将	自主研发	大批量生产	电子信息功能材料、导热散热功能材	主要以非专利技术秘密形式予以保护

序号	技术分类	技术名称	技术先进性表征	技术来源	技术所处阶段	应用的主营产品	技术保护措施
			粉体的无序堆积转化为有序密排结构，并建立较为完善的数据库；同时通过“纳米尺度润滑层”，将颗粒间摩擦转化为颗粒与树脂的界面滑移，可实现多维度协同效应，显著提升粉体填充量与导热系数。公司通过应用级配分散技术，使产品实现高填充、高导热、低粘度、高稳定等优异性能。			料等	
22	自动化控制系统开发技术		公司自主开发了产线自动化控制系统，能够根据系统化工艺经验对整体产线进行多个维度的参数设置；自主搭建了数据采集记录系统，能够有效监测生产过程中的各节点状态，及时追溯生产过程中出现的问题。	自主研发	大批量生产	全系列产品	主要以非专利技术秘密形式予以保护

2、核心技术在主营业务及产品中的应用和贡献情况

公司核心技术广泛应用于公司各类功能性材料产品的研发与生产过程之中，与粉体合成、超细研磨、球化处理、煅烧、分级、配方复配、表面改性等主要生产工序紧密关联，并在工艺优化、良率提升、产品性能提升等方面持续创新。公司主要依靠核心技术开展主营业务，报告期各期来自核心技术的产品收入占主营业务收入的比例分别为 99.30%、98.69%和 97.71%，具体如下：

单位：万元

产品板块	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	100,838.03	71,655.46	51,416.02
主营业务收入	103,206.52	72,604.62	51,780.03
占比	**97.71%**	**98.69%**	**99.30%**

3、公司核心技术保护措施

核心技术对于公司的持续性发展和核心竞争力至关重要，为了更好地保护核心技术，公司建立了完善的技术保护措施，加强对专利与非专利技术的保护，主要措施如下：

（1）专利保护：积极申请国家专利保护对核心技术进行保护。截至本招股说明书签署日，公司对于主要技术创新已申请专利，已取得有效专利共计 72 项。

（2）建立技术保密机制：公司与相关核心技术人员、生产制造高级别人员签署技术保密协议、知识产权协议和竞业协议，保证保密义务明晰且范围安全；公司与客户、供应商签署保密协议，并以特定编码标识等方式进行技术保护，保障在正常经营业务开展过程中公司核心技术信息处于严格保密状态。

（3）信息隔离墙与代码、权限保护：采购端、生产端和销售端对于每种物料均采用不同代码，生产人员并不知晓代码对应的具体物料，不同部门间人员所知晓的代码亦有所不同，实现信息分割和隔墙操作；研发部门严格管控人员权限，不同工艺阶段、同一项目不同阶段的人员保证严格隔墙操作，仅有高层管理人员能够接触不同阶段的信息来进行统筹安排。

（4）公司建立了严守技术秘密、保护工艺制造数据的企业文化，并组织员工定期学习有关保密知识，提升员工保护核心技术的意识和技能。

（二）核心技术的科研实力和成果情况

1、公司获得的重要奖项及荣誉

截至本招股说明书签署日，公司所获主要荣誉资质情况如下：

序号	荣誉资质名称	主体	认定部门	获得时间
1	国家级专精特新重点“小巨人”企业	发行人	工业和信息化部	2024 年 9 月
2	国家级专精特新“小巨人”企业	发行人	工业和信息化部	2022 年 8 月
3	非金属矿科学技术奖-科技进步奖一等奖（国科奖社字 0301 号）	发行人	中国非金属矿工业协会	2021 年 10 月
4	先进封装矿物粉体材料行业重点实验室	发行人	中国非金属矿工业协会	2025 年 8 月
5	2025 年度全国非金属矿产品及制品领域标准化工作先进单位	发行人	全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会	2025 年 12 月
6	国家高新技术企业	发行人	江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省税务局	2025 年 11 月
7	江苏省企业技术中心	发行人	江苏省工信厅	2022 年 8 月
8	江苏省电子信息用功能性粉体工程技术研究中心	发行人	江苏省科技厅	2022 年 9 月
9	江苏省专精特新产品	发行人	江苏省工信厅	2021 年 12 月
10	江苏省科技型中小企业	发行人	江苏省科技厅	2019 年 6 月
11	江苏省高新技术企业培育企业	发行人	江苏省科技厅、江苏省财政厅	2019 年 9 月
12	江苏省潜在独角兽企业	发行人	江苏省生产力促进中心	2025 年 9 月
13	江苏省瞪羚计划企业	发行人	江苏省生产力促进中心	2023 年 11 月
14	江苏省科技型民营企业	发行人	江苏省民营科技协会	2019 年 10 月
15	江苏省科技型中小企业	南京宇热	江苏省科学技术委员会	2013 年 7 月
16	江苏省材料学会科学技术奖[注 1]	发行人	江苏省材料学会	2024 年 12 月
17	江苏省颗粒学会科技创新奖[注 2]	发行人	江苏省颗粒学会	2024 年 11 月
18	苏州市独角兽培育企业	发行人	苏州市人民政府	2021 年 4 月
19	苏州市瞪羚计划企业	发行人	苏州市人民政府	2020 年 12 月
20	苏州市超细改性粉体工程技术研究中心	发行人	苏州市科技局	2022 年 8 月

注 1：由发行人作为完成单位、副总经理胡林政作为第一完成人参与的“低介电中空二氧化硅微球制备技术”项目，于 2024 年 12 月获得江苏省材料学会科学技术奖；
注 2：由发行人作为完成单位之一、副总经理胡林政作为完成人之一参与的“掺杂改性钛酸钡纳米粉体的可控制备与应用研究”项目，于 2024 年 11 月获得江苏省颗粒学会科技创新奖。

2、核心技术的科研成果

（1）专利授权

截至本招股说明书签署日，公司及附属子公司已取得有效专利 72 项，其中发明专利 65 项、实用新型 7 项。具体内容详见“第五节 业务与技术”之“五、发行人主要资产情况”之“（二）主要无形资产情况”之“2、专利”。

（2）承担的科研项目

截至本招股说明书签署日，公司已完成或正在参与、承担的各级部门技术、业务相关的项目如下：

序号	项目名称	计划类别	项目来源	项目开始时间
1	先进封装基板用高性能球形二氧化硅研发及产业化	国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目	工业和信息化部	2024 年 10 月
2	电子陶瓷粉体的制备技术开发	江苏省产学研合作项目、江苏省科技副总项目	江苏省科学技术厅	2020 年 8 月
3	电路板印刷用低温固化铜浆的研发与产业化	常熟市“昆承英才”科技创新创业领军人才计划项目	常熟市科技局	2021 年 7 月

（3）参与标准制定

截至本招股说明书签署日，公司参与的标准制定情况如下：

序号	标准名称	标准编号	标准类别	发布时间	参与程度
1	集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉	GB/T 46381-2025	国家标准	2025 年 10 月	参与
2	集成电路封装用球形氧化铝微粉	GB/T 46378-2025	国家标准	2025 年 10 月	参与
3	锂电池隔膜涂覆用勃姆石	T/EJCCCSE 082—2024	团体标准	2025 年 1 月	参与

（4）高等院校合作

公司与南京航空航天大学、西南科技大学、南京理工大学、河北工业大学等高等院校开展合作开发等产学研合作，实现资源共享、优势互补，共同攻克行业技术难题，不断提升公司的研发水平和能力。

（三）公司研发项目情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的对目前或未来经营有重大影响的主要研发项目、项目目标介绍、所处阶段及应用前景如下：

序号	项目名称	项目目标	所处阶段[注]	应用前景
1	超低介电常数填料开发	①开发中空二氧化硅及相关超低介电填料体系，通过调控比表面积、孔径结构与表面羟基密度，满足超低介电性能要求，实现高填充条件下介电常数（Dk）＜2.8、介电损耗（Df）＜0.0005，且具备良好流动性、高耐压强度，符合 M9 及以上等级高速覆铜板、低介电载板、ABF 膜、类载板（SLP）、低介电常数芯片底部填充胶等领域的需求； ②重点突破中空结构破碎、团聚等工程化难题，适配超低介电树脂体系	中试阶段	适配 AI 算力设施等新兴领域需求
2	超低损耗球形硅微粉开发	①研究开发超低介电损耗球形硅微粉，符合高等级高速覆铜板应用需求； ②实现介电常数（Dk）≤3.88、介电损耗（Df）≤0.0002，符合 M9 及以上等级高速覆铜板领域的需求； ③超低介电损耗机理与关键影响因子研究，球形硅微粉煅烧与结构纯化控制研究，改性剂水解行为与表面反应机理研究，改性效果评价与工程化验证	开发阶段（部分子项目已中试/量产）	适配 AI 算力设施等新兴领域需求
3	超分散球形硅微粉及浆料开发	以公司高性能球形硅微粉产品为起点，开发 IC 载板、ABF 膜用高分散球硅浆料	中试阶段	部分可替代国外领先企业产品，可用于 IC 载板、ABF 膜等高端场景
4	新型有机球硅研发项目	针对高等级高速覆铜板、芯片封装、ABF 膜等电子领域需求，开发新型有机球硅	中试阶段	高端产品原料合成，实现原材料自给及降本增效
5	高导热氮化铝粉体开发	①氮化铝双重耐水解处理，氮化铝原料、不同粒径氮化铝粉体及改性氮化铝粉体的开发，实现氮化铝粉体的批量供应； ②大单晶氮化铝：研究一次合成更大粒度、球形单分散的氮化铝粉体，填充在胶体中导热系数达到 10W/（m·k）以上； ③高纯（纯度＞99%）球形氮化铝开发，导热系数提升 10%-20%且产品流动性更优	量产阶段（部分子项目为样品阶段）	可用于 AI 服务器、存储芯片、手机芯片等散热场景
6	特种氮化硼粉体及浆料开发	①球形度 95%以上，纯度 99.5%以上的团聚氮化硼粉体，解决片层结构导致的比表面积大、推挤密度和剥离强度低导致的应用问题； ②可应用于导热 PI 膜的小粒径、易分散、含量高于 99.2%的亚微米氮化硼； ③在纳米氮化硼基础上开发高填充、高导热的纳米氮化硼浆料； ④类球型氮化硼开发，高堆积密度、高致密度、高流动性、剪切强度高不易打散	开发阶段	解决行业难点问题
7	高导热低损耗填料开发	开发复合、多元形貌等高导热低损耗粉体材料，实现兼顾低介电、低损耗、高导热等性能，应用于导热覆铜板等领域	小样阶段	可用于导热覆铜板等领域
8	封装用填料开发项目	①实现更高级别球形硅微粉在 EMC 领域（包含 LMC、GMC 等高端场景）的应用； ②开发高导热、低放射性、低热膨胀系数、低	中试阶段（部分产品系列已	部分可替代国外领先企业产品，可用于 2.5D/3D 、 Chiplet 、

序号	项目名称	项目目标	所处阶段[注]	应用前景
		流变性的封装用填料，满足 2.5D/3D、Chiplet、HBM 等先进封装需求	量产）	HBM 等先进封装领域
9	隔膜涂覆纳米粉体开发	新能源锂电池隔膜涂覆用纳米粉体材料，包括更小粒径勃姆石、小粒径超细氧化铝、多孔氧化铝、更强吸液性的改性氧化铝以及超低磁性杂质的纳米级氧化铝，解决行业痛点问题	中试阶段	解决行业难点问题
10	MLCC 用纳米钛酸钡粉体开发	粒径 600nm 及以下，介电常数可达 4600 以上，介电损耗低于 0.01，粒度范围 60nm~600nm 的完整晶型、均匀粒度钛酸钡粉体，满足中高端 MLCC 用相关原材料需求	部分量产	替代国外领先企业产品，可用于 AI 服务器高容高压场景
11	电子浆料制备及开发	①开发烧结温度低于 220℃、耐受温度高于 200℃的低温液相烧结（TLPS）铜浆、银浆、低温烧结银胶等低温电子浆料，满足 AI 用高密度互联 PCB、下世代玻璃基板（TGV）通孔金属化、MLCC 电极、功率模块粘接、芯片封装等需求，也可用于代替普通焊料； ②开发可在大气气氛中加热固化的低温固化铜浆技术，可用于导电线路印刷等场景； ③开发 MLCC、电子陶瓷用高温烧结铜浆	小样阶段	可用于 AI 高密度互联、TGV 等先进应用场景
12	抛光液用纳米氧化物研发项目	开发用于 CMP 工艺的纳米级抛光粉体及稳定浆料，重点控制粒径分布、表面状态与分散稳定性，实现高去除率、低缺陷的芯片抛光需求	小样阶段	用于先进芯片制程
13	负膨胀系数陶瓷粉体开发	开发负膨胀系数陶瓷粉体材料，通过精准控制界面应力与包覆结构，获得-1~-12 ppm/℃的热膨胀系数	中试阶段	解决行业难点问题
14	纳米粉体高分散及固液分离技术研究项目	针对纳米、亚微米粉体在高粘体系中的团聚与沉降问题，系统性开发构建分散剂体系、预处理工艺及高效固液分离技术，形成稳定可复制的分散解决方案，并开发分散浆料（Masterbatch）产品形态	实验室研发阶段	解决行业难点问题

注：发行人主要在研项目系多个子项目合并而成，以主要子项目的实施阶段为代表。

（四）合作研发情况

截至报告期末，公司正在从事的主要合作研发项目情况如下：

序号	项目名称	合作方	合作有效期	合作协议主要内容	知识产权归属约定	保密措施
1	水热合成纳米氧化钒功能材料及其应用	南京航空航天大学	2024.12.03-2028.12.03	双方共同研究开发水热合成纳米氧化钒功能材料及其应用	本合同下产生的知识产权和由此产生后续技术成果，归属合作方共有	已约定保密措施
2	新能源燃料电池固体电解质开发及表面功能化	南京理工大学	2025.03.01-2027.03.01	双方共同研究开发新能源燃料电池固体电解质开发及表面功能化	本合同所产生的知识产权：发明专利归发行人所有；学术论文归合作双方所有	已约定保密措施

（五）研发投入情况

公司自成立以来即秉持以研发为先导的经营理念，产品与技术的研发创新为公司紧跟下游应用迭代发展趋势、不断拓展前沿新材料应用，并夯实公司在高端品类市场的领先优势的关键支撑。随着公司业务快速发展，公司在研发投入方面长期保持高强度投入。报告期内，公司研发费用及占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	4,210.85	3,420.40	2,793.28
占营业收入比例	4.07%	4.69%	5.38%

（六）公司研发人员和核心技术人员情况

1、研发人员情况

公司研发人员认定标准系根据员工所属职能部门及具体工作职责确定，将从事新技术、新工艺、新产品的预研、开发和优化，生产设备的设计研制，前沿技术储备研究，及与研发活动密切相关的管理人员认定为研发人员。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司研发人员数量分别为 73 人、91 人和 91 人，公司员工总数分别为 535 人、621 人和 741 人，公司研发人员占当年员工总数的比例分别为 13.64%、14.65%和 12.28%。报告期各期末研发人员数量、占比、学历分布情况如下：

学历	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
博士研究生	2	2.20%	1	1.10%	1	1.37%
硕士研究生	36	39.56%	38	41.76%	29	39.73%
本科及大专	42	46.15%	43	47.25%	35	47.95%
高中及以下	11	12.09%	9	9.89%	8	10.96%
合计	**91**	**100.00%**	**91**	**100.00%**	**73**	**100.00%**

发行人研发人员主要负责研发项目的开展，具体承担新产品、新材料的研究开发、技术攻关、产品测试，生产设备、生产工艺的设计和研制，以及研发管理等职责，主要工作内容与公司研发活动直接相关。报告期内，发行人存在少量非全时研发人员，各期人数分别为 2 人、4 人及 8 人，占研发人员数量比例分别为

2.74%、4.40%和 8.79%，整体占比较低。报告期内，该等人员研发活动工时占其总工时的比例均超过 50%。除此之外，公司研发人员均为专职研发人员，不存在兼职从事生产经营活动的情形。

2、核心技术人员情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共 4 人，分别为胡林政、罗艳玲、贾波和沈晓燕。公司核心技术人员简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“3、高级管理人员”和“4、其他核心人员”。

公司核心技术人员的研发贡献及获奖情况具体如下：

核心技术人员	研发贡献及获奖情况
胡林政	1、深耕新材料领域二十余年，主持公司技术开发工作，主导公司完成粉体合成、粉体微纳加工、表面改性等多项核心技术开发及整体技术平台搭建，主导公司完成多款核心产品及前沿产品开发，包括高性能球形硅微粉系列、高导热氮化物系列、导热氧化铝系列、锂电池隔膜功能材料系列及其他超细功能粉体系列，以发明人身份参与公司 49 项已授权发明专利的发明过程； 2、所负责的“一步法合成超细高纯球形硅微粉制备技术及产业化”获得中国非金属矿工业协会“非金属矿科学技术奖-科技进步奖一等奖”；作为项目第一完成人参与的“低介电中空二氧化硅微球制备技术”获得江苏省材料学会科学技术一等奖；所参与的“掺杂改性钛酸钡纳米粉体的可控制备与应用研究”获得江苏省颗粒学会科技创新奖。
罗艳玲	1、主持电子浆料等高端前沿产品开发，为公司丰富“无机+”技术，并拓展电子浆料等产品矩阵，实现电子浆料在 AI 用高密度互联 PCB、下世代玻璃基板（TGV）、先进封装、陶瓷电路板、消费电子等领域的技术攻关和应用布局，以发明人身份参与公司 4 项已授权发明专利的发明过程； 2、获得江苏省“双创博士”、常熟市科技创新创业领军人才等奖项。
沈晓燕	1、作为主要参与者，完成粉体合成技术群多项核心技术开发，参与高性能球形硅微粉、锂电池隔膜功能材料多个前沿产品以及负膨胀系数陶瓷粉体、钛酸钡、硅碳负极等重要研发项目，在公司硅系材料、铝系材料、电子陶瓷、固态电解质等多个领域取得系列创新成果，以发明人身份参与公司 17 项已授权发明专利的发明过程； 2、被认定为苏州市重点产业紧缺人才。
贾波	1、作为主要参与者，完成粉体微纳加工技术群、表面改性技术群、粉体合成技术群等多项核心技术的开发，参与高性能球形硅微粉、高导热氮化物、钛系材料等重要研发项目，以及早期覆铜板用角型硅微粉开发及创新升级等项目，以发明人身份参与公司 20 项已授权发明专利的发明过程。

3、公司核心技术人员的约束和激励措施

发行人对核心技术人员实施的约束激励措施主要包括：（1）公司针对核心技术人员实施股权激励，分享公司发展经营成果，实现长期激励与绑定，提高人员

稳定性；（2）为核心技术人员提供了具有市场竞争力的薪酬及相关福利待遇，并持续完善绩效考核体系；（3）通过自身培养、外出进修学习等方式营造人才快速成长与发展的良好氛围，充分调动核心技术人员的工作积极性；（4）与全体核心技术人员均已签署了保密及竞业限制协议，对其任职期间和离职后的保密、竞业事项进行了严格约定。

4、报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响

报告期内，公司核心技术人员不存在重大变化，不会对公司的生产经营和研发产生不利影响。

（七）保持技术持续创新的机制、技术储备及创新安排

1、技术创新管理机制

公司坚持以研发创新为核心驱动力，将研发工作定义为公司全局战略的领头地位，已建立较完备的研发体系。公司制定了《项目立项管理流程》《新产品设计开发管理程序》等研发管理制度，从项目立项、研发投入、成果转化等方面，对研发工作进行了严格的管理和控制。另外，公司引入多项流程控制体系和标准程序，包括共性技术（CBB）管理流程、节点评审内容和标准汇总、研发文件化信息管理程序和产品开发关键节点评审和控制规则等，同时引入各项先进控制系统和分析模型，以实现对研发过程的精细评估和风险控制。

2、技术储备及创新安排

公司技术储备情况请参见本节之“六、公司核心技术及研发情况”之“（三）公司研发项目情况”。

公司致力于先进无机功能性粉体材料领域创新性技术研发及产业化应用，通过下游深度技术合作、人才吸纳、优化研发流程、加大研发资金投入等创新安排，不断丰富技术储备、提升自身技术实力。公司保持技术创新能力的主要安排如下：

（1）深耕下游产业链，与行业标杆企业保持深度技术合作：公司通过与下游及终端市场领先企业开展技术交流、市场调研等方式，及时把握客户产品迭代诉求与行业新兴技术趋势，在下游新一代产品开发试验阶段即同步开展配套研发工作，提前进行相应技术储备，为实现高端前沿领域产品的先发供应奠定坚实基

础。

（2）充分利用高校科研资源，持续充实研发团队实力：公司与多所高等院校开展合作开发等产学研合作，实现资源共享、优势互补，共同攻克行业技术难题。人才引进方面，公司积极引进高校专业领域硕博人才，不断夯实研发团队建设，为持续技术创新提供人才保障。

（3）持续优化研发工作流程，建立公司层面的泛研发机制：公司严格执行高效合理、分工明确的研发管理制度，不断优化新产品开发流程，保障研发项目顺利有效推进；同时充分调动公司层面资源，在研发、生产、设备、工艺、质量各部门间建立了技术攻关协调讨论机制，助力公司综合技术实力发展。

（4）持续加大研发投入，深化技术创新与前沿攻关：报告期内，公司累计研发投入金额达到 10,424.53 万元。未来，公司将进一步加大研发投入，为下游高端、前沿领域产品研发与技术攻关提供资金保障。

七、发行人环境保护及安全生产情况

公司主营业务为先进无机非金属粉体材料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》《关于印发<企业环境信用评价办法（试行）>的通知》（环发[2013]150 号）等相关规范性文件规定，公司所处行业不属于重污染行业。公司在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，生产经营场所已取得必要的环境保护许可手续。公司生产经营中涉及的主要环境污染物、处理措施如下：

污染物类别	污染物内容	主要处理措施	运行情况
废气	生产废气（颗粒物、非甲烷总烃等）	生产废气经固定收集器、集气罩收集、管道负压收集后，通过水喷淋、活性炭吸附装置处理达标后排放	正常运行
废水	生产废水、实验室清洗废水（COD、SS、PH）、冷却塔强排水	生产废水、实验室清洗废水、冷却塔强排水经收集预处理后排入污水处理装置，采用生化处理工艺；满足接管标准后排放至污水处理厂后续处理	正常运行
固废	生产、实验过程中产生的固体废物	回收使用或委托有资质的废物处理公司处理	正常运行
噪声	设备运行噪声	采取隔声减振等处理措施	正常运行

公司生产经营中涉及的主要污染物为废气、废水、固废和噪声等，公司在生产经营过程中已采取相应的污染防治措施，确保污染物经过环保设施处理后达标排放。公司环保投入主要包括环保设施/设备投资、污染物处理费、环境监测费等环保相关支出。报告期内，公司环保设施完备、处理措施完善，处理能力良好，不存在因违反相关法律法规而受到环境保护部门行政处罚的情形。

公司高度重视安全生产，严格遵守国家有关安全法规、制度和标准，已建立较完备的安全生产体系。报告期内，公司安全有序开展生产活动，不存在重大安全事故和纠纷，亦未因违反安全生产相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

八、发行人境外经营情况

2026 年 3 月，发行人设立境外子公司新加坡锦艺作为其海外运营主体，截至本招股说明书签署之日，该境外子公司尚未实际开展生产经营活动，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司、参股公司情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经容诚会计师审计的财务报表及其附注。公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告全文。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动资产：			
货币资金	24,627.63	9,127.55	5,343.88
交易性金融资产	40.02	9.18	-
应收票据	3,648.07	3,079.64	3,042.24
应收账款	40,986.80	29,702.63	19,959.33
应收款项融资	1,183.01	1,867.85	4,193.57
预付款项	917.82	1,639.13	876.80
其他应收款	303.27	281.97	340.85
存货	18,147.78	18,679.26	16,751.05
其他流动资产	3,544.67	1,564.63	421.11
流动资产合计	**93,399.07**	**65,951.82**	**50,928.83**
非流动资产：			
长期股权投资	747.98	673.53	569.76
固定资产	66,228.09	41,301.69	39,675.17
在建工程	18,219.30	23,083.67	7,871.59
使用权资产	1,769.55	1,919.22	446.58
无形资产	4,509.61	4,495.63	4,404.96
商誉	1,071.12	1,071.12	1,071.12
长期待摊费用	2,474.42	-	-
递延所得税资产	1,199.87	854.73	751.82
其他非流动资产	1,746.15	2,906.27	1,772.31
非流动资产合计	**97,966.08**	**76,305.85**	**56,563.32**
资产总计	**191,365.14**	**142,257.67**	**107,492.15**

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动负债：			
短期借款	22,931.65	12,633.93	5,436.95
交易性金融负债	-	1.31	-
应付票据	3,080.86	853.21	701.28
应付账款	21,852.45	14,464.15	9,305.45
合同负债	63.95	30.82	16.60
应付职工薪酬	2,525.40	1,688.51	1,388.39
应交税费	1,578.20	1,056.47	558.86
其他应付款	535.83	843.49	363.83
一年内到期的非流动负债	9,481.00	4,197.87	4,080.50
其他流动负债	3,270.40	2,362.15	2,301.87
流动负债合计	**65,319.74**	**38,131.89**	**24,153.72**
非流动负债：			
长期借款	17,095.04	12,454.05	3,367.80
租赁负债	1,204.00	1,360.03	207.85
递延收益	3,056.33	1,976.88	359.45
递延所得税负债	-	-	335.03
非流动负债合计	**21,355.37**	**15,790.96**	**4,270.12**
负债合计	**86,675.11**	**53,922.85**	**28,423.85**
所有者权益：			
股本	16,714.51	16,714.51	16,714.51
资本公积	49,283.85	49,445.80	49,131.48
盈余公积	3,976.21	2,189.56	1,267.80
未分配利润	34,800.50	19,984.95	11,960.10
归属于母公司所有者权益合计	**104,775.07**	**88,334.82**	**79,073.88**
少数股东权益	-85.04	-	-5.58
所有者权益合计	**104,690.03**	**88,334.82**	**79,068.30**
负债和所有者权益总计	**191,365.14**	**142,257.67**	**107,492.15**

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**103,586.02**	**72,857.24**	**51,950.91**

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其中：营业收入	103,586.02	72,857.24	51,950.91
二、营业总成本	**83,548.87**	**61,501.57**	**45,288.31**
其中：营业成本	68,321.39	50,368.78	36,077.94
税金及附加	907.45	611.45	325.02
销售费用	2,381.39	2,032.72	1,762.05
管理费用	6,888.87	4,626.04	4,102.16
研发费用	4,210.85	3,420.40	2,793.28
财务费用	838.93	442.17	227.88
其中：利息费用	805.15	605.78	294.78
利息收入	112.02	48.76	10.93
加：其他收益	841.72	599.93	433.97
投资收益	79.45	113.12	286.19
公允价值变动收益	41.32	0.17	-
信用减值损失	-26.10	-41.48	-45.08
资产减值损失	-1,901.34	-1,897.08	-68.48
资产处置收益	-5.09	-48.99	-28.08
三、营业利润	**19,067.12**	**10,081.35**	**7,241.12**
加：营业外收入	6.70	2.80	5.15
减：营业外支出	150.15	33.53	60.97
四、利润总额	**18,923.67**	**10,050.62**	**7,185.30**
减：所得税费用	2,406.50	1,114.24	581.10
五、净利润	**16,517.17**	**8,936.38**	**6,604.20**
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润	16,517.17	8,936.38	6,604.20
2、终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司所有者的净利润	16,602.20	8,946.61	6,609.78
2、少数股东损益	-85.04	-10.24	-5.58
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	**16,517.17**	**8,936.38**	**6,604.20**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,602.20	8,946.61	6,609.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-85.04	-10.24	-5.58

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.99	0.54	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.98	0.53	0.39

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	79,698.17	53,841.14	37,608.94
收到的税费返还	147.33	-	365.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,918.12	2,058.48	239.37
经营活动现金流入小计	**81,763.63**	**55,899.62**	**38,213.42**
购买商品、接受劳务支付的现金	37,891.44	30,717.78	25,490.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,149.16	11,456.76	9,411.91
支付的各项税费	7,081.96	3,852.00	1,553.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,765.05	3,737.71	2,087.85
经营活动现金流出小计	**61,887.61**	**49,764.25**	**38,543.17**
经营活动产生的现金流量净额	**19,876.02**	**6,135.37**	**-329.74**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12,600.74	17,515.58	11,300.00
取得投资收益收到的现金	24.48	11.99	38.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.50	105.54	4.70
收到其他与投资活动有关的现金	10.50	506.00	-
投资活动现金流入小计	**12,658.23**	**18,139.11**	**11,343.69**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,161.91	18,464.98	7,203.43
投资支付的现金	12,600.74	17,515.58	8,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	292.75	-	-
投资活动现金流出小计	**34,055.40**	**35,980.56**	**15,603.43**
投资活动产生的现金流量净额	**-21,397.17**	**-17,841.45**	**-4,259.74**
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	32,272.61	21,952.36	7,022.90
筹资活动现金流入小计	**32,272.61**	**21,952.36**	**7,022.90**

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
偿还债务支付的现金	12,602.19	5,422.79	2,097.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176.85	732.22	365.90
支付其他与筹资活动有关的现金	715.29	1,129.15	292.89
筹资活动现金流出小计	**14,494.33**	**7,284.16**	**2,756.16**
筹资活动产生的现金流量净额	**17,778.28**	**14,668.20**	**4,266.74**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-27.45**	**91.55**	**10.64**
五、现金及现金等价物净增加额	**16,229.67**	**3,053.67**	**-312.10**
加：期初现金及现金等价物余额	8,397.45	5,343.78	5,655.88
六、期末现金及现金等价物余额	**24,627.12**	**8,397.45**	**5,343.78**

二、财务报表的编制基础及审计意见

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

（二）注册会计师的审计意见

容诚会计师作为公司本次公开发行的财务审计机构，对本公司报告期内的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2026]215Z0053 号审计报告（以下简称“《审计报告》”）。

容诚会计师认为：“公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锦艺新材 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

（一）关键审计事项

关键审计事项是容诚会计师根据职业判断，认为对 2025 年度、2024 年度和 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，容诚会计师不对这些事项单独发表意见。

1、营业收入的确认

相关会计期间：2025 年度、2024 年度和 2023 年度。

（1）事项描述

报告期各期锦艺新材的营业收入分别为 103,586.02 万元、72,857.24 万元和 51,950.91 万元。由于营业收入是锦艺新材的关键业绩指标之一，营业收入的确认对锦艺新材的经营成果影响较大，从而存在锦艺新材管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

针对营业收入的确认，容诚会计师实施的相关程序包括但不限于：

1）了解、评价和测试锦艺新材与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2）通过访谈管理层与检查销售合同，了解和评估公司的收入确认政策是否符合会计准则的要求，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；

3）执行分析性程序，主要包括分析报告期内各期间收入、成本及毛利率的波动情况及原因；比较报告期内各期间主要产品的单位售价、单位成本及毛利率与可比期间的数据，分析其变动趋势；将公司毛利率水平与同行业可比公司进行对比，分析差异及合理性等；

4）检查主要客户销售合同或订单、销售出库单、增值税发票、送货签收单、出口报关单及提单等收入确认关键证据，并结合对主要客户实施函证及走访等程

序，评价收入确认的真实性、完整性及准确性；

5）实施期后检查，检查期后收款及退货情况，关注是否存在异常退款或退货情形；

6）对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

2、存货跌价准备的计提

相关会计期间：2025 年度、2024 年度和 2023 年度。

（1）事项描述

报告期各期末锦艺新材的存货账面余额分别为 19,886.10 万元、20,102.25 万元和 17,393.52 万元，存货跌价准备余额分别为 1,738.32 万元、1,422.99 万元和 642.47 万元。于资产负债表日管理层对存货采用成本与可变现净值孰低计量，对于账面价值超过可变现净值的存货计提存货跌价准备。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，因此我们将存货跌价准备的计提为关键审计事项。

（2）审计应对

针对存货跌价准备的计提，容诚会计师实施的相关程序包括但不限于：

1）了解、评价和测试管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2）了解锦艺新材存货跌价准备计提政策，并与可比上市公司的存货跌价准备计提政策进行对比分析，评价其是否符合企业会计准则的规定；查询报告期各期可比上市公司存货跌价准备计提的具体情况，并与公司情况进行对比分析；

3）获取报告期各期末存货库龄明细，关注是否存在库龄较长等情形，结合存货周转情况等，对库龄较长的存货进行分析性复核，了解存货库龄较长的原因，分析存货跌价准备计提是否充分；

4）结合存货监盘，对存货的外观形态进行检视，以了解其物理形态是否正常，了解主要产品售价波动、技术或市场需求的变化情况，同时关注有无积压滞销的存货，并分析期末各项存货是否存在减值迹象；

5）根据成本与可变现净值孰低的计价方法，评价存货跌价准备所依据的资料、假设及计提方法，考虑是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值，复核其合理性；

6）获取存货跌价准备计算表，考虑不同存货的可变现净值的确定原则，实施存货跌价计提测试，复核管理层存货跌价准备计提是否准确。

（二）重大事项或重要性水平的判断标准

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收款项	单项期末余额≥500.00 万元
重要的在建工程项目	单项在建工程项目预算、发生额或期末余额超过资产的 1%且金额≥2,000.00 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款余额超过 500.00 万元
重要的合营企业或联营企业	长期股权投资账面价值占公司合并资产总额 1%以上或投资收益金额占公司合并利润总额 3%以上

四、合并财务报表的范围及具体变化情况

（一）合并财务报表合并范围

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子/孙公司如下：

子/孙公司名称	主要经营地	取得方式	持股比例	
			直接	间接
云阳锦艺	重庆云阳	同一控制下企业合并	100.00%	-
功能材料	江苏苏州	设立	100.00%	-
山东锦艺	山东临沂	非同一控制下企业合并	100.00%	-
临沂创实	山东临沂	非同一控制下企业合并	-	100.00%
苏州锦禾	江苏苏州	设立	-	100.00%
铭隆新材料	江苏苏州	设立	100.00%	
锦艺半导体	江苏苏州	设立	70.00%	

（二）报告期内合并范围具体变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围内的子/孙公司变化及原因如下：

子/孙公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
云阳锦艺	是	是	是

子/孙公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
功能材料	是	是	是
山东锦艺	是	是	是
临沂创实	是	是	是
苏州锦禾	是	是	是
铭隆新材料	是	是	是
嘉兴锦艺	/	是	是
锦艺半导体	是	/	/

1、合并范围增加

2025 年 5 月，公司设立控股子公司锦艺半导体，公司持股比例 70.00%，锦艺半导体自设立起纳入合并范围。

2、合并范围减少

2025 年 8 月，嘉兴锦艺注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。

五、分部信息

报告期内，本公司各业务之间共用资产及人力资源，无法具体划分各业务类型对应资产负债，故无报告分部。

六、重要的会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

（二）主要会计政策和会计估计

报告期内，公司完整会计政策和会计估计参见容诚会计师出具的《审计报告》，主要会计政策及会计估计具体情况如下：

1、收入确认原则和计量方法

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本

无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确

认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5）客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

1）销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：一般情况下，公司在商品交付给客户，取得客户或其指定第三方确认的签收单据后确认收入；领用确认的，商品运至客户指定地点，公司经核对客户确认单后确认收入。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司产品在境内港口装船后，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给了购货方。因此，实际操作中，公司以报关单上记载的出口日期作为出口收入的确认时点，确认销售收入的实现。

2）受托加工服务

受托加工服务收入确认需满足以下条件：对于境内受托加工业务，根据合同约定完成加工并最终以产品的形式进行交付后确认收入；对于境外受托加工业务，将受托加工的产品装船后已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给了客户，以报关单上记载的出口日期作为出口收入确认的时点。

3）技术服务

技术服务收入确认满足以下条件：根据合同约定，公司将服务提供完毕并经

客户验收确认后确认技术服务收入。

2、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排为合营企业。合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

3、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金

流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公

允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存

在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款和应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款和应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款和应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1　信用等级较低的银行承兑汇票

应收票据组合 2　商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1　合并范围内关联方客户

应收账款组合 2　合并范围外关联方客户

应收账款组合 3　其他外部客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1　应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2　应收押金和保证金

其他应收款组合 3　应收其他经营性资金

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1　信用等级较高的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人

在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

1）终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，

且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

2）继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

3）继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认

所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节之“六、重要的会计政策和会计估计”之“（二）主要会计政策和会计估计”“4、公允价值计量”。

4、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生

经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

（1）估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

（2）公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

3）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

6、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，

以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合

并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

1）成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成

本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2）权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节之“六、重要的会计政策和会计估计”之“（二）主要会计政策和会计估计”之“10、长期资产减值”。

7、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	年折旧率（%）	预计净残值率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	2.38-9.50	5.00
机器设备	年限平均法	3-12 年	7.92-31.67	5.00
运输设备	年限平均法	5-12 年	7.92-19.00	5.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5 年	19.00-31.67	5.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

8、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算；

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类 别	转固标准和时点
房屋及建筑物	（1）建造主体工程及配套工程已经全部完成或实质上已经全部完成；（2）继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生；（3）所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备	（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

9、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

1）本公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，其使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	3-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2）无形资产的摊销

针对使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

（3）研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、材料投入、折旧与摊销、股份支付、试验检测费、水电气费用及其他费用等。

10、长期资产减值

对子公司、合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记

至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付均为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

1）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日

以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

12、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1）执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所

得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2）执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

3）执行《企业会计准则解释第 18 号》

2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称“解释 18 号”），其中“保证类质保费用应计入营业成本”内容自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行解释 18 号的相关规定，对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更。

七、主要税种、税率及税收优惠情况

（一）主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、6%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

报告期内，公司适用不同企业所得税税率的纳税主体如下：

纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
锦艺新材	15%	15%	15%

纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
云阳锦艺	15%	20%	20%
功能材料	25%	25%	25%
山东锦艺	25%	20%	20%
临沂创实	20%	20%	20%
苏州锦禾	20%	20%	20%
铭隆新材料	20%	20%	20%
嘉兴锦艺	20%	20%	20%
锦艺半导体	20%	-	-

（二）报告期内享受的税收优惠情况

1、高新技术企业所得税税收优惠

发行人分别于 2022 年 12 月 12 日和 2025 年 11 月 18 日取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GR202232013140 和 GR202532003477，有效期三年，到期日分别为 2025 年 12 月 12 日和 2028 年 11 月 18 日。报告期内，本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2、小型微利企业所得税税收优惠

2022 年 3 月 14 日，财政部、税务总局发布《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号），执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2023 年 3 月 26 日，财政部、税务总局发布《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6 号），执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2023 年 8 月 2 日，财政部、税务总局发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税[2023]12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

报告期内，子公司苏州锦禾、临沂创实、铭隆新材料、嘉兴锦艺和锦艺半导体属于小型微利企业；子公司山东锦艺和云阳锦艺在 2023 年度至 2024 年度属于小型微利企业；上述子公司在各自相关期间内，享受小微企业所得税税收优惠。

3、西部大开发企业所得税税收优惠

根据财政部税务总局颁布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

子公司云阳锦艺主营业务符合西部大开发产业结构调整目录中鼓励类企业要求，享受该税收优惠政策，在 2025 年度适用的企业所得税税率为 15%。

4、先进制造企业增值税加计抵减税收优惠

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告[2023]43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。公司符合以上规定，在报告期内享受该税收优惠政策。

5、增值税出口退税税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号），发行人属于生产企业，出口自产货物享受增值税免抵退政策优惠。报告期内，公司相关产品销售享受 13%出口退税税率。

6、增值税期末留抵退税税收优惠

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署[2019]39 号）、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）的规定并经主管税务机关核准，2023 年度，子公司临沂创实收到增值税留抵税额退税 550,168.73 元。

（三）税收优惠对经营成果的影响

报告期内，公司所得税税收优惠金额及其占利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
所得税税收优惠金额	1,854.16	1,076.95	1,167.08
利润总额	18,923.67	10,050.62	7,185.30
占比	**9.80%**	**10.72%**	**16.24%**

报告期各期，随着公司销售规模的扩大以及盈利能力的提升，公司取得的税收优惠占利润总额的比例有所下降。报告期内，发行人享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠，该税收优惠政策与发行人经营业务密切相关，预计发行人未来可持续被认定为高新技术企业；另外，发行人享受的税收优惠政策属于国家支持符合一定条件的企业发展的长期性政策，未来税收优惠具有较好的可持续性。

但若未来公司未能继续享受相应税收优惠，或者国家税收优惠政策发生变化，可能对公司业绩造成不利影响，公司已在本招股说明书“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（三）财务风险”之“4、税收优惠政策变化风险”提示投资者注意相关风险。

八、经申报会计师核验的非经常性损益

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]215Z0045号《非经常性损益鉴证报告》，报告期内发行人非经常性损益明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32.65	-74.76	-37.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	345.15	297.43	197.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	56.63	19.86	40.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115.89	-4.96	-46.37
非经常性损益总额	**253.25**	**237.57**	**154.25**
减：非经常性损益的所得税影响数	5.96	39.50	23.91
非经常性损益净额	**247.28**	**198.08**	**130.35**

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	0.00		-0.01
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**247.28**	**198.08**	**130.35**
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**16,354.92**	**8,748.54**	**6,479.43**

九、报告期内发行人主要财务指标

（一）基础财务指标

以下会计数据及财务指标中，除注明以母公司财务报告的数据为基础计算外，均以合并财务报告的数据为基础进行列示。

项目	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
流动比率（倍）	1.43	1.73	2.11
速动比率（倍）	1.15	1.24	1.42
资产负债率（母公司）	33.77%	32.62%	31.44%
资产负债率（合并）	45.29%	37.91%	26.44%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	6.27	5.28	4.73
应收账款周转率（次/年）	2.57	2.36	2.16
存货周转率（次/年）	3.71	2.84	2.25
息税折旧摊销前利润（万元）	24,534.63	14,634.89	10,794.62
利息保障倍数（倍）	24.50	17.59	25.38
归属于母公司股东的净利润（万元）	16,602.20	8,946.61	6,609.78
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	16,354.92	8,748.54	6,479.43
研发投入占营业收入的比例	4.07%	4.69%	5.38%
每股经营活动现金流量净额（元）	1.19	0.37	-0.02
每股净现金流量（元）	0.97	0.18	-0.02

注：上述主要财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率（母公司）=负债总额/资产总额

4、资产负债率（合并）=负债总额/资产总额

5、归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于公司普通股股东的权益/期末股本总额

6、应收账款周转率=营业收入/应收票据、应收账款及应收款项融资平均账面价值

7、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

8、息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息支出＋折旧费＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销

9、利息保障倍数=息税前利润/利息费用

10、归属于发行人股东的扣除非经常经损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东的非经常性损益

11、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
12、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
13、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，报告期内加权平均净资产收益率、基本和稀释每股收益如下：

计算口径	加权平均净资产收益率（%）		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.19	10.69	8.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.94	10.45	8.58
计算口径	基本每股收益（元/股）		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.54	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.52	0.39
计算口径	稀释每股收益（元/股）		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.53	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.52	0.38

注：上述指标的计算方法如下：
（1）加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（2）基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十、经营成果分析

（一）经营成果概览

报告期内，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	103,586.02	72,857.24	51,950.91
营业成本	68,321.39	50,368.78	36,077.94
营业利润	19,067.12	10,081.35	7,241.12
利润总额	18,923.67	10,050.62	7,185.30
净利润	16,517.17	8,936.38	6,604.20
归属于母公司股东的净利润	16,602.20	8,946.61	6,609.78
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16,354.92	8,748.54	6,479.43

报告期内，公司营业收入分别为 51,950.91 万元、72,857.24 万元和 103,586.02 万元，年均复合增长率为 41.21%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 6,479.43 万元、8,748.54 万元和 16,354.92 万元，年均复合增长率为 58.88%。报告期内，公司经营业绩呈现高速增长趋势，主要原因如下：

1、公司系电子信息领域无机功能性粉体行业领先企业，紧握 AI 产业变革机遇，实现跨越式发展

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域二十余载，已成长为电子信息领域无机功能性粉体行业领先企业。自 2008 年起，公司陆续进入台光电子、联茂电子、台燿科技、生益科技、南亚电子、韩国斗山、华正新材、南亚新材、建滔化工、日本松下等全球前十大高速覆铜板制造商（CR10>90%），并成为多个龙头客户的重要供应商，较早在高等级高速覆铜板、高阶 HDI 板领域构筑起领先的供应地位。伴随 AI 人工智能的爆发式发展，并带动高速网络通信、云计算、先进封

装等多个产业领域交互式高速发展，以高速覆铜板为代表的高性能覆铜板，作为电子电路的核心基材，逐步成为 AI 等产业基础设施的“性能基石”，由此步入高速发展周期，并催生出对上游高性能原材料的显著应用需求。公司凭借多年来在高性能球形硅微粉领域构建的领先优势，以及较早在高等级高速覆铜板领域建立起的优势供应地位，积极把握 AI 产业变革机遇，实现经营规模的跨越式增长，报告期内，公司高性能球形硅微粉收入分别为 19,241.19 万元、35,497.12 万元及 56,983.06 万元，复合增长率达 72.09%，为公司整体业绩增长注入强劲动力。

2、公司产品结构持续优化，高端产品打造业绩增长核心驱动力

公司自设立以来坚持高端化发展方向，致力于高端、前沿材料的国产替代实现和自主创新突破，经过多年耕耘，逐步实现在电子信息功能材料、导热散热功能材料领域等多类高性能产品的技术突破及产业化应用，并成长为覆铜板用高性能球形硅微粉行业领先企业，在高导热氮化物市场不断替代外资厂商供应份额，随着 AI 等先进产业高速发展，带动对高性能电子信息功能材料、导热散热材料的强劲应用需求，公司高端产品显著放量，产品结构持续优化，以公司主要产品为例，报告期内，电子信息功能材料方面，公司高性能球形硅微粉销售收入占比由 51.96%逐年提升至 66.32%、72.89%，导热散热功能材料方面，公司高导热氮化物销售收入占比由 18.42%逐年提升至 31.57%、52.02%，成为公司业绩增长的核心驱动力。

3、公司横向拓展不断深化，多元化业务布局助力业绩增长

公司在不断夯实电子信息领域纵深发展的同时，对具有技术同源性的多种无机非金属材料，锚定具备高附加值、创新性应用前景领域进行拓展性开发，成功实现在导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料等领域的横向拓展。目前，公司已与多个行业龙头客户建立深入合作关系，如导热领域的陶氏化学、汉高、迈图、莱尔德、瓦克化学、洛德、比亚迪、苏州天脉、博恩新材；锂电池领域的恩捷股份、金力股份、中材科技；涂料领域的阿克苏诺贝尔、立邦、老虎、PPG 等。2023 年至 2025 年，公司导热散热功能材料、锂电池隔膜功能材料、涂料功能材料等营业收入合计为 13,495.37 万元、17,654.17 万元以及 22,730.55 万元，为公司构建起多元业绩支点，有效提供业绩增长助力。

（二）营业收入分析

1、营业收入总体分析

报告期内，公司营业收入具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	103,206.52	99.63	72,604.62	99.65	51,780.03	99.67
其他业务收入	379.51	0.37	252.62	0.35	170.88	0.33
合计	**103,586.02**	**100.00**	**72,857.24**	**100.00**	**51,950.91**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入分别为 51,780.03 万元、72,604.62 万元及 103,206.52 万元，占营业收入的比例分别为 99.67%、99.65%及 99.63%，主营业务突出。其他业务收入占比较小，主要系材料销售、技术服务等收入。

2、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子信息功能材料	78,181.81	75.75	53,524.84	73.72	37,031.51	71.52
导热散热功能材料	13,126.16	12.72	10,602.26	14.60	7,682.41	14.84
其他新兴功能材料	11,898.55	11.53	8,477.52	11.68	7,066.10	13.65
合计	**103,206.52**	**100.00**	**72,604.62**	**100.00**	**51,780.03**	**100.00**

报告期内，公司主要从事无机非金属粉体材料研发、生产和销售，主要产品包括电子信息功能材料、导热散热功能材料和其他新兴功能材料。报告期内，公司主营业务收入主要来自于电子信息功能材料及导热散热功能材料，两类产品占主营业务收入的比例合计超过 85%。

单位：万元、%

项目	2025 年度较上年			2024 年度较上年		
	收入增长额	收入增长率	增长贡献率	收入增长额	收入增长率	增长贡献率
电子信息功能材料	24,656.97	46.07	33.96	16,493.33	44.54	31.85
导热散热功能材料	2,523.90	23.81	3.48	2,919.85	38.01	5.64

项目	2025 年度较上年			2024 年度较上年		
	收入增长额	收入增长率	增长贡献率	收入增长额	收入增长率	增长贡献率
其他新兴功能材料	3,421.03	40.35	4.71	1,411.42	19.97	2.73
合计	**30,601.90**	**42.15**	**42.15**	**20,824.59**	**40.22**	**40.22**

注：增长贡献率=该品类本期收入增长额/上期主营业务收入，下同。

报告期内，公司主营业务收入保持高速增长趋势。2024 年度和 2025 年度，公司主营业务收入分别较上年度增长 20,824.59 万元和 30,601.90 万元，增长率分别为 40.22%和 42.15%，主要源于电子信息功能材料的持续高速增长驱动。2024 年度和 2025 年度，电子信息功能材料销售增长率分别达 44.54%、46.07%，同时，导热散热功能材料、其他新兴功能材料亦呈现较好增长趋势，共同为公司贡献 8.36%、8.19%的销售增长率。公司主要产品类别收入变动情况分析如下：

（1）电子信息功能材料

报告期内，公司电子信息功能材料销售收入分别为 37,031.51 万元、53,524.84 万元及 78,181.81 万元，占主营业务收入的比例分别为 71.52%、73.72%及 75.75%。公司电子信息功能材料板块产品包括化学法球形硅微粉、直燃法球形硅微粉、火焰法球形硅微粉等高性能球形硅微粉产品，软性复合填料、熔融硅微粉等角形硅微粉，以及其他电子信息功能材料，具体构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
高性能球形硅微粉	56,983.06	60.53	35,497.12	84.49	19,241.19
角形硅微粉	18,071.46	16.05	15,571.47	1.21	15,385.36
其他电子信息功能材料	3,127.28	27.32	2,456.24	2.13	2,404.96
合计	**78,181.81**	**46.07**	**53,524.84**	**44.54**	**37,031.51**

报告期内，公司电子信息功能材料主要细分产品的销售收入、销售数量、平均单价情况如下：

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
高性能球形硅微粉	销售收入（万元）	56,983.06	35,497.12	19,241.19
	销售数量（吨）	6,151.39	3,994.76	2,258.42
	单价（万元/吨）	9.26	8.89	8.52

角形硅微粉	销售收入（万元）	18,071.46	15,571.47	15,385.36
	销售数量（吨）	32,632.50	28,603.94	30,169.64
	单价（万元/吨）	0.55	0.54	0.51

报告期内，公司电子信息功能材料销售收入呈现快速增长趋势，主要受益于 AI 等先进产业爆发式发展，带来对高性能球形硅微粉的显著增长需求，公司依托深厚的技术实力和领先的产品性能，紧握新兴产业变革机遇，面向 AI 等终端基础亟需的高等级高速覆铜板、高阶 HDI 板领域，实现高性能产品销售大幅增长。

2024 年度，公司电子信息功能材料销售收入较上年度增长 16,493.33 万元，销售增长率达 44.54%，主要系 2023 年被称为生成式 AI 元年，至 2024 年期间，AI 算力基础设施呈现爆发式增长需求，并带动高速网络通信、先进封装等交互式高速发展，推动公司应用于 AI 等先进产业终端的高性能球形硅微粉大幅放量。2024 年度，公司高性能球形硅微粉销量较上年同比增长 76.88%，同时，高性能产品销售价格位于近十万/吨的较高水平，拉动公司电子信息功能材料平均售价由 2023 年度的 1.07 万元/吨快速提升至 2024 年度的 1.54 万元/吨，增长幅度达 43.49%，共同驱动电子信息功能材料销售收入实现大幅增长。

2025 年度，公司电子信息功能材料销售收入较上年度增长 24,656.97 万元，销售增长率达 46.07%，主要系 AI 保持强劲发展势头和高速迭代频率，对 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等 AI 算力相关设备提出更高性能要求，驱动电子信息功能材料朝着 low Dk、low Df、low CTE、高导热、高模量等更优性能方向发展，带动对公司更高规格等级产品的采购需求，促进公司产品结构进一步优化。2025 年度，公司高性能球形硅微粉产品销量较上年度增长 53.99%，拉动电子信息功能材料平均售价进一步提升至 1.90 万元/吨，成为当期电子信息功能材料业绩增长的主要引擎。

（2）导热散热功能材料

报告期内，公司导热散热功能材料销售收入分别为 7,682.41 万元、10,602.26 万元及 13,126.16 万元，占主营业务收入的比例分别为 14.84%、14.60%及 12.72%。公司导热散热功能材料板块产品包括氮化铝、氮化硼等高导热氮化物，以及导热氧化铝和其他导热散热功能材料，具体构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
高导热氮化物	6,828.31	104.03	3,346.65	136.44	1,415.42
导热氧化铝	5,363.15	-17.78	6,522.84	27.46	5,117.69
其他导热散热功能材料	934.70	27.56	732.77	-36.24	1,149.31
合计	**13,126.16**	**23.81**	**10,602.26**	**38.01**	**7,682.41**

报告期内，公司导热散热功能材料主要细分产品的销售收入、销售数量、平均单价情况如下：

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
高导热氮化物	销售收入（万元）	6,828.31	3,346.65	1,415.42
	销售数量（吨）	98.21	45.89	20.29
	单价（万元/吨）	69.53	72.92	69.77
导热氧化铝	销售收入（万元）	5,363.15	6,522.84	5,117.69
	销售数量（吨）	4,914.86	4,647.78	3,757.67
	单价（万元/吨）	1.09	1.40	1.36

2024 年度，公司导热散热功能材料销售收入较上年度增长 2,919.85 万元，销售增长率为 38.01%，具体原因如下：①公司依托高导热氮化物实现产品结构优化，一方面在通讯基站、汽车域控制器、手机芯片等高要求散热领域，公司氮化铝产品市场渗透率不断提升，另一方面，AI 人工智能的兴起，新增 AI 服务器和算力中心等超高密度、高功率场景对高性能产品氮化铝的采购需求，此外，公司新开发的部分氮化硼材料完成前期验证步入放量阶段，使得公司高导热氮化物产品销量较上年度增 126.22%，同时，高导热氮化物产品售价位于几十万每吨的较高水平，伴随其销售占比的提升，拉动导热散热功能材料平均销售价格增长 25.06%，共同驱动公司导热散热功能材料销售规模大幅增长；②受欧美市场新能源汽车电池导热需求增长影响，公司导热氧化铝产品销售量较上年度增长 23.69%，成为公司导热散热功能材料销售收入快速增长的另一重要原因。

2025 年度，公司导热散热功能材料销售收入较上年度增长 2,523.90 万元，销售增长率为 23.81%，主要受益于高导热氮化物销售规模保持高速增长趋势。2025 年度，公司高导热氮化物销售收入同比增长 3,481.66 万元，增幅达 104.03%，主要系氮化铝产品凭借优良的散热性能在 AI 服务器散热模组，存储芯片、手机

芯片封装、无人机等高速发展的先进产业领域得以规模应用，产品销售数量较上年度大幅增长 113.99%。

（3）其他新兴功能材料

报告期内，公司其他新兴功能材料销售收入分别为 7,066.10 万元、8,477.52 万元及 11,898.55 万元，占主营业务收入的比例分别为 13.65%、11.68%及 11.53%。公司其他新兴功能材料板块产品主要为锂电池隔膜功能材料和涂料功能材料。

锂电池隔膜功能材料系公司应用平台型技术在锂电池领域开展的横向业务拓展与布局。报告期内，公司锂电池隔膜功能材料分别为 3,700.90 万元、4,870.38 万元及 7,797.24 万元，占主营业务收入的比例分别为 7.15%、6.71%及 7.55%。2024 年度，公司锂电池隔膜功能材料销售规模同比增长 1,169.48 万元、增幅为 31.60%，主要系公司依托优异的产品性能，持续在动力电池领域提升对金力股份等终端龙头客户的供应规模，并将产品成功拓展至储能电池市场。2025 年度，公司锂电池隔膜功能材料销售规模保持高速增长趋势，较上年度增长 2,926.86 万元，增幅达 60.10%，主要受益于国家政策有效促进动力电池领域扩量提质，叠加大客户金力股份自身市场份额不断提升，共同带来对公司锂电池隔膜功能材料的增长需求。

涂料功能材料是公司锚定创新性应用前景，将同源技术在涂料领域进行横向拓展的又一业务布局。报告期内，公司涂料功能材料分别为 2,112.06 万元、2,181.53 万元及 1,807.15 万元，占主营业务收入的比例分别为 4.08%、3.00%及 1.75%。2024 年度，公司涂料功能材料收入规模与上年度基本持平。2025 年度，公司涂料功能材料销售规模较上年度小幅下降 374.38 万元、降幅为 17.16%，主要系以建筑领域为代表的终端市场景气度下行，行业竞争加剧，产品销量出现阶段性下滑。

3、主营业务收入按地区分析

报告期内，公司境内、境外销售收入占比总体保持稳定，公司主营业务收入按地区划分构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	91,303.32	88.47	62,460.27	86.03	44,708.60	86.34
华东	48,899.07	47.38	34,548.93	47.59	24,348.24	47.02
华南	25,459.11	24.67	20,363.45	28.05	15,920.04	30.75
华中	13,291.47	12.88	5,012.01	6.90	2,264.64	4.37
其他	3,653.67	3.54	2,535.87	3.49	2,175.68	4.20
境外	11,903.19	11.53	10,144.35	13.97	7,071.43	13.66
合计	**103,206.52**	**100.00**	**72,604.62**	**100.00**	**51,780.03**	**100.00**

报告期内，公司以境内销售为主，境内销售收入占主营业务收入比重为 86.34%、86.03%和 88.47%，其中，华东地区和华南地区销售占比较高，合计占主营业务收入的比重为 77.77%、75.63%和 72.05%，主要系公司主要产品电子信息功能材料下游应用于覆铜板，而覆铜板厂商主要集中于珠三角和长三角地区。公司境外销售主要面向全球覆铜板制造领域龙头企业台光股份、台燿股份等供应电子信息功能材料，以及向国际知名企业汉高集团供应导热散热材料。

4、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	95,539.54	92.57	68,411.77	94.23	49,110.20	94.84
非直销	7,666.98	7.43	4,192.85	5.77	2,669.82	5.16
合计	**103,206.52**	**100.00**	**72,604.62**	**100.00**	**51,780.03**	**100.00**

报告期内，公司主要采用直销模式，且销售模式结构较为稳定，直销模式销售收入占主营业务收入的比例为 94.84%、94.23%和 92.57%，主要系公司与下游客户合作稳定，直销模式可更好地保障产品供应的稳定性、可靠性，以及提供更高效的技术支持和服务响应。报告期内，公司通过非直销模式实现的销售收入占比较低，主要系公司部分产品通过非直销模式拓宽销售渠道，有效触达终端客户并建立业务联系所致。

5、主营业务收入按季节分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	19,897.51	19.28	14,632.99	20.15	9,421.34	18.19
第二季度	25,617.78	24.82	19,002.39	26.17	12,081.32	23.33
第三季度	29,243.32	28.33	17,938.73	24.71	15,367.34	29.68
第四季度	28,447.91	27.56	21,030.51	28.97	14,910.02	28.79
合计	**103,206.52**	**100.00**	**72,604.62**	**100.00**	**51,780.03**	**100.00**

报告期内，公司的主营业务收入不存在显著的季节性波动，且各季度收入占比较为稳定。公司第一季度收入占全年收入比例稍低，第三、第四季度销售收入占比相对较高，主要系第一季度受下游厂商春节假期影响，导致业务量相对较少。

（三）营业成本分析

1、营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	67,790.35	99.22	50,098.07	99.46	35,869.55	99.42
其他业务成本	531.04	0.78	270.71	0.54	208.39	0.58
合计	**68,321.39**	**100.00**	**50,368.78**	**100.00**	**36,077.94**	**100.00**

报告期内，公司营业成本主要来自于主营业务成本，公司主营业务成本分别为 35,869.55 万元、50,098.07 万元和 67,790.35 万元，主营业务成本随销售收入规模的扩大而增加，成本与收入变动趋势一致。报告期内，公司其他业务成本分别为 208.39 万元、270.71 万元和 531.04 万元，金额较低。

2、主营业务成本按产品类别分析

报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子信息功能材料	46,001.20	67.86	34,449.87	68.76	24,388.26	67.99
导热散热功能材料	10,284.10	15.17	8,657.33	17.28	6,250.30	17.43
其他新兴功能材料	11,505.05	16.97	6,990.86	13.95	5,230.98	14.58
合计	**67,790.35**	**100.00**	**50,098.07**	**100.00**	**35,869.55**	**100.00**

报告期内，随着经营规模的扩大，公司主营业务成本也相应增加，公司各类产品成本变动趋势与主营业务收入变动趋势相匹配。

3、主营业务成本按性质构成分析

报告期内，公司主营业务成本按照成本性质构成分析如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	42,403.64	62.55	29,437.37	58.76	20,370.73	56.79
直接人工	4,019.11	5.93	3,275.55	6.54	2,142.31	5.97
制造费用	19,411.33	28.63	15,693.14	31.32	11,926.49	33.25
运输费用	1,956.27	2.89	1,692.00	3.38	1,430.02	3.99
合计	**67,790.35**	**100.00**	**50,098.07**	**100.00**	**35,869.55**	**100.00**

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运输费用构成。报告期内，公司成本结构较为稳定，不存在大幅异常变化的情形。其中，直接材料成本、制造费用是主营业务成本主要构成部分。

报告期内，公司直接材料成本为 20,370.73 万元、29,437.37 万元和 42,403.64 万元，随营业收入增长而上升；占主营业务成本的比重分别为 56.79%、58.76%和 62.55%，占比呈上升趋势，主要系公司产品结构持续优化，高性能球形硅微粉、高导热氮化物等销售占比逐年提升，带动原材料成本增加所致。

报告期内，公司直接人工成本为 2,142.31 万元、3,275.55 万元和 4,019.11 万元，随生产规模扩大而增加；占主营业务成本的比重分别为 5.97%、6.54%和 5.93%，整体变动较小。

报告期内，公司制造费用为 11,926.49 万元、15,693.14 万元和 19,411.33 万

元，随生产规模扩大逐年提升；占主营业务成本的比重分别为 33.25%、31.32%和 28.63%，占比呈现持续下降趋势，主要得益于规模效应显现。

报告期内，公司运输费用分别为 1,430.02 万元、1,692.00 万元和 1,956.27 万元，占主营业务成本的比重分别为 3.99%、3.38%和 2.89%，随着销售规模的增长，运输费用占比逐年下降。

（四）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及变动分析

报告期内，公司营业毛利额具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	35,416.17	100.43	22,506.55	100.08	15,910.47	100.24
其他业务毛利	-151.53	-0.43	-18.09	-0.08	-37.51	-0.24
合计	**35,264.64**	**100.00**	**22,488.46**	**100.00**	**15,872.97**	**100.00**

报告期内，公司主营业务毛利额分别为 15,910.47 万元、22,506.55 万元和 35,416.17 万元，整体呈现快速增长趋势，系公司营业毛利的主要来源。2023 年度至 2025 年度，公司其他业务毛利额为负，主要系低价处理部分使用价值较低的材料所致。报告期内，公司主营业务毛利额按产品类别构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子信息功能材料	32,180.61	90.86	19,074.96	84.75	12,643.25	79.46
导热散热功能材料	2,842.07	8.02	1,944.93	8.64	1,432.11	9.00
其他新兴功能材料	393.49	1.11	1,486.66	6.61	1,835.12	11.53
合计	**35,416.17**	**100.00**	**22,506.55**	**100.00**	**15,910.47**	**100.00**

报告期内，公司主营业务毛利额保持快速增长，与公司收入规模大幅提升趋势相符。其中，电子信息功能材料、导热散热功能材料各年度合计毛利额占比分别为 88.47%、93.39%和 98.89%，是公司主营业务毛利的主要来源。

2、毛利率变动分析

报告期内，公司综合毛利率及主营业务毛利率具体情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	毛利率	变动百分点%	毛利率	变动百分点%	毛利率
电子信息功能材料	41.16%	5.52	35.64%	1.50	34.14%
导热散热功能材料	21.65%	3.31	18.34%	-0.30	18.64%
其他新兴功能材料	3.31%	-14.23	17.54%	-8.43	25.97%
主营业务毛利率	**34.32%**	**3.32**	**31.00%**	**0.27**	**30.73%**
综合毛利率	**34.04%**	**3.18**	**30.87%**	**0.31**	**30.55%**

注：变动百分点=该品类本期毛利率-上期毛利率，下同。

报告期内，公司综合毛利率分别为 30.55%、30.87%和 34.04%，呈现逐步上升趋势，主要来自于主营业务的业绩贡献。报告期内，公司主营业务毛利率持续提升，2024 年度较上年度增长 0.27 个百分点，2025 年度较上年度提升 3.32 个百分点，主要受益于 AI 等先进产业蓬勃发展，带动高端电子信息功能材料、导热散热功能材料销售占比不断提升，驱动产品结构持续向高端化发展，且部分产品毛利率不断提升等共同影响所致。报告期内，公司各类主要产品的毛利率及其收入占比对主营业务毛利率的影响情况如下：

项目	2025 年度较上年			2024 年度较上年		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	小计	毛利率变动影响	收入占比变动影响	小计
电子信息功能材料	4.07%	0.84%	4.91%	1.07%	0.79%	1.86%
导热散热功能材料	0.48%	-0.41%	0.07%	-0.04%	-0.04%	-0.09%
其他新兴功能材料	-1.66%	0.00%	-1.67%	-1.15%	-0.35%	-1.50%
主营业务	**3.32%**	**/**	**3.32%**	**0.27%**	**/**	**0.27%**

注：毛利率变动影响=（本期毛利率-上期毛利率）×上期收入占比，收入占比变动影响=（本期收入占比-上期收入占比）×本期毛利率，下同。

（1）电子信息功能材料

报告期内，公司电子信息功能材料按照细分产品分类的毛利率及其收入占比情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
高性能球形硅微粉	44.35%	72.89%	38.71%	66.32%	36.57%	51.96%
角形硅微粉	34.24%	23.11%	32.06%	29.09%	33.71%	41.55%
其他电子信息功能材料	23.02%	4.00%	13.82%	4.59%	17.48%	6.49%
合计	**41.16%**	**100.00%**	**35.64%**	**100.00%**	**34.14%**	**100.00%**

报告期内，公司电子信息功能材料各细分产品的毛利率及其收入占比对电子信息功能材料毛利率的影响情况如下：

项目	2025 年度较上年			2024 年度较上年		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	小计	毛利率变动影响	收入占比变动影响	小计
高性能球形硅微粉	3.74%	2.91%	6.65%	1.12%	5.56%	6.68%
角形硅微粉	0.63%	-2.05%	-1.41%	-0.68%	-3.99%	-4.68%
其他电子信息功能材料	0.42%	-0.14%	0.29%	-0.24%	-0.26%	-0.50%
电子信息功能材料	**5.52%**	/	**5.52%**	**1.50%**	/	**1.50%**

2024 年度，公司电子信息功能材料毛利率较上年度增长 1.50 个百分点，主要受益于 AI 等先进产业的快速兴起，带来对高性能球形硅微粉的显著采购需求，当期高性能球形硅微粉的销量增长幅度为 76.88%，销售收入占比由上年度的 51.96%提升至 66.32%，推动电子信息功能材料板块产品结构进一步优化，有效促进毛利率增长；另一方面，伴随高性能球形硅微粉销售规模迅速提升，促使公司对上游原材料的规模采购及议价能力增强，叠加原材料采购价格下降共同影响，带动高性能球形硅微粉毛利率提升 2.14 个百分点，共同驱动当期电子信息功能材料毛利率增长。

2025 年度，公司电子信息功能材料毛利率较上年度增长 5.52 个百分点，主要源于高性能球形硅微粉销售收入占比及其毛利率持续提升的共同贡献：伴随 AI、高速网络通信等先进产业的强劲发展势头，公司高性能球形硅微粉销量较上年度增长 53.99%，带动高性能球形硅微粉销售收入占比由上年度的 66.32%提升至 72.89%，促进公司产品结构进一步朝向高端化发展，同时，受益于下游需求大幅提升，规模效应逐步显现，叠加原材料成本有效管控，推动高性能球形硅微粉毛利率上升 5.64 个百分点，综合使得当期电子信息功能材料毛利率增长明显。

（2）导热散热功能材料

报告期内，公司导热散热功能材料按照细分产品分类的毛利率及其收入占比情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
高导热氮化物	38.73%	52.02%	32.41%	31.57%	31.21%	18.42%
导热氧化铝	1.18%	40.86%	11.03%	61.52%	13.73%	66.62%
其他导热散热功能材料	14.34%	7.12%	19.19%	6.91%	25.02%	14.96%
合计	**21.65%**	**100.00%**	**18.34%**	**100.00%**	**18.64%**	**100.00%**

报告期内，公司导热散热功能材料各细分产品的毛利率及其收入占比对导热散热功能材料毛利率的影响情况如下：

项目	2025 年度较上年			2024 年度较上年		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	小计	毛利率变动影响	收入占比变动影响	小计
高导热氮化物	1.99%	7.92%	9.92%	0.22%	4.26%	4.48%
导热氧化铝	-6.06%	-0.24%	-6.30%	-1.80%	-0.56%	-2.36%
其他导热散热功能材料	-0.33%	0.03%	-0.30%	-0.87%	-1.54%	-2.42%
导热散热功能材料	**3.31%**	**/**	**3.31%**	**-0.30%**	**/**	**-0.30%**

2024 年度，公司导热散热功能材料毛利率较上年度下降 0.30 个百分点，一方面，公司高导热氮化物产品渡过前期培育阶段开始放量，同时伴随 AI 等产业兴起带来广阔增量需求，公司高导热氮化物产品销量大幅提升 126.22%，推动公司导热散热功能材料产品结构有所优化，另一方面，公司部分导热性能相对较低的成熟产品，市场竞争日趋激烈，产品销售价格持续下滑，抵减了高端产品销售收入占比提升对毛利率的拉动效果，共同使得当期整体毛利率小幅下降 0.30 个百分点。

2025 年度，公司导热散热功能材料毛利率较上年度增长 3.31 个百分点，主要系高导热氮化物销售收入占比大幅提升及其毛利率有所增长共同影响所致：一方面，公司进一步深化高端化发展策略，将资源集中投向技术壁垒更高、附加值更高的高导热氮化物产品，凭借优良的导热性能，公司高导热氮化物在 AI 服务器散热模组，存储芯片及手机芯片封装、无人机等多个先进产业领域快速放量，

产品销量较上年度大幅增长 113.99%，推动公司导热散热功能材料产品结构显著优化；另一方面，公司有效加强供应链管理，优化产品制备成本、提升盈利空间，共同驱动当期导热散热功能材料毛利率增长。

（3）其他新兴功能材料

报告期内，公司其他公司新兴功能材料毛利率分别为 25.97%、17.54%和 3.31%。公司其他新兴功能材料主要为锂电池隔膜功能材料和涂料功能材料，该等产品销售收入在其他新兴功能材料板块的占比合计为 82.27%、83.18%和 80.72%。

报告期内，公司锂电池隔膜功能材料的毛利率分别为 29.63%、14.39%和 6.28%，呈下降趋势，主要系 2023 年至 2024 年期间，锂电池隔膜行业产能集中释放，阶段性出现供需失衡的局面，头部企业为巩固市场份额降价竞争，使得上游原材料锂电池隔膜功能材料销售价格承压，公司相应采用了竞争性定价策略；此外，随着技术路径的迭代，公司毛利率较高的受托加工收入占比逐步降低，综合导致产品毛利率下滑。

报告期内，公司涂料功能材料的毛利率分别为 23.80%、35.59%和 27.19%。2024 年度，公司涂料功能材料毛利率较上年度增长 11.79 个百分点，主要系当期涂料功能材料最为主要的细分产品销售量增长 15.94%，带动规模效应显现，驱动产品毛利率快速提升；2025 年度，公司涂料功能材料毛利率较上年度下降 8.41 个百分点，主要系终端应用领域市场景气度下行，行业竞争加剧，产品销量及售价均有所下滑所致。

3、与同行业毛利率比较情况

公司主要从事先进无机功能性粉体材料研发、生产和销售，主要产品包括电子信息功能材料、导热散热功能材料和其他新兴功能材料等，广泛应用于高等级高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用各类高端覆铜板，以及高导热胶等导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料、半导体制造与封装材料等多个领域。A 股上市公司中暂无与公司业务完全相似的企业，综合考虑主营业务内容和产品下游应用领域，公司选取材料行业中的联瑞新材、国瓷材料、雅克科技、壹石通、天马新材等五家企业作为同行业可比上市公司，具体情况如下：

公司名称	主营业务	主要产品	应用领域
联瑞新材	主要从事功能性先进粉体材料的研发、制造和销售	角形二氧化硅、球形二氧化硅、球形氧化铝等	主要应用于半导体封装材料（环氧塑封料），涵盖电子电路基板、导热材料等行业
国瓷材料	主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售	电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料等	产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷等领域
雅克科技	主营业务是电子材料业务、LNG 保温绝热板材相关业务和阻燃剂业务	电子材料、液化天然气（LNG）保温绝热板材、阻燃剂等	其中，电子材料产品涵盖半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统（LDS）等
壹石通	主营业务是先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售	无机功能粉体材料、聚合物材料等	其中，无机功能粉体材料主要应用在锂电池涂覆材料领域、电子通信功能填充材料等领域
天马新材	主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售	电子陶瓷用粉体材料、电子及光伏玻璃用粉体材料、高压电器用粉体材料等	主要应用于电子陶瓷、高压电器、电子及光伏玻璃、锂电池隔膜、研磨抛光、高导热材料和耐火材料等领域

注：同行业可比公司信息来源于其公开披露的招股说明书、募集说明书、年度报告等。

报告期内，公司与同行业可比公司毛利率对比分析情况如下：

公司名称	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联瑞新材	角形二氧化硅	20.41%	27.57%	32.75%
	球形二氧化硅	51.92%	49.12%	46.22%
	球形氧化铝	未披露	33.81%	33.10%
	综合毛利率	40.66%	40.38%	39.26%
国瓷材料	电子材料	34.49%	36.29%	37.58%
	综合毛利率	37.57%	39.67%	38.65%
雅克科技	电子材料	31.01%	32.21%	33.80%
	综合毛利率	30.96%	31.59%	31.33%
壹石通	无机功能粉体材料	19.07%	21.73%	24.93%
	综合毛利率	20.03%	22.68%	26.18%
天马新材	电子陶瓷用粉体材料	24.09%	26.75%	29.90%
	综合毛利率	17.74%	24.21%	26.23%
综合毛利率平均值		**29.39%**	**31.71%**	**32.33%**
锦艺新材	**电子信息功能材料**	41.16%	35.64%	34.14%
	导热散热功能材料	21.65%	18.34%	18.64%

公司名称	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	综合毛利率	34.04%	30.87%	30.55%

注：同行业可比公司信息来源于其公开披露的招股说明书、募集说明书、年度报告等。

报告期内，公司与同行业可比公司毛利率存在一定差异，主要系公司产品结构、应用领域、规模体量与可比公司并不完全相同，因此在毛利率方面不完全可比。报告期内，公司电子信息功能材料毛利率位于同行业较高水平，主要系公司深耕高端覆铜板领域，已成长为电子信息领域无机功能性粉体行业领先企业，公司产品主要应用于高等级高速覆铜板，高阶 HDI 板、IC 载板、类载板（SLP）用各类高端覆铜板，终端应用主要为 AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块、低轨卫星、半导体制造与封装等高阶应用场景，下游发展前景广阔且产品附加值加高。同时，公司依托在电子信息领域积淀的优势基底，将同源技术逐步横向拓展至导热散热等其他业务领域，报告期前期，公司整体业务体量相对较小，处于快速成长阶段，部分产品尚处于培育阶段，高附加值产品毛利率水平暂未充分体现，使得公司综合毛利率在同行业公司中处于中间水平，略低于行业平均值。随着 AI 等先进产业兴起，带来对高端无机非金属粉体材料的显著应用需求，依托在高端市场领域构建的深厚优势基底，公司以高性能球形硅微粉为代表的高端产品销售规模大幅增长，驱动公司产品结构持续优化，2025 年度，公司毛利率提升至 34.04%，优于同行业平均水平 29.39%。

（五）期间费用分析

报告期内，公司各项期间费用金额及费用率的情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	2,381.39	2.30	2,032.72	2.79	1,762.05	3.39
管理费用	6,888.87	6.65	4,626.04	6.35	4,102.16	7.90
研发费用	4,210.85	4.07	3,420.40	4.69	2,793.28	5.38
财务费用	838.93	0.81	442.17	0.61	227.88	0.44
合计	**14,320.04**	**13.82**	**10,521.34**	**14.44**	**8,885.36**	**17.10**

报告期内，公司期间费用分别为 8,885.36 万元、10,521.34 万元和 14,320.04 万元，期间费用率分别 17.10%、14.44%和 13.82%。报告期内期间费用率整体降

低，主要系随着公司收入规模的扩大，规模效应逐步显现所致。

1、销售费用分析

（1）销售费用变动分析

报告期内，公司销售费用具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,526.55	64.10	1,268.03	62.38	1,156.14	65.61
办公费用	259.19	10.88	246.63	12.13	224.27	12.73
业务招待费	402.79	16.91	240.07	11.81	172.77	9.81
差旅费用	121.57	5.10	96.48	4.75	62.13	3.53
股份支付	-45.38	-1.91	81.71	4.02	64.35	3.65
汽车费用	73.75	3.10	78.93	3.88	80.54	4.57
折旧与摊销	30.07	1.26	2.07	0.10	1.54	0.09
其他费用	12.85	0.54	18.79	0.92	0.30	0.02
合计	**2,381.39**	**100.00**	**2,032.72**	**100.00**	**1,762.05**	**100.00**

报告期内，公司销售费用分别为 1,762.05 万元、2,032.72 万元和 2,381.39 万元，占当期营业收入的比重分别为 3.39%、2.79%和 2.30%。报告期内随着公司营业收入规模持续快速增长，在规模效应影响下，销售费用率逐年下降。

公司销售费用主要包括职工薪酬、办公费和业务招待费，报告期各年上述费用合计占比分别为 88.15% 、86.32%和 91.90%。

1）职工薪酬

报告期内，公司销售人员薪酬分别为 1,156.14 万元、1,268.03 万元和 1,526.55 万元，呈逐年上升趋势，主要原因为报告期内公司业务规模增长速度较快，市场拓展效果显著，销售人员数量相应增加。

2）办公费用

报告期内，公司销售部门产生的日常办公费用金额分别为 224.27 万元、246.63 万元和 259.19 万元，各年度费用发生额相对稳定，波动较小。

3）业务招待费

报告期内，计入公司销售费用的业务招待费金额分别为 172.77 万元、240.07 万元和 402.79 万元，主要系公司为业务拓展和维护客户关系发生的招待费用支出。报告期内随着公司业务规模快速增长，业务招待需求增加，各年度业务招待费规模相应增长。

（2）销售费用率与同行业公司对比分析

报告期各期，公司销售费用率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联瑞新材	1.31%	1.14%	1.50%
壹石通	2.12%	2.53%	3.46%
国瓷材料	5.42%	5.66%	4.84%
雅克科技	3.79%	4.23%	3.25%
天马新材	1.18%	1.04%	1.21%
行业均值	**2.76%**	**2.92%**	**2.85%**
锦艺新材	**2.30%**	**2.79%**	**3.39%**

注：同行业可比公司信息来源于其公开披露的招股说明书、募集说明书、年度报告等。

报告期内，发行人各期销售费用率分别为 3.39%、2.79%和 2.30%，总体位于同行业可比公司销售费用率分布区间内。2023 年，公司营业收入规模相对偏低，销售费用率高于行业平均水平；随着公司报告期内销售额快速增长，受规模效应影响，2024 年和 2025 年公司销售费用率逐年下降，与同行业平均销售费用率相对接近。

2、管理费用分析

（1）管理费用变动分析

报告期内，公司管理费用具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,661.00	53.14	2,687.11	58.09	2,426.84	59.16
办公费用	603.04	8.75	438.33	9.48	424.78	10.36

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
中介费用	876.08	12.72	432.20	9.34	300.89	7.33
折旧与摊销	655.75	9.52	324.15	7.01	328.78	8.01
业务招待费	302.50	4.39	168.72	3.65	126.23	3.08
租赁费用	260.78	3.79	257.06	5.56	189.63	4.62
差旅费用	72.17	1.05	58.27	1.26	34.66	0.84
股份支付	-22.53	-0.33	64.02	1.38	6.10	0.15
其他费用	480.09	6.97	196.18	4.24	264.25	6.44
合计	**6,888.87**	**100.00**	**4,626.04**	**100.00**	**4,102.16**	**100.00**

报告期内，公司管理费用分别为 4,102.16 万元、4,626.04 万元和 6,888.87 万元，占各期营业收入的比重分别为 7.90%、6.35%和 6.65%。2023 年由于公司营业收入规模相对偏低，管理费用率高于其他各年度，随着报告期内收入快速增长，2024 年和 2025 年公司管理费用率明显下降。

公司管理费用主要由管理人员薪酬、折旧与摊销、办公费用和中介服务费构成，报告期各年上述费用合计占比分别为 84.86%、83.91%和 84.13%。

1）职工薪酬

报告期各期，公司管理人员职工薪酬分别为 2,426.84 万元、2,687.11 万元和 3,661.00 万元。报告期内管理人员的职工薪酬逐年增长，主要为随着公司经营规模扩大、盈利能力提升，管理人员数量及平均薪酬水平整体上涨所致。

2）折旧与摊销

报告期各期，公司计入管理费用的折旧与摊销金额分别为 328.78 万元、324.15 万元和 655.75 万元，其中 2025 年度较上年增幅较大，主要系部分产线建设项目转固后因设备调试等原因尚未正式投产，其厂房等资产折旧摊销计入管理费用，导致管理费用有所增加。

3）办公费

报告期各期，公司办公费分别为 424.78 万元、438.33 万元和 603.04 万元，2025 年度计入管理费用的办公费增幅较大，主要系公司业务规模增长，办公用品、员工培训等办公支出增加所致。

4）中介服务费

报告期各期，公司中介服务费分别为 300.89 万元、432.20 万元和 876.08 万元，主要为审计、律师和财务顾问等中介机构相关费用支出，2025 年中介服务费较高主要系前次申报终止后，原计入其他流动资产的中介机构费用一次性计入当期损益所致。

（2）管理费用率与同行业公司对比分析

报告期各期，公司管理费用率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联瑞新材	5.19%	5.93%	6.92%
壹石通	12.89%	12.63%	12.71%
国瓷材料	6.81%	7.66%	6.58%
雅克科技	6.39%	7.31%	8.64%
天马新材	3.67%	4.56%	4.90%
行业均值	**6.99%**	**7.62%**	**7.95%**
锦艺新材	**6.65%**	**6.35%**	**7.90%**

注：同行业可比公司信息来源于其公开披露的招股说明书、募集说明书、年度报告等。

报告期各期，发行人管理费用率处于同行业可比公司合理区间范围内，与同行业可比公司之间不存在显著差异。

3、研发费用分析

（1）研发投入的确认依据、核算方法

报告期内，公司研发投入均采取费用化的会计处理，不存在研发支出资本化的情况。公司研发支出的归集范围包括人工费用、材料费用、折旧摊销等其他费用。公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

人工费用方面，主要根据研发人员在 RDM 研发管理系统中填写的工作日志等，按工时比例分配至各研发项目；材料费用方面，根据领料环节登记的项目信息在不同研发项目中进行归集；折旧摊销方面，按研发专用的固定资产、无形资产的折旧摊销额计入研发费用中，房屋建筑物等共用资产根据占用比例分摊计入研发费用。

（2）研发费用变动分析

报告期内，公司研发费用具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,606.45	61.90	2,114.01	61.81	1,701.95	60.93
材料投入	641.62	15.24	437.85	12.80	289.14	10.35
折旧与摊销	290.44	6.90	262.57	7.68	218.66	7.83
股份支付	-66.17	-1.57	110.36	3.23	110.91	3.97
试验检测费	47.15	1.12	33.35	0.98	29.60	1.06
水电气费	124.05	2.95	74.76	2.19	97.14	3.48
其他费用	567.31	13.47	387.51	11.33	345.88	12.38
合计	**4,210.85**	**100.00**	**3,420.40**	**100.00**	**2,793.28**	**100.00**

报告期内，公司研发费用分别为 2,793.28 万元、3,420.40 万元和 4,210.85 万元，占各期营业收入的比重分别为 5.38%、4.69%、4.07%，主要由研发人员薪酬、材料投入、折旧与摊销等费用构成。2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司累计研发投入研发费用合计 10,424.53 万元，最近三年研发投入复合增长率为 22.78%。

1）职工薪酬

报告期各期，公司研发费用中的职工薪酬分别为 1,701.95 万元、2,114.01 万元和 2,606.45 万元，占当期研发费用的比例分别为 60.93%、61.81%和 61.90%，是研发费用的主要构成部分。报告期内，计入研发费用的职工薪酬逐年增长，主要系公司立足于高端化发展定位，为匹配 AI 等下游先进产业的高阶性能要求和快速迭代需求，公司持续提高研发投入强度，加强研发队伍建设，并优化激励机制所致。

2）材料投入

报告期各期，公司研发费用中的材料投入分别为 289.14 万元、437.85 万元和 641.62 万元，占当期研发费用的比例分别为 10.35%、12.80%和 15.24%。报告期内，计入研发费用的材料投入快速增长，主要系随着公司研发强度的提升而相应增长，同时，公司产品结构持续向高端化发展，研发项目领用的物料价值较高，

共同使得研发材料投入规模快速增长。

3）折旧摊销费用

报告期各期，公司研发费用中的折旧摊销费用分别为 218.66 万元、262.57 万元和 290.44 万元，占当期研发费用的比例分别为 7.83%、7.68%和 6.90%。报告期内，公司计入研发的折旧摊销费用逐年增长，主要系随着公司研发力度的提升，根据研发需求加大研发设备投入，对应的折旧费用有所增长。

4）股份支付费用

报告期各期，公司研发费用中的股份支付费用分别为 110.91 万元、110.36 万元和-66.17 万元，占研发费用的比例分别为 3.97%、3.23%和-1.57%。2025 年度，公司研发费用中的股份支付金额为负数，主要系股票期权等待期延长所致。股份支付的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（二）发行人制定的拟在上市后实施的期权计划”。

（3）研发费用率与同行业公司对比分析

报告期各期，公司研发费用率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联瑞新材	5.75%	6.29%	6.66%
国瓷材料	6.93%	7.25%	6.78%
雅克科技	4.00%	3.63%	4.02%
壹石通	10.73%	9.57%	12.13%
天马新材	4.18%	4.32%	4.73%
行业均值	**6.32%**	**6.21%**	**6.86%**
锦艺新材	**4.07%**	**4.69%**	**5.38%**

注：上述数据均来自同行业可比公司招股说明书、年报或公开发行文件。

报告期内，公司研发费用率分别为 5.38%、4.69%和 4.07%，高于雅克科技、天马新材，低于同行业可比公司平均值，位于同行业中间水平。报告期内，公司研发费用规模呈现快速增长趋势，研发费用率持续降低，主要系公司依托在高端无机功能粉体材料市场构建的领先优势，积极把握 AI 等先进产业发展机遇，迎来高速增长，报告期期内，公司营业收入复合增长率达 41.21%，处于同行业可

比公司中的最高水平，受营业收入增速明显高于研发费用增速影响，公司研发费用率相对较低。此外，2023 年度，可比公司壹石通当期受下游锂电池企业去库存、需求放缓等影响，营业收入下降约 22%，但同期研发费用增长约 41%，拉高行业研发费用率平均水平，剔除壹石通研发费用率影响后，公司研发费用率与同行业可比公司平均水平相近。整体来看，公司研发费用率处于合理区间范围内，与同行业可比公司相比不存在重大偏离。

（4）主要研发项目情况

报告期内，公司累计投入超过 200 万元的主要研发项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截至报告期末实施进度	项目预算	2025 年度	2024 年度	2023 年度	报告期合计
1	电子浆料制备及开发	进行中	1,094.00	382.74	312.12	320.94	1,015.80
2	锂电池负极材料粉体开发	进行中	800.00	103.17	150.91	273.34	527.41
3	MLCC 用纳米钛酸钡粉体开发-固相（200-600nm）项目	部分量产	500.00	170.16	214.92	109.42	494.50
4	超低介电常数填料开发-中空二氧化硅项目	进行中	456.40	119.29	176.48	128.97	424.74
5	隔膜涂覆纳米粉体开发-勃姆石项目	进行中	400.00	14.52	133.24	217.88	365.65
6	高导热氮化铝粉体开发-氮化铝项目	部分量产	369.32	22.85	89.46	141.78	254.09
7	新型有机球硅研发项目	进行中	280.00	111.07	101.97	32.33	245.38
8	超分散球形硅微粉及浆料开发	进行中	350.00	40.24	57.51	107.75	205.50
合计				**964.05**	**1,236.61**	**1,332.41**	**3,533.06**

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	805.15	605.78	294.78
其中：租赁负债利息支出	65.33	35.63	28.74
减：利息收入	112.02	48.76	10.93

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
汇兑损益	128.81	-132.05	-68.79
银行手续费及其他	16.98	17.21	12.82
合计	**838.93**	**442.17**	**227.88**

报告期内，公司财务费用分别为 227.88 万元、442.17 万元和 838.93 万元，占各期营业收入比重分别为 0.44%、0.61%和 0.81%。公司报告期内财务费用主要为利息支出、利息收入和汇兑损益等构成。

报告期内公司财务费用呈现逐年上升趋势，主要原因为随着公司生产经营规模不断扩大、产能建设投入增加，资金需求量逐步增加，报告期内公司扩大银行借款规模，因此利息支出各年度逐步增长。报告期内，汇兑损益主要系公司与部分客户采用外币结算，汇率变动产生相关汇兑损益。

（六）利润表其他项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	423.81	312.58	197.40
增值税加计抵减金额	417.56	287.26	236.56
个税扣缴税款手续费	0.34	0.09	0.01
合计	**841.72**	**599.93**	**433.97**

报告期内，公司其他收益金额分别为 433.97 万元、599.93 万元和 841.72 万元，主要由政府补助以及增值税加计抵减等构成。

（1）与资产相关的政府补助

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
招拍挂土地基础设施补贴返还款	7.72	7.72	7.72
工业企业有效投入奖补资金	14.02	7.43	-
先进材料战略性新兴产业融合集群发展专项资金	21.99	-	-
生产设备智能运维系统项目专项资金	2.20	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
租赁高新技术产业园厂房装修补贴	29.17	-	-
国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目	3.56		
合计	**78.66**	**15.15**	**7.72**

（2）与收益相关的政府补助

1）2025 年度

单位：万元

项目	金额
租金奖励补助	250.00
苏州市“科创指数惠”补助	50.00
扩岗稳岗补贴	28.85
其他零星补助	16.30
合计	**345.15**

2）2024 年度

单位：万元

项目	金额
财政局上市挂牌补贴	150.00
制造业高质量发展项目奖补	38.00
江苏省财政厅财政支付局拨付上市奖金	30.00
重点人群税收减免	26.65
常熟市科技创新创业领军人才计划项目资金	12.00
高新技术企业补助奖励	12.00
扩岗稳岗补贴	11.96
申报绿色工厂资金奖励	10.00
其他零星补助	6.82
合计	**297.43**

3）2023 年度

单位：万元

项目	金额
2023 年企业利用资本市场实现高质量发展苏州市级财政奖补资金	60.00
扩岗稳岗补贴	34.30

项目	金额
重点人群税收减免	22.77
独角兽培育企业研发后补助经费	20.00
省专精特新产品奖励	20.00
知识产权工作实绩奖励	20.00
其他零星补助	12.62
合计	**189.69**

2、投资收益

报告期内，公司投资收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
权益法核算的长期股权投资收益	79.23	103.76	233.13
外汇衍生产品到期产生的投资收益	6.30	-8.12	12.32
理财产品取得的投资收益	9.01	27.81	40.75
满足终止确认条件的票据贴现收益	-15.09	-10.33	-
合计	**79.45**	**113.12**	**286.19**

报告期内，公司的投资收益分别为 286.19 万元、113.12 万元和 79.45 万元，对公司经营成果及盈利能力影响较小，其中权益法核算的长期股权投资收益为对合营公司锦艺阿泰欧权益法核算的长期股权投资损益，详见本招股说明书“第六节/十一/（三）/1、长期股权投资”相关内容。

3、公允价值变动收益

报告期内，公司的公允价值变动收益系 2024 年度、2025 年度外汇衍生金融工具产生的公允价值变动收益 0.17 万元和 41.32 万元。衍生金融工具系公司为规避汇率风险而购买的尚未到期交割的外汇衍生产品，详见本招股说明书“第六节/十一/（二）/2、交易性金融资产”和“第六节/十二/（一）/2/（2）交易性金融负债”相关内容。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	-	10.08	29.62
应收账款坏账损失	-24.98	-55.85	-75.83
其他应收款坏账损失	-1.12	4.28	1.13
合计	**-26.10**	**-41.48**	**-45.08**

报告期内，公司信用减值损失分别为-45.08 万元、-41.48 万元和-26.10 万元，金额较小，主要系计提应收票据、应收账款及其他应收款的坏账损失。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-1,901.34	-1,163.59	-68.48
固定资产减值损失	-	-733.48	-
合计	**-1,901.34**	**-1,897.08**	**-68.48**

报告期各期，公司资产减值损失分别为-68.48 万元、-1,897.08 万元和-1,901.34 万元，存货跌价损失、固定资产减值损失计提具体情况详见本招股说明书“第六节/十一/（二）/7/（2）存货跌价准备”和“第六节/十一/（三）/2/（2）固定资产折旧及减值情况分析”相关内容。

6、资产处置收益

报告期各期，公司资产处置收益分别为-28.08 万元、-48.99 万元和-5.09 万元，金额较小，系处置固定资产的收益或损失。

7、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入分别为 5.15 万元、2.80 万元和 6.70 万元，金额较小，主要为废品收入。

8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠、临时工受伤补偿等，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	27.56	25.77	9.45
捐赠支出	-	5.00	-
罚款及滞纳金支出	2.22	0.30	16.67
违约及赔偿款支出	120.00	-	32.01
其他	0.36	2.46	2.84
合计	**150.15**	**33.53**	**60.97**

报告期各期，公司营业外支出分别为 60.97 万元、33.53 万元和 150.15 万元。2023 年赔偿支出主要系公司因第三方物流公司卸货意外事件承担赔偿责任所致，该等意外事项不涉及发行人安全生产问题，公司亦未因安全生产受到相关部门处罚，不存在安全生产问题造成的重大诉讼或纠纷，未受到相关部门对其安全生产的调查。2025 年因公司与供应商就安装工程实施方案未达成一致，经友好协商解除中标并终止合作，因而产生违约赔偿款支出。

（七）纳税情况

报告期内，公司主要税种的缴纳情况如下：

1、增值税及所得税

单位：万元

税种	期间	期初未交	本期应交	本期退税	本期已交	期末未交
增值税	2025 年度	-696.07	1,141.01	147.33	3,442.03	-2,849.75
	2024 年度	-52.57	1,277.86	-	1,921.36	-696.07
	2023 年度	-184.70	812.24	365.12	1,045.23	-52.57
企业所得税	2025 年度	532.01	2,751.64	38.01	2,854.78	466.88
	2024 年度	338.84	1,552.17	47.30	1,406.31	532.01
	2023 年度	-307.81	492.13	641.56	487.04	338.84

注：预缴企业所得税、期末留抵进项税额及待认证进项税额等已进行重分类调整。

报告期内，公司遵守国家及地方的税收法律、法规，依法缴纳各种税金，执行的税种、税率均符合相关税收法律、法规的规定。

公司税收优惠情况详见本招股说明书本节之“七、主要税种、税率及税收优惠情况”。

2、税金及附加

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	334.38	215.29	89.32
教育费附加	143.43	93.73	39.71
地方教育附加	95.62	61.25	30.93
房产税	191.48	142.69	74.58
城镇土地使用税	52.75	52.75	52.75
印花税	72.29	36.17	37.35
环境保护税	17.51	9.58	0.39
合计	**907.45**	**611.45**	**325.02**

报告期各期，公司的税金及附加金额分别为 325.02 万元、611.45 万元和 907.45 万元，主要包括城市维护建设税、教育费附加、房产税、印花税等。

3、企业所得税费用与会计利润的关系

（1）所得税费用的构成

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	2,751.64	1,552.17	492.13
递延所得税费用	-345.14	-437.93	88.97
合计	**2,406.50**	**1,114.24**	**581.10**

（2）会计利润与所得税费用调整过程

报告期内，公司所得税费用与会计利润的关系如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	18,923.67	10,050.62	7,185.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,838.55	1,507.59	1,077.79
子公司适用不同税率的影响	-195.23	-84.75	-101.57
调整以前期间所得税的影响	-	8.50	-8.94

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非应税收入的影响	-11.17	-15.56	-25.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41.59	24.99	19.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-47.63	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	305.16	195.95	2.58
研发费用加计扣除的影响	-568.84	-473.05	-383.53
残疾人工资加计扣除	-3.57	-1.80	-
所得税费用	**2,406.50**	**1,114.24**	**581.10**

报告期内，公司未发生因税收政策重大变化而对公司生产经营造成重大影响的情况。

十一、资产质量分析

（一）资产总体构成及变化

报告期各期末，公司资产总体构成及变化情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	93,399.07	48.81	65,951.82	46.36	50,928.83	47.38
非流动资产	97,966.08	51.19	76,305.85	53.64	56,563.32	52.62
合计	**191,365.14**	**100.00**	**142,257.67**	**100.00**	**107,492.15**	**100.00**

报告期各期末，公司资产总额分别为 107,492.15 万元、142,257.67 万元和 191,365.14 万元。随着公司报告期内经营规模的快速扩大、产能建设投入增加，公司资产总额呈现显著增长的态势。

报告期各期末，流动资产占期末资产总额的比例分别为 47.38%、46.36%和 48.81%；非流动资产占期末资产总额的比例分别为 52.62%、53.64%和 51.19%，公司各期末总体资产结构相对稳定。

（二）流动资产分析

报告期内，公司流动资产的主要构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	24,627.63	26.37	9,127.55	13.84	5,343.88	10.49
交易性金融资产	40.02	0.04	9.18	0.01	-	-
应收票据	3,648.07	3.91	3,079.64	4.67	3,042.24	5.97
应收账款	40,986.80	43.88	29,702.63	45.04	19,959.33	39.19
应收款项融资	1,183.01	1.27	1,867.85	2.83	4,193.57	8.23
预付款项	917.82	0.98	1,639.13	2.49	876.80	1.72
其他应收款	303.27	0.32	281.97	0.43	340.85	0.67
存货	18,147.78	19.43	18,679.26	28.32	16,751.05	32.89
其他流动资产	3,544.67	3.80	1,564.63	2.37	421.11	0.83
合计	**93,399.07**	**100.00**	**65,951.82**	**100.00**	**50,928.83**	**100.00**

报告期各期末，公司流动资产账面价值分别为 50,928.83 万元、65,951.82 万元和 93,399.07 万元，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货、其他流动资产等。报告期各期末公司流动资产规模呈现明显上涨趋势，主要原因为报告期内随着公司业务规模扩大、销售收入持续快速增长，货币资金、应收账款等流动资产同步快速增长。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	24,627.63	100.00	9,113.55	99.85	5,343.88	100.00
数字货币-人民币	-	-	14.00	0.15	-	-
合计	**24,627.63**	**100.00**	**9,127.55**	**100.00**	**5,343.88**	**100.00**

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 5,343.88 万元、9,127.55 万元和 24,627.63 万元，占流动资产的比例分别为 10.49%、13.84%和 26.37%，主要由银行存款构成。由于报告期内公司营业收入、经营规模持续快速增长，经营活动现金净流量大幅提升，报告期各期末公司货币资金余额上升趋势显著。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金中的受限资金为 0.51 万元，金额较

小，主要为 ETC 保证金、政府补助监管账户受限资金。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司的交易性金融资产余额分别为 0 万元、9.18 万元和 40.02 万元，在流动资产中占比较小，主要系公司为规避汇率风险而购买的尚未到期交割的外汇衍生产品。

3、应收票据及应收款项融资

（1）应收票据及应收款项融资基本情况

报告期内各期末，公司应收票据及应收款项融资的具体情况如下：

单位：万元

项目	类别	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收票据	银行承兑汇票	3,648.07	3,079.57	2,985.42
	商业承兑汇票	-	0.07	66.90
	账面余额小计	**3,648.07**	**3,079.64**	**3,052.32**
	减：坏账准备	-	-	10.08
	账面价值小计	**3,648.07**	**3,079.64**	**3,042.24**
应收款项融资	银行承兑汇票	1,183.01	1,867.85	4,193.57
合计		**4,831.08**	**4,947.48**	**7,235.80**

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资账面价值合计 7,235.80 万元、4,947.48 万元和 4,831.08 万元，占流动资产比例分别为 14.20%、7.50%和 5.17%。报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资以银行承兑汇票为主，银行承兑汇票承兑具有充分保障，到期不获支付的可能性较低。截至本招股说明书签署日，公司未发生银行承兑汇票到期无法兑付的情况。

报告期内，公司为提高资金使用效率，将部分银行承兑汇票进行贴现或背书，管理上述应收票据的业务模式满足既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此公司将 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行和交通银行）和 9 家上市股份制商业银行（招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行和浙商银行）（以下简称“6+9 银行”）的银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款

项融资。

（2）公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况

对于“6+9 银行”的未到期票据背书或贴现，信用风险和延期付款风险较小，并且票据相关的利率风险已转移，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认，其余银行承兑汇票或商业承兑汇票背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的不终止确认。

报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据和应收款项融资均为银行承兑汇票，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	8,385.43	3,262.33	5,740.33	2,385.53	3,541.34	2,299.71
合计	**8,385.43**	**3,262.33**	**5,740.33**	**2,385.53**	**3,541.34**	**2,299.71**

4、应收账款

（1）应收账款变动情况分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 19,959.33 万元、29,702.63 万元和 40,986.80 万元，占流动资产比例分别为 39.19%、45.04%和 43.88%。公司报告期内销售收入快速增长，因此各期末应收账款余额相应呈现增长趋势。报告期各期末，公司应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 38.79%、41.11%和 39.83%。

报告期内，应收账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收账款余额	41,260.27	29,951.11	20,151.97
坏账准备	273.47	248.49	192.64
应收账款账面价值	**40,986.80**	**29,702.63**	**19,959.33**
营业收入	103,586.02	72,857.24	51,950.91
应收账款余额/营业收入	39.83%	41.11%	38.79%
应收账款余额增长率	37.76%	48.63%	17.38%

（2）应收账款质量分析

报告期各期末，公司应收账款账龄构成及坏账计提情况如下：

单位：万元、%

账龄	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
6 个月以内	40,622.40	98.45	29,314.61	97.87	19,333.86	95.94
6 个月-9 个月	428.94	1.04	428.03	1.43	713.89	3.54
9 个月-1 年	185.19	0.45	147.47	0.49	45.27	0.22
1 年-1 年半	23.74	0.06	19.97	0.07	15.46	0.08
1 年半以上	-	-	41.03	0.14	43.49	0.22
小计	**41,260.27**	**100.00**	**29,951.11**	**100.00**	**20,151.97**	**100.00**
减：坏账准备	273.47	/	248.49	/	192.64	/
合计	**40,986.80**	**/**	**29,702.63**	**/**	**19,959.33**	**/**

公司应收账款账龄起算时点为账面确认应收账款日，报告期各期末，账龄在 6 个月以内的应收账款余额占比分别为 95.94%、97.87%和 98.45%，是应收账款的主要组成部分。公司下游主要客户为覆铜板、导热等领域知名头部客户，信用状况良好，行业地位稳固，且与公司保持了长期稳定的良好合作关系。报告期内公司对主要客户的信用政策相对稳定，应收账款的账龄短；公司销售回款方式主要为银行转账和票据结算，各期及期后回款情况良好。

报告期各期末，公司应收账款均采用按组合计提的方式计提坏账准备。公司报告期内严格按照坏账计提政策足额计提坏账准备，坏账准备计提充分。

（3）公司应收账款坏账政策与同行业可比公司对比情况

报告期内，同行业可比公司应收账款坏账计提比例情况如下：

账龄	联瑞新材	壹石通	国瓷材料	雅克科技	天马新材	锦艺新材
6 个月以内	0.24%	5.00%	5.00%	0.00%	5.00%	0.50%
6 个月-9 个月				5.00%		5.00%
9 个月-1 年						20.00%
1 年-1 年半	100.00%	10.00%	10.00%	20.00%	10.00%	50.00%
1 年半-2 年						100.00%
2-3 年	100.00%	40.00%	50.00%	50.00%	20.00%	100.00%

账龄	联瑞新材	壹石通	国瓷材料	雅克科技	天马新材	锦艺新材
3 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50%、80%、100%	100.00%

注：上表同行业可比公司数据来源于其公开披露的年度报告等；其中天马新材 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的应收账款坏账计提比例分别为 50%、80%、100%。

公司应收账款的坏账计提政策与同行业公司相比不存在重大差异，且坏账计提政策较为谨慎。

（4）应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况具体如下：

单位：万元

项目	客户名称	余额	占比	坏账准备
2025-12-31	台光电子	24,884.91	60.31%	124.42
	南亚新材	1,411.70	3.42%	7.06
	台燿科技	1,196.56	2.90%	5.98
	锦艺阿泰欧	1,130.29	2.74%	5.65
	生益科技	911.64	2.21%	4.56
	合计	**29,535.09**	**71.58%**	**147.68**
2024-12-31	台光电子	17,471.52	58.33%	87.36
	锦艺阿泰欧	1,872.52	6.25%	9.36
	台燿科技	867.70	2.90%	4.34
	南亚新材	798.44	2.67%	3.99
	生益科技	797.25	2.66%	3.99
	合计	**21,807.43**	**72.81%**	**109.04**
2023-12-31	台光电子	8,191.79	40.65%	40.96
	锦艺阿泰欧	1,802.67	8.95%	9.01
	生益科技	952.14	4.72%	4.76
	南亚新材	903.52	4.48%	4.52
	比亚迪供应链	767.58	3.81%	24.91
	合计	**12,617.71**	**62.61%**	**84.16**

报告期各期末，应收账款前五名客户余额合计占比分别为 62.61%、72.81%和 71.58%。上述应收账款客户均为行业知名客户或公司长期稳定合作伙伴，信用状况良好，应收账款坏账风险较低。

报告期各期末，除锦艺阿泰欧系公司合营企业外，公司应收账款前五名客户

中无持股 5%以上股东及其他关联单位。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 876.80 万元、1,639.13 万元和 917.82 万元，占各期末流动资产的比重分别为 1.72%、2.49%和 0.98%，主要为预付原材料货款、水电燃气费等。

公司预付款项账龄主要集中在 1 年以内，报告期各期末具体情况如下：

单位：万元、%

账龄	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	877.05	95.56	1,610.27	98.24	875.65	99.87
1-2 年	37.19	4.05	28.86	1.76	1.15	0.13
2-3 年	3.58	0.39	-	-	-	-
合计	**917.82**	**100.00**	**1,639.13**	**100.00**	**876.80**	**100.00**

截至 2025 年末，公司预付款项余额中排名前五的供应商情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	账面余额	比例
杭摩新材料集团股份有限公司	69.00	7.52%
常熟滨江热力有限公司	67.76	7.38%
连云港航阔新材料有限公司	61.47	6.70%
连云港中云铝业新材料有限公司	57.13	6.22%
中铝新材料有限公司	47.02	5.12%
合计	**302.38**	**32.94%**

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款按款项性质分类的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
押金保证金	303.99	295.33	331.63
其他经营性资金	15.24	1.48	28.34
账面余额小计	**319.23**	**296.81**	**359.97**
减：坏账准备	15.96	14.84	19.12

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
账面价值合计	**303.27**	**281.97**	**340.85**

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 340.85 万元、281.97 万元和 303.27 万元，占流动资产的比例分别为 0.67%、0.43%和 0.32%，金额及占比较小，主要为押金保证金。

报告期各期末，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：万元、%

账龄	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	32.05	10.04	15.91	5.36	9.46	2.63
1-2 年	9.86	3.09	4.13	1.39	296.11	82.26
2-3 年	3.65	1.14	224.68	75.70	40.84	11.35
3 年以上	273.66	85.72	52.09	17.55	13.56	3.77
合计	**319.23**	**100.00**	**296.81**	**100.00**	**359.97**	**100.00**

2025 年末，公司 3 年以上账龄的其他应收款主要为向天然气公司支付的押金以及向出租方支付的租赁保证金等。截至报告期末上述押金保证金仍在履约期限内。

7、存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,751.05 万元、18,679.26 万元和 18,147.78 万元，占各期末流动资产的比例分别为 32.89%、28.32%和 19.43%。

（1）存货构成

报告期各期末，公司存货余额明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	2,460.40	12.37	3,371.85	16.77	3,429.13	19.71
库存商品	4,236.77	21.31	6,533.71	32.50	5,337.72	30.69
半成品	9,677.92	48.67	7,785.70	38.73	6,721.17	38.64
发出商品	547.20	2.75	170.55	0.85	212.98	1.22
委托加工物资	1,283.26	6.45	684.43	3.40	520.99	3.00

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
周转材料	1,680.55	8.45	1,556.00	7.74	1,171.54	6.74
合计	**19,886.10**	**100.00**	**20,102.25**	**100.00**	**17,393.52**	**100.00**

公司存货主要由原材料、库存商品、半成品、委托加工物资和周转材料构成，其中原材料、库存商品和半成品占比较高，各期末余额合计占比分别为 89.04%、88.01%和 82.34 %。

公司生产所需主要原材料包括有机硅球、氧化铝原料、火焰法球硅原料等。公司通常根据客户订单情况、生产计划、采购周期及供应商供货能力等，合理安排原料采购及库存管理。报告期内，随着公司产能提升并优化备料管理，原材料周转效率提升，各期末原材料余额及占比呈现下降趋势。

公司采用“订单+备货”结合的方式安排生产计划，报告期内，公司下游客户订单量增加、产销规模快速增长，公司综合考虑销售订单、客户需求预测、当前库存数量等情况，提前进行备产备货，以满足产品交付需求，因此各期末半成品及库存商品余额占比较高。

（2）存货跌价准备

报告期各期末，公司计提的存货跌价准备情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例
原材料	274.01	11.14	310.18	9.20	199.51	5.82
库存商品	593.67	14.64	528.97	8.10	276.51	5.18
半成品	864.94	8.95	576.07	7.40	166.46	2.48
发出商品	5.70	0.77	7.77	4.56	-	-
合计	**1,738.32**	**8.74**	**1,422.99**	**7.08**	**642.47**	**3.69**

2024 年起，公司存货跌价准备计提金额有所增长，一方面系随着公司产销规模迅速扩大，基于谨慎性原则，公司结合存货库龄和去化情况足额计提跌价准备；另一方面系对勃姆石等非主营业务重点方向、市场前景存在不确定性的产品计提了跌价准备。存货跌价准备的计提方法和可变现净值的确定依据详见本招股说明书“第六节/六/（二）/5/（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法”。

报告期内，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提的具体情况如下表所示：

公司	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
联瑞新材	0.36%	0.17%	0.11%
国瓷材料	12.16%	6.31%	5.25%
雅克科技	2.65%	1.21%	1.05%
壹石通	4.40%	2.48%	2.31%
天马新材	0.76%	0.61%	1.87%
行业均值	**4.07%**	**2.16%**	**2.12%**
锦艺新材	**8.74%**	**7.08%**	**3.69%**

报告期内各期，公司存货跌价准备综合计提比例高于同行业可比公司，存货跌价准备计提政策谨慎，存货跌价计提充分。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
增值税借方余额重分类	3,497.50	1,004.52	112.61
预交企业所得税	-	-	3.11
上市中介费用	47.17	560.11	305.39
合计	**3,544.67**	**1,564.63**	**421.11**

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 421.11 万元、1,564.63 万元和 3,544.67 万元，占流动资产比例分别为 0.83%、2.37%和 3.80%，公司其他流动资产主要包括增值税期末留抵进项税额、待认证进项税额以及上市中介费用等。2024 年末、2025 年末其他流动资产金额较高，主要原因为电子用功能性纳米粉体新材料项目处于建设期，持续购建长期资产导致增值税期末留抵进项税额等较高。

（三）非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产的主要构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	747.98	0.76	673.53	0.88	569.76	1.01

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	66,228.09	67.60	41,301.69	54.13	39,675.17	70.14
在建工程	18,219.30	18.60	23,083.67	30.25	7,871.59	13.92
使用权资产	1,769.55	1.81	1,919.22	2.52	446.58	0.79
无形资产	4,509.61	4.60	4,495.63	5.89	4,404.96	7.79
商誉	1,071.12	1.09	1,071.12	1.40	1,071.12	1.89
长期待摊费用	2,474.42	2.53	-	-	-	-
递延所得税资产	1,199.87	1.22	854.73	1.12	751.82	1.33
其他非流动资产	1,746.15	1.78	2,906.27	3.81	1,772.31	3.13
合计	**97,966.08**	**100.00**	**76,305.85**	**100.00**	**56,563.32**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动资产账面价值分别为 56,563.32 万元、76,305.85 万元和 97,966.08 万元，主要包括固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期待摊费用等。各期末公司非流动资产账面价值逐年增长，主要原因为报告期内公司购建厂房、产线设备等用于提升完善产能布局，固定资产及在建工程规模快速增长导致。

1、长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资期末余额分别为 569.76 万元、673.53 万元和 747.98 万元，占非流动资产的比例分别为 1.01%、0.88%和 0.76%。公司的长期股权投资系以权益法核算的对合营企业锦艺阿泰欧的投资。报告期内长期股权投资余额增长系各期对合营企业确认投资收益所致。

锦艺阿泰欧的具体情况参见“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司、参股公司情况”。

2、固定资产

（1）固定资产构成情况分析

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
账面原值合计	**83,389.87**	**54,652.40**	**49,082.62**

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
其中：房屋建筑物	38,611.32	17,349.30	17,434.69
机器设备	42,620.92	35,503.60	29,949.32
运输设备	627.90	583.80	571.45
电子及其他设备	1,529.74	1,215.69	1,127.16
累计折旧合计	**16,428.30**	**12,617.23**	**9,407.45**
其中：房屋建筑物	3,231.11	2,398.57	1,815.96
机器设备	12,017.11	9,268.38	6,895.38
运输设备	343.12	303.38	245.72
电子及其他设备	836.95	646.89	450.39
减值准备合计	**733.48**	**733.48**	**-**
其中：房屋建筑物	-	-	-
机器设备	733.48	733.48	-
运输设备	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-
账面价值合计	**66,228.09**	**41,301.69**	**39,675.17**
其中：房屋建筑物	35,380.20	14,950.73	15,618.74
机器设备	29,870.32	25,501.73	23,053.94
运输设备	284.78	280.42	325.72
电子及其他设备	692.79	568.80	676.77

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 39,675.17 万元、41,301.69 万元和 66,228.09 万元，占非流动资产的比例为 70.14%、54.13%和 67.60%，公司固定资产主要由房屋建筑物、机器设备等构成。2025 年末公司固定资产大幅增长，主要原因系子公司新建厂房、产线设备当年完工转固导致。

（2）固定资产折旧及减值情况分析

报告期内，公司与同行业可比公司均采用年限平均法计提固定资产折旧，公司与同行业可比公司各类固定资产的折旧年限对比情况具体如下：

类别	联瑞新材	壹石通	国瓷材料	雅克科技	天马新材	锦艺新材
房屋及建筑物	12-30 年	10-20 年	10-40 年	10-20 年	20 年	10-40 年
机器设备	6-12 年	5-10 年	5-10 年	10-15 年	10 年	3-12 年
运输设备	6-12 年	6 年	5 年	5 年	4-5 年	5-12 年

类别	联瑞新材	壹石通	国瓷材料	雅克科技	天马新材	锦艺新材
电子及其他设备	6-12 年	5 年	5-10 年	5-8 年	3 年	3-5 年

注：上述数据均来自同行业可比公司的招股说明书、年报或公开发行文件。

公司各类固定资产折旧年限合理，与同行业公司相比，发行人主要固定资产折旧方式不存在重大差异。

报告期各期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行了审慎评估判断。2024 年末公司计提固定资产减值准备 733.48 万元，主要原因为公司根据下游市场竞争环境、产品体系规划及未来经营战略等因素，综合判断勃姆石产品未来产销情况、预期经济效益存在一定不确定性，因相关生产设备未来经济绩效低于预期而存在减值迹象，公司基于谨慎性原则对相关产线设备计提减值准备。除此之外，报告期内公司其他固定资产不存在减值迹象。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程余额分别 7,871.59 万元、23,083.67 万元和 18,219.30 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 13.92%、30.25%和 18.60%，明细情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
在建工程	17,637.59	22,911.68	7,851.58
工程物资	581.70	171.99	20.02
合计	**18,219.30**	**23,083.67**	**7,871.59**

随着公司产销规模快速增长，报告期内公司产能建设投入增加，因此 2024 年末与 2025 年末在建工程规模与 2023 年末相比，呈现大幅增长。2024 年末公司在建工程余额及占比相对较高，主要原因为电子用功能性纳米粉体新材料新建项目厂房当年建设投入较高导致。

报告期内，公司厂房、产线设备等达到预定可使用状态后，转入固定资产，有效优化及扩大公司产能规模。报告期各期，公司大额在建工程转入固定资产情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非金属矿超细粉末加工工程	7.05	2,648.13	16,893.87
电子用功能性纳米粉体新材料新建项目	18,360.38	-	-
云阳高端电子功能材料新建项目	5,527.22	-	-
合计	**23,894.65**	**2,648.13**	**16,893.87**

截至 2025 年 12 月末，公司在建工程中尚未完工交付项目主要是电子用功能性纳米粉体新材料新建项目、非金属矿超细粉末加工工程等，预计于 2026 年起陆续达到预定可使用状态并转入固定资产。

报告期各期末，公司在建工程整体情况良好，不存在减值迹象。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 446.58 万元、1,919.22 万元和 1,769.55 万元，占非流动资产比例分别为 0.79%、2.52%和 1.81%，主要系公司租赁的生产经营性房屋建筑物。

报告期各期末，公司使用权资产不存在可收回金额低于其账面价值的情形，故未计提使用权资产减值准备。

5、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
账面原值合计	**5,292.96**	**5,108.04**	**4,878.26**
其中：土地使用权	4,499.12	4,499.12	4,499.12
计算机软件	793.84	608.92	379.14
累计摊销合计	**783.35**	**612.41**	**473.30**
其中：土地使用权	545.30	452.53	359.76
计算机软件	238.05	159.88	113.54
减值准备合计	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	--
计算机软件	-	-	-
账面价值合计	**4,509.61**	**4,495.63**	**4,404.96**

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
其中：土地使用权	3,953.82	4,046.59	4,139.36
计算机软件	555.79	449.04	265.59

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 4,404.96 万元、4,495.63 万元和 4,509.61 万元，占非流动资产的比例分别为 7.79%、5.89%和 4.60%。公司无形资产主要由土地使用权、计算机软件构成。报告期各期末，公司无形资产使用状况良好，不存在减值迹象，故未计提减值准备。

6、商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值为 1,071.12 万元、1,071.12 万元和 1,071.12 万元，系公司 2019 年 11 月通过非同一控制下企业合并收购山东锦艺（曾用名南京宇热）时产生的商誉，各期末占非流动资产的比例分别为 1.89%、1.40%和 1.09%。报告期各期末，公司对商誉及相关的资产组进行了减值测试，公司商誉不存在减值的迹象。

公司聘请了具有证券期货相关业务评估资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对该商誉相关资产组可收回价值进行了减值测试，出具了《苏州锦艺新材料科技股份有限公司拟对合并山东锦艺新材料有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的资产组资产评估报告》（嘉学评估评报字[2026]811007 号、811008 号、811009 号）。根据资产评估报告及管理层测算，该商誉相关资产组账面价值低于未来现金流现值，不存在减值情形。

7、长期待摊费用

2025 年末，公司长期待摊费用账面价值为 2,474.42 万元，占非流动资产的比例为 2.53%，主要为子公司山东锦艺租赁厂房、办公场所的装修改造支出等。

8、递延所得税资产、递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
资产减值准备	383.54	317.03	101.49

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
信用减值准备	43.48	39.54	33.79
递延收益	580.31	371.53	53.92
可抵扣亏损	341.12	268.40	344.10
租赁负债税会差异	358.47	402.31	176.39
股权激励费用	81.70	105.41	57.53
企业合并形成的资产评估增值	65.21	77.24	89.26
合计	**1,853.83**	**1,581.46**	**856.48**

公司递延所得税资产主要来源于资产减值准备、递延收益、可抵扣亏损等产生的可抵扣暂时性差异。

（2）未经抵销的递延所得税负债

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
固定资产折旧税会差异	276.92	303.05	335.03
使用权资产税会差异	371.05	422.50	104.66
交易性金融资产公允价值变动	6.00	1.18	-
合计	**653.97**	**726.73**	**439.69**

公司递延所得税负债主要来源于固定资产折旧税会差异、使用权资产税会差异等产生的应纳税暂时性差异。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	互抵金额	抵消后余额	互抵金额	抵消后余额	互抵金额	抵消后余额
递延所得税资产	653.97	1,199.87	726.73	854.73	104.66	751.82
递延所得税负债	653.97	-	726.73	-	104.66	335.03

9、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 1,772.31 万元、2,906.27

万元和 1,746.15 万元，占非流动资产的比例分别为 3.13%、3.81%和 1.78%，主要系预付设备及工程款。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	2.57	2.36	2.16
存货周转率（次/年）	3.71	2.84	2.25

注：上述指标计算公式如下：
应收账款周转率=营业收入/应收票据、应收账款及应收款项融资平均账面价值
存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

1、应收账款周转率

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.16 次/年、2.36 次/年和 2.57 次/年。报告期内由于公司营业收入规模快速增长，且下游优质客户回款情况较好，应收账款周转率逐年提升，应收账款周转情况良好。

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司比较如下：

单位：次/年

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联瑞新材	2.97	2.94	2.37
壹石通	2.09	2.24	1.91
国瓷材料	2.07	1.94	2.08
雅克科技	6.36	5.69	4.43
天马新材	2.98	2.89	2.25
行业均值	**3.29**	**3.14**	**2.61**
锦艺新材	**2.57**	**2.36**	**2.16**

注：上述数据均来自同行业可比公司招股说明书、年报或公开发行文件。

报告期各期，公司应收账款周转率与同行业可比公司联瑞新材、壹石通、国瓷材料、天马新材相对接近，低于雅克科技，整体上处于同行业可比公司应收账款周转率的合理区间范围内，不存在显著差异。

2、存货周转率

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.25 次/年、2.84 次/年和 3.71 次/年。

报告期内公司存货周转率逐年上升，主要原因系公司销售规模持续增长，产品生产和交付速度加快，同时公司不断优化库存管理水平，使得存货周转率显著提升。

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司比较如下：

单位：次/年

可比公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联瑞新材	5.38	5.98	5.31
壹石通	3.11	2.79	2.64
国瓷材料	3.50	2.96	2.82
雅克科技	2.67	2.42	2.33
天马新材	1.97	2.25	2.09
行业均值	**3.33**	**3.28**	**3.04**
锦艺新材	**3.71**	**2.84**	**2.25**

注：上述数据均来自同行业可比公司招股说明书、年报或公开发行文件。

报告期内，随着公司库存管理不断优化、存货周转效率逐年提升，公司存货周转率与同行业可比公司差异较小。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债结构及变动分析

1、负债总体变动及构成分析

报告期内，公司负债总体构成及变化情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	65,319.74	75.36	38,131.89	70.72	24,153.72	84.98
非流动负债	21,355.37	24.64	15,790.96	29.28	4,270.12	15.02
合计	**86,675.11**	**100.00**	**53,922.85**	**100.00**	**28,423.85**	**100.00**

报告期各期末，公司负债总额分别为 28,423.85 万元、53,922.85 万元和 86,675.11 万元，公司负债总额总体呈现增长趋势。

报告期各期末，流动负债金额占公司负债总额的比例分别为 84.98%、70.72%和 75.36%；非流动负债占总负债比例分别为 15.02%、29.28%和 24.64%。2024 年末公司流动负债占比较 2023 年末明显下降，主要原因为公司通过增加长期银

行借款满足产能建设资金需求，同时当年因产能扩建新增生产经营场所租赁，进而导致年末非流动负债规模增幅较快。

2、流动负债分析

报告期内，公司流动负债的主要构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	22,931.65	35.11	12,633.93	33.13	5,436.95	22.51
交易性金融负债	-	-	1.31	0.00	-	-
应付票据	3,080.86	4.72	853.21	2.24	701.28	2.90
应付账款	21,852.45	33.45	14,464.15	37.93	9,305.45	38.53
合同负债	63.95	0.10	30.82	0.08	16.60	0.07
应付职工薪酬	2,525.40	3.87	1,688.51	4.43	1,388.39	5.75
应交税费	1,578.20	2.42	1,056.47	2.77	558.86	2.31
其他应付款	535.83	0.82	843.49	2.21	363.83	1.51
一年内到期的非流动负债	9,481.00	14.51	4,197.87	11.01	4,080.50	16.89
其他流动负债	3,270.40	5.01	2,362.15	6.19	2,301.87	9.53
合计	**65,319.74**	**100.00**	**38,131.89**	**100.00**	**24,153.72**	**100.00**

报告期各期末，公司流动负债余额分别为 24,153.72 万元、38,131.89 万元和 65,319.74 万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债等构成。报告期各期末公司流动负债余额显著呈现增长趋势，主要原因为随着公司近年生产经营规模快速扩张，银行借款以及应付供应商款项规模均有相应增长导致。

（1）短期借款

报告期各期末，公司的短期借款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
保证借款	-	1,300.00	2,903.50
信用借款	19,467.06	11,295.67	2,519.40
已贴现未终止确认应收票据	-	27.39	-

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
信用证福费廷融资	3,450.00	-	-
应付利息	14.59	10.87	14.05
合计	**22,931.65**	**12,633.93**	**5,436.95**

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 5,436.95 万元、12,633.93 万元和 22,931.65 万元，占流动负债总额的比例分别为 22.51%、33.13%和 35.11%，主要为保证借款、信用借款和信用证福费廷融资等。

报告期内，随着公司生产经营规模持续快速增长，公司通过短期银行借款方式满足业务发展的部分营运资金需求，导致报告期各期末短期借款余额逐年增长。

报告期内，公司信用记录良好，不存在本金或利息逾期未偿还的情形。

（2）交易性金融负债

报告期各期末，公司交易性金融负债余额分别为 0 万元、1.31 万元和 0 万元，在流动负债中占比较小，主要系公司为规避汇率风险而购买的尚未到期交割的外汇衍生产品公允价值。

（3）应付票据

报告期各期末，公司的应付票据具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
银行承兑汇票	3,080.86	853.21	701.28
合计	**3,080.86**	**853.21**	**701.28**

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 701.28 万元、853.21 万元和 3,080.86 万元，占流动负债的比例分别为 2.90%、2.24%和 4.72%，均为向供应商开具的银行承兑汇票。2025 年随着公司业务规模快速增长，使用票据结算供应商货款增多，因此期末应付票据余额增加。

（4）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应付货款	8,140.38	5,500.29	4,383.82
应付设备及工程款	10,901.34	7,195.98	3,872.85
应付其他采购款	2,810.74	1,767.88	1,048.78
合计	**21,852.45**	**14,464.15**	**9,305.45**

报告期各期末，公司应付账款账面价值分别为 9,305.45 万元、14,464.15 万元和 21,852.45 万元，占期末流动负债的比例分别为 38.53%、37.93%和 33.45%。公司应付账款主要为日常经营中应付供应商的货款和工程设备款等。随着公司报告期内业务规模的逐步扩大，各期应付供应商款项余额规模相应增长。报告期内，公司新增较多基建项目和设备采购，各期末应付工程设备款余额的变动主要与结算进度有关。

（5）合同负债

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 16.60 万元、30.82 万元和 63.95 万元，占公司流动负债的比例分别为 0.07%、0.08%和 0.10%，金额及占比均较低，均为公司预收货款。

（6）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
短期薪酬	2,519.14	1,681.34	1,388.39
离职后福利-设定提存计划	6.26	7.17	-
合计	**2,525.40**	**1,688.51**	**1,388.39**

报告期各期末，公司应付职工薪酬的余额分别为 1,388.39 万元、1,688.51 万元和 2,525.40 万元，占流动负债比例分别为 5.75%、4.43%和 3.87%，主要为员工短期薪酬。公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金等，报告期内随着员工人数及人均薪酬、奖金的增长，应付职工薪酬期末余额持续增长。

（7）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
增值税	647.75	308.45	60.04
城市维护建设税	50.16	31.56	10.02
教育费附加	21.35	13.21	4.36
地方教育附加	13.85	8.80	2.91
企业所得税	466.88	532.01	341.96
个人所得税	265.89	102.63	86.41
印花税	16.59	12.27	15.53
房产税	80.02	34.23	27.13
土地使用税	10.39	10.39	10.39
环境保护税	5.32	2.93	0.11
合计	**1,578.20**	**1,056.47**	**558.86**

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 558.86 万元、1,056.47 万元和 1,578.20 万元，占流动负债比重分别为 2.31%、2.77%和 2.42% ，主要由应交企业所得税、应交增值税、代扣代缴个人所得税等构成。报告期内，公司应交税费余额整体呈增长趋势，主要系公司快速发展，销项税额增速较快，且随着员工人数增加，代扣代缴个人所得税增长共同导致。

（8）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 363.83 万元、843.49 万元和 535.83 万元，占期末流动负债的比例分别为 1.51%、2.21%和 0.82%，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
押金保证金	437.25	736.30	281.85
代扣代缴社保公积金	24.64	25.38	25.45
其他经营性资金	73.95	81.81	56.53
合计	**535.83**	**843.49**	**363.83**

公司其他应付款主要包括押金保证金、代扣代缴社保公积金等。

（9）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 4,080.50 万元、4,197.87 万元和 9,481.00 万元，占期末流动负债的比例分别为 16.89%、11.01%和 14.51%，主要为一年内到期的长期借款和租赁负债，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
一年内到期的长期借款	9,000.00	3,750.00	3,500.00
一年内到期的租赁负债	481.00	447.87	580.50
合计	**9,481.00**	**4,197.87**	**4,080.50**

（10）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 2,301.87 万元、2,362.15 万元和 3,270.40 万元，占期末流动负债的比例分别为 9.53%、6.19%和 5.01%，主要为已背书未到期但不符合终止确认条件的应收票据，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
待转销项税额	8.07	4.01	2.16
已背书未到期的不符合终止确认条件的应收票据	3,262.33	2,358.14	2,299.71
合计	**3,270.40**	**2,362.15**	**2,301.87**

3、非流动负债分析

报告期内，公司非流动负债的主要构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	17,095.04	80.05	12,454.05	78.87	3,367.80	78.87
租赁负债	1,204.00	5.64	1,360.03	8.61	207.85	4.87
递延收益	3,056.33	14.31	1,976.88	12.52	359.45	8.42
递延所得税负债	-	-	-	-	335.03	7.85
合计	**21,355.37**	**100.00**	**15,790.96**	**100.00**	**4,270.12**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 4,270.12 万元、15,790.96 万元和 21,355.37 万元，主要由长期借款、租赁负债和递延收益构成。报告期各期末

公司非流动负债金额增长的主要原因为长期银行借款融资规模增加所致。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
保证、抵押借款	26,065.28	16,188.86	6,859.45
计提利息	29.77	15.20	8.35
小计	**26,095.04**	**16,204.05**	**6,867.80**
减：一年内到期的长期借款	9,000.00	3,750.00	3,500.00
合计	**17,095.04**	**12,454.05**	**3,367.80**

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 3,367.80 万元、12,454.05 万元和 17,095.04 万元，占非流动负债比例分别为 78.87%、78.87%和 80.05%，主要为保证、抵押借款等。报告期各期末公司长期借款余额呈增长趋势，主要由于公司报告期内产能建设投入较高，所需部分资金通过长期银行贷款方式筹集。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
租赁付款额	1,854.29	2,037.85	807.80
减：未确认融资费用	169.30	229.95	19.45
小计	**1,684.99**	**1,807.90**	**788.35**
减：一年内到期的租赁负债	481.00	447.87	580.50
合计	**1,204.00**	**1,360.03**	**207.85**

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为 207.85 万元、1,360.03 万元和 1,204.00 万元，占非流动负债比例分别为 4.87%、8.61%和 5.64%，主要为应付房屋及建筑物租赁款项。2024 年，发行人子公司山东锦艺因产能扩建新增租赁临沭县光电产业园厂房，用于生产经营及办公，使得当年末公司租赁负债规模增长较高。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 359.45 万元、1,976.88 万元和 3,056.33 万元，占非流动负债比例分别为 8.42%、12.52%和 14.31%，均为公司收到的与资产相关政府补助产生的递延收益。

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	与资产/收益相关
招拍挂土地基础设施补贴返还款	344.02	351.73	359.45	与资产相关
工业企业有效投入奖补资金	131.12	145.14	-	与资产相关
先进材料战略性新兴产业融合集群发展专项资金	708.01	730.00	-	与资产相关
生产设备智能运维系统项目专项资金	547.80	550.00	-	与资产相关
租赁高新技术产业园厂房装修补贴	670.83	200.00	-	与资产相关
超长期特别国债资金设备更新项目	373.12	-	-	与资产相关
国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目	281.44	-	-	与资产相关
合计	**3,056.33**	**1,976.88**	**359.45**	-

（二）偿债能力分析

1、最近一期末主要债务情况

截至 2025 年 12 月末，公司短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款余额分别为 22,931.65 万元、9,000.00 万元和 17,095.04 万元，主要系公司为满足营运资金需求以及产能建设投入而进行的长短期银行借款融资。报告期末，公司不存在关联方借款、或有负债，除因正常经营业务形成的应付票据、应付账款、其他应付款等负债外，公司不存在其他特殊的重大合同承诺债务。报告期内，公司资信情况良好，不存在逾期未偿还债项的情形。

报告期内，公司借款费用资本化情况具体如下：

单位：万元

期间	项目	资本化金额	资本化依据
2023 年度	非金属矿超细粉末加工工程	110.96	同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使
	电子用功能性纳米粉体新材料新建项目	0.83	
2024 年度	电子用功能性纳米粉体新材料新建项目	165.74	

期间	项目	资本化金额	资本化依据
2025 年度	电子用功能性纳米粉体新材料新建项目	416.50	用状态所必要的购建活动已经开始

2、未来十二个月内可预见的需偿还负债和利息情况及偿债能力分析

报告期末，公司未来十二个月内可预见的需偿还负债和利息情况参见本节“十二、偿债能力、流动性和持续经营能力分析”之“（一）负债结构及变动分析”之“2、流动负债分析”，主要为短期借款、应付账款、应付票据、一年内到期的长期借款、一年内到期的租赁负债等。

报告期内，公司不存在期未偿还银行借款等债项的情形，公司银行资信状况良好、授信额度充足，并与主要金融机构和供应商保持长期良好合作关系。此外，报告期内公司业务规模和营业收入持续快速增长，经营活动产生的现金流量净额亦呈显著上升趋势，可预见的未来发生无法偿还负债和利息的风险较低。

3、公司主要偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
流动比率（倍）	1.43	1.73	2.11
速动比率（倍）	1.15	1.24	1.42
资产负债率（母公司）	33.77%	32.62%	31.44%
资产负债率（合并）	45.29%	37.91%	26.44%
息税折旧摊销前利润（万元）	24,534.63	14,634.89	10,794.62
利息保障倍数（倍）	24.50	17.59	25.38

报告期各期期末，公司的流动比率分别为 2.11 倍、1.73 倍和 1.43 倍，速动比率分别为 1.42 倍、1.24 倍和 1.15 倍，合并报表层面资产负债率分别为 26.44%、37.91%和 45.29%。报告期各期公司流动比率、速动比率呈现下降趋势，资产负债率呈现上升趋势，主要原因为报告期内随着公司生产经营规模快速扩大，产能建设投入持续增加，公司增加银行借款债务融资规模，同时各期末应付供应商货款及工程设备款项亦显著增长，共同导致各期末负债增长幅度高于资产增长幅度。

报告期内，息税折旧摊销前利润分别为 10,794.62 万元、14,634.89 万元和 24,534.63 万元，利息保障倍数分别为 25.38 倍、17.59 倍和 24.50 倍，报告期内

公司盈利能力不断增强，公司利润对利息支出的覆盖情况良好，偿债能力较强，流动性风险较低。

4、与同行业公司比较情况

报告期各期末，公司主要偿债能力指标与同行业可比公司对比情况如下：

财务指标	公司名称	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率（倍）	联瑞新材	3.41	3.29	3.79
	壹石通	2.38	2.63	2.78
	国瓷材料	2.77	2.74	2.55
	雅克科技	2.10	1.31	1.70
	天马新材	3.42	3.57	4.71
	行业均值	**2.82**	**2.71**	**3.11**
	锦艺新材	**1.43**	**1.73**	**2.11**
速动比率（倍）	联瑞新材	3.08	2.98	3.45
	壹石通	2.05	2.29	2.52
	国瓷材料	2.23	2.12	2.00
	雅克科技	1.45	0.82	1.20
	天马新材	2.05	2.41	3.57
	行业均值	**2.17**	**2.12**	**2.55**
	锦艺新材	**1.15**	**1.24**	**1.42**
资产负债率（%）	联瑞新材	24.55	23.54	23.21
	壹石通	39.69	31.36	24.75
	国瓷材料	18.91	20.96	22.70
	雅克科技	42.60	38.88	31.30
	天马新材	18.90	21.35	15.82
	行业均值	**28.93**	**27.22**	**23.56**
	锦艺新材	**45.29**	**37.91**	**26.44**

注：上述数据均来自同行业可比公司招股说明书、年报或公开发行文件。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，资产负债率高于同行业可比公司平均水平。主要由于近年公司生产经营规模、产能建设投入均处于快速增长阶段，公司报告期较多通过扩大银行借款债务融资规模支持营运资金及建设资金需求。同行业可比上市公司融资渠道及资本运作方式相对丰富，因此受发行人高增长业务发展阶段特点及有限的融资渠道共同影响，报告

期各期末公司流动比率、速度比率及资产负债率指标与同行业公司存在合理差异。

报告期内，发行人流动资产、速动资产金额均大于流动负债，资产负债率良好，公司整体财务状况相对稳健，偿债能力良好，通过本次公开发行股票并上市，未来公司融资能力及资本结构将得到进一步优化。

（三）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,876.02	6,135.37	-329.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,397.17	-17,841.45	-4,259.74
筹资活动产生的现金流量净额	17,778.28	14,668.20	4,266.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.45	91.55	10.64
现金及现金等价物的净增加额	16,229.67	3,053.67	-312.10

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	79,698.17	53,841.14	37,608.94
收到的税费返还	147.33	-	365.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,918.12	2,058.48	239.37
经营活动现金流入小计	**81,763.63**	**55,899.62**	**38,213.42**
购买商品、接受劳务支付的现金	37,891.44	30,717.78	25,490.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,149.16	11,456.76	9,411.91
支付的各项税费	7,081.96	3,852.00	1,553.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,765.05	3,737.71	2,087.85
经营活动现金流出小计	**61,887.61**	**49,764.25**	**38,543.17**
经营活动产生的现金流量净额	**19,876.02**	**6,135.37**	**-329.74**

公司经营活动现金流量主要包括销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、

接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等。报告期各年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-329.74 万元、6,135.37 万元和 19,876.02 万元。

2023 年度，公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司按期兑付以前年度及当期向供应商开具的银行承兑票据而产生的现金流出较多，同时 2023 年下半年公司以票据结算供应商货款的占比下降，共同导致 2023 年度经营活动现金净流量为负。2024 年及 2025 年，随着公司业绩规模快速增长且客户持续保持良好回款情况，经营活动现金流入增幅较大，公司报告期内经营活动产生的现金流量净额快速增长。

报告期内，公司经营性现金净流量与净利润之间的勾稽关系如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	**16,517.17**	**8,936.38**	**6,604.20**
加：资产减值损失	1,901.34	1,897.08	68.48
信用减值损失	26.10	41.48	45.08
固定资产折旧	3,933.57	3,517.05	2,939.85
使用权资产折旧	622.43	370.43	283.19
无形资产摊销	142.82	91.03	91.51
长期待摊费用摊销	106.99	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5.09	48.99	28.08
固定资产报废损失	27.56	25.77	9.45
公允价值变动损失	-41.32	-0.17	-
财务费用	875.72	514.22	284.13
投资损失	-94.54	-123.45	-286.19
递延所得税资产减少	-345.14	-102.91	118.02
递延所得税负债增加	-	-335.03	-29.06
存货的减少	-1,369.86	-3,091.80	-1,480.71
经营性应收项目的减少	-15,148.24	-12,127.45	-8,611.86
经营性应付项目的增加	12,874.44	6,154.57	-637.86
其他	-158.10	319.19	243.95
经营活动产生的现金流量净额	**19,876.02**	**6,135.37**	**-329.74**

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	12,600.74	17,515.58	11,300.00
取得投资收益收到的现金	24.48	11.99	38.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.50	105.54	4.70
收到其他与投资活动有关的现金	10.50	506.00	
投资活动现金流入小计	**12,658.23**	**18,139.11**	**11,343.69**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,161.91	18,464.98	7,203.43
投资支付的现金	12,600.74	17,515.58	8,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	292.75	-	
投资活动现金流出小计	**34,055.40**	**35,980.56**	**15,603.43**
投资活动产生的现金流量净额	**-21,397.17**	**-17,841.45**	**-4,259.74**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要包括收回投资收到的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金等。报告期各年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,259.74 万元、-17,841.45 万元和-21,397.17 万元。

报告期内，因公司产能建设投入产生的资本性支出逐年增长，导致各年度公司投资活动现金流量净额持续为负，具体体现为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出金额报告期内大幅增长。收回投资收到的现金、投资支付的现金主要为公司基于资金管理需求购买和赎回的理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得借款收到的现金	32,272.61	21,952.36	7,022.90
筹资活动现金流入小计	**32,272.61**	**21,952.36**	**7,022.90**
偿还债务支付的现金	12,602.19	5,422.79	2,097.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176.85	732.22	365.90

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	715.29	1,129.15	292.89
筹资活动现金流出小计	**14,494.33**	**7,284.16**	**2,756.16**
筹资活动产生的现金流量净额	**17,778.28**	**14,668.20**	**4,266.74**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要包括取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金等。报告期各年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为4,266.74 万元、14,668.20 万元和 17,778.28 万元。

报告期内公司生产经营规模快速扩张，公司主要通过银行借款方式满足快速增长的营运资金需求及产能建设需求，因此各年度取得借款收到的现金规模逐年增长，导致各期筹资活动产生的现金流量净额增长幅度较高。报告期内筹资活动现金流出主要为偿还借款本息支付的现金。

（五）流动性变化、风险趋势以及具体应对措施

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.11、1.73 和 1.43；速动比率分别为1.42、1.24 和 1.15。报告期内，公司流动资产超额覆盖流动负债，资产流动性较好，具体的变动原因参见本节“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（二）偿债能力分析”之“3、公司主要偿债能力指标”。未来，公司将通过公开发行股票或积极拓展外部融资渠道、进一步加强应收账款回款管理，优化债务结构和改善经营活动现金流，为公司持续发展提供有效的资金保障，以进一步降低公司的流动性风险。

（六）持续经营能力分析

公司专注于先进无机功能性粉体材料领域创新性技术研发及产业化应用，主要产品广泛应用于电子信息、导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等领域，尤其是应用于各级覆铜板的电子信息功能填充材料，具备突出竞争地位和领先的技术水平，多个产品突破了外资企业长期以来对高性能粉体材料市场的垄断，得到了全球各大覆铜板龙头企业的认可。

2023 年至 2025 年期间，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会证明，在高等级高速覆铜板的球形硅微粉领域，公司全球市场占有率超过 40%，位列第一；根据中国非金属矿工业协会证明，公司在覆铜板用硅微粉领域销售规模位居

国内第一。

同时，公司成功将同源技术横向拓展至导热散热，以及锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等其他新兴功能应用领域，与陶氏化学、汉高、迈图、莱尔德、恩捷股份、金力股份、阿克苏诺贝尔等各领域知名厂商建立合作关系。

报告期内，公司主营业务发展情况良好，营业收入规模持续增长，报告期各期分别为 51,950.91 万元、72,875.24 万元和 103,586.02 万元，2023 年至 2025 年公司营业收入复合增长率为 41.21%。

截至本招股说明书签署日，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化。基于公司丰富的产品线和持续的研发优势，公司在可预见的未来具有持续盈利能力，不存在重大经营风险。此外，本次募集资金投资项目将有效推动公司产品结构的调整升级，增强公司的研发和创新能力，助力公司在行业领先身位进一步提升盈利能力和核心竞争力。

十三、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司的重大资本性支出主要为基建项目及设备购置产生的。2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 7,203.43 万元、18,464.98 万元和 21,161.91 万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出情况

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次公开发行股票募集资金拟投资项目，具体详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（三）报告期内资产业务重组情况

报告期内，公司不存在重大资产业务重组的情况。

十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，除为合并报表范围内的子公司提供担保，以及本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、资产质量分析”之“（二）流动资产分析”之“3、应收票据及应收款项融资”披露的期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况外，公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

（四）重大担保、诉讼事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重大担保、诉讼事项。

十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日后，公司经营状况正常。公司生产经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、公司适用税收政策未发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

十六、盈利预测

公司未对本次发行编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资方向

2026 年 5 月 15 日，公司股东会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》，公司本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
1	电子信息用高性能粉体材料扩产项目	139,405.46	139,405.46
2	扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目	19,685.56	19,685.56
3	智能化升级改造项目	16,537.84	16,537.84
4	研发中心建设项目	31,276.19	31,276.19
5	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		**221,905.05**	**221,905.05**

若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将按照项目轻重缓急实施，不足部分由公司自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资额，剩余部分公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用。本次发行募集资金到位前，若公司因公司实际经营需求或市场变动等因素需要先期投入的，公司拟根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金先行支付。待本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度置换本次发行前已投入使用的自有或自筹资金。

（二）募集资金使用管理制度

公司于 2026 年 5 月 15 日召开股东会，审议通过《关于制定<苏州锦艺新材料科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。本次首次公开发行募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。公司将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的专户存储、使用、资金用途变更等进行管理。

（三）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目系公司综合考虑发展战略、技术水平、国家产业政策、行业发展情况、市场竞争情况、下游市场需求等综合因素确定，系对公司主营业务的进一步发展和深化，符合国家产业政策与公司未来发展战略要求。随着下游AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算等新兴应用领域对无机功能性粉体材料需求的增加，公司生产经营规模呈现快速增长趋势，业务规模不断扩大，产品结构不断向高端化方向延伸，公司产能不足、研发资源不足等瓶颈问题日益凸显。

公司本次募集资金运用围绕主营业务展开，可有效解决上述问题，其中，电子信息用高性能粉体材料扩产项目、扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目系对公司高性能球形硅微粉、氮化铝等高端产品的产能建设与补充，智能化升级改造项目系对公司生产、仓储、物流等环节的智能化升级改造，研发中心建设项目系对前沿技术摸索与高性能材料开发的深入创新，上述募集资金投资项目对于提高公司产品供应能力、提升生产经营效率、增强研发实力及吸引人才等方面产生积极效果。此外，补充流动资金可满足公司快速发展过程中的营运资金需求，通过资金合理规划及运用，增强公司抗风险能力。因此，公司确定上述项目作为本次募集资金投资项目。

（四）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响，对业务创新、创造、创意性的支持作用

公司现有主营业务具有创新、创造、创意的特征，而募投项目与公司现有主营业务关系密切，既包括公司高性能球硅、高导热粉体等高端产品的产能建设与补充，也包括生产经营重要环节的智能化升级改造。另一方面，研发中心项目的建设有助于公司提高技术研发实力、增强技术储备，能够给公司业务高质量发展提供技术支撑。流动资金的补充有助于公司增加资金实力、优化资本结构，确保公司业务稳定发展。

综上所述，本次募集资金投资项目对促进公司主营业务发展、达成未来战略发展目标具有重要意义，对业务创新、创造、创意性具有支持作用。

（五）募集资金投资项目对公司同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目主体为发行人母公司或全资子公司，不涉及与他人合作，项目将紧密围绕公司主营业务展开，有利于进一步增强公司的核心竞争力，项目实施后不会新增同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金投资项目具体情况

本次募集资金投资项目的具体运用情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件 5 募集资金投资项目具体情况”。

三、项目的必要性和可行性分析

（一）项目的必要性

1、深化高端产能布局，把握 AI 等先进产业发展机遇，夯实领先地位

在全球 AI 产业发展浪潮之下，AI 服务器、高阶通用服务器、交换机、光模块等终端设施步入快速建设阶段，催生出对 AI PCB、高端覆铜板、高性能粉体填料等产业链上游各个环节的显著应用需求，同时，AI 等先进产业保持高速迭代频率，对于数据传输速率、传输损耗、散热效率、热稳定性等性能要求持续升级，带动对上游功能性粉体材料的使用需求朝着更高规格等级、更高填充比例不断演进，共同驱动高性能球形硅微粉市场迎来广阔发展前景。与此同时，AI 人工智能的迅猛发展，带动高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 通讯）、云计算、半导体制造与封装等先进产业交互式高速发展，随着 AI 算力设施、先进封装、5G/5G-A 通讯等超高功耗、高热流密度场景的迅速发展，高端导热散热材料作为保障芯片性能和 AI 算力设施稳定运行的重要材料，迎来高速发展周期。

依托在高性能球形硅微粉领域构建的领先优势，以及同源技术在高端散热材料领域的延展能力，报告期内，公司紧握 AI 等先进产业变革机遇，实现高速发展，目前公司总体产能已趋于饱和，面对下游不断涌现的快速发展需求，公司亟需提升高性能球形硅微粉、高导热氮化物等高端产品产能，以积极把握下游先进产业变革机遇实现进一步发展。同时，公司致力于高端化发展路线，已在高端前沿领域进行多项技术储备，公司拟使用本次募集资金布局下世代产品产能，以适配 M9 等级及以上高速覆铜板、高端 IC 载板、芯片底部填充胶（UF）等高端前

沿领域的应用需求，进一步拓展优势产品边界，并夯实在电子信息功能材料领域的领先地位。

2、提升自动化及智能化生产水平，实现降本增效

全球制造业正加快迈向数字化、自动化及智能化时代，智能制造对企业竞争力的重要性日益彰显。随着公司产销规模不断扩张，以及产品被广泛应用于 AI 算力设施等高阶场景，下游对于产品供应效率、质量一致性和交付稳定性提出更高要求，公司现有产线人工投入成本较高，并在自动化程度及智能化过程控制能力方面存在局限。公司拟使用本次募集资金，部署自动化立体仓库、AGV/RGV 智能物流系统、产线自动化升级、工艺装备升级、产线环境综合治理等，构建“智能仓储-自动物流-高校作业-先进工艺-洁净生产”一体化升级体系，将有效提升公司生产效率与成本控制能力，并通过构建数字化可追溯体系，以更高的供应链协同水平满足下游高端客户对品质一致性与供应稳定性的严苛要求，是公司将技术优势转化为制造体系优势、巩固行业领先地位的重要战略举措。

3、优化研发资源，提升公司综合研发实力

公司所处的先进无机非金属材料行业为研发驱动、技术密集型行业，呈现跨学科多领域、专业化程度高、研发投入大、研发周期长的特征，行业内企业需依托持续的研发投入和深厚的技术沉淀，以满足下游先进产业日益提出的更高性能要求。同时，下游产业技术保持高速迭代频率，粉体供应商不仅需紧跟下游快速升级步伐，保持高强度研发创新节奏，还需自主研判下游技术发展趋势并进行前瞻性布局，以确保在产业链中持续保持竞争力。公司拟使用本次募集资金，建设集中先进的研发中心，以满足公司业务规模高速扩张后研发所需的基础环境，并通过引入先进研发及检测设备和高端技术人才，进一步充实研发资源和建设研发队伍，为公司系统性提升整体研发实力提供关键平台，以高效响应下游先进产业提出的严格技术要求，为公司在行业内长久保持竞争力提供重要保障。

4、提升资本实力，满足业务快速发展需求

受益于 AI 等下游先进产业快速发展，报告期内公司营业收入快速增长，产销规模不断扩张，目前，AI 等先进产业仍处于高速发展周期，未来，随着公司业务规模进一步提升，公司流动资金需求将随之增长，充足的流动资金将保障公

司未来正常的运营和业务快速发展，并降低公司资产负债率、优化资本结构，为公司业务的长期稳健发展提供有效助力。

（二）项目的可行性

1、国家政策支持为项目实施提供有利宏观环境

先进无机非金属材料行业是国家重点鼓励发展的先进基础材料产业，近年来，高端先进无机非金属材料被广泛应用于 AI 人工智能、高速网络通信、云计算、低轨卫星、半导体制造与封装、新能源等战略新兴领域，已成为支撑国家电子信息等产业链自主可控的关键材料，其发展受到国家产业政策的大力支持。目前，《新材料中试平台建设指南（2024—2027 年）》《战略性新兴产业分类（2018）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》等一系列国家产业政策的推出，为推动多层次、多领域的先进无机非金属材料发展，提供良好的制度和政策保障。随着系列政策举措不断推出、落实和深化，不仅为高端电子信息功能材料、导热散热材料的发展指明方向，亦为本次募投项目的实施创造了良好的宏观环境。

2、广阔的下游发展前景为项目实施奠定坚实基础

AI 人工智能、高速网络通信（如光通信、5G/5G-A 先进通信）、云计算、半导体制造与封装等新兴应用领域的快速发展和技术突破，为高端功能性粉体材料行业发展注入强劲动力，带来广阔的市场需求空间。当前，全球 AI 算力设施处于快速建设阶段，以高等级高速覆铜板为代表的高性能覆铜板，作为印制电路板（PCB）的核心基材，已成为 AI 服务器等算力设施的“性能基石”，高性能球形硅微粉系高端覆铜板的核心功能性填料，伴随 AI 爆发式发展带来的显著应用需求，叠加 AI 等产业技术持续升级带来的更高规格等级、更高填充比例使用需求，迎来高速增长周期。同时，随着 AI 算力设施、先进封装、5G/5G-A 通讯等超高功耗、高热流密度场景的迅速发展，热管理问题成为保障芯片性能和 AI 算力设施等稳定运行的重要课题，高端导热散热功能性材料作为电子元件热管理系统的重要组成部分，亦迎来高速发展机遇。整体来看，在 AI 等先进产业迅速扩张及技术高速迭代的双重趋势之下，本次募投项目新增高端产品产能契合行业发展趋势，产能释放与市场增长形成良性协同，为项目实施奠定坚实的市场基础。

3、优质的客户基础为项目实施提供关键保障

公司自设立以来坚持高端化发展方向，目前已构建起以高性能球形硅微粉、高导热氮化物等高端产品为代表的重点产品矩阵，近年来被广泛应用于 AI 算力设施、半导体封装等高阶应用场景，依托优良的产品性能，公司已全面覆盖台光电子、联茂电子、台燿科技、生益科技、南亚新材、华正新材、南亚电子、建滔化工、韩国斗山、日本松下等全球高速覆铜板前十大厂商（CR10>90%），以及陶氏、汉高、莱尔德以及中石伟业、浙江三元、苏州天脉、鸿富诚等国内外知名导热企业，并在重点产品领域建立起领先的供应地位，与龙头标杆客户的深厚合作关系，系本次募投项目顺利实施的关键保障，丰富的市场资源也将为公司了解市场需求、把握技术动向及持续技术升级提供有效助力。

4、成熟的生产管理体系和深厚的研发能力保障项目顺利推进

公司经过二十余载发展，已建立起成熟的生产管理体系，在生产运营、成本控制及质量控制方面具有扎实的管理基础，基于在过往产线建设与技术改造过程中积累的丰富经验，能够有效保障本次智能化升级改造项目的顺利推进。同时，公司自设立以来，坚持以自主创新和高端突破为发展牵引，深耕先进无机非金属材料领域，构建起涵盖粉体合成技术群、粉体微纳加工技术群、表面改性技术群在内的核心技术体系，并形成可持续迭代的研发创新机制，将为本次研发中心建设项目的顺利实施和各项研发任务的高效推进提供有效保障。

四、公司未来发展战略及发展规划

（一）公司战略规划

公司深耕先进无机功能性粉体材料领域二十余载，致力于自主创新与底层突破，已成长为电子信息领域无机功能性粉体材料行业领先企业，并以电子信息领域为技术原点构建起平台型技术，锚定高附加值、创新性应用前景领域进行拓展性开发，并在部分由外资主导或下世代前沿领域持续攻关并不断突破，打造电子信息功能材料、导热散热功能材料和其他新兴功能材料三大产品矩阵，实现以电子信息领域为核心，辐射导热散热、锂电新能源、先进涂料、半导体制造与封装等领域的多元业务布局。

未来公司将继续以技术创新为驱动，巩固在电子信息领域无机功能性粉体材

料的领先地位，并不断深化在导热、锂电、涂料、IC 先进制造与封装等领域的业务布局及市场拓展。此外，公司还将加快新技术、新产品的规模化量产和客户推广，持续攻克业界重难点前沿品类的技术落地及国产化，逐步形成重点突出、多点突破的战略发展格局。公司将通过不断的研发投入推动发展战略的有效落地，不断巩固和提升公司在先进无机非金属材料领域的竞争力和影响力，成为品类丰富、应用行业广泛、技术谱系全面的应用型新材料行业代表企业。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续加强研发投入与技术储备

公司深耕先进无机功能性粉体材料行业二十余年，始终高度重视研发投入，坚持以研发创新为核心驱动力。AI 算力设施、高速网络通信、半导体先进制造与封装等终端应用领域技术发展高速迭代，对发行人所在的上游原材料行业提出更高的技术创新要求。报告期内，公司持续加大研发投入，保持高强度技术创新与产品迭代，针对下游应用需求进行提前自主研判和前瞻性探索布局。公司依托粉体合成、微纳加工、表面改性等核心技术优势，持续深化在高端、前沿领域的战略布局与技术储备，在产业链中持续保持竞争力。

2、深化与客户的战略合作，巩固公司市场地位

报告期内，公司持续推动技术攻关与产品创新，深入配合下游客户产品迭代与产品性能升级，不断巩固在多领域、多行业的创新性拓展应用与市场竞争力，构建起了覆盖多技术赛道、多应用场景的产品矩阵。公司下游客户覆盖全球前十大高速覆铜板制造商，并在导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料等领域横向拓展，与多个行业龙头客户建立深入合作关系。报告期内，公司不断加强与深化客户服务与战略合作，及时响应客户需求，为客户提供高性能产品、创新性技术支持，持续巩固市场地位与核心供应商地位。

3、海外渠道建设，推进全球化发展

公司在保持与巩固国内市场竞争地位及客户合作关系的基础上，逐步拓展在海外市场的战略布局与渠道建设。报告期内，公司向全球覆铜板制造领域龙头企业台光股份、台燿股份供应高性能球形硅微粉，以及向国际知名企业汉高集团供应导热散热材料，并积极拓展其他海外客户，着眼于国际市场业务拓展，积极推

进全球化布局。公司已取得境外投资备案相关文件，并于 2026 年 3 月新设立新加坡全资子公司新加坡锦艺，该公司将作为发行人战略布局海外市场的运营主体，进一步加强与国际客户的业务合作及国际市场的开拓发展，方便引进国际人才和进行技术交流，充分了解和把握国际客户及下游行业动向，提升品牌的国际影响力。

（三）未来规划采取的措施

1、持续增强研发投入与团队建设

公司将坚定以创新驱动为导向，进一步增强研发投入，完善研发体系建设，在现有技术储备基础上持续进行迭代创新与技术突破，紧密追踪前沿应用趋势，布局下一代关键技术，丰富产品矩阵，巩固公司的核心竞争优势。公司未来持续深耕下游产业链，与行业标杆企业保持深度技术合作，充分利用高校科研资源，持续充实研发团队实力，持续优化研发工作流程，建立公司层面的泛研发机制，持续加大研发投入，深化技术创新与前沿攻关。

同时，公司将持续增强团队建设，通过内部培养和高端人才引入相结合的机制，不断提升员工综合素质，并进一步完善内部培训体系与绩效考核机制，建立更为合理、有效的薪酬体系和激励计划，持续完善员工培训制度及安排，建设一支结构合理、能力突出、与公司战略发展高度适配的人才队伍，为公司业务高质量发展奠定人才基础。

2、持续提升运营管理水平

随着公司产销规模不断扩张，以及产品被广泛应用于 AI 算力设施等高阶场景，下游对于产品供应效率、质量一致性和交付稳定性提出更高要求，公司将通过部署自动化立体仓库、智能物流系统、产线自动化及工艺装备升级等方式，构建“智能仓储-自动物流-高校作业-先进工艺-洁净生产”一体化升级体系，有效提升公司运营管理水平、生产效率与成本控制能力，以更高的供应链协同水平满足下游高端客户对品质一致性与供应稳定性的严苛要求。

同时，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求进行规范运作，持续完善公司的法人治理结构与组织架构，进一步完善内部决策与内部控制机制，根据自身业务及外界客观条件及时调整公司管理机制，充分发挥股东会、

董事会、管理层等治理与管理职能，确保公司高质量运营管理。

3、持续开拓市场，提升品牌影响力

未来公司将进一步巩固、优化与高速覆铜板、导热界面材料、锂电池隔膜材料、先进涂料等领域现有优质客户的合作关系，增强客户黏性，从材料端满足客户及终端领域工艺技术迭代的创新性需求，深度挖掘现有客户前沿领域技术及产品需求。此外，公司也将充分利用现有的技术创新基础，持续推动 IC 制造与封装功能材料、电子浆料等领域的产业化进程，不断挖掘新领域新客户，增强公司综合实力和核心竞争力，提升公司的市场份额和行业品牌影响力。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，逐步建立并健全了规范的公司治理结构，依法设立股东会、董事会及其专门委员会、监事会（已于 2025 年 11 月取消）、独立董事及董事会秘书，并制定了相关工作细则与议事规则。

2025 年 11 月 7 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<苏州锦艺新材料科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订现行有效且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》等议案，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并据此对公司相关制度进行修订。

公司的股东会、董事会及其专门委员会、管理层、独立董事人员均能按照《公司章程》和公司治理规范性文件履行职责，公司对外担保、关联交易、投资、重大交易、内部审计等均能严格按照《公司章程》规定的程序和相应的管理制度执行，能够切实保护中小股东的利益。参照公司治理相关法律法规的标准，公司管理层认为在公司在治理层面不存在重大缺陷。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层的自我评估意见

公司董事会对公司的内部控制进行了自查和评估后认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”

（二）注册会计师对公司内部控制的审计报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审

字[2026]215Z0075 号），其审计意见为：“锦艺新材于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施等情况

报告期内，公司及其子公司受到的行政处罚情况如下：

序号	处罚机关	被处罚人	处罚时间	处罚金额	文号	处罚事由
1	中华人民共和国常熟海关	锦艺新材	2023 年 4 月 13 日	1.33 万元	虞关稽缉违字[2023]4 号	因工作疏忽及对商品归类认识不足，造成税则号列申报不实
2	中华人民共和国常熟海关	锦艺新材	2025 年 12 月 18 日	0.2 万元	虞关稽缉违字[2025]7 号	因工作失误，未及时了解国家管制规定，导致出口申报不规范

2021 年 1 月至 2023 年 1 月期间，因工作疏忽及对商品归类认识不足，发行人以一般贸易监管方式出口部分商品时，税则号归类错误，影响国家出口退税款人民币 6,542.09 元。“税则号列申报不实”一案常熟海关作为简易案件处理，且处罚执行完毕之日起至今已满三十六个月，根据中华人民共和国常熟海关盖章确认的《情况说明》，常熟海关认为相关违法行为情节轻微且已及时纠正，应不属于重大违法违规行为。

2025 年 4 月，因发行人出口的产品在实际生产过程中添加了稀土元素氧化物，稽查部门认为上述出口商品属于需实施出口管制的两用物项，应当向商务主管部门申请许可，并在报关时备注栏中注明管制物项等信息。根据常熟海关出具的《行政处罚决定书》，确认发行人出口商品不属于两用物项出口管制清单物项或临时管制物项，但发行人应在出口申报时按照相关规定，加强物项识别，报关时应在备注栏中明确是否属于管制物项。“出口申报不规范”一案属于依简易程序和快速办理行政处罚案件，处罚金额较小，且不属于海关相关处罚裁量基准从重情节或幅度，处罚依据未将其认定为情节严重的情形。

发行人已缴清相关罚款，并积极采取整改措施、规范管理工作。上述处罚均不属于重大违法违规行为，对发行人生产经营未产生重大不利影响。除上述情况外，公司及其子公司不存在其他违法违规行为或受到处罚、监督管理措施等情况。

四、发行人资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、独立性

自设立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均具有独立性。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

（一）资产完整

公司系由锦艺有限整体变更而来。变更时，公司整体继承了锦艺有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。截至本招股说明书签署日，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与其生产经营相关的土地、房屋、机器设备、商标、专利等资产的所有权或使用权，具有独立的原料采购、产品销售系统。公司全部资产均由公司独立拥有或使用，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形。

（二）人员独立

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、由董事会聘任高级管理人员。公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领薪；公司的财务人员未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立后，已依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设置了独立的财务部门，并按照

业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，与关联方保持了财务独立。公司独立对外签订合同，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立

公司按照规范法人治理结构的要求，设立了股东会、董事会、监事会/审计委员会、董事会其他各专门委员会等决策与监督机构，聘任了独立董事，并制定了相应的议事规则。根据业务经营需要，公司设置了相应的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与公司控股股东及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（五）业务独立

公司拥有独立的生产及质量检测系统、采购和销售系统，具备面向市场自主经营业务的能力，不受制于任何关联方。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。公司与供应商建立了长期的合作关系，采购部门负责公司生产经营所需的原材料、辅助材料等的采购。公司的质量中心独立负责样品的检测，把控产品各项指标是否符合标准。公司研发中心独立进行产品、技术和工艺的研发，拥有独立的研发设备和人员体系，具有相应的知识产权和专利技术。公司搭建了独立的销售团队，制订了完备的销售管理制度，具有独立且完整的销售系统。

（六）主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员稳定情况

公司主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）其他对持续经营有重大影响事项的情况

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续

经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）同业竞争情况

发行人控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业均未持有其他任何与发行人经营相同或相似业务公司的股权，也未开展任何与发行人相同或相似的生产经营活动，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为保证公司及公司其他股东利益不受损害，公司控股股东、实际控制人分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件 1 与投资者保护相关的承诺”之“（九）其他承诺”之“1、关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方、关联关系

基于重要性原则和可读性原则，本招股书说明书以列举方式披露了报告期内主要关联方或与发行人存在交易的关联方，并以文字概述方式确定了其余关联方的范围。根据《公司法》《企业会计准则 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，截至本招股说明书签署日，发行人主要关联方及关联关系如下：

（一）关联法人

1、发行人控股股东

公司控股股东为广州锦族，广州锦族直接持有公司 45.18%的股权，其基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、发行人的控股子公司、参股公司

发行人控股子公司、参股公司具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司、参股公司情况”。

3、控股股东控制的其他法人或组织

除控股发行人外，广州锦族未对外投资其他企业。

4、持有发行人 5%以上股份的其他法人或组织，及其一致行动人

持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人为公司关联方。直接持有发行人 5%以上股份的股东的具体情况，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（二）其他直接持股 5%以上股东的基本情况”。

5、关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的其他法人或组织

发行人实际控制人、董事、高级管理人员，以及控股股东的董事、监事及高级管理人员所直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的其他法人或组织，均为发行人关联方，主要如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	广州福商	公司董事长陈锦魁持有该公司 95.00%的股权并担任其执行董事
2	华诚投资	公司董事长陈锦魁持有该公司已发行股份的 87.86%，并担任董事
3	锦艺纺织	华诚投资的全资子公司
4	汇鼎资本	公司董事长陈锦魁持有该公司 70%的股权，广州锦族经理董诗丰任董事长、经理
5	平潭锦商	汇鼎资本持有该企业 1.7794%的合伙份额并担任执行事务合伙人
6	平潭汇普安鼎	汇鼎资本持有该企业 0.50%的合伙份额并担任执行事务合伙人
7	达安金控控股集团有限公司	公司董事长陈锦魁担任该公司的董事
8	上海爵众企业管理咨询有限公司	公司副总经理黄勇峰与其配偶唐艺合计持有该公司 100%的股权

除上述企业外，发行人实际控制人、董事、高级管理人员，以及控股股东的

董事、监事及高级管理人员之关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）所直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的其他法人或组织，亦为发行人关联方，其中与发行人存在关联交易的关联方如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	国锦（广州）电子商务有限公司	公司董事长陈锦魁近亲属陈锦艳、陈锦东控制的公司

（二）关联自然人

1、发行人实际控制人

发行人实际控制人为陈锦魁，陈锦魁间接持有公司 50.45%的股权，其基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、发行人董事、高级管理人员

发行人董事及高级管理人员请参见“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况”。

3、控股股东的董事、监事及高级管理人员

发行人控股股东为广州锦族，截至本招股书签署日，陈锦魁为广州锦族董事，董诗丰为广州锦族经理。

4、上述 1 至 3 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母

发行人实际控制人、董事、高级管理人员，以及控股股东的董事、监事及高级管理人员之关系密切的家庭成员均为发行人关联方，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

根据发行人的陈述及其报告期内员工花名册，发行人实际控制人、董事、监

事（取消监事会前）、高级管理人员签署确认的基本情况调查表，以及相关人员提供的居民身份证等资料，上述关系密切家庭成员中，在发行人处任职或持有发行人股份的人员如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	陈芷薇	发行人实际控制人之女
2	曲直	发行人实际控制人女儿配偶
3	林野	取消监事会前监事会主席林智睿父亲
4	曲广明	发行人实际控制人女儿配偶之父亲

（三）曾经存在的关联方

1、曾与公司存在关联关系的关联自然人

报告期前 12 个月及报告期内，曾直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人，曾任发行人董事、高级管理人员、控股股东董事、监事及高级管理人员的人员均为发行人曾经的关联自然人，主要如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	林智睿	报告期内曾任公司监事会主席，2025 年 11 月取消监事会不再担任
2	庄雨	报告期内曾任公司监事，2025 年 11 月取消监事会不再担任
3	李泽惠	报告期内曾任公司监事，2025 年 11 月取消监事会不再担任
4	杨素忠	曾任公司董事，已于 2022 年 3 月离任
5	徐强	曾任公司监事，已于 2022 年 8 月离任
6	林子榕	曾任公司董事，已于 2022 年 11 月离任
7	姜达才	曾任公司董事，已于 2026 年 4 月离任
8	吴宜治	曾任控股股东广州锦族监事，已于 2024 年 11 月 18 日离任
9	陈航斌	曾通过郑州锦谋间接持有公司 5%以上股权，郑州锦谋股权已于 2026 年 3 月转出

除上述企业外，报告期前 12 个月及报告期内，曾直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人，以及曾任发行人董事、高级管理人员、控股股东董事、监事及高级管理人员之关系密切的家庭成员亦为发行人曾经的关联自然人，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、曾与公司存在关联关系的关联法人

报告期前 12 个月及报告期内，曾直接或者间接控制发行人的法人或者其他组织，及其直接或者间接控制的除发行人及控股子公司以外其他法人或组织，曾持有发行人 5%以上股份的其他法人或组织，曾直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人，以及曾任发行人董事、高级管理人员、控股股东董事、监事及高级管理人员所直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及控股子公司以外的其他法人或组织，均为发行人曾经的关联法人，主要如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	远致华信	曾持有发行人 5%以上股权
2	穗合投资	曾持有发行人 5%以上股权
3	郑州锦谋	曾持有发行人 5%以上股权
4	哈勃投资	曾持有发行人 5%以上股权
5	重庆锦艺	陈锦魁曾实际控制的企业，2022 年 12 月注销
6	深圳文传房地产开发有限公司	陈锦魁曾担任该公司董事，2025 年 12 月卸任
7	平潭畅祥	陈锦魁持有该企业 88.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，已于 2023 年 4 月 18 日注销
8	强一半导体（苏州）股份有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2026 年 4 月离任
9	北京昂瑞微电子技术股份有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2026 年 4 月离任
10	矽电半导体设备（深圳）股份有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2026 年 4 月离任
11	赛美特信息集团股份有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2025 年 9 月离任
12	巨霖科技（上海）有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2025 年 9 月离任
13	武汉天喻软件有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2025 年 7 月离任
14	海普瑞（常州）洁净系统科技有限公司	公司原董事姜达才曾担任该公司董事，2023 年 9 月离任
15	广东天域半导体股份有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
16	江苏润开鸿数字科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
17	深圳泊松软件技术有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
18	徐州博康化学科技股份有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
19	上海先普科技股份有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
20	重庆励颐拓软件有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事

序号	关联方名称	关联关系
21	苏州同元软控技术股份有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
22	北京特思迪半导体设备有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
23	杰冯测试技术（昆山）有限责任公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
24	苏州烯晶半导体科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
25	广州颖力科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
26	上海九同方技术有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
27	费勉科技（上海）股份有限公司（曾用名：费勉仪器科技（上海）有限公司）	公司原董事姜达才担任该公司董事
28	中科艾尔（北京）科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
29	上海培风图南半导体有限公司（曾用名：苏州培风图南半导体有限公司）	公司原董事姜达才担任该公司董事
30	上海曼光信息科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
31	北京罗迅科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
32	上海立芯软件科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
33	北京新美互通科技有限公司	公司原董事姜达才担任该公司董事
34	江苏晶材颗粒科技有限公司	公司独立董事杨毅担任该公司执行董事、法定代表人，已于 2025 年 5 月卸任
35	苏颗粒科技南京有限公司	公司独立董事杨毅担任该公司执行董事，已于 2024 年 10 月卸任
36	重庆极环涂料涂装有限公司	公司副总经理黄勇峰持有该公司 50.00%的股权，已于 2022 年 7 月注销
37	武汉昱升光电股份有限公司	离职董事杨素忠曾担任该公司董事，已于 2022 年 6 月离任
38	南通山口精工机电有限公司	离职董事杨素忠曾担任该公司董事，已于 2022 年 6 月离任
39	江苏奥华新扬投资有限公司	离职监事徐强担任该公司董事
40	江苏中兴新泰物联网科技园有限公司	离职监事徐强担任该公司董事
41	深圳市车电网络有限公司	离职监事徐强曾担任该公司董事，已于 2022 年 12 月 30 日卸任
42	福建金鑫纺织有限公司	离职董事林子榕持有该公司 74.9126%的股权并担任其董事长兼任总经理
43	东方安贞（北京）医院管理有限公司	曾间接持有发行人 5%以上股权的股东陈航斌担任董事的企业
44	四川时观文化旅游发展有限公司	曾间接持有发行人 5%以上股权的股东陈航斌担任董事的企业
45	四川蒲江锦艺文化旅游开发有限责任公司	曾间接持有发行人 5%以上股权的股东陈航斌担任总经理的企业
46	平潭锦升投资合伙企业（有限合伙）	曾间接持有发行人 5%以上股权的股东陈航斌曾控制该企业，2022 年 6 月注销
47	平潭锦悦投资合伙企业（有限合伙）	曾间接持有发行人 5%以上股权的股东陈航斌曾控制该企业，2022 年 6 月注销

除上述企业外，报告期前 12 个月及报告期内，曾直接或者间接持有发行人

5%以上股份的自然人，以及曾任发行人董事、高级管理人员、控股股东董事、监事及高级管理人员之关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）所直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及控股子公司以外的其他法人或组织，亦为发行人曾经的关联法人。

（四）其他关联方

除上述已披露的关联方之外，发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，其中主要有发行人员工持股平台平潭锦材。

八、关联交易

（一）关联交易汇总表

报告期内，发行人关联交易情况汇总如下：

单位：万元

性质	关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经常性关联交易	锦艺阿泰欧	采购商品	1,534.12	1,295.51	1,053.79
	国锦（广州）电子商务有限公司	采购商品	51.89	41.09	-
	锦艺阿泰欧	销售商品/提供劳务、技术服务	5,846.73	4,129.14	3,471.92
	锦艺阿泰欧	关联租赁	8.56	6.39	13.36
	董事、高管、取消监事会前在任监事	关键管理人员报酬	901.57	719.45	555.44
偶发性关联交易	陈锦魁、广州锦族、云阳锦艺	提供担保	详见本节“八、关联交易”之“（三）一般关联交易”之“2、一般偶发性关联交易”		

（二）重大关联交易

1、重大关联交易的判断标准及依据

根据发行人《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，公司对关联方提供的担保需经公司股东大会审议批准；公司与关联方发生的交易金额（获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上且超过 3,000

万元的交易的关联交易需经公司股东会审议批准。

公司将满足上述标准的关联交易、以及金额虽未达到上述标准但公司认为性质较为重要的关联交易，认定为重大关联交易。

公司单方面获得利益的关联交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等）、公司与控股子公司之间发生的或控股子公司之间发生的交易、关键管理人员薪酬，均为一般关联交易。

2、重大经常性关联交易

报告期内，公司重大经营性关联交易为与合营公司锦艺阿泰欧之间发生的交易往来，具体如下：

单位：万元

关联方名称	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
锦艺阿泰欧	采购商品	1,534.12	1,295.51	1,053.79
	销售商品/提供劳务	5,827.41	3,985.80	3,454.82
	提供技术服务及其他	19.32	143.34	17.11
	关联租赁	8.56	6.39	13.36

（1）销售商品、提供劳务

发行人与全球特种氧化铝行业知名企业 Alteo Holding S.A.S 设立合营公司锦艺阿泰欧，并约定由 Alteo Holding S.A.S 提供优质原材料，发行人提供研发支持和全流程生产加工制造，合营公司锦艺阿泰欧作为销售平台，负责产品运营及营销工作。

报告期内，发行人通过直接销售产成品或结算原材料加工费的方式，向锦艺阿泰欧供应锂电池隔膜功能材料产品，并通过锦艺阿泰欧实现最终销售。报告期各期，发行人对锦艺阿泰欧的关联销售金额分别为 3,454.82 万元、3,985.80 万元和 5,827.41 万元，占发行人营业收入的比例分别为 6.65%、5.47%和 5.63%。

产成品售价方面，由于发行人销售的锂电池隔膜功能材料产品具有定制化特点，锦艺阿泰欧通常根据其与下游客户的市场化议价情况，再与发行人就产品结算的合理价格进行协商确定；材料加工服务定价方面，发行人按照成本加成的方式与锦艺阿泰欧协商确定加工费率，因此关联交易价格具有合理性和公允性。

报告期内，随着公司锂电池隔膜功能材料业务规模扩大及产能增加，以及下游客户需求拉动，发行人对锦艺阿泰欧的关联销售相应呈现上升趋势。

（2）采购商品

报告期内，发行人向合营公司锦艺阿泰欧购买原材料用于加工生产锂电池隔膜功能材料产品。报告期各期，发行人向锦艺阿泰欧的原材料采购金额分别为1,053.79 万元、1,295.51 万元和 1,534.12 万元，占发行人营业成本比例分别为2.92%、2.57%和 2.25%。

报告期内随着发行人锂电池隔膜功能材料业务产销规模扩大，向关联方原材料采购金额相应呈现增长趋势。报告期内公司关联采购占营业成本比重相对较小，对经营成果及主营业务影响有限，双方结合同类原材料交易价格进行友好协商定价，关联交易价格具有公允性。

（3）提供技术服务及其他

报告期内，发行人协助锦艺阿泰欧销售人员持续向下游客户提供产品及技术支持服务、产品检测服务等，因此产生服务费收入。报告期各期，技术服务相关交易额分别为 17.11 万元、143.34 万元和 19.32 万元，占营业收入比重较小，因各年度服务支持频率和内容存在差异，因此各期交易金额存在正常波动。发行人与锦艺阿泰欧以技术服务人工薪酬等为基础协商定价，具有合理性与公允性。

（4）关联租赁

报告期各年，发行人作为出租方对锦艺阿泰欧收取的租金分别为 13.36 万元、6.39 万元和 8.56 万元，系合营企业锦艺阿泰欧向发行人租赁办公场地、存货仓储场地而产生的租赁费用，该等租赁交易价格参照市场价格协商确定，定价具有合理性与公允性。

鉴于发行人未来锂电池隔膜功能材料业务板块将继续保持良好的发展态势，双方将根据市场化的原则持续合作，预计以上各类经常性关联交易将持续发生。

3、重大偶发性关联交易

报告期内，公司未发生重大偶发性关联交易。

（三）一般关联交易

1、一般经常性关联交易

（1）采购商品

报告期内，基于业务招待需要，发行人向国锦（广州）电子商务有限公司采购酒品，2024 年及 2025 年采购额分别为 41.09 万元和 51.89 万元，在发行人成本费用中占比较小。报告期内，国锦（广州）电子商务有限公司对发行人的酒品销售价格与该关联方同类客户市场销售价格基本一致，关联交易价格具有公允性。

（2）向董事、监事、高级管理人员支付薪酬

报告期内，公司向董事、监事（取消监事会前）和高级管理人员支付薪酬情况，具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	901.57	719.45	555.44

2、一般偶发性关联交易

报告期内，公司一般偶发性关联交易为关联担保，发行人均为被担保方，具体如下：

单位：万元

担保方	担保金额	债务履行/发生期限	担保期间	截至报告期末担保是否已经履行完毕
陈锦魁	5,000.00	2019.5.20-2024.4.29	最后一期债务履行期届满之日后两年	否
陈锦魁	3,000.00	2020.8.3-2021.4.21	主债权发生期间届满之日起两年	是
陈锦魁、云阳锦艺	26,000.00	2020.6.10-2027.6.9	债务履行期限届满之日起二年	否
广州锦族	16,000.00	2020.6.10-2027.6.9	债务履行期限届满之日起二年	否
陈锦魁	1,200.00	2020.5.11-2022.5.10	债务履行期限届满之日起二年	是
陈锦魁	2,400.00	2020.8.26-2020.12.31	债务履行期限届满之日起三年	是
陈锦魁	5,000.00	2021.12.14-2022.12.31	应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年或展期期间届满后另加三年	是

担保方	担保金额	债务履行/发生期限	担保期间	截至报告期末担保是否已经履行完毕
陈锦魁	5,000.00	2022.5.11-2023.5.9	债务履行期限届满之日起三年	否
陈锦魁	3,600.00	2022.9.28-2022.12.31	债务履行期限届满之日起三年	是
陈锦魁	5,500.00	2022.11.17-2027.11.17	借款期限届满之次日起三年或借款提前到期之次日起三年	否
陈锦魁	5,000.00	2023.1.5-2024.1.4	应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年或展期期间届满后另加三年	否
陈锦魁、云阳锦艺	31,100.00	2023.11.1-2027.6.9	债务履行期限届满之日起三年	否

（四）关联方往来余额

报告期各期末，发行人与关联方应收款项余额及坏账准备具体情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	锦艺阿泰欧	1,130.29	5.65	1,872.52	9.36	1,802.67	9.01

报告期各期末，发行人与关联方应付账款情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	锦艺阿泰欧	424.72	-	-

（五）关联交易对财务状况和经营成果的影响

发行人具有独立的采购和销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。前述经常性关联交易均为公司日常业务开展所产生的交易、向关键管理人员支付薪酬，偶发性关联交易为关联担保。上述关联交易遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响。

（六）报告期内关联交易履行的程序及独立董事的独立意见

公司召开董事会和股东会，审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度三年关联交易的议案》，关联股东或者董事在审议上述议案时已回

避表决。公司独立董事已就公司报告期内的关联交易情况发表了独立意见，确认公司2023年1月1日至2025年12月31日期间发生的关联交易事项真实、准确、完整，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不存在严重影响公司独立性的情形。报告期内，公司关联交易的审议程序符合现行有效的《公司章程》《关联交易决策制度》等制度安排。

（七）关于规范和减少关联交易的措施

1、建立完善的内部控制及关联交易决策制度

报告期内，公司采取了以下措施规范和减少关联交易：

（1）严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立了独立完整的生产经营系统，人员、财务、资产、业务和机构与股东严格分开；关联交易履行法定的批准程序，股东大会决策时关联股东进行回避。

（2）建立独立董事工作制度，强化对关联交易事项的监督。

（3）按照“公平、公正、公允、合理”原则确定关联交易价格，确保关联交易不损害公司和股东利益。

（4）公司制定《关联交易决策制度》，从关联交易的决策程序与披露等方面严格规范关联交易，以保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

（5）完善相关内部控制制度。

2、减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易作出承诺如下：

“一、本公司/本人已按照法律法规及证监会的有关规定对关联方和关联交易的情况进行了完整、详尽的披露，除已披露的关联交易外，不存在其他按照法律法规及证监会的有关规定需要披露的关联交易事项。

二、本公司/本人将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本公司/本人提供任何形式的违法违规担保。

三、本公司/本人将尽量避免和减少本公司/本人与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。

四、本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人，本公司/本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会、股东会进行关联交易表决时相应的回避程序。

五、本公司/本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本公司/本人同时采取或接受以下措施：

（一）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（二）在股东会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；（三）造成投资者损失的，依法赔偿损失；（四）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

六、本公司/本人承诺自签字盖章之日即行生效并不可撤销。”

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案》，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后新老股东按持股比例共享。

二、发行人股利分配政策

（一）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前，公司主要根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，在弥补亏损和提取公积金后按照股东持有股份比例分配所余税后利润。

本次发行后的利润分配政策根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，进一步完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整程序，并根据公司发展阶段制定了差异化的现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保护。本次发行前后股利分配政策不存在重大差异情况。

（二）本次发行上市后的股利分配政策

2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《公司章程（草案）》及《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，本次首次公开发行股票并上市后，具体利润分配政策详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件 2 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况”之“（二）发行人股利分配政策”。

（三）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由

公司董事会着眼于长远和可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，综合考虑了企业实际情况、未来发展目标、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《公

司上市后三年股东分红回报规划》，对利润分配事项做出了相应的制度性安排，以促进公司的持续稳定健康发展。

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司章程（草案）》及《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，并已提交 2025 年年度股东会审议通过。

（四）发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排

1、利润分配计划的具体内容

发行人所制定的上市后适用的股东回报规划的具体内容包括利润分配的原则、形式、条件和比例、期间间隔、决策程序与机制等内容，与公司章程保持一致，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件 2 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况”之“（二）发行人股利分配政策”。

2、利润分配计划的制定依据

公司上市后三年内的分红回报规划依据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、部门规章和规范性文件所制定，严格履行了董事会及股东会决策程序。制定上述政策时，董事会重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，具体参见本节之“（三）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由”。

3、利润分配计划的可行性

公司上市后三年内的分红回报规划系综合考虑了企业实际情况、未来发展目标、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素所制定，公司具备核心技术自主研发能力，市场开拓能力较强，具备良好的持续盈利能力。报告期内，公司经营情况良好，各年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 6,479.43 万元、8,748.54 万元和 16,354.92 万元，预计未来保持良好的增长势头，公司已经具备进行持续、稳定的利润分配的基础；且公司已建立健全现代企业制度，完善的内部控制组织体系和有效的内部控制制度能够有效保障分红回报规划的执行。综合上述原因，公司利润分配计划具有可行性。

4、公司未分配利润的使用安排

公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情况和需要，主要用于保证公司正常开展业务所需的营运资金、补充公司资本以增强公司资本实力、用于合理业务扩张所需的投资以及其他特殊情况下的需求，具体使用计划安排原则上由董事会根据当年公司发展计划和公司发展目标拟定。

（五）公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素

公司长期回报规划的内容，以及规划制定时的主要考虑因素具体情况参见本节之“二、发行人股利分配政策”之“（四）发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排”。

三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业关于投资者保护的措施

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不属于尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

截至报告期末，除本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”部分已披露的关联交易相关合同外，发行人及其子公司已经履行完毕、正在履行和将要履行的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的重大合同情况如下：

（一）销售合同

报告期内，公司与主要客户签订的已履行、正在履行和将要履行的重大销售合同（指年度销售金额 1,000 万元以上客户的主要框架协议）如下：

序号	客户	合同标的	合同价款（万元）	合同期限/签署日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	台光电子材料（昆山）股份有限公司	超细高纯硅微粉	以定货单为准	2023.01.01-2024.12.31	履行完毕
2	中山台光电子材料有限公司	超细高纯硅微粉	以定货单为准	2023.01.01-2024.12.31	履行完毕
3	台光电子材料股份有限公司	超细高纯硅微粉	以定货单为准	2023.01.01-2024.12.31	履行完毕
4	台光电子材料（黄石）有限公司	超细高纯硅微粉	以定货单为准	2023.01.01-2024.12.31	履行完毕
5	台光电子材料（昆山）股份有限公司（注 1）	以订单为准	以订单为准	2025.01.01-2026.12.31	正在履行
6	锦艺阿泰欧（苏州）锂电池材料科技有限公司	以订单为准	以订单为准	2020.03.01-2025.02.28	履行完毕
7	锦艺阿泰欧（苏州）锂电池材料科技有限公司	以订单为准	以订单为准	2025.03.01-2030.02.28	正在履行
8	广东生益科技股份有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2021.12.01-2023.12.31	履行完毕
9	广东生益科技股份有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2024.01.01-2026.12.31	正在履行
10	南亚新材料科技（江西）有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2021.12.01-2023.12.31	履行完毕
11	南亚新材料科技（江西）有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2024.01.01-2026.12.31	正在履行
12	南亚新材料科技股份有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2021.12.01-2023.12.31	履行完毕
13	南亚新材料科技股份有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2024.01.01-2026.12.31	正在履行
14	苏州天脉导热科技股份有限公司	以订单为准	以订单为准	2025.01.05-2026.01.04	正在履行
15	江西生益科技有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2021.12.01-2023.12.31	履行完毕

序号	客户	合同标的	合同价款（万元）	合同期限/签署日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
16	江西生益科技有限公司	超细高纯硅微粉等	以月定货单为准	2024.01.01-2026.12.31	正在履行
17	深圳比亚迪供应链管理有限公司	生产性物料	以具体订单为准	2020.11.30-2026.11.29（注 2）	正在履行

注：
1、根据合同约定，台光电子材料（昆山）股份有限公司的所有关联公司，包含但不限于台光电子材料股份有限公司、中山台光电子材料有限公司、台光电子材料（黄石）有限公司等依照本合同之规定采购标的物；合同期满前双方无异议自动续约一年。
2、根据框架合同中有关“协议期限”的条款，发行人与深圳市比亚迪供应链管理有限公司的框架合同已自动续期三年。

（二）采购合同

报告期内，公司及子公司签订的已履行、正在履行和将要履行的重大原材料及外协加工采购合同（指年度采购金额 1,000 万元以上供应商的主要框架协议，或单笔金额 1,000 万元以上的采购合同）如下：

序号	供应商	合同标的	合同价款（万元）	合同期限/签署日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	加工服务	以具体订单为准	2019.06.01-2029.05.31	正在履行
2	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	加工服务	以具体订单为准	2019.12.10-2023.05.31	履行完毕
3	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	加工服务	以具体订单为准	2023.05.28-2026.12.30	正在履行
4	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	加工服务	以具体订单为准	2019.12.18-2023.05.31	履行完毕
5	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	加工服务	以具体订单为准	2023.05.28-2026.12.30	正在履行
6	成都大邑汇辰玻璃压制厂	原材料	以具体订单为准	2018.12.15-2027.09.14	正在履行
7	青岛三锐佰德新材料有限公司	原材料	1,425.00	2023.03.16-2023.12.31	履行完毕
8	青岛三锐佰德新材料有限公司	原材料	2,550.00	2024.01.19-2024.12.31	履行完毕
9	青岛三锐佰德新材料有限公司	原材料	以具体订单为准	2025.03.01-2025.06.30	履行完毕
10	青岛三锐佰德新材料有限公司	原材料	1,600.00	2025.12.29	正在履行
11	宜兴市优利特电器元件有限公司	加工服务	以具体订单为准	2025.01.01-2025.12.31	履行完毕
12	连云港航阔新材料有限公司	原材料	以具体订单为准	2022.11.01-2023.11.30	履行完毕
13	连云港航阔新材料有限公司	原材料	以具体订单为准	2024.01.01-2024.12.31	履行完毕

序号	供应商	合同标的	合同价款（万元）	合同期限/签署日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
14	安徽正锐新材料科技有限公司	加工服务	以具体订单为准	2025.08.01-2026.12.30	正在履行
15	阿泰欧法铝业（上海）有限公司（Alteo Shanghai Co., Ltd）	原材料	1,128.60	2024.10.14	履行完毕
16	惠源（上海）化工有限公司	原材料	1,842.75	2025.06.26	正在履行
17	惠源（上海）化工有限公司	原材料	2,320.00	2025.06.26	正在履行

（三）银行借款及授信合同

1、借款合同

报告期内，公司与银行签订的已履行、正在履行和将要履行的合同金额在 2,000 万元及以上或其他对公司业务经营有重要影响的银行借款合同如下：

序号	借款方	合同编号	贷款银行	借款金额（万元）	借款期限	担保方式	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	锦艺新材	中银（常熟）贷字（2019）年第 075 号	中国银行常熟分行	5,000.00	2019.05.20-2024.04.29	实际控制人提供连带责任保证，不动产抵押担保	履行完毕
2	锦艺新材	SZJY202005250001	农业银行常熟分行	16,000.00（注 1）	2020.06.10-2027.06.09	实际控制人、云阳锦艺提供最高额保证，广州锦族提供连带责任保证，不动产抵押担保	正在履行
3	功能材料	中银（常熟）贷字（2023）年第 0529 号	中国银行常熟分行、建设银行常熟分行、农业银行常熟分行	46,000.00（注 2）	2023.12.21-2031.06.21	不动产抵押担保	正在履行

注：
1、2023 年 1 月 8 日，公司与银行签订《人民币 1.6 亿元固定资产借款合同补充协议》，将借款分次提款期限延长至 2024 年 12 月 31 日；公司与农业银行签订的《固定资产借款合同》的借款金额 16,000.00 万元系最高借款额度，截至 2025 年 12 月 31 日，公司借款余额为 5,859.45 万元；
2、子公司功能材料与银团签订的《固定资产银团贷款合同》的借款金额 46,000.00 万元系最高借款额度，截至 2025 年 12 月 31 日，功能材料借款余额为 20,205.83 万元。

2、授信合同

报告期内，公司与银行签订的已履行、正在履行和将要履行的合同金额在

2,000 万元及以上或其他对公司业务经营有重要影响的银行授信情况如下：

序号	被授信人	合同编号	授信银行	授信额度（万元）	授信期间	担保方式	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	锦艺新材	512XY2023000942	招商银行苏州分行	5,000.00	2023.01.05-2024.01.04	最高额保证	履行完毕
2	锦艺新材	512XY2024001783	招商银行苏州分行	5,000.00	2024.01.12-2025.01.11	不涉及	履行完毕
3	锦艺新材	512XY250123T000140	招商银行苏州分行	5,000.00	2025.01.23-2026.01.22	不涉及	正在履行
4	锦艺新材	2023 银信字/第 JYXC 号	中信银行苏州分行	3,000.00	2023.08.04-2024.08.04	不涉及	履行完毕
5	锦艺新材	2024 苏银信 e 融字/第 CS20240710256153 号	中信银行苏州分行	3,000.00	2024.08.28-2025.08.06	不涉及	履行完毕
6	锦艺新材	2025 苏银信字第 CS20250721154419 号	中信银行苏州分行	5,000.00	2025.08.29-2026.08.19	不涉及	正在履行
7	锦艺新材	（2024）苏银字第 000049 号	广发银行苏州分行	25,000.00（注 1）	2024.03.07-2024.12.28	不涉及	履行完毕
8	锦艺新材	（2025）苏银综授额字第 000094 号	广发银行苏州分行	25,000.00（注 2）	2025.03.28-2026.03.13	不涉及	正在履行
9	锦艺新材	中银（常熟）授字（2024）年第 0106 号	中国银行常熟分行	10,000.00	2025.01.07-2025.09.26	不涉及	履行完毕
10	锦艺新材	中银（常熟）授字（2025）年第 0133 号	中国银行常熟分行	10,000.00	2025.11.21-2026.09.14	不涉及	正在履行

注：
1、广发银行苏州分行向发行人提供的授信额度最高限额为 25,000 万元，授信额度敞口最高限额为 5,000 万元。
2、广发银行苏州分行向发行人提供的授信额度最高限额为 25,000 万元，授信额度敞口最高限额为 5,000 万元。

（四）建设工程施工合同

报告期内，公司及子公司签订的 2,000 万元以上的重大建设工程施工合同如下：

序号	签订主体	供应商	合同主要内容	合同金额（万元）	签署日期	截至 2025 年 12 月 31 日履行情况
1	功能材料	江苏筑永建设工程有限公司	功能性纳米粉体新材料新建项目	10,000.00（注 1）	2023.12.02	正在履行
2	山东锦艺	嘉林建设集团有限公司	高端无机电子专用新材料制造及研发中心实验室建设项目	2,782.31（注 2）	2024.06.01	正在履行
3	功能材料	中国化学工程第六建设有限公司	设备、管道、电仪等安装工程	2,150.00（注 3）	2025.08.08	正在履行

注：
1、工程暂定合同含税价款为 10,000.00 万元，最终合同总价按合同约定的计价办法按竣工图

按实结算；
2、合同暂定含税价款包含主合同价款 2,600.00 万元及补充协议增补工程价款 182.31 万元，结算总价根据实际验收结算；
3、工程暂定合同含税价款为 2,150.00 万元，最终以双方书面认可的工程量清单为依据结算。

（五）重大合同对发行人的影响及存在的风险

报告期内，发行人签署的重大合同主要涉及正常生产经营活动，不存在对发行人构成重大不利影响的潜在风险和纠纷。

二、对外担保

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司不存在对外担保情况。

三、重大诉讼及仲裁事项

（一）公司及子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司不存在尚未结案或尚未执行完毕的重大诉讼、仲裁案件。报告期内发行人及其子公司不存在其他对发行人产生较大影响的诉讼、仲裁，也不存在报告期外发生但仍对发行人产生较大影响的诉讼、仲裁。

（二）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

根据发行人提供的资料，报告期内发行人实际控制人不存在尚未结案或尚未执行完毕的重大诉讼、仲裁案件。发行人控股股东、董事、监事（取消监事会前）、高级管理人员和其他核心人员不存在其他对发行人产生较大影响的诉讼、仲裁事项。

四、违法违规情况

（一）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的违法行为

最近三年，发行人董事、监事（取消监事会前）、高级管理人员和其他核心人员均未涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

（二）控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，发行人的控股股东、实际控制人均不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

第十一节 声明

一、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈锦魁　　郑家强　　黄云余

贾　波　　张乐伟　　唐靖炎

杨　毅　　赵晓明

全体审计委员会成员签名：

赵晓明　　唐靖炎　　杨毅

非董事高级管理人员签名：

黄勇峰　　胡林政　　佟　刚

苏州锦艺新材料科技股份有限公司（盖章）

2026年 6月23日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司（或本人）承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：广州锦族新材料投资有限公司（盖章）

控股股东之法定代表人（签字）：

陈锦魁

发行人实际控制人（签字）：

陈锦魁

2026年 6 月 23 日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

陈 翔

保荐代表人：

姚 思 宋 亮

法定代表人：

张纳沙

国信证券股份有限公司

2016年6月23日

保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读苏州锦艺新材料科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：

邓 舸

董事长：

张纳沙

国信证券股份有限公司

2016 年 6 月 23 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

负责人：

沈国权

经办律师：

孙亦涛 陈 嵩 王舒庭

上海市锦天城律师事务所

2026年 6 月 25 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读苏州锦艺新材料科技股份有限公司的招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州锦艺新材料科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供苏州锦艺新材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

会计师事务所负责人签名：

刘维

签字注册会计师签名：

郑纪安

何厚泉

李平

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年6月23日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

梁 熙　　佘韩烁（已离职）

资产评估机构负责人：

陈喜佟

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

2026年 6 月 23 日

关于签字资产评估师离职的说明

本机构作为苏州锦艺新材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的资产评估机构，于 2021 年 10 月 1 日出具了《苏州锦艺新材料科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第 A0757 号），签字资产评估师为佘韩烁、梁熙，现将资产评估相关情况说明如下：

截至本说明书出具之日，佘韩烁因个人原因已于 2022 年 8 月 1 日从本公司离职，故苏州锦艺新材料科技股份有限公司本次发行声明文件中资产评估机构声明无签字资产评估师佘韩烁的签名，佘韩烁的离职不影响本机构出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人签名：

陈喜佟

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

2026年 6 月 23 日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州锦艺新材料科技股份有限公司的招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告（容诚专字[2026]215Z0048 号）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

刘维

签字注册会计师签名：

郑纪安

何厚泉

李平

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年 6月 23日

第十二节 附件

一、备查文件

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书》的规定，以下文件为本招股说明书备查文件及附件：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况；

（十三）募集资金投资项目具体情况；

（十四）子公司、参股公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

（一）查阅时间

工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

（二）查阅地点

1、发行人：苏州锦艺新材料科技股份有限公司

联系地址：常熟市碧溪街道兴港路 25-1 号

联系人：黄云余

联系电话：0512-52653039

传真：0512-52653039

2、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区国信金融大厦 35 楼

联系人：宋亮

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82131766

除以上查阅地点外，投资者可以登录证券交易所指定网站，查阅《招股说明书》等电子文件。

附件 1 与投资者保护相关的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、发行人控股股东广州锦族承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司首发前股份，也不由公司回购该等股份。

（2）公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（3）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本公司届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本公司届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本公司届时所持股份锁定期限 6 个月。“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准。“届时所持股份”是指本公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

（4）如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所对上述锁定期安排另有特别规定或有更严格要求的，本公司将按照监管机构的相关规定或要求执行。

（5）本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，同时本公司在锁定期满后减持将严格遵守相关法律、法规及深圳证券交易所规范性文件的规定，并及时、准确地履行信息披露义务。

（6）如本公司违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本公司自行承担。

（7）本承诺函所述承诺事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司将依法承担相应责任。

2、发行人实际控制人、董事长、总经理陈锦魁承诺

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首发前股份，也不由公司回购该等股份。

（2）上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守上述限制性规定。同时，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行价。

（3）公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（4）发行人存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人将不会减持发行人股份。

（5）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准。“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

（6）本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事、

高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（7）如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

3、发行人股东杭州泽涵等 24 名最新 12 个月内新增股东承诺

发行人股东杭州泽涵、尚融投资、君安勇诚、华泰渝富、嘉兴萃英、君安嘉平、宁波甬诚、华泰产发、苏州创投、广发信德、常熟创投、福州创科、合肥经韬、东方富海三号、厦门经韬、嘉兴经韬、苏州致兴、苏州致盛、福建创盈、尚融聚鑫、苏州卓璞、共青城智晟、成都建鑫、南京厚盈作出承诺如下：

（1）自本企业取得发行人股份之日 36 个月内或自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所对上述锁定期安排另有特别规定或有更严格要求的，本企业将按照监管机构的相关规定或要求执行。

（3）本企业在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及深圳证券交易所规范性文件的规定，并及时、准确地履行信息披露义务。

（4）本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业将依法承担相应责任。

4、发行人股东平潭锦新、哈勃投资、远致华信、穗合投资、平潭锦材、晨道投资、哇牛制享、百瑞信托、常熟经开、欣亿源、超兴创投、信福汇十二号、苏州时点、信福汇四号承诺

发行人股东平潭锦新、哈勃投资、远致华信、穗合投资、平潭锦材、晨道投

资、哇牛制享、百瑞信托、常熟经开、欣亿源、超兴创投、信福汇十二号、苏州时点、信福汇四号作出承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所对上述锁定期安排另有特别规定或有更严格要求的，本企业将按照监管机构的相关规定或要求执行。

（3）本企业在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及深圳证券交易所规范性文件的规定，并及时、准确地履行信息披露义务。

（4）本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业将依法承担相应责任。

5、发行人股东星火投资承诺

发行人股东星火投资作出承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）就本企业在 2026 年 5 月股份转让中取得的 1,200,000.00 股股份，自取得之日起 36 个月内或自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（3）如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所对上述锁定期安排另有特别规定或有更严格要求的，本企业将按照监管机构的相关规定或要求执行。

（4）本企业在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及深圳证券交易所规范性文件的规定，并及时、准确地履行信息披露义务。

（5）本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，

对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业将依法承担相应责任。

6、发行人股东国投创业基金承诺

发行人股东国投创业基金作出承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；

（2）本承诺出具后，如有新的法律、法规、证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以届时有效的新的法律、法规、证券交易所规范性文件规定为准。

7、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员的承诺

除陈锦魁外，间接持有发行人股份的董事、高级管理人员黄勇峰、黄云余、胡林政作出承诺如下：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首发前股份，也不由公司回购该等股份。

（2）上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守上述限制性规定。同时，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行价。

（3）公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（4）发行人存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之

日起至发行人股票终止上市前，本人将不会减持发行人股份。

（5）本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（6）如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

8、间接持有发行人股份的监事（取消监事会前）的承诺

间接持有发行人股份的取消监事会前在任监事林智睿作出承诺如下：

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首发前股份，也不由公司回购该等股份。

2、上述股份锁定期届满后，本人在公司担任董事/高级管理人员职务期间每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守上述限制性规定。

3、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、发行人存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人将不会减持发行人股份。

5、本人将严格遵守法律法规以及深圳证券交易所业务规则对股份转让的规定，若相关规定发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承

诺。

6、如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

（二）本次公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺

1、发行人控股股东广州锦族承诺

（1）本公司已作出关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前持有的发行人股份，本公司拟长期持有发行人股票。

（2）上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：

①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满；

②如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经依法承担赔偿责任。

（3）如果在锁定期届满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

（4）本公司在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）；减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。

（5）本公司拟减持发行人股票的，将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，及时、准确地履行必要的信息披露义务。

（6）如果本公司未履行上述承诺，本公司将在发行人股东会及中国证监会

指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉，本公司持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持，且本公司应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给发行人或其他股东因此造成的损失。

2、发行人实际控制人陈锦魁承诺

（1）本人已作出关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前持有的发行人股份，本人拟长期持有发行人股票。

（2）上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：

①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满；

②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。

（3）如果在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

（4）本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）；减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。

（5）本人拟减持发行人股票的，将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，及时、准确地履行必要的信息披露义务。

（6）如果本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉，本人持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持，且本人应将违反

承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给发行人或其他股东因此造成的损失。

3、发行人持股 5%以上股东国投创业基金承诺

发行人持股 5%以上股东国投创业基金作出承诺：

（1）如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，本企业在作为锦艺新材股东期间将认真遵守《公司法》《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后实施减持；

（2）本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（3）本承诺出具后，如有新的法律、法规、证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以届时有效的新的法律、法规、证券交易所规范性文件规定为准。

4、发行人持股 5%以上股东平潭锦新、杭州泽涵、君安嘉平承诺

发行人持股 5%以上股东平潭锦新、杭州泽涵、君安嘉平作出承诺：

（1）本公司已作出关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前持有的发行人股份。

（2）上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：

①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满；

②如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司及其出资人已经依法承担赔偿责任。

（3）如果在锁定期届满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

（4）本公司在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增

股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）；减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。

（5）本公司拟减持发行人股票的，将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，及时、准确地履行必要的信息披露义务。

（6）如果本公司未履行上述承诺，本公司将在发行人股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉，本公司持有的发行人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持，且本公司应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给发行人或其他股东因此造成的损失。

（三）关于稳定股价的承诺

1、稳定股价的预案

按照发行人 2025 年度股东会审议通过的《关于制定公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》，主要内容为：

（1）预案的有效期

本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

（2）启动和停止本预案的条件

1、启动条件

公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则按照优先顺序依次触发公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。

2、停止条件

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）；

（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

（3）本预案的具体措施

1、公司回购

（1）公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东会审议，回购方案经公司股东会审议通过后生效。

但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

（2）在股东会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，并办理审批或备案手续。

公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

（3）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应同时遵循以下原则：①单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；且②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年

度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

2、控股股东及实际控制人增持

（1）若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司控股股东及实际控制人增持股份的义务。

（2）在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东及实际控制人应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

（3）公司控股股东及实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东及实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于增持股份的资金金额不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；且②单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不

再计入累计现金分红金额。

3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持

（1）若公司控股股东及实际控制人未在触发增持股份义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东及实际控制人增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期末经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份的义务。

（2） 不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

（3）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果公司披露其买入计划 3 个交易日内或实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上述增持公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；且②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（4）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众道歉。

公司控股股东及实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果控股股东及实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本单位现金分红予以扣留或扣减。

公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。

（5）本预案的法律程序

如因法律法规修订或政策变动等情形导致预案与相关规定不符，公司应对预案进行调整的，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、稳定股价的承诺

（1）公司关于稳定股价的承诺

公司就稳定股价作出如下承诺：

一、公司承诺，公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，公司将按照《苏州锦艺新材料科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“稳定股价的预案”）的相关要求，

切实履行该预案所述职责。

二、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：

（一）公司将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，向本公司投资者提出补充方案或替代方案，以尽可能保护投资者的权益，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（二）公司将扣留控股股东、实际控制人当年及其后年度现金股利，停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按稳定股价的预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕或股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的。

（三）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（四）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

（2）控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺

公司控股股东、实际控制人就稳定股价作出如下承诺：

一、本公司/本人承诺，发行人股票上市后三年内，若发行人股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持发行人股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，本公司/本人将积极配合发行人按照《苏州锦艺新材料科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责。

二、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司/本人未按照上述预

案采取稳定股价的具体措施，本公司/本人同意采取下列约束措施：

（一）本公司/本人将在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

（二）如本公司/本人负有增持股票义务，但未提出或未实施增持计划的，将由发行人及时公告本公司/本人未履行承诺的事实及原因，除不可抗力或其他非归属于发行人股东的原因外，本公司/本人将在未履行承诺的事实发生之日后 10 个工作日起，不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付本公司/本人的现金红利予以扣留，不转让所持有的发行人股份，直至本公司/本人采取相应的措施并实施完毕时为止。

（三）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本公司/本人在一定时期内无法履行增持义务的，本公司/本人可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

（3）董事（不包括外部董事和独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺

公司董事（不包括外部董事和独立董事）、高级管理人员就稳定股价作出如下承诺：

一、本人承诺，公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，本人将积极配合公司按照《苏州锦艺新材料科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责。

二、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：

（一）本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（二）如本人负有增持股票义务，但未提出或未实施增持计划的，则由公司及时公告本人未履行承诺的事实及原因，除不可抗力或其他非归属于公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的原因外，本人承诺向公司按如下公式支付现金补偿：本人最低增持金额（即本人上年度薪酬总和的 20%）减去本人实际增持股票金额（如有）。若本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减应向本人支付的报酬直至本人承诺履行完毕。在公司稳定股价措施实施期间，本人将不转让所持有的公司股份。

（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、公司关于欺诈发行上市的股份购回的承诺

公司对欺诈发行上市的股份购回事宜作出承诺如下：

（1）本公司保证本公司本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

2、控股股东关于欺诈发行上市的股份购回的承诺

公司控股股东对欺诈发行上市的股份购回事宜作出承诺如下：

（1）本公司保证发行人本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次发行的全部新股。

3、实际控制人关于欺诈发行上市的股份购回的承诺

公司实际控制人对欺诈发行上市的股份购回事宜作出承诺如下：

（1）保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将配合公司在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司关于填补被摊薄即期回报的承诺

公司就填补被摊薄即期回报事宜承诺如下：

（1）积极发展现有业务，巩固市场地位，提升核心竞争力

公司将在稳固现有市场和客户的基础上，进一步加强现有业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的经营规模，提高公司盈利规模；公司将加强研发力度，推动产品升级及新产品开发，通过不断推动现有产品的换代升级巩固并扩大市场份额，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，扩大品牌影响力，从而实现企业经济效益、社会效益、规模及综合实力的提升。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，随着募集资金投资项目的落地，公司业务规模和盈利能力将迎来进一步提升。

（2）提高日常运营效率、努力降本增效

公司将坚持以效率为中心，科学合理调配资源，加强生产运营、安全运行等方面的管理，健全供应商、客户服务管理体系，提高运营效率。公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。公司将完善薪酬和激励机制，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

（3）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《苏州锦艺新材料股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，严格控制募集资金使用的各个环节，确保募集资金合理有效使用。

（4）严格执行股利分配政策，优化投资回报制度

公司制定了《苏州锦艺新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，在对未来经营绩效合理预计的基础上，制定了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行《苏州锦艺新材料科技股份有限公司章程（草案）》及股东回报规划文件中的利润分配政策，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，保持利润分配政策的连续性与稳定性。

2、公司控股股东关于填补被摊薄即期回报的承诺

公司控股股东就填补被摊薄即期回报事宜承诺如下：

（1）不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

（2）本承诺出具日后至发行人本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本公司承诺届时将按中国证监会和深圳证券交易所发布的新规出具补充承诺。

（3）作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

（4）若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、公司实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

公司实际控制人就填补被摊薄即期回报事宜承诺如下：

（1）督促公司切实履行填补被摊薄即期回报的措施；

（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（3）承诺对本人作为董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（4）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（5）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）若公司后续推出股权激励的，承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求；

（8）本承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并将依法承担补偿责任。

4、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

公司董事、高级管理人员就填补被摊薄即期回报事宜承诺如下：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺支持董事会制定薪酬制度时，与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺若公司未来实施股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本人承诺届时将按中国证监会和深圳证券交易所发布的新规出具补充承诺；

（7）如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东会及中国证监会、深圳证券交易所指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若

因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（六）利润分配政策的承诺

公司就利润分配政策承诺如下：

一、本次发行及上市后，公司将严格遵守并执行《苏州锦艺新材料科技股份有限公司章程（草案）》及《公司上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配政策的相关规定。

二、若公司违反上述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

《公司上市后三年股东分红回报规划》具体如下：

“（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。其中，现金股利政策目标剩余股利，制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或最近一个会计年度末资产负债率高于 70%，或最近一个会计年度经营活动产生的现金流量净额为负数，或出现法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则等规定的其他情形时，可以不进行利润分配。

（二）利润分配的形式

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（三）现金分红的条件和比例

1、在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且未出现本议案第（一）款所述“可以不进行利润分配”的情形，公司应当进行现金分红；在公司应当进行现金分红的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%（以现金方式要约回购股份的资金视同为现金分红）。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

3、上述重大投资计划或重大现金支出是指：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；或

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或

（3）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过人民币 3,000 万元。

（四）股票股利分配的条件

在综合考虑公司成长性、盈利规模、现金流状况和资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东会审议通过。

（五）利润分配的期间间隔

公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（六）公司利润分配（含现金分红）的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

2、公司每年利润分配预案经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准。

3、公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

4、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或者最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审计委员会应当对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（七）公司利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

（八）调整公司利润分配政策（含现金分红）的决策程序和机制

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。”

（七）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

1、公司依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

公司就依法承担赔偿或赔偿责任作出如下承诺：

（1）如公司招股说明书及其他信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东会。公司将根据股东会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

（2）如公司违反上述承诺，公司将在股东会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（3）如公司招股说明书及其他信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行。

（4）上述承诺为公司真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。

2、公司控股股东关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

公司控股股东就依法承担赔偿或赔偿责任作出如下承诺：

（1）公司的招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若发行人本次发行的招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司承诺将督促发行人按照如下方式依法回购本次发行的全部新股，并在股东会审议过程中投赞成票：

在中国证监会或者其他有权部门认定发行人招股说明书及其他信息披露文件存在本款前述违法违规情形之日起的 20 个交易日内，发行人将根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东会，启动股份回购措施，回购价格为发行人本次发行时的发行价（如因派发现金红利、送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管部门、深圳证券交易所的有关规定进行相应调整）加上自本次发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息。发行人应在上述股份回购义务触发之日起 3 个月内完成回购。

（3）若发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失：

①在中国证监会或者其他有权部门认定发行人本次发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 20 个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

②投资者损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案为准。

3、公司实际控制人关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

公司实际控制人就依法承担赔偿或赔偿责任作出如下承诺：

（1）如公司招股说明书及其他信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本承诺人也将购回公司上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

（2）如本承诺人违反上述承诺，则将在公司股东会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因，并在违反上述承诺之日起停止在公司领取分红（如有），同时本承诺人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

（3）如公司招股说明书及其他信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本承诺人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行。

（4）上述承诺为本承诺人真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本承诺人将依法承担相应责任。

4、公司董事、审计委员会成员、高级管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

公司董事、审计委员会成员、高级管理人员就依法承担赔偿或赔偿责任作出如下承诺：

（1）公司的招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若发行人本次发行的招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：

①有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

②本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

（3）本人将不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

（八）关于公司本次发行在审期间不进行现金分红的承诺

发行人关于公司本次发行在审期间不进行现金分红的承诺如下：

（1）公司首次公开发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有；

（2）在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市的申报受理后至本公司股票在深圳证券交易所上市前不进行现金分红或提出现金分红的方案。

（3）上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

（九）其他承诺

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定

发展，公司控股股东、实际控制人已出具不可撤销的《关于避免与发行人同业竞争的申明与承诺》。

（1）控股股东承诺

一、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与发行人及其控制的企业之间不存在直接或间接的同业竞争情形。

二、在作为发行人控股股东期间，本公司不会在中国境内或境外以任何方式从事直接或间接对发行人及其控制的企业的经营构成同业竞争的相关业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式从事直接或间接对发行人及其控制的企业的经营构成同业竞争的相关业务或活动。

三、为了更有效地避免未来本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与发行人及其控制的企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：

（一）通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不直接或间接从事与发行人及其控制的企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（二）如本公司获得与发行人及其控制的企业相同或相似的业务机会，且该机会可能直接或间接导致本公司与发行人及其控制的企业产生同业竞争，本公司将于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会优先让予发行人及其控制的企业；

（三）如本公司直接或间接控制的其他企业获得与发行人及其控制的企业相同或相似的业务机会，本公司将通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，尽最大努力将相竞争的业务机会优先让予发行人及其控制的企业。

四、本承诺函自本公司签署之日起生效，并在发行人有效存续且本公司作为发行人控股股东期间持续有效。

（2）实际控制人承诺

一、截至本承诺作出之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业与公司及

其控制的企业之间不存在直接或间接的同业竞争情形。

二、在作为公司实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式从事直接或间接对公司及其控制的企业的经营构成同业竞争的相关业务或活动；本人亦将促使本人直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式从事直接或间接对公司及其控制的企业的经营构成同业竞争的相关业务或活动。

三、为了更有效地避免未来本人及本人直接或间接控制的其他企业与公司及其控制的企业之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：

（一）通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不直接或间接从事与公司及其控制的企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（二）如本人获得与公司及其控制的企业相同或相似的业务机会，且该机会可能直接或间接导致本人与公司及其控制的企业产生同业竞争，本人将于发现该业务机会后立即通知公司，并尽最大努力促使该业务机会优先让予公司及其控制的企业；

（三）如本人直接或间接控制的其他企业获得与公司及其控制的企业相同或相似的业务机会，本人将通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，尽最大努力将相竞争的业务机会优先让予公司及其控制的企业。

四、本承诺函自本人签署之日起生效，并在公司有效存续且本人作为公司实际控制人期间持续有效。

2、关于规范和减少关联交易的承诺

发行人控股股东广州锦族及实际控制人陈锦魁出具了《减少和规范关联交易的承诺》，具体内容详见本招股说明书“第八节　公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（七）关于规范和减少关联交易的措施”之“2、减少和规范关联交易的承诺”。

3、关于股东信息披露的承诺

公司就公司相关股东的情况承诺如下：

（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；

（2）截至招股说明书签署之日，本公司不存在股权代持、委托持股、信托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

（3）截至招股说明书签署之日，本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

（4）公司为本次公开发行股票并在创业板上市所聘请的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；

（5）本公司不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。

本公司已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，并依法履行了信息披露义务。本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

（十）关于未能履行承诺时约束措施的承诺

1、发行人未能履行承诺时的约束措施

“一、在股东会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

二、向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者权益；

三、停止制定或实施重大资产重组、增发股份等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；

四、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、审计委员会成员、高级管理人员调减或停发薪酬、津贴；

五、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”

2、公司控股股东广州锦族承诺

“一、本公司若未能履行发行人招股说明书中披露的本公司作出的公开承诺事项的，在股东会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

二、给公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

三、向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（需按法律、法规、公司章程等的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

四、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

五、如未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

3、公司实际控制人陈锦魁承诺

“一、本人若未能履行公司招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

二、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

三、暂不领取公司应支付的薪酬或者津贴；

四、给公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

五、如未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

4、公司董事、审计委员会成员和高级管理人员承诺

“一、本人若未能履行公司招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

二、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

三、暂不领取公司应支付的薪酬或者津贴；

四、给公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

五、如未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

5、持股 5%以上股东平潭锦新、杭州泽涵、君安嘉平承诺

“一、本公司若未能履行发行人招股说明书中披露的本公司作出的公开承诺事项的，在股东会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

二、给公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

三、向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（需按法律、法规、公司章程等的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

四、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

五、如未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

6、持股 5%以上股东国投创业基金承诺

“1、通过公司及时披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向公司股东、社会公众投资者道歉；

2、向公司及其投资者提出变更承诺、补充承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本企业在股东会审议该事项时回避表决；

3、将本企业违反承诺所得收益归属于公司。

如因本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本企业将对公司或投资者依法承担赔偿责任。”

附件 2 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）投资者关系的主要安排

1、信息披露制度和流程

公司结合实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《公司章程》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件制定了相关信息披露管理制度，对公司信息

披露的基本原则、内容、应披露的交易和其他重大事件、程序、媒体、责任划分、保密措施等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。

本次公开发行股票上市后，公司将严格按照规定开展信息披露工作，根据法律、法规、规章、本制度以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，确保信息披露的内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保所有投资者可以平等获取信息。

2、投资者沟通渠道的建立情况

公司首次公开发行股票并在创业板上市后，将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整地报送及披露信息。

公司投资者关系管理工作在董事会领导下开展工作，董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，公司设置了联系电话、电子邮件等投资者沟通渠道，并将积极采取定期报告和临时公告、业绩说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等多样化方式开展与投资者沟通工作。

3、未来开展投资者关系管理的规划

本次发行上市后，公司将严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件以及相关信息披露管理制度、投资者关系管理制度等内部制度的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度，为投资者获取信息、参与重大决策、选择管理者等方面提供制度保障，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保护投资者权益。

同时，公司将不断提高投资者关系管理工作的专业性，加强公司与投资者之间的良性互动，尽力满足符合法律法规等相关规定的投资者信息获取需求，尽快妥善答复投资者对公司相关情况的咨询，促进公司与投资者间的双向沟通，实现公司整体利益最大化。公司也将不断完善投资者关系管理工作机制，强化投资者

关系管理工作考核，加强对相关人员业务培训，保证服务工作质量，不断提升投资者关系管理水平。

（二）发行人股利分配政策

1、发行人本次发行前的股利分配政策

公司的股利分配严格执行有关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报。根据《公司法》和《公司章程》，公司本次发行前的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。股东会对利润分配方案作出决议后，董事会应当在股东会决议作出之日起六个月内进行分配。

2、发行人本次发行后的股利分配政策

根据公司第二届董事会第六次会议及 2025 年度股东会通过的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”），本次发行后，公司的股利分配政策如下：

（1）公司章程中利润分配相关规定

第一七一条 公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润，具体利润分配政策如下：

（一）利润分配的基本原则：

1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

公司将严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东会审议该议案时应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）利润分配的时间间隔：

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会根据公司盈利和资金状况可以提议公司进行中期现金分配。

（五）公司利润分配的决策程序和机制：

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会在审议现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

1、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和审计委员会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。

利润分配预案经二分之一以上独立董事及审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策

的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和审计委员会的审核意见。

董事会制订利润分配方案前以及股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、邮件、投资者互动平台、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（六）公司利润分配方案的实施：

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（七）调整公司利润分配政策的决策程序和机制：

1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。

2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东会批准。股东

会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）分红回报规划主要内容

“（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。其中，现金股利政策目标剩余股利，制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或最近一个会计年度末资产负债率高于 70%，或最近一个会计年度经营活动产生的现金流量净额为负数，或出现法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则等规定的其他情形时，可以不进行利润分配。

（二）利润分配的形式

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（三）现金分红的条件和比例

1、在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且未出现本议案第（一）款所述“可以不进行利润分配”的情形，公司应当进行现金分红；在公司应当进行现金分红的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%（以现金方式要约回购股份的资金视同为现金分红）。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下

列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

3、上述重大投资计划或重大现金支出是指：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；或（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或（3）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过人民币 3,000 万元。

（四）股票股利分配的条件

在综合考虑公司成长性、盈利规模、现金流状况和资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东会审议通过。

（五）利润分配的期间间隔

公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（六）公司利润分配（含现金分红）的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

2、公司每年利润分配预案经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准。

3、公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

4、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或者最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审计委员会应当对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（七）公司利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

（八）调整公司利润分配政策（含现金分红）的决策程序和机制

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由审计委员会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东会批准。股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

（三）发行人股东投票机制的建立情况

公司目前已按照证监会的有关规定建立了累积投票制、中小投资者单独计票机制、网络投票制等股东投票机制，发行上市后，公司将进一步完善股东投票机制，充分保障投资者参与公司决策的权利。

1、累积投票制

根据《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》的规定，股东会选举两名以上非独立董事，或者股东会选举两名以上独立董事时，根据公司章程的规定，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事（含独立董事）时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

2、中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、股东大会网络投票方式

根据《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》的规定，股东会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司还可提供安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东会提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明表决时间以及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。

4、征集投票权

根据《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》的规定，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律法规设立的投资者

保护机构可以公开征集提案权、表决权等股东权利。征集人应当依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定充分披露股东作出授权委托所必需的信息、征集进展情况和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。

附件 3 股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

自股份制公司成立以来，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，制定和完善了公司相关内部控制制度，公司建立了股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度和董事会各专门委员会制度，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

（一）股东会的制度建立健全及运行情况

1、建立及职权

2021 年 11 月 2 日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会。

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中约定了股东大会的职责、权限及基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，股东大会是公司的最高权力机构。

2、运行情况

报告期内，历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

发行人在有限公司阶段共召开 6 次股东会，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	出席会议情况
1	有限公司 2019 年第一次临时股东会	2019.06.19	全体 5 名股东出席
2	有限公司 2020 年第一次临时股东会	2020.09.10	全体 5 名股东出席

序号	会议名称	会议时间	出席会议情况
3	有限公司 2020 年第二次临时股东会	2020.09.11	全体 13 名股东出席
4	有限公司 2020 年第三次临时股东会	2020.12.20	全体 14 名股东出席
5	有限公司 2021 年第一次临时股东会	2021.08.03	全体 14 名股东出席
6	有限公司 2021 年第二次临时股东会	2021.10.17	全体 14 名股东出席

股份制公司阶段，公司已召开 14 次股东（大）会，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	出席会议情况
1	股份公司创立大会暨首次股东大会	2021.11.02	全体 14 名股东出席
2	股份公司 2021 年第一次临时股东大会	2021.12.16	全体 22 名股东出席
3	股份公司 2022 年第一次临时股东大会	2022.03.31	全体 22 名股东出席
4	股份公司 2021 年度股东大会	2022.06.22	全体 22 名股东出席
5	股份公司 2022 年第二次临时股东大会	2022.09.06	全体 22 名股东出席
6	股份公司 2022 年第三次临时股东大会	2022.11.07	全体 22 名股东出席
7	股份公司 2022 年度股东大会	2023.06.09	全体 22 名股东出席
8	股份公司 2023 年第一次临时股东大会	2023.12.14	全体 22 名股东出席
9	股份公司 2023 年度股东大会	2024.04.28	全体 22 名股东出席
10	股份公司 2024 年第一次临时股东大会	2024.12.02	全体 22 名股东出席
11	股份公司 2024 年度股东会	2025.06.25	全体 22 名股东出席
12	股份公司 2025 年第一次临时股东会	2025.08.28	全体 26 名股东出席
13	股份公司 2025 年第二次临时股东会	2025.11.07	全体 30 名股东出席
14	股份公司 2025 年度股东会	2026.5.15	全体 41 名股东出席

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、建立及职权

2021 年 11 月 2 日，股份公司召开的第一次股东大会选举产生了第一届董事会，董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，可连选连任。2024 年 12 月 2 日，公司召开股东大会选举产生了第二届董事会，公司董事会目前由 8 名董事组成，含董事长 1 名、副董事长 1 名、独立董事 3 名。

2、运行情况

公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，董事会规范运作，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法

规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

发行人在有限公司阶段共召开 4 次董事会会议，具体情况如下表所示：

序号	会议名称	会议时间	出席会议情况
1	有限公司董事会第一次会议	2020.09.10	全体 3 名董事出席
2	有限公司董事会第二次会议	2020.09.10	全体 3 名董事出席
3	有限公司董事会第三次会议	2020.12.20	全体 5 名董事出席
4	有限公司董事会第四次会议	2021.10.02	全体 5 名董事出席

股份制公司阶段共召开 18 次董事会会议，具体情况如下表所示：

序号	会议名称	会议时间	出席会议情况
1	股份公司第一届董事会第一次会议	2021.11.02	全体 6 名董事出席
2	股份公司第一届董事会第二次会议	2021.12.01	全体 6 名董事出席
3	股份公司第一届董事会第三次会议	2022.03.16	全体 5 名董事出席
4	股份公司第一届董事会第四次会议	2022.06.01	全体 9 名董事出席
5	股份公司第一届董事会第五次会议	2022.08.11	全体 9 名董事出席
6	股份公司第一届董事会第六次会议	2022.09.13	全体 9 名董事出席
7	股份公司第一届董事会第七次会议	2022.10.10	全体 9 名董事出席
8	股份公司第一届董事会第八次会议	2022.11.14	全体 9 名董事出席
9	股份公司第一届董事会第九次会议	2023.05.15	全体 8 名董事出席
10	股份公司第一届董事会第十次会议	2023.11.29	全体 8 名董事出席
11	股份公司第一届董事会第十一次会议	2024.04.08	全体 8 名董事出席
12	股份公司第一届董事会第十二次会议	2024.11.15	全体 8 名董事出席
13	股份公司第二届董事会第一次会议	2025.03.18	全体 9 名董事出席
14	股份公司第二届董事会第二次会议	2025.06.05	全体 9 名董事出席
15	股份公司第二届董事会第三次会议	2025.08.13	全体 8 名董事出席
16	股份公司第二届董事会第四次会议	2025.09.30	全体 9 名董事出席
17	股份公司第二届董事会第五次会议	2025.10.23	全体 9 名董事出席
18	股份公司第二届董事会第六次会议	2026.4.24	全体 8 名董事出席

（三）独立董事制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了规范的独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、

行使职权的保障等均作出了明确详尽的规定。公司聘任的独立董事占董事会人数的三分之一以上。

公司独立董事自聘任以来，按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，积极出席各次董事会会议，认真监督管理层的工作；各位独立董事亦根据自身的专长，分别担任董事会下设各专门委员会委员，参与董事会下属专门委员会的工作。公司独立董事在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、提高董事会决策水平等各方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善。

（四）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

2021 年 11 月 2 日，公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄云余担任公司董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》，公司董事会秘书的主要职责为：

1	负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织和督促公司制定并执行信息披露事务管理制度
2	负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通
3	组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录
4	负责保管公司股东名册、董事名册以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等
5	促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章及《公司章程》时，应当提醒与会董事；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关其个人的意见记载于会议记录上
6	帮助公司董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程等对其设定的责任。为公司重大决策提供咨询和建议
7	《公司法》和《公司章程》所要求履行的其他职责

公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东（大）会，并及时向公司股东、董事汇报公司相关信息，与股东建立了顺畅的沟通渠道，为完善公司治理结构及股东（大）会、董事会、监事会（取消监事会前）、审计委员会正常运行发挥了应有的效用。

附件 4 审计委员会及其他专门委员会的设置情况

2022 年 6 月 1 日，经公司第一届董事会第四次会议决议通过，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》，选举了各专门委员会的委员。专门委员会对董事会负责，全部由董事组成，为董事会决策提供咨询意见。

截至本招股说明书签署日，各委员会委员名单如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	陈锦魁	陈锦魁、唐靖炎、杨毅
提名委员会	杨毅	陈锦魁、唐靖炎、杨毅
审计委员会	赵晓明	赵晓明、唐靖炎、杨毅
薪酬与考核委员会	唐靖炎	郑家强、唐靖炎、赵晓明

公司董事会各专门委员会自设立之日起，严格按照《公司法》《公司章程》及相关工作细则，勤勉尽职地履行了职责，对公司审计工作、战略规划、董事与高级管理人员人选及董事与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范和完善了公司的治理结构。

附件 5 募集资金投资项目具体情况

（一）电子信息用高性能粉体材料扩产项目

1、项目概况

项目实施主体为锦艺新材及全资子公司功能材料，建设地点为江苏省苏州市常熟市。该项目总投资为 139,405.46 万元，项目建设期拟定为 2 年，拟用于新建电子信息用高性能粉体材料生产线，旨在提升公司高性能球形硅微粉产能规模，并为下世代产品进行产能布局，以进一步迎接 AI 等下游先进产业广阔发展机遇，夯实公司在电子信息功能材料领域的领先地位。

2、项目投资概算

本项目预计总投资为 139,405.46 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	**建设投资**	**133,650.04**	**95.87%**
1.1	建筑工程费	49,272.95	35.35%
1.2	设备、软件购置及安装费	70,923.65	50.88%
1.3	工程建设其他费用	7,246.29	5.20%
1.4	预备费	6,207.14	4.45%
2	**铺底流动资金**	**5,755.42**	**4.13%**
合计		**139,405.46**	**100.00%**

3、项目用地情况

子公司功能材料承建部分已取得项目用地产权证书（证书编号：苏（2026）常熟市不动产权第 8100862 号）。

锦艺新材承建部分拟通过新购置土地进行建设，实施地位于江苏省苏州市常熟经济技术开发区，发行人与常熟经济技术开发区管理委员会签署《电子信息高性能粉体材料项目投资协议》，约定该项目用地事宜，当地管委会承诺将协调相关载体、地块优先供应给发行人使用；常熟经济技术开发区管理委员会已出具《说明函》：“本单位支持锦艺新材‘电子级高性能粉体材料生产基地项目’用地需求，协调锦艺新材取得相关建设用地，并根据锦艺新材项目建设计划及实际需要依法办理土地出让各项手续，保障项目按计划正常实施”，综合上述情况，预计发行人取得募投用地不存在实质性障碍。

4、项目审批、核准或备案情况

本项目已完成江苏省投资项目备案，取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常开管投备[2026]190 号，项目代码：2605-320545-89-01-654153）以及《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常开管投备[2026]111 号，项目代码：2604-320545-89-01-589493）。

截至本招股说明书签署日，公司正在推进募投项目环境影响评价工作，功能材料承建部分（常开管投备[2026]190 号）目前已进入征求意见稿形成后的第二次公示阶段，锦艺新材承建部分（常开管投备[2026]111 号）已公示结束，根据常熟经济技术开发区管理委员会出具的《说明函》：“锦艺新材‘电子级高性能粉体材料生产基地项目’总体符合国家和地方产业政策，满足土地管理、用地规划、

城市规划、环境保护、安全生产及节能审查等方面要求”，预计发行人取得该项目的环评批复不存在实质性障碍。

（二）扩建年产 430 吨高导热球形氮化铝粉项目

1、项目概况

项目实施主体为锦艺新材，建设地点为江苏省常熟市经济技术开发区。该项目总投资为 19,685.56 万元，项目建设期拟定为 3 年，拟用于建设高导热球形氮化铝粉生产线，提升公司在高导热氮化物领域的规模供应能力，以契合 AI 算力设施、芯片封装等超高热流密度、高功耗场景带动的高导热材料广阔发展前景，进一步深化公司在导热散热功能材料领域的横向拓展与高端化布局。

2、项目投资概算

本项目预计总投资为 19,685.56 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	**建设投资**	**18,044.65**	**91.66%**
1.1	建筑工程费	2,800.00	14.22%
1.2	设备购置费	13,183.50	66.97%
1.3	工程建设其他费用	1,256.18	6.38%
1.4	预备费	804.97	4.09%
2	**铺底流动资金**	**1,640.91**	**8.34%**
合计		**19,685.56**	**100.00%**

3、项目用地情况

本项目拟通过租赁用地进行建设，实施地为江苏省苏州市常熟市经济技术开发区新材料孵化基地园区，发行人已与常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司签署《租赁意向书》，明确双方交易意向，双方后续将依据意向书相关约定签署租赁合同；发行人已与常熟经济技术开发区管理委员会签署《高导热功能性粉体材料项目投资协议》，当地管委会承诺将协调相关载体优先供应给发行人使用。

4、项目审批、核准或备案情况

本项目已完成江苏省投资项目备案，取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常开管投备[2026]71 号，项目代码：2603-320545-89-01-597434）。

截至本招股说明书签署日，公司已取得环评批复，环评批复文号为常开管审[2026]51 号。

（三）智能化升级改造项目

1、项目概况

项目实施主体为锦艺新材，建设地点为江苏省苏州市常熟市。该项目总投资为 16,537.84 万元，项目建设期拟定为 2 年，计划在发行人现有厂区内，通过引入自动化、智能化生产设备和软件系统等方式，对公司现有仓库、产线、工艺装备进行升级改造，显著提升产线、仓储的智能化、自动化和运行效率。

2、项目投资概算

本项目预计总投资为 16,537.84 万元，具体情况如下：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
1	**建设投资**	**16,537.84**	**100.00%**
1.1	建筑工程费	900.00	5.44%
1.2	设备及软件购置费	15,031.00	90.89%
1.4	工程建设其他费用	125.16	0.76%
1.5	预备费	481.68	2.91%
合计		**16,537.84**	**100.00%**

3、项目用地情况

本项目基于公司现有厂房实施，已取得土地产权证书《苏（2020）常熟市不动产权第 8100328 号》《苏（2024）常熟市不动产权第 8129926 号》。

4、项目审批、核准或备案情况

本项目已完成江苏省投资项目备案，取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常开管投备[2026]158 号，项目代码：2602-320545-89-02-364900）。

本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》所载建设项目，不属于环境影响评价范畴，无需办理环境影响评价审批手续。

（四）研发中心建设项目

1、项目概况

项目实施主体为锦艺新材，建设地点为江苏省苏州市常熟市。该项目总投资为 31,276.19 万元，项目建设期拟定为 3 年，拟通过建设研发办公中心，以满足公司规模扩张后研发所需基础环境，并购置先进研发及检测设备、引进高端技术人才，基于公司现有技术储备及产业化布局，结合下游行业发展情况、技术演进趋势等因素，开展覆铜板用高性能填料、高性能导热散热材料、半导体先进制造与封装材料相关课题研究，进一步提升公司整体研发实力。

2、项目投资概算

本项目预计总投资为 31,276.19 万元，具体情况如下：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
1	**建设投资**	**31,276.19**	**100.00%**
1.1	建筑工程费	10,312.67	32.97%
1.2	设备及软件购置费	12,011.30	38.40%
1.3	其他费用	8,281.00	26.48%
1.4	预备费	671.22	2.15%
合计		**31,276.19**	**100.00%**

注：其他费用主要为人员工资

3、项目用地情况

本项目拟通过购置房产进行建设，实施地为江苏省苏州市常熟市数字科技新城科创港，发行人已与常熟市信虞科技产业园有限公司签署《购买意向协议书》，明确双方交易意向，双方后续将签署正式房屋买卖协议；发行人已与常熟经济技术开发区管理委员会签署《苏州锦艺研发中心项目投资协议》，当地管委会承诺将协调相关载体优先供应给发行人使用。

4、项目审批、核准或备案情况

本项目已完成江苏省投资项目备案，取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常数据投备[2026]491 号，项目代码：2604-320581-89-01-468681）。

截至本招股说明书签署日，公司正在推进募投项目环境影响评价工作，已进

入环评公示阶段，根据发行人与常熟经济技术开发区管理委员会签署的《苏州锦艺研发中心项目投资协议》，当地管委会承诺将协助发行人做好环评等相关手续办理，预计发行人取得该项目的环评批复不存在实质性障碍。

（五）补充流动资金

公司本次公开发行拟使用募集资金 15,000.00 万元用于补充公司主营业务发展所需要的流动资金。伴随业务规模持续扩大，公司营运需求相应增加，本次拟拟将部分募集资金用于补充营运资金降低公司资产负债率、优化资本结构，有效满足公司日益扩展的业务增长需求，为公司持续经营及长远发展提供资金保障。